

杭州朗迅科技股份有限公司

Hangzhou Luntek Technology Co., Ltd.

(浙江省杭州市滨江区六和路368号1幢(南)5楼E5029室)



首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）



(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

（一）服务国家战略，构筑国产高端集成电路产业链测试端自主可控重要拼图，打造全球领先的第三方集成电路测试企业

集成电路测试是集成电路制造中必不可少的环节，能够提升芯片良率、控制制造成本以及指导工艺改进等，亦是国产芯片量产初期筛查潜在缺陷、优化工艺稳定性的核心支撑，是国产集成电路产业链自主可控进程的重要环节。近年来，国家大力鼓励和支持集成电路产业的发展，出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列积极的产业政策，为行业发展提供了政策支持与发展机遇。

近年来，全球产业链稳定性不断受到挑战，贸易摩擦时有发生；中国半导体产业规模持续扩大，保障集成电路测试环节自主可控的重要性不断凸显。公司专注于第三方集成电路测试业务，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）等服务。公司聚焦装备国产化及客户、产品的高端化，通过本次发行，公司将进一步提升测试产能、提升研发能力，助力国家集成电路战略和产业链的自主可控进程。

（二）强化产研能力，夯实主营业务发展根基，持续推进高端芯片测试的国产化替代，助力国产工艺、设备及软件系统的催熟

近年来公司业务规模保持高速增长，现有测试能力难以持续满足境内集成电路产业的需求。同时，集成电路测试行业属于人才、技术密集型行业，芯片制程的不断突破、先进封装技术应用与下游新兴领域的不断发展，对测试企业的技术能力提出了持续的高要求。通过本次发行和募集资金投资项目的实施，公司将有效扩充集成电路的测试产能，尤其是高端芯片的测试服务能力，为公司营业收入的持续增长提供坚实的产能支撑；同时，依托资本市场和上市公司平台，公司能够进一步提升对行业高端人才的吸引力，完善研发人才梯队建设，夯实主营业务发展根基，构建持续的核心技术壁垒。

随着国产集成电路产业的快速发展，国产集成电路制造的各个环节均在持

续实现突破，不断提升产研能力，提升国产化程度，走在实现战略性新兴产业领域独立自主和做大做强的道路上。

上市后，公司将继续秉承产业使命，履行产业和社会责任，不断提升业绩和经营规模，致力于为股东、投资者、产业、社会带来持续的价值回报。

二、发行人现代企业制度的建立和健全情况

发行人建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了权责明确、运作规范的法人治理结构。发行人股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。着眼于公司的长远和可持续发展，切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，以及提高股东对公司经营和利润分配的监督，稳定投资者预期，发行人制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

发行人本次募集资金将投资于杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目、越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目、总部研发大楼项目以及补充流动资金项目，致力于进一步提升公司的先进集成电路测试能力，加强技术研发实力，并为公司业务发展提供长期资金支持。

上述项目的实施，将进一步增强公司高端芯片的测试能力，满足持续增长的测试需求，推动公司规模化发展，巩固行业地位；同时提升公司研究开发能力，改善研发及办公环境，增强公司技术储备，提升人才吸引力，为实现公司未来经营规模增长、保持行业技术领先提供有力支撑。因此，通过本次融资实施募投项目具有必要性。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司是国产高端集成电路产业链发展和突破过程的重要参与者，近年来伴随集成电路产业国产化和自主可控程度不断提高的浪潮，实现了快速发展。2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，增长较快。

未来，公司将秉承“建设世界一流的集成电路测试基地”的愿景，发挥在

参与国产高端集成电路产业链构建与催熟过程中积累的核心技术、产业经验等方面的优势，继续深耕前沿集成电路测试领域，进一步推动测试能力提升，满足包括算力芯片、光学芯片、车载芯片等一系列高端芯片的测试需求。同时，公司将在服务好现有客户的基础上持续进行客户拓展与开发，进一步巩固和扩大竞争优势，更好地服务于集成电路产业链的国产化进程。

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页）

实际控制人、董事长签名：


徐 振


杭州朗迅科技股份有限公司
2026 年 8 月 20 日

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟公开发行人股份不超过 1,430.7187 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所主板
发行后总股本	不超过 5,722.8747 万股
保荐人、主承销商	广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

声 明.....	1
致投资者的声明	2
一、发行人上市的目的.....	2
二、发行人现代企业制度的建立和健全情况.....	3
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....	3
四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....	3
发行概况	6
目 录.....	7
第一节 释义	11
一、一般释义.....	11
二、专业释义.....	14
第二节 概览	16
一、重大事项提示.....	16
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	18
三、本次发行概况.....	19
四、发行人主营业务经营情况.....	21
五、发行人板块定位情况.....	22
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.....	24
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	24
八、发行人选择的具体上市标准.....	25
九、发行人公司治理特殊安排.....	25
十、募集资金运用与未来发展规划.....	25
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	26
第三节 风险因素	27
一、与发行人相关的风险.....	27
二、与行业相关的风险.....	30
三、募集资金投资项目风险.....	31
四、其他风险.....	32

第四节 发行人基本情况	33
一、发行人基本情况	33
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东的变化情况	33
三、发行人成立以来重要事件	53
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况	53
五、发行人股权结构	53
六、发行人子公司、参股公司情况	54
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况	58
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况	64
九、发行人协议控制架构的情况	65
十、发行人控股股东、实际控制人的合规性	65
十一、发行人股本情况	65
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况	77
十三、公司股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况	88
十四、发行人员工及其社会保障情况	92
第五节 业务与技术	96
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况	96
二、发行人所处行业基本情况	107
三、销售情况和主要客户	137
四、发行人采购情况和主要供应商	140
五、发行人主要资产情况	142
六、特许经营权	144
七、技术和研发情况	144
八、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力	153
九、境外经营情况	154
第六节 财务会计信息与管理层分析	155
一、财务报表	155
二、注册会计师的审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准	159
三、会计报表编制基础、合并范围及变化情况	162
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	163

五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.....	183
六、主要税项.....	184
七、主要财务指标.....	186
八、经营成果分析.....	188
九、资产质量分析.....	208
十、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.....	225
十一、重大投资、资本性支出与业务重组.....	237
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	237
第七节 募集资金运用与未来发展规划	239
一、募集资金运用概况.....	239
二、公司未来发展战略规划.....	242
第八节 公司治理与独立性	245
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.....	245
二、公司内部控制评价意见.....	245
三、公司违法违规情况.....	246
四、公司资金占用和对外担保情况.....	247
五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况.....	247
六、同业竞争.....	249
七、关联方及关联交易.....	250
第九节 投资者保护	262
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....	262
二、本次发行前后的股利分配政策及差异.....	262
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累 计未弥补亏损的，应披露保护投资者合法权益的各项措施.....	267
第十节 其他重要事项	268
一、重要合同.....	268
二、对外担保.....	276
三、重大诉讼或仲裁事项.....	276
第十一节 声明	277
一、发行人及其全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....	277

二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	278
三、保荐人（主承销商）声明.....	279
四、发行人律师声明.....	282
五、审计机构声明.....	283
六、资产评估机构声明.....	284
七、验资机构声明.....	286
八、验资机构声明.....	288
第十二节 附件	289
一、备查文件.....	289
二、查阅时间.....	289
三、查阅地点.....	290
四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票 机制建立情况.....	290
五、与投资者保护相关的承诺.....	292
六、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 说明.....	325
七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....	327
八、募集资金具体运用情况.....	328
九、子公司、参股公司简要情况.....	336
十、主要固定资产和无形资产.....	349

第一节 释义

在本招股说明书中，除上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

发行人、本公司、公司、朗迅科技	指	杭州朗迅科技股份有限公司，系由杭州朗迅科技有限公司整体改制而来
朗迅有限	指	杭州朗迅科技有限公司，发行人前身
本次发行	指	公司首次公开发行不超过 1,430.7187 万股社会公众股 A 股的行为
股票或A股	指	公司本次发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
招股说明书、本招股说明书	指	《杭州朗迅科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家财政部	指	中华人民共和国财政部
市场监管总局	指	国家市场监督管理总局
税务总局	指	国家税务总局
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计准则	指	中国会计规章制度，包括《企业会计准则》及相关规定
《公司章程》	指	《杭州朗迅科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《杭州朗迅科技股份有限公司章程（草案）》
保荐机构、保荐人	指	广发证券股份有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天册所	指	浙江天册律师事务所
致同所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

立信评估	指	上海立信资产评估有限公司
杭州汇芯	指	杭州汇芯企业管理合伙企业（有限合伙）
杭州朗新	指	杭州朗新投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州聚芯	指	杭州聚芯企业管理合伙企业（有限合伙）
鸿溢盛新	指	宁波鸿溢盛新创业投资合伙企业（有限合伙）
鸿溢盛朗	指	宁波鸿溢盛朗创业投资合伙企业（有限合伙）
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
天问磐盈	指	诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）
天问华欣	指	天问华欣（新泰）投资合伙企业（有限合伙）
天问愿景	指	诸暨天问愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
天问时代	指	天问时代私募基金管理（海南）有限公司
和丰创投	指	宁波和丰创业投资有限公司
瑞芯晶飞	指	共青城瑞芯晶飞股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州高新创投	指	杭州高新创业投资有限公司
真和投资	指	杭州真和投资管理合伙企业（有限合伙）
翰富智维	指	杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业（有限合伙）
紫金文化	指	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）
毅达工投	指	宁波毅达工投股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖畔小园	指	杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）
天堂硅谷	指	武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）
博通集成	指	博通集成电路（上海）股份有限公司
产才融合	指	江苏产才融合创业投资五期基金（有限合伙）
长三角嘉善	指	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）
丽水奋智	指	丽水奋智股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州集成电路基地	指	杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司， 现已更名为国泰海通证裕投资有限公司
吉六零基金	指	长三角吉六零科创走廊私募基金（上海）合伙企业（有限合伙）
赋实投资	指	杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州晶悦	指	杭州晶悦企业管理合伙企业（有限合伙）

数文基金	指	长三角数文（绍兴上虞）股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海格金	指	珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
中叶善水	指	杭州中叶善水创业投资合伙企业（有限合伙）
中叶至源	指	上海中叶至源创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州产投	指	杭州产业投资有限公司
产投集团	指	杭州产投集团有限公司
桦昀投资	指	上海桦昀投资管理合伙企业（有限合伙）
浙江省产业基金	指	浙江省产业基金有限公司
视谷创投	指	杭州视谷创业投资合伙企业（有限合伙）
工融创新	指	杭州工融创新股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波工投	指	宁波市工业投资有限责任公司
湖畔小竹	指	杭州湖畔小竹股权投资合伙企业（有限合伙）
海南优八	指	海南优八咨询合伙企业（有限合伙）
宁波通商	指	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）
无锡鼎晖弘嘉	指	无锡鼎晖弘嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
成都鼎晖盈嘉	指	成都鼎晖盈嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
财通创新	指	财通创新投资有限公司
绿创产投	指	苏州绿创产投投资合伙企业（有限合伙）
嘉值琨瑜	指	共青城嘉值琨瑜股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州芯云	指	杭州芯云半导体集团有限公司
朗迅数智	指	杭州朗迅数智科技有限公司
朗迅智杰	指	北京朗迅智杰科技有限公司
诸暨教育	指	诸暨芯云教育发展有限公司
朗迅方夏	指	北京朗迅方夏科技有限公司
浙江芯华	指	浙江芯华云景智能科技有限公司
浙江华芯	指	浙江华芯半导体技术有限公司
杭州芯云海	指	杭州芯云海半导体有限公司
诸暨越芯	指	越芯半导体（诸暨）有限公司
诸暨芯云	指	芯云半导体（诸暨）有限公司

杭州芯光	指	杭州芯光半导体有限公司
上海芯云纵横	指	芯云纵横半导体（上海）有限公司
朗迅集成	指	杭州朗迅集成电路有限公司
重庆朗芯	指	重庆朗芯半导体有限公司
江阴芯云	指	江阴芯云信息技术有限公司
苏州芯云纵横	指	芯云纵横半导体（苏州）有限公司
江西朗驰	指	江西朗驰科技有限公司
新加坡芯云纵横	指	XINYUN ZONGHENG (SINGAPORE) PTE. LTD.
福建晋芯	指	福建晋芯半导体有限公司
深圳芯云湾	指	芯云湾科技（深圳）有限公司
盛合晶微	指	盛合晶微半导体（江阴）有限公司，国内领先的封装测试厂商
青岛科创	指	青岛科创投资发展集团有限公司
《新加坡法律意见书》	指	德尊（新加坡）律师事务所出具的《关于 XINYUN ZONGHENG（SINGAPORE） PTE. LTD.的控股公司杭州朗迅科技股份有限公司在中华人民共和国深圳证券交易所的拟议首次公开发行项目之法律意见书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年、2024 年和 2025 年

二、专业释义

CP	指	Chip Probing，也称为晶圆测试，是对晶圆级集成电路的各种性能指标和功能指标的测试
FT	指	Final Test，也称为成品测试，在芯片封装完成后进行，是对封装后的芯片进行各种性能指标和功能指标的测试
OSAT	指	Outsourced Semiconductor Assembly and Testing 半导体委外封装和测试，是专门为晶圆制造企业（Foundry 企业）做集成电路封装和测试的产业链环节
IDM	指	Integrated Device Manufacturing，垂直整合制造模式，是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造模式
BI	指	Burn-in，老化测试，通过在高温、高电压条件下对芯片进行长时间加电负载，强制其潜在缺陷提前暴露的加速寿命试验
SLT	指	System Level Test，系统级测试，模拟终端使用场景下对芯片进行的功能和性能测试，验证芯片在实际系统中的功能、性能和可靠性
Socket	指	测试座，与封装后的成品芯片直接连接，用于固定芯片并连接至测试板的治具
Load Board	指	测试板，与测试座相连接，用于承载封装后成品芯片进行

		测试的治具
SoC	指	System on chip，是指将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的集成电路，常被应用作为智能手机、平板电脑等设备的核心处理器
CIS	指	CMOS Image Sensor，即 CMOS 图像传感器，是将光学图像转换成电子信号电子器件，也是绝大多数视觉成像系统的核心元器件，广泛应用于手机、相机、车载等各类消费与工业电子设备
Die	指	裸芯片或晶片，以半导体材料制作而成、未经封装的一小块集成电路本体
UFS	指	Universal Flash Storage，通用闪存存储，是一种内嵌式存储器的标准规格和符合该标准的存储产品
浴盆曲线	指	半导体产品随时间变化的失效率曲线，产品故障率通常呈现“两头高，中间低”的形态，即早期失效率随时间的增加迅速下降，后长期保持较低且稳定趋势，末期故障率指数攀升，因曲线整体形态酷似浴缸横截面，故得名“浴盆曲线”
2.5D封装	指	通过硅中介层或有机基板横向集成多颗芯片，利用硅通孔（TSV）实现高密度互连，典型应用于 HBM 内存与逻辑芯片协同封装
3D封装	指	采用垂直堆叠架构，芯片间通过凸块直接键合，实现层间信号传输与功耗优化，主要用于存算一体芯片及超薄器件集成
Chiplet封装	指	指将多个功能不同、独立设计和制造的芯片，通过先进封装技术在同一封装内进行高密度互连与集成，使其在系统层面协同工作，以实现更高的性能、带宽和良率

特别说明：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入形成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素

公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险：

1、客户集中度较高且第一大客户占比较大的风险

报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 93.75%、96.55%和 98.22%，集中度较高。其中，对 A 公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为 87.05%、86.49%和 92.57%，公司存在客户集中度较高的风险。

公司客户集中度较高主要受下游行业竞争格局及自身业务发展影响。公司主要客户 A 公司是全球领先的半导体与器件设计公司，产品线广泛，具备雄厚的技术积累，在国产集成电路领域具有较高行业地位。

报告期内，公司积极进行其他客户的业务拓展，但由于近年来 A 公司业务规模及测试需求的快速增长，对 A 公司的收入占比仍然较高。如果未来公司以第一大客户为代表的主要客户由于市场竞争、宏观经济波动以及自身产品等原因经营情况发生重大不利变化，或由于受到外部贸易限制导致订单需求下降，抑或公司因为测试服务质量等原因影响与主要客户的业务往来，使得客户自身经营稳定性及与公司业务的持续性受到损害，将对公司的经营产生不利影响。

2、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为 80.82%、77.27%和 77.11%，集中度较高，但不存在对单一供应商采购超过 50%或严重依赖少数供应商的情形。集成电路测试业务需要较多的测试设备投入，主要采购测试机、探针台、分选机等测试设备及相关配件。集成电路测试设备行业生产厂商数量整体较为有限，能够满足高端芯片测试需求的设备厂商数量更少，现

有主要设备供应商包括较少数量的国际知名厂商，以及 D 公司等国产设备厂商。公司供应商较为集中主要系行业上游格局、集成电路产业国产化需求及公司持续扩产等因素所致。尽管公司与主要供应商建立了良好的合作关系，且主要设备均有不止一家供应商储备，但若未来各类不利事件集中发生或产业及行业发生重大不利转变等，导致公司与现有供应商的合作受到重大影响，而公司未及时落实新的供应商开拓和储备、无法及时实现供应体系的更新和替代，则将对公司经营产生不利影响。

3、主营业务毛利率波动的风险

报告期各期，公司集成电路测试业务毛利率分别为 39.25%、35.86%和 45.37%，毛利率存在一定程度的波动。公司毛利率受产能利用情况、测试业务结构、固定资产折旧、人力成本、测试方案等因素影响。报告期内，公司紧跟下游发展持续加大投入、投建新产能，测试的芯片产品也随着国产集成电路高端应用领域的发展而不断更新升级。若未来上述因素发生不利变化，如公司无法跟进市场发展，测试设备折旧、人力成本等上升过快，收入结构中毛利率较高的业务类型占比减少，或公司产能利用率严重下降等情况发生，则公司主营业务毛利率可能存在下滑风险。

4、固定资产折旧金额较大的风险

报告期各期，公司固定资产折旧金额分别为 12,394.92 万元、23,031.90 万元和 41,382.91 万元，占同期营业收入的比例分别为 23.14%、21.18%和 20.05%，占比相对较高。截至 2025 年末，公司固定资产原值为 56.84 亿元，其中专用设备的原值为 48.84 亿元，为固定资产的主要构成。

报告期内，公司经营规模处于快速增长态势，产能规模不断扩大，固定资产持续投入。若后续因市场环境产生重大不利变化，或公司因管理不善等原因导致无法充分利用现有固定资产，综合效益提升无法抵消折旧费用，将会对公司业绩产生不利影响。

5、测试技术更新迭代不及时，无法满足持续进步的国产半导体测试需求的风险

近年来，国产半导体制程工艺持续进步，测试技术持续迭代升级，2.5D 及

3D 封装、Chiplet 封装等先进封装技术带来的一系列集成电路测试需求不断涌现，要求行业内企业快速响应市场、技术及客户需求的变化形势，持续进行研发投入，提供能够符合客户技术要求并具备较强市场竞争力的测试服务。

公司在集成电路测试领域持续投入资源开展研发活动，紧跟行业、技术及市场形势。但由于集成电路行业的快速发展和国产技术的持续迭代，仍面临技术更新不及时的风险。如果公司未来技术迭代不及时或测试效果不达预期，无法满足客户的测试需求，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司提示投资者阅读公司、实际控制人、其他股东、董事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等本次发行相关责任方作出的与本次发行相关的承诺事项，具体承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”。

（三）本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

（四）本次发行上市后公司的利润分配政策

本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策。公司发行上市后的股利分配政策具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后的股利分配政策及差异”。本公司提请投资者认真阅读该章节的全部内容。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	杭州朗迅科技股份有限公司	成立日期	2010 年 5 月 14 日
注册资本	4,292.1560 万元	法定代表人	徐振
注册地址	浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢（南）5 楼 E5029 室	主要生产经营地址	浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢（南）5 楼 E5029 室

控股股东	徐振	实际控制人	徐振
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	广发证券股份有限公司	主承销商	广发证券股份有限公司
发行人律师	浙江天册律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	上海立信资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股说明书签署日，保荐人广发证券全资子公司广发乾和、广发信德管理的私募基金珠海格金合计持有发行人 2.95%股份。除前述情况外，发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接股权关系或其他权益关系	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,430.7187 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,430.7187 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 5,722.8747 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率（标明计算基础和口径）	【】（发行价格/每股收益，每股收益按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计后的归	发行后每股收益	【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后

	属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)		孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)
发行市净率（标明计算基础和口径）	【】（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会要求或认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户并开通主板交易的境内自然人、法人以及符合证券监管机构规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】		
募集资金净额	【】		
募集资金投资项目	杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目		
	越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目		
	总部研发大楼项目		
	补充流动资金项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中承销保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元、用于本次发行的信息披露费【】万元、用于本次发行的发行手续费及材料制作费等其他费用【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	无		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	无		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	【】年【】月【】日		

四、发行人主营业务经营情况

（一）公司的主要业务、主要产品及用途

公司是最大的内资第三方集成电路测试企业，专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。公司凭借优秀的自主研发能力和强大的产业化落地能力，顺应先进工艺和先进封装的行业趋势，持续助力高端芯片测试的国产化替代，为客户提供包括晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、老化测试（BI）、系统级测试（SLT）、工程测试服务等在内的一站式芯片量产测试解决方案。公司测试的芯片产品包括算力芯片、高性能 SoC 芯片、光学芯片、车载芯片、射频芯片、传感器芯片等多种芯片类型，下游应用聚焦高端算力、消费电子、车载智控、通讯及工控等重要领域，同时还覆盖导航通信、智能家居、穿戴设备等多个重要场景。

报告期内，公司的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	97,895.60	48.14%	53,404.88	51.46%	24,171.98	49.87%
	CP	61,731.51	30.36%	25,517.79	24.59%	13,189.12	27.21%
	小计	159,627.11	78.50%	78,922.67	76.05%	37,361.10	77.07%
工程测试服务		43,715.47	21.50%	24,856.34	23.95%	11,112.72	22.93%
合计		203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

（二）发行人主要经营模式

在采购模式方面，公司在综合考虑供应链自主可控、采购及生产稳定性的基础上开展采购，内容主要包括测试设备、测试治具等。其中，测试设备为主要采购内容，主要根据产能需求、设备交期、公司投资安排等情况由公司直接采购；测试治具包括探针卡、测试座等，主要根据订单及生产需求由公司采购。

在生产及服务模式中，公司采取“以销定产”的生产模式，实行订单式测试服务，并对各经营主体的测试产能进行总体控制与灵活管理，保障测试作业

的顺利完成。公司集成电路测试服务主要由制造中心下属的各个测试主体承担，各业务部门配合完成。

在销售及盈利模式方面，公司为第三方集成电路测试服务商，测试业务采用直销的模式开展销售，为客户提供晶圆测试、成品测试服务等并取得测试服务收入。集成电路测试业务由公司营销中心整体负责，通过专业的销售服务团队开展客户沟通维护、销售报价、合同签署等工作，并协同公司制造中心、质量中心完成具体测试安排及商务条款的确定。测试业务的合作关系建立及业务导入所需周期通常较长，公司通常与客户开展长期业务合作，营销中心后续将持续跟进各测试项目进度、对账结算以及客户关系维护等系列工作。

（三）发行人竞争地位

公司深耕第三方集成电路测试业务，深度参与集成电路国产化和自主可控的历史进程，在时代浪潮中实现了长足发展。随着集成电路产业国产化进程的快速推进，公司不仅是最大的内资第三方集成电路测试企业，也是 2023 至 2025 年度内资第三方集成电路测试领域前五名中增长最快的企业，三年主营业务复合增长率超过 100%。基于在国产化测试工艺、软件系统及国产化测试设备资源等方面的积累和储备，公司已成为国产集成电路产业应对潜在国际政治经济及贸易风险扰动的重要战略选择。

五、发行人板块定位情况

发行人专注于第三方集成电路测试服务，聚焦自主可控的国产集成电路测试供应链，持续推进高端芯片测试的国产化替代，具备规模化的测试能力，并与行业领先的集成电路设计企业建立了稳定且互利的业务关系。按照集成电路测试业务收入统计，公司已成为最大的内资第三方集成电路测试企业，是国产高端芯片自主可控进程中不可或缺的核心配套力量。

发行人整体业务模式成熟，经营业绩规模较大且报告期内增长较快，主营业务相关技术成熟且自主可控，能够保障公司稳定经营、推动行业国产化进程，是具有行业代表性的优质企业。

（一）发行人业务模式成熟、稳定

报告期内，公司主要业务模式均保持稳定、未发生变化，且成熟度较高，

与行业内主要厂商不存在显著差异。发行人自成立以来即投身于集成电路相关行业，报告期内主要业务为第三方集成电路测试服务。公司销售模式、采购模式、生产模式等主要经营模式系由长期产业实践形成，且与行业通用业务模式整体一致，具体参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“一/（二）发行人的主要经营模式”。

（二）发行人经营业绩稳定、规模较大

发行人深耕第三方集成电路测试服务，经过长期的技术研发与国产工艺适配，与 A 公司等集成电路设计及封装企业建立了稳定的合作关系，经营规模较大、经营业绩稳定。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，报告期内业务规模较大、盈利能力稳定，且业绩持续增长。同时，发行人营业收入规模较大，在集成电路测试领域具备较高的市场份额，且已成为最大的内资第三方集成电路测试企业。2025 年度，发行人主营业务收入为 20.33 亿元，在境内第三方集成电路测试服务的市场份额约为 18%，占比较高。

（三）发行人是具有代表性的优质企业

公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业，专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。

公司深耕第三方集成电路测试业务，深度参与集成电路国产化和自主可控的历史进程，在时代浪潮中实现了长足发展。随着集成电路产业国产化进程的快速推进，公司不仅是最大的内资第三方集成电路测试企业，也是 2023 至 2025 年度内资第三方集成电路测试领域前五名中增长最快的企业，三年主营业务复合增长率超过 100%。基于在国产化测试工艺、软件系统及国产化测试设备资源等方面的积累和储备，公司已成为国产集成电路产业应对潜在国际政治经济及贸易风险扰动的重要战略选择。

公司始终聚焦装备国产化及客户、产品的高端化，在国产集成电路行业的

发展历程中具有鲜明代表性。

综上所述，公司业务模式成熟、稳定，报告期内经营业绩稳定、规模较大，具有行业代表性，符合主板板块定位。

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

发行人报告期内的主要财务数据和财务指标如下：

项目	2025-12-31/ 2025 年度	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度
资产总额（万元）	836,223.08	567,858.70	305,858.08
归属于母公司所有者权益（万元）	231,532.12	166,951.16	104,571.18
资产负债率（合并）	71.37%	69.19%	63.20%
资产负债率（母公司）	19.46%	7.41%	6.53%
营业收入（万元）	206,430.25	108,728.04	53,553.63
净利润（万元）	61,972.16	20,266.39	9,941.85
归属于母公司所有者的净利润（万元）	62,046.98	20,251.37	9,959.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	53,457.09	13,358.44	5,902.13
基本每股收益（元）	14.46	5.28	2.78
稀释每股收益（元）	14.40	5.28	2.78
加权平均净资产收益率	31.14%	17.65%	14.97%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	175,882.16	48,938.12	82,265.23
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	7.46%	9.39%	12.47%

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处行业的产业政策未发生重大调整，业务模式及竞争趋势未出现重大变化。公司生产经营情况稳定，整体经营及主要供应商、客户合作情况良好，未发生重大不利变化；公司董事、高级管理人员及其他核心人员，以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

八、发行人选择的具体上市标准

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》，公司选择如下具体上市标准：“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或者营业收入累计不低于 15 亿元。”

2023 年、2024 年和 2025 年，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，最近三年净利润均为正，且累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为 82,265.23 万元、48,938.12 万元和 175,882.16 万元，累计不低于 2 亿元；营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，累计不低于 15 亿元。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

本次募集资金投向经公司股东会审议通过，由董事会负责实施。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	实施主体
1	杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目	400,000.00	320,000.00	杭州芯光
2	越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目	200,000.00	200,000.00	诸暨越芯
3	总部研发大楼项目	41,683.99	41,683.99	朗迅科技
4	补充流动资金项目	90,000.00	90,000.00	朗迅科技
合计		731,683.99	651,683.99	-

注：杭州芯光、诸暨越芯均为发行人全资子公司。

如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据上述项目的实际情况以自筹资金先行投入，并于募集资金到位后置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过项目需求，公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。有关募集资金用途的具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“一、募集资金运用概况”以及“第十二节 附件”之“八、募集资金具体运用情况”。

（二）发展规划

未来，公司将秉承“建设世界一流的集成电路测试基地”的愿景，发挥在参与国产集成电路产业链构建与催熟过程中积累的核心技术、产业经验等方面的优势，继续深耕前沿集成电路测试领域，进一步推动测试能力增长，满足包括算力芯片、光学芯片、车载芯片等一系列高端芯片的测试需求。同时，公司将在服务好现有客户的基础上持续进行客户拓展与开发，进一步巩固和扩大竞争优势，更好地推动集成电路产业链的国产化进程。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素已遵循重要性原则或可能影响投资决策的程度按顺序披露，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、客户集中度较高且第一大客户占比较大的风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一/（一）/1、客户集中度较高且第一大客户占比较大的风险”。

2、供应商集中度较高的风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一/（一）/2、供应商集中度较高的风险”。

3、公司发展需持续投入大量资金的风险

集成电路测试行业，尤其是高端芯片测试对生产设备及产线的精细化、自动化要求较高，相关设备单价通常处于较高金额区间，导致固定资产投资规模较大，对行业进入者构成了较高的资金门槛。随着生产规模的持续扩张，公司对于设备及资金投入需求持续提升。为进一步满足持续增长的测试需求，公司需要配置充足的测试产能及对应的测试平台，对于资金投入需求较高。

截至 2025 年末，公司固定资产金额为 494,347.48 万元，占公司总资产的比例为 59.12%。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 81,691.92 万元、173,616.63 万元和 229,866.14 万元。如果公司未来不能取得足够的经营收益，或融资渠道、规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场竞争力造成不利影响。

4、经营业绩增速放缓或下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，增长率分别为 103.03%和 89.86%；扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润分别为 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，经营业绩增长较快，且已经具有较大规模。

随着公司业绩规模的扩大，后续同比增长幅度或将有所降低，同时公司经营业绩受到下游市场发展趋势、主要客户测试需求、供应商选择、公司自身产能等因素影响，未来若公司未能保持自身竞争优势、测试技术无法满足持续进步的国产半导体测试需求或主要客户未来终端产品市场需求下降，可能导致公司未来经营业绩存在增速放缓或下滑的风险。

（二）财务风险

1、主营业务毛利率波动的风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一/（一）/3、主营业务毛利率波动的风险”。

2、固定资产折旧金额较大的风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一/（一）/4、固定资产折旧金额较大的风险”。

3、净资产收益率和每股收益下降的风险

报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净资产收益率分别为 8.87%、11.64%和 26.83%，基本每股收益分别为 1.65 元、3.49 元和 12.45 元，呈现持续增长态势。本次发行完成后，公司净资产及股本将有所增加，鉴于募集资金投资项目存在一定建设周期，产生效益需要一定时间，因此，公司在短期内存在净资产收益率和每股收益下降的风险。

4、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》，公司主要经营主体享受了高新技术企业优惠所得税率、集成电路企业所得税“两免三减半”、增值税进项税加计抵减等优惠政策。报告期内，公司经营业绩主要来源于主营业务，对税收优惠不存在重大依赖，但若未来国家优惠政策收紧，或公司主要经营主体未能持续满足相关税收优惠政策

的条件，将会对公司经营业绩带来一定不利影响。

5、政府补助变动风险

报告期各期，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 3,970.32 万元、6,493.01 万元和 8,954.48 万元，主要包括设备及厂房补贴、创新项目奖励、中小企业发展专项补助等。公司报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，主营业务经营情况良好，但若未来政府部门对公司所处产业的支持力度减弱，公司获得的政府补助大幅减少或无法取得相关补助，则可能会对公司经营业绩造成一定不利影响。

6、偿债风险

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.87、0.92 和 1.22，速动比率分别为 0.85、0.90 和 1.19，合并报表资产负债率分别为 63.20%、69.19%和 71.37%，公司资产负债率相对较高且逐渐增加，经营活动现金流量净额分别为 82,265.23 万元、48,938.12 万元和 175,882.16 万元。鉴于公司未来仍将持续扩大生产经营规模，资金需求量也将不断增加，若公司不能有效进行资金管理，则会面临一定资金压力和偿债风险。

（三）创新及技术风险

1、测试技术更新迭代不及时，无法满足持续进步的国产半导体测试需求风险

参见本招股说明书“第二节 概览”之“一/（一）/5、测试技术更新迭代不及时，无法满足持续进步的国产半导体测试需求风险”。

2、研发技术人员流失的风险

集成电路测试属于人才、技术密集型行业，测试方案开发与导入、测试量产工艺优化等均有赖于具备丰富专业知识和工程经验的研发技术人员。公司经过多年的产业积累，已经建立了专业的研发技术团队，并建立了完善的薪酬及激励机制。与此同时，随着集成电路市场规模的快速增长，行业内对于人才的竞争将愈发激烈，如果公司不能持续吸引行业优秀人才，不能打造和维持与业

务发展相适应的研发团队，可能会面临研发技术人员流失的风险，进而对公司的研发及持续经营能力产生一定不利影响。

3、核心技术及知识产权泄露风险

经过在集成电路测试行业持续的研发积累，公司已经掌握并应用了多项测试核心技术并取得自主知识产权，相关技术体系是公司整体竞争力的重要构成和保障。公司高度重视对于核心技术的保护工作，与核心技术人员签署了保密协议，积极申请知识产权进行成果保护，并建立了技术相关的内控制度和严格的保密制度。但未来如果公司相关内控制度未得到有效执行而导致出现核心技术泄密的情况，则可能损害公司的核心竞争力。

二、与行业相关的风险

（一）行业需求波动风险

集成电路测试是集成电路制造的必要环节，在垂直分工模式下，公司作为第三方集成电路测试服务厂商与集成电路行业整体发展高度相关。集成电路行业服务和渗透于国民经济的各个领域，且其生产制造涉及广泛的产业链协同，行业需求受到宏观经济形势、贸易壁垒等多种因素的影响。近年来，人工智能、汽车电子、5G 通讯等前沿领域需求增长，国际政治经济和贸易形势纷繁扰动，境内集成电路市场需求和产能在此环境下快速增长。但如果后续宏观经济增长放缓、国际政治经济环境巨变，造成集成电路行业或公司主要客户需求减少，将对公司业绩持续增长带来一定的不利影响。

（二）集成电路测试行业的竞争风险

集成电路测试服务的主要提供方包括第三方测试服务企业、封测一体企业两大类。中国境内第三方测试行业处于快速增长阶段，但与封测一体模式相比起步仍相对较晚，行业内现有企业相对于长电科技、通富微电等代表性封测一体企业规模相对较小，在收入体量、客户覆盖范围、资金实力等方面仍有一定距离；同时，京元电子、矽格、欣铨等全球范围内的第三方测试巨头亦具备较大的业务规模、深厚的技术积累和广泛的全球大型客户服务经验，测试行业竞争风险较为显著。

随着集成电路市场规模的扩张、垂直分工模式的深化和供应链本土化趋势

的加速，境内集成电路测试需求持续稳定增长，政府部门也加大了包括测试行业在内的半导体领域的政策扶持力度，行业内第三方测试企业、封测一体企业持续增加资金及资源投入，市场竞争日趋激烈。若公司未来无法持续保持较强的市场竞争能力，则有可能在市场竞争中处于不利地位。

三、募集资金投资项目风险

（一）募投项目实施风险

本次募集资金金额及投资项目综合考虑了行业和市场状况、技术水平及发展趋势等因素，并对可行性进行了充分论证，具备合理性。但公司募投项目投资规模整体较大，且涉及较大规模的工程建设、设备投入等，对公司项目管理及实施能力提出了较高的要求。如公司无法有效实施项目进度管理、管控项目投资成本，或外部市场环境发生较大变化，则可能对募集资金投资项目实施产生不利影响。

（二）关于募投项目新增产能无法消化的风险

本次募集资金计划投资于杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目、越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目以进行测试产能扩充，拟使用募集资金 52.00 亿元投资前述项目。项目达产后，公司集成电路测试能力预计将得到显著提升。相关项目规划系基于行业需求、公司整体发展战略及产销情况等整体合理规划确定，并已经根据项目计划做好了人才储备、营销管理等一系列准备工作，但新增产能消化受到行业需求、技术发展、客户需求等多种因素影响，如果相关因素出现重大不利变化，公司可能面临本次募投项目新增产能无法消化的风险。

（三）新增折旧摊销及摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金到位后，公司固定资产、总股本及净资产将大幅增长。考虑到募投项目需要一定的建设及产能爬坡周期，无法立即实现预期效益，募集资金到位后短时间内可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标被摊薄。同时，募投项目建设预计新增生产设备和研发设备等，新增较大规模的折旧及摊销金额，如果因市场环境等因素变化，导致募投项目达产后整体盈利水平不及预期、无法弥补新增固定资产带来的折旧费用，则可能对公司盈利能力造成

不利影响。

四、其他风险

（一）公司规模扩张带来的管理风险

近年来公司经营规模快速增长，报告期内营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，最近三年复合增长率为 96.33%。本次发行完成后随着募集资金投资项目的实施与落地，公司业务、资产及人员规模预计将进一步扩大，将对公司经营管理能力和内部控制体系提出更高的要求和挑战。未来如果公司整体经营管理水平不能随着资本市场要求、业务规模的扩张而持续提升，或者内部控制制度不能持续有效执行，将对公司的经营效率和发展质量带来不利影响。

（二）发行失败风险

本次发行的结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。若存在投资者认购不足或其他影响发行的不利情形，可能导致本次发行面临发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：	杭州朗迅科技股份有限公司
英文名称：	Hangzhou Luntek Technology Co., Ltd.
注册资本：	4,292.1560 万元
法定代表人：	徐振
有限公司成立日期：	2010 年 5 月 14 日
股份公司设立日期：	2022 年 10 月 31 日
住所：	浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢（南）5 楼 E5029 室
邮政编码：	310053
电话：	0571-8668 1836
传真：	/
互联网网址：	https://www.luntek.com.cn
电子信箱：	IR@luntek.cn
负责信息披露和投资者关系的部门：	董事会办公室
负责人和联系方式：	夏丽君，0571-8668 1836

二、发行人设立情况和报告期内股本、股东的变化情况

（一）公司设立情况

发行人设立情况如下表所示：

阶段	时间	注册资本 (万元)	股东情况
有限公司设立情况	2010 年 5 月	100.00	徐振、孙彬彬、杨晓萍、陈沉、陈玮刚、舒丽霞共同出资设立朗迅有限
股份公司设立情况	2022 年 10 月	1,814.56	整体变更设立股份公司

1、有限公司设立情况

发行人前身朗迅有限系由徐振、孙彬彬、杨晓萍、陈沉、陈玮刚、舒丽霞共同出资设立的有限责任公司，设立时公司注册资本为 100.00 万元，其中徐振以货币出资 37.50 万元，孙彬彬、杨晓萍、陈沉、陈玮刚、舒丽霞分别以货币

出资 12.50 万元。

杭州同华会计师事务所（普通合伙）对朗迅有限成立时的出资进行审验，并于 2010 年 5 月 13 日出具《验资报告》（杭同会验字[2010]第 A344 号）。

2010 年 5 月 14 日，杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局向朗迅有限核发了营业执照，其成立时的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例
1	徐振	37.50	37.50%
2	孙彬彬	12.50	12.50%
3	杨晓萍	12.50	12.50%
4	陈沉	12.50	12.50%
5	陈玮刚	12.50	12.50%
6	舒丽霞	12.50	12.50%
合计		100.00	100.00%

2、股份公司设立情况

2022 年 9 月 15 日，朗迅有限召开股东会并作出股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2022 年 7 月 31 日为审计、评估基准日。

2022 年 9 月 30 日，致同所出具了《审计报告》（致同审字（2022）第 332B025087 号），确认截至 2022 年 7 月 31 日公司经审计的净资产账面值为 44,390.92 万元。

2022 年 9 月 30 日，立信评估以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日对朗迅有限进行评估并出具了《资产评估报告》（信资评报字[2022]第 050048 号），确认截至 2022 年 7 月 31 日公司净资产评估值为 54,984.29 万元，公司未根据上述评估结果进行账务调整。

2022 年 10 月 8 日，朗迅有限召开股东会并作出股东会决议，审议通过《关于有限公司变更为股份有限公司确认审计评估结果的决定》，同意以经致同所《审计报告》审计的截至 2022 年 7 月 31 日账面净资产 44,390.92 万元为基数，折为 1,814.56 万股，每股面值 1 元，净资产超过股本的部分转为资本公积，整

体变更为股份有限公司。

2022 年 10 月 24 日，朗迅科技召开了创立大会暨第一次股东大会。

2022 年 10 月 27 日，致同所出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000605 号）对上述整体变更进行了审验。

2022 年 10 月 31 日，公司于杭州市市场监督管理局完成了工商变更。整体变更后，朗迅科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	573.79	31.62%
2	杭州汇芯	195.90	10.80%
3	杭州朗新	160.00	8.82%
4	杭州聚芯	111.01	6.12%
5	黄庆红	97.13	5.35%
6	鸿溢盛新	91.65	5.05%
7	张伟杰	74.20	4.09%
8	广发乾和	50.40	2.78%
9	天问磐盈	45.82	2.53%
10	和丰创投	40.32	2.22%
11	舒丽霞	40.00	2.20%
12	瑞芯晶飞	36.29	2.00%
13	杭州高新创投	34.37	1.89%
14	真和投资	27.75	1.53%
15	翰富智维	25.20	1.39%
16	顾华	25.20	1.39%
17	紫金文化	25.20	1.39%
18	毅达工投	25.20	1.39%
19	湖畔小园	24.41	1.35%
20	天堂硅谷	24.41	1.35%
21	博通集成	24.41	1.35%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
22	产才融合	20.16	1.11%
23	长三角嘉善	15.12	0.83%
24	丽水奋智	15.12	0.83%
25	杭州集成电路基地	11.46	0.63%
合计		1,814.56	100.00%

（二）报告期内的股本和股东变化情况

报告期初，公司注册资本及股权结构参见本节之“二/（一）/2、股份公司设立情况”。公司设立早期，存在个别股东通过无形资产出资的情形，相关方已在报告期及股份公司设立前，通过现金出资方式予以完整补足。报告期初至今，发行人股本和工商登记的股东变化具体情况如下：

时间	股权变动事项	股东变化情况	变动后注册资本/股份（万元）
2023 年 8 月	报告期内第一次增资	海通创新、吉六零基金、赋实投资和杭州晶悦等股东合计增资 252.90 万元。	2,067.46
2023 年 9 月	报告期内第二次增资（资本公积转增股本）	以股东股本溢价形成的资本公积 1,682.54 万元转增股本。	3,750.00
2023 年 12 月	报告期内第三次增资	浙江省产业基金增资 82.28 万元。	3,832.28
2025 年 1 月	股份无偿划转及第四次增资	杭州产投将其持有的 23.51 万股股份无偿划转至产投集团。赋实投资、视谷创投、工融创新和宁波工投等股东合计增资 459.87 万元。	4,292.16
2025 年 1 月	报告期内第一次股份转让	张伟杰将其持有的 23.30 万股股份转让给海南优八。天问磐盈将其持有的 15.54 万股股份转让给海南优八。	4,292.16
2025 年 3 月	报告期内第二次股份转让	徐振将其持有的 47.02 万股股份转让给宁波通商。	4,292.16
2025 年 3 月	报告期内第三次股份转让	张伟杰将其持有的 18.13 万股股份转让给无锡鼎晖弘嘉；将其持有的 18.13 万股股份转让给成都鼎晖盈嘉。天问磐盈将其持有的 18.13 万股股份转让给无锡鼎晖弘嘉；将其持有的 18.13 万股股份转让给成都鼎晖盈嘉。	4,292.16
2025 年 6 月	报告期内第四次股份转让	徐振将其持有的 34.58 万股股份转让给财通创新。	4,292.16
2025 年 9 月	报告期内第五次股份转让	瑞芯晶飞将其持有的 41.52 万股股份转让给嘉值珣瑜。	4,292.16

1、2023 年 8 月，报告期内第一次增资

2023 年 6 月 21 日，经朗迅科技股东大会审议通过，同意海通创新、吉六零基金、赋实投资、杭州晶悦分别增资 32.40 万元；数文基金、珠海格金分别增资 19.44 万元；中叶善水增资 17.82 万元；中叶至源增资 14.58 万元；湖畔小园、杭州产投、鸿溢盛朗分别增资 12.96 万元；和丰创投、杭州高新创投分别增资 6.48 万元；桦昀投资增资 0.16 万元。以上出资均系以货币方式出资，溢价部分计入朗迅科技的资本公积。

本次增资完成后，公司注册资本由 1,814.56 万元增至 2,067.46 万元，增资总额为 252.90 万元。天健所对本次出资进行审验并出具了验资报告。

2023 年 8 月 16 日，杭州市市场监督管理局向朗迅科技换发了营业执照。本次增资完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	573.79	27.75%
2	杭州汇芯	195.90	9.48%
3	杭州朗新	160.00	7.74%
4	杭州聚芯	111.01	5.37%
5	黄庆红	97.13	4.70%
6	鸿溢盛新	91.65	4.43%
7	张伟杰	74.20	3.59%
8	广发乾和	50.40	2.44%
9	和丰创投	46.80	2.26%
10	天问磐盈	45.82	2.22%
11	杭州高新创投	40.85	1.98%
12	舒丽霞	40.00	1.93%
13	湖畔小园	37.38	1.81%
14	瑞芯晶飞	36.29	1.76%
15	海通创新	32.40	1.57%
16	吉六零基金	32.40	1.57%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
17	赋实投资	32.40	1.57%
18	杭州晶悦	32.40	1.57%
19	真和投资	27.75	1.34%
20	毅达工投	25.20	1.22%
21	紫金文化	25.20	1.22%
22	翰富智维	25.20	1.22%
23	顾华	25.20	1.22%
24	天堂硅谷	24.41	1.18%
25	博通集成	24.41	1.18%
26	产才融合	20.16	0.98%
27	数文基金	19.44	0.94%
28	珠海格金	19.44	0.94%
29	中叶善水	17.82	0.86%
30	丽水奋智	15.12	0.73%
31	长三角嘉善	15.12	0.73%
32	中叶至源	14.58	0.71%
33	杭州产投	12.96	0.63%
34	鸿溢盛朗	12.96	0.63%
35	杭州集成电路基地	11.46	0.55%
36	桦昀投资	0.16	0.01%
合计		2,067.46	100.00%

2、2023年9月，报告期内第二次增资（资本公积转增股本）

2023年9月15日，经朗迅科技股东大会审议通过，同意朗迅科技以股本溢价形成的资本公积1,682.54万元转增股本至3,750.00万元。

天健所对本次资本公积转增股本进行审验并出具了验资报告。

2023年9月26日，杭州市市场监督管理局向朗迅科技换发了营业执照。本次转增股本完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	1,040.75	27.75%
2	杭州汇芯	355.32	9.48%
3	杭州朗新	290.21	7.74%
4	杭州聚芯	201.35	5.37%
5	黄庆红	176.18	4.70%
6	鸿溢盛新	166.23	4.43%
7	张伟杰	134.58	3.59%
8	广发乾和	91.43	2.44%
9	和丰创投	84.89	2.26%
10	天问磐盈	83.12	2.22%
11	杭州高新创投	74.09	1.98%
12	舒丽霞	72.55	1.93%
13	湖畔小园	67.79	1.81%
14	瑞芯晶飞	65.83	1.76%
15	海通创新	58.77	1.57%
16	吉六零基金	58.77	1.57%
17	赋实投资	58.77	1.57%
18	杭州晶悦	58.77	1.57%
19	真和投资	50.34	1.34%
20	毅达工投	45.71	1.22%
21	紫金文化	45.71	1.22%
22	翰富智维	45.71	1.22%
23	顾华	45.71	1.22%
24	天堂硅谷	44.28	1.18%
25	博通集成	44.28	1.18%
26	产才融合	36.57	0.98%
27	数文基金	35.27	0.94%
28	珠海格金	35.27	0.94%
29	中叶善水	32.33	0.86%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
30	丽水奋智	27.43	0.73%
31	长三角嘉善	27.43	0.73%
32	中叶至源	26.45	0.71%
33	杭州产投	23.51	0.63%
34	鸿溢盛朗	23.51	0.63%
35	杭州集成电路基地	20.78	0.55%
36	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		3,750.00	100.00%

3、2023 年 12 月，报告期内第三次增资

2023 年 12 月 15 日，经朗迅科技股东大会审议通过，同意公司注册资本由 3,750.00 万元增至 3,832.28 万元，增资总额为 82.28 万元，由浙江省产业基金增资，以货币方式出资，溢价部分计入朗迅科技的资本公积。

2023 年 12 月 25 日，朗迅科技、朗迅科技原股东与浙江省产业基金签署了《增资协议》。

天健所对本次出资进行审验并出具了验资报告。

2023 年 12 月 28 日，杭州市市场监督管理局向朗迅科技换发了营业执照。本次增资完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	1,040.75	27.16%
2	杭州汇芯	355.32	9.27%
3	杭州朗新	290.21	7.57%
4	杭州聚芯	201.35	5.25%
5	黄庆红	176.18	4.60%
6	鸿溢盛新	166.23	4.34%
7	张伟杰	134.58	3.51%
8	广发乾和	91.43	2.39%
9	和丰创投	84.89	2.22%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
10	天问磐盈	83.12	2.17%
11	浙江省产业基金	82.28	2.15%
12	杭州高新创投	74.09	1.93%
13	舒丽霞	72.55	1.89%
14	湖畔小园	67.79	1.77%
15	瑞芯晶飞	65.83	1.72%
16	海通创新	58.77	1.53%
17	吉六零基金	58.77	1.53%
18	赋实投资	58.77	1.53%
19	杭州晶悦	58.77	1.53%
20	真和投资	50.34	1.31%
21	毅达工投	45.71	1.19%
22	紫金文化	45.71	1.19%
23	翰富智维	45.71	1.19%
24	顾华	45.71	1.19%
25	天堂硅谷	44.28	1.16%
26	博通集成	44.28	1.16%
27	产才融合	36.57	0.95%
28	数文基金	35.27	0.92%
29	珠海格金	35.27	0.92%
30	中叶善水	32.33	0.84%
31	丽水奋智	27.43	0.72%
32	长三角嘉善	27.43	0.72%
33	中叶至源	26.45	0.69%
34	杭州产投	23.51	0.61%
35	鸿溢盛朗	23.51	0.61%
36	杭州集成电路基地	20.78	0.54%
37	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		3,832.28	100.00%

4、2025 年 1 月，股份无偿划转及报告期内第四次增资

2024 年 11 月 8 日，杭州市国有资本投资运营有限公司召开董事会会议，同意其全资子公司杭州产投将持有的朗迅科技股份无偿划转至其全资子公司产投集团。

杭州产投与产投集团于 2024 年 11 月 13 日签署《国有股权无偿划转协议》，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，杭州产投将其持有的朗迅科技 23.51 万股股份无偿划转至产投集团。

2024 年 12 月 20 日，经朗迅科技股东大会审议通过，同意公司注册资本由 3,832.28 万元增至 4,292.16 万元，增资总额为 459.87 万元，其中，赋实投资、视谷创投、工融创新、宁波工投分别增资 109.49 万元；湖畔小竹增资 21.90 万元，均系以货币方式出资，溢价部分计入朗迅科技的资本公积。

2024 年 12 月 30 日，朗迅科技、朗迅科技原股东与赋实投资等投资方签署了《增资协议》。

天健所对本次出资进行审验并出具了验资报告。

2025 年 1 月 10 日，杭州市市场监督管理局向朗迅科技换发了营业执照。本次无偿划转及增资完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	1,040.75	24.25%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%
8	张伟杰	134.58	3.14%
9	视谷创投	109.49	2.55%
10	工融创新	109.49	2.55%
11	宁波工投	109.49	2.55%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
12	广发乾和	91.43	2.13%
13	和丰创投	84.89	1.98%
14	天问磐盈	83.12	1.94%
15	浙江省产业基金	82.28	1.92%
16	杭州高新创投	74.09	1.73%
17	舒丽霞	72.55	1.69%
18	湖畔小园	67.79	1.58%
19	瑞芯晶飞	65.83	1.53%
20	海通创新	58.77	1.37%
21	吉六零基金	58.77	1.37%
22	杭州晶悦	58.77	1.37%
23	真和投资	50.34	1.17%
24	毅达工投	45.71	1.07%
25	紫金文化	45.71	1.07%
26	翰富智维	45.71	1.07%
27	顾华	45.71	1.07%
28	天堂硅谷	44.28	1.03%
29	博通集成	44.28	1.03%
30	产才融合	36.57	0.85%
31	数文基金	35.27	0.82%
32	珠海格金	35.27	0.82%
33	中叶善水	32.33	0.75%
34	丽水奋智	27.43	0.64%
35	长三角嘉善	27.43	0.64%
36	中叶至源	26.45	0.62%
37	产投集团	23.51	0.55%
38	鸿溢盛朗	23.51	0.55%
39	湖畔小竹	21.90	0.51%
40	杭州集成电路基地	20.78	0.48%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
41	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		4,292.16	100.00%

5、2025 年 1 月，报告期内第一次股份转让

2025 年 1 月 16 日，张伟杰与海南优八签订《股份转让协议》，约定将其持有的公司 23.30 万股股份转让给海南优八。天问磐盈与海南优八签订《股份转让协议》，约定将持有的公司 15.54 万股股份转让给海南优八。上述股份转让款均已支付完毕。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	1,040.75	24.25%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%
8	张伟杰	111.28	2.59%
9	视谷创投	109.49	2.55%
10	工融创新	109.49	2.55%
11	宁波工投	109.49	2.55%
12	广发乾和	91.43	2.13%
13	和丰创投	84.89	1.98%
14	浙江省产业基金	82.28	1.92%
15	杭州高新创投	74.09	1.73%
16	舒丽霞	72.55	1.69%
17	湖畔小园	67.79	1.58%
18	天问磐盈	67.58	1.57%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
19	瑞芯晶飞	65.83	1.53%
20	海通创新	58.77	1.37%
21	吉六零基金	58.77	1.37%
22	杭州晶悦	58.77	1.37%
23	真和投资	50.34	1.17%
24	毅达工投	45.71	1.07%
25	紫金文化	45.71	1.07%
26	翰富智维	45.71	1.07%
27	顾华	45.71	1.07%
28	天堂硅谷	44.28	1.03%
29	博通集成	44.28	1.03%
30	海南优八	38.84	0.90%
31	产才融合	36.57	0.85%
32	数文基金	35.27	0.82%
33	珠海格金	35.27	0.82%
34	中叶善水	32.33	0.75%
35	丽水奋智	27.43	0.64%
36	长三角嘉善	27.43	0.64%
37	中叶至源	26.45	0.62%
38	产投集团	23.51	0.55%
39	鸿溢盛朗	23.51	0.55%
40	湖畔小竹	21.90	0.51%
41	杭州集成电路基地	20.78	0.48%
42	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		4,292.16	100.00%

6、2025 年 3 月，报告期内第二次股份转让

2025 年 3 月 10 日，徐振与宁波通商签订《股权转让协议》，约定将其持有的公司 47.02 万股股份转让给宁波通商。上述股份转让款均已支付完毕。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	993.73	23.15%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%
8	张伟杰	111.28	2.59%
9	视谷创投	109.49	2.55%
10	工融创新	109.49	2.55%
11	宁波工投	109.49	2.55%
12	广发乾和	91.43	2.13%
13	和丰创投	84.89	1.98%
14	浙江省产业基金	82.28	1.92%
15	杭州高新创投	74.09	1.73%
16	舒丽霞	72.55	1.69%
17	湖畔小园	67.79	1.58%
18	天问磐盈	67.58	1.57%
19	瑞芯晶飞	65.83	1.53%
20	海通创新	58.77	1.37%
21	吉六零基金	58.77	1.37%
22	杭州晶悦	58.77	1.37%
23	真和投资	50.34	1.17%
24	宁波通商	47.02	1.10%
25	毅达工投	45.71	1.07%
26	紫金文化	45.71	1.07%
27	翰富智维	45.71	1.07%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
28	顾华	45.71	1.07%
29	天堂硅谷	44.28	1.03%
30	博通集成	44.28	1.03%
31	海南优八	38.84	0.90%
32	产才融合	36.57	0.85%
33	数文基金	35.27	0.82%
34	珠海格金	35.27	0.82%
35	中叶善水	32.33	0.75%
36	丽水奋智	27.43	0.64%
37	长三角嘉善	27.43	0.64%
38	中叶至源	26.45	0.62%
39	产投集团	23.51	0.55%
40	鸿溢盛朗	23.51	0.55%
41	湖畔小竹	21.90	0.51%
42	杭州集成电路基地	20.78	0.48%
43	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		4,292.16	100.00%

7、2025 年 3 月，报告期内第三次股份转让

2025 年 3 月 25 日，张伟杰、天问磐盈与无锡鼎晖弘嘉、成都鼎晖盈嘉签订《股份转让协议》，约定张伟杰将其持有的公司 18.13 万股股份转让给无锡鼎晖弘嘉；张伟杰将其持有的公司 18.13 万股股份转让给成都鼎晖盈嘉；天问磐盈将其持有的公司 18.13 万股股份转让给无锡鼎晖弘嘉；天问磐盈将其持有的公司 18.13 万股股份转让给成都鼎晖盈嘉。上述股份转让款均已支付完毕。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	993.73	23.15%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%
8	视谷创投	109.49	2.55%
9	工融创新	109.49	2.55%
10	宁波工投	109.49	2.55%
11	广发乾和	91.43	2.13%
12	和丰创投	84.89	1.98%
13	浙江省产业基金	82.28	1.92%
14	张伟杰	75.03	1.75%
15	杭州高新创投	74.09	1.73%
16	舒丽霞	72.55	1.69%
17	湖畔小园	67.79	1.58%
18	瑞芯晶飞	65.83	1.53%
19	海通创新	58.77	1.37%
20	吉六零基金	58.77	1.37%
21	杭州晶悦	58.77	1.37%
22	真和投资	50.34	1.17%
23	宁波通商	47.02	1.10%
24	毅达工投	45.71	1.07%
25	紫金文化	45.71	1.07%
26	翰富智维	45.71	1.07%
27	顾华	45.71	1.07%
28	天堂硅谷	44.28	1.03%
29	博通集成	44.28	1.03%
30	海南优八	38.84	0.90%
31	产才融合	36.57	0.85%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
32	无锡鼎晖弘嘉	36.25	0.84%
33	成都鼎晖盈嘉	36.25	0.84%
34	数文基金	35.27	0.82%
35	珠海格金	35.27	0.82%
36	中叶善水	32.33	0.75%
37	天问磐盈	31.33	0.73%
38	丽水奋智	27.43	0.64%
39	长三角嘉善	27.43	0.64%
40	中叶至源	26.45	0.62%
41	产投集团	23.51	0.55%
42	鸿溢盛朗	23.51	0.55%
43	湖畔小竹	21.90	0.51%
44	杭州集成电路基地	20.78	0.48%
45	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		4,292.16	100.00%

8、2025 年 6 月，报告期内第四次股份转让

2025 年 6 月 17 日，徐振与财通创新签订《股份转让协议》，约定将其持有的公司 34.58 万股股份转让给财通创新。上述股份转让款均已支付完毕。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	959.15	22.35%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
8	视谷创投	109.49	2.55%
9	工融创新	109.49	2.55%
10	宁波工投	109.49	2.55%
11	广发乾和	91.43	2.13%
12	和丰创投	84.89	1.98%
13	浙江省产业基金	82.28	1.92%
14	张伟杰	75.03	1.75%
15	杭州高新创投	74.09	1.73%
16	舒丽霞	72.55	1.69%
17	湖畔小园	67.79	1.58%
18	瑞芯晶飞	65.83	1.53%
19	海通创新	58.77	1.37%
20	吉六零基金	58.77	1.37%
21	杭州晶悦	58.77	1.37%
22	真和投资	50.34	1.17%
23	宁波通商	47.02	1.10%
24	毅达工投	45.71	1.07%
25	紫金文化	45.71	1.07%
26	翰富智维	45.71	1.07%
27	顾华	45.71	1.07%
28	天堂硅谷	44.28	1.03%
29	博通集成	44.28	1.03%
30	海南优八	38.84	0.90%
31	产才融合	36.57	0.85%
32	无锡鼎晖弘嘉	36.25	0.84%
33	成都鼎晖盈嘉	36.25	0.84%
34	数文基金	35.27	0.82%
35	珠海格金	35.27	0.82%
36	财通创新	34.58	0.81%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
37	中叶善水	32.33	0.75%
38	天问磐盈	31.33	0.73%
39	丽水奋智	27.43	0.64%
40	长三角嘉善	27.43	0.64%
41	中叶至源	26.45	0.62%
42	产投集团	23.51	0.55%
43	鸿溢盛朗	23.51	0.55%
44	湖畔小竹	21.90	0.51%
45	杭州集成电路基地	20.78	0.48%
46	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		4,292.16	100.00%

9、2025 年 9 月，报告期内第五次股份转让

2025 年 9 月 22 日，瑞芯晶飞与嘉值琨瑜签订《股权转让协议》，约定将其持有的 41.52 万股股份转让给嘉值琨瑜。上述股份转让款均已支付完毕。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
1	徐振	959.15	22.35%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%
8	视谷创投	109.49	2.55%
9	工融创新	109.49	2.55%
10	宁波工投	109.49	2.55%
11	广发乾和	91.43	2.13%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
12	和丰创投	84.89	1.98%
13	浙江省产业基金	82.28	1.92%
14	张伟杰	75.03	1.75%
15	杭州高新创投	74.09	1.73%
16	舒丽霞	72.55	1.69%
17	湖畔小园	67.79	1.58%
18	海通创新	58.77	1.37%
19	吉六零基金	58.77	1.37%
20	杭州晶悦	58.77	1.37%
21	真和投资	50.34	1.17%
22	宁波通商	47.02	1.10%
23	毅达工投	45.71	1.07%
24	紫金文化	45.71	1.07%
25	翰富智维	45.71	1.07%
26	顾华	45.71	1.07%
27	天堂硅谷	44.28	1.03%
28	博通集成	44.28	1.03%
29	嘉值琨瑜	41.52	0.97%
30	海南优八	38.84	0.90%
31	产才融合	36.57	0.85%
32	无锡鼎晖弘嘉	36.25	0.84%
33	成都鼎晖盈嘉	36.25	0.84%
34	数文基金	35.27	0.82%
35	珠海格金	35.27	0.82%
36	财通创新	34.58	0.81%
37	中叶善水	32.33	0.75%
38	天问磐盈	31.33	0.73%
39	丽水奋智	27.43	0.64%
40	长三角嘉善	27.43	0.64%

序号	股东名称/姓名	持有股份（万股）	持股比例
41	中叶至源	26.45	0.62%
42	瑞芯晶飞	24.30	0.57%
43	产投集团	23.51	0.55%
44	鸿溢盛朗	23.51	0.55%
45	湖畔小竹	21.90	0.51%
46	杭州集成电路基地	20.78	0.48%
47	桦昀投资	0.29	0.01%
合计		4,292.16	100.00%

三、发行人成立以来重要事件

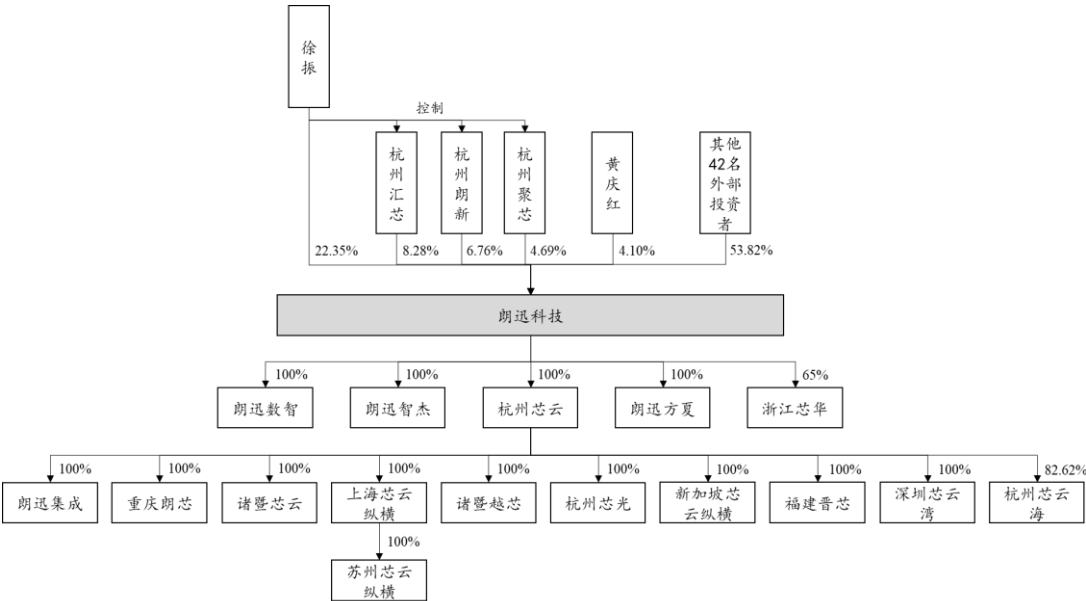
发行人报告期内未进行重大资产重组。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

自设立至本招股说明书签署日，公司不存在在其他证券市场上市、挂牌的情况。

五、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构情况如下：



六、发行人子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有 5 家子公司、11 家孙公司、2 家分公司，无参股公司。报告期初至本招股说明书签署日，公司注销了 4 家子（孙）公司。公司子（孙）公司、分公司具体情况如下所示：

（一）重要子公司

公司将最近一年利润总额指标超过公司合并口径利润总额的 15%的子（孙）公司，或虽不具有财务重大性，但在公司业务经营、战略规划中承担重要职能的子（孙）公司认定为重要子公司。

截至本招股说明书签署日，发行人的重要子公司为杭州芯云、杭州芯云海和诸暨芯云，具体情况如下：

1、杭州芯云

企业名称：	杭州芯云半导体集团有限公司
统一社会信用代码：	91330108MA2HXBHQ77
法定代表人：	徐振
成立时间：	2020年5月11日
类型：	有限责任公司
注册资本：	135,000.00万元
实收资本：	135,000.00万元
股东构成及控制关系：	发行人持股100%
注册地和主要生产经营地：	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号一幢（南）一楼F1066室
经营范围：	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
在发行人业务板块中的定位：	发行人主要集成电路测试主体之一

杭州芯云最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	431,381.23
净资产	182,981.12
营业收入	209,060.72
净利润	34,182.32

注：上述数据已经天健所审计。

2、杭州芯云海

企业名称：	杭州芯云海半导体有限公司
统一社会信用代码：	91330183MABYQNLKXW
法定代表人：	徐振
成立时间：	2022年10月10日
类型：	有限责任公司
注册资本：	72,618.30万元
实收资本：	72,618.30万元
股东构成及控制关系：	发行人全资子公司杭州芯云持股82.62%、杭州禾合滨创股权投资合伙企业（有限合伙）持股8.69%、杭州鑫创引领自有资金投资合伙企业（有限合伙）持股8.69%
注册地和主要生产经营地：	浙江省杭州市富阳区灵桥镇罗山路155号
经营范围：	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
在发行人业务板块中的定位：	发行人主要集成电路测试主体之一

杭州芯云海最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	333,183.95
净资产	111,867.68
营业收入	82,546.21
净利润	12,666.12

注：上述数据已经天健所审计。

3、诸暨芯云

企业名称：	芯云半导体（诸暨）有限公司
统一社会信用代码：	91330681MA2JUD605U
法定代表人：	徐振
成立时间：	2021年7月12日
类型：	有限责任公司
注册资本：	25,000.00万元
实收资本：	25,000.00万元
股东构成及控制关系：	发行人全资子公司杭州芯云持股100%
注册地和主要生产经营地：	浙江省诸暨市暨阳街道兴农路9号312室
经营范围：	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
在发行人业务板块中的定位：	发行人主要集成电路测试主体之一

诸暨芯云最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	161,739.67
净资产	55,717.83

项目	2025-12-31/2025 年度
营业收入	67,878.80
净利润	13,416.68

注：上述数据已经天健所审计。

（二）其他子公司

序号	名称	股权结构	注册资本	成立时间	主营业务/业务 板块定位
1	朗迅数智	发行人持股 100%	1,000.00 万元	2019-08-29	集成电路产教 融合软硬件装 备销售
2	朗迅智杰	发行人持股 100%	500.00 万元	2024-12-04	暂未实际经营
3	朗迅方夏	发行人持股 100%	300.00 万元	2026-02-02	暂未实际经营
4	浙江芯华	发行人持股 65%	1,000.00 万元	2025-12-22	暂未实际经营
5	朗迅集成	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	200.00 万元	2016-12-23	集成电路测试 业务
6	重庆朗芯	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	200.00 万元	2019-04-18	暂未实际经营
7	上海芯云 纵横	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	2,000.00 万元	2022-02-23	集成电路测试 业务
8	诸暨越芯	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	35,000.00 万元	2022-11-18	集成电路测试 业务
9	新加坡芯云 纵横	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	100.00 万美元	2024-06-13	暂未实际经营
10	杭州芯光	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	87,000.00 万元	2024-09-18	集成电路测试 业务
11	苏州芯云 纵横	发行人全资子公司 杭州芯云的全资子 公司上海芯云纵横 持股 100%	2,000.00 万元	2022-09-16	暂未实际经营
12	福建晋芯	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	2,000.00 万元	2026-06-29	暂未实际经营
13	深圳芯云湾	发行人全资子公司 杭州芯云持股 100%	1,000.00 万元	2026-09-09	暂未实际经营

（三）注销的子公司

报告期初至本招股说明书签署日，公司注销了 4 家子（孙）公司，分别为
江阴芯云、江西朗驰、浙江华芯和诸暨教育，具体情况参见本招股说明书“第
十二节 附件”之“九/（二）注销子公司”。

（四）分公司

1、朗迅科技青岛分公司

企业名称	杭州朗迅科技股份有限公司青岛分公司
成立时间	2023 年 2 月 14 日
负责人	刘欣妍
注册地和主要生产经营地	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 23 号青岛德国企业中心 3A 层 3A06-3 单元
经营范围	一般项目：集成电路销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、杭州芯云深圳分公司

企业名称	杭州芯云半导体集团有限公司深圳分公司
成立时间	2024 年 6 月 28 日
负责人	石丽萍
注册地和主要生产经营地	深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路 393 号海发大厦 A1407
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东、实际控制人为徐振。截至本招股说明书签署日，徐振直接持有公司 22.35%股权；徐振担任杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯的执行事务合伙人，上述合伙企业分别持有公司 8.28%、6.76%和 4.69%的股权，徐振通过上述主体控制公司 19.73%的表决权；同时，徐振与黄庆红、章小婵、何涛、寿佳琪系一致行动人，基于相关协议形成一致行动关系，各方在所有重大事项的决

策和行动上与徐振保持一致，并将该等一致意见体现在董事会或股东会上。综上，徐振及其一致行动人合计控制公司 46.18%的表决权。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。公司控股股东、实际控制人的基本情况具体如下：

徐振，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3307211977*****，担任公司董事长、总经理。

徐振简历参见本节之“十二/（一）/1、董事”。

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人持有公司的股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。

（三）持有公司 5%以上股份或表决权的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人徐振外，直接持有公司 5%以上股份的股东为杭州汇芯、杭州朗新，杭州汇芯、杭州朗新及杭州聚芯均系徐振担任执行事务合伙人的企业，分别持有公司 8.28%、6.76%和 4.69%的股份；公司股东赋实投资和视谷创投的私募基金管理人均为杭实资产管理（杭州）有限公司，实际控制人均为杭州市实业投资集团有限公司，分别持有公司 3.92%、2.55%的股份，合计持有公司 6.47%的股份；公司股东宁波通商的基金管理人为宁波通商基金管理有限公司，宁波通商基金管理有限公司与公司股东宁波工投、和丰创投均系宁波通商控股集团有限公司控制的企业，宁波通商、宁波工投、和丰创投分别持有公司 1.10%、2.55%和 1.98%的股份，合计持有公司 5.62%的股份。徐振等自然人股东的情况参见本节之“十一/（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务”，其他股东具体情况如下：

1、杭州汇芯、杭州朗新及杭州聚芯

（1）杭州汇芯

企业名称	杭州汇芯企业管理合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

成立时间	2020 年 5 月 11 日			
认缴出资额	1,500.00 万元			
执行事务合伙人	徐振			
统一社会信用代码	91330108MA2HXBHH3K			
企业类型	有限合伙企业			
注册地和主要生产 经营地	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3760 号 11 层 1108 室			
股东情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
	徐振	普通合伙人	1,180.94	78.73%
	刘思霖	有限合伙人	50.00	3.33%
	周文清	有限合伙人	20.00	1.33%
	刘东晓	有限合伙人	20.00	1.33%
	史姣姣	有限合伙人	20.00	1.33%
	蒋益钦	有限合伙人	20.00	1.33%
	寿佳琪	有限合伙人	20.00	1.33%
	汪明珠	有限合伙人	20.00	1.33%
	丁盛峰	有限合伙人	20.00	1.33%
	何涛	有限合伙人	20.00	1.33%
	李志凯	有限合伙人	20.00	1.33%
	夏蕾	有限合伙人	20.00	1.33%
	吴荣荣	有限合伙人	20.00	1.33%
	许修健	有限合伙人	20.00	1.33%
	魏巍	有限合伙人	20.00	1.33%
	王寒冰	有限合伙人	9.06	0.60%
经营范围	一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；财务咨询；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			

(2) 杭州朗新

企业名称	杭州朗新投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 6 月 13 日

认缴出资额	160.00 万元			
执行事务合伙人	徐振			
统一社会信用代码	91330108MA2CCFNT1F			
企业类型	有限合伙企业			
注册地和主要生产 经营地	浙江省杭州市滨江区南环路 3760 号华荣创艺大厦 308 室			
股东情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
	徐振	普通合伙人	104.00	65.00%
	洪涛	有限合伙人	56.00	35.00%
经营范围	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			

(3) 杭州聚芯

企业名称	杭州聚芯企业管理合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2020 年 5 月 11 日			
认缴出资额	2,401.00 万元			
执行事务合伙人	徐振			
统一社会信用代码	91330108MA2HXB074			
企业类型	有限合伙企业			
注册地和主要生产 经营地	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3760 号 1110 室			
股东情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
	徐振	普通合伙人	1.00	0.04%
	章小婵	有限合伙人	1,160.00	48.31%
	天问华欣	有限合伙人	523.00	21.78%
	上海珥云企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	400.00	16.66%
	天问愿景	有限合伙人	317.00	13.20%
经营范围	一般项目：企业管理；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；财务咨询；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			

2、赋实投资及视谷创投

赋实投资及视谷创投合计持有发行人 277.76 万股股份，占发行人总股本的 6.47%。赋实投资、视谷创投的基金管理人均为杭实资产管理（杭州）有限公司，实际控制人均为杭州市实业投资集团有限公司。

（1）赋实投资

企业名称	杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2017 年 12 月 25 日			
认缴出资额	1,000,000.00 万元			
执行事务合伙人	杭实资产管理（杭州）有限公司			
统一社会信用代码	91330102MA2AYYBD4Q			
企业类型	有限合伙企业			
注册地和主要生产经营地	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 192 室-20			
股东情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
	杭实资产管理（杭州）有限公司	普通合伙人	100.00	0.01%
	杭实创新（杭州）投资发展集团有限公司	有限合伙人	999,900.00	99.99%
经营范围	服务：投资管理，非证券业务的投资咨询，受托企业资产管理。（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保，代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			

（2）视谷创投

企业名称	杭州视谷创业投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2023 年 3 月 8 日			
认缴出资额	101,000.00 万元			
执行事务合伙人	杭州杭实杭视股权投资合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91330109MACAAC1K5F			
企业类型	有限合伙企业			
注册地和主要生产经营地	浙江省杭州市萧山区湘湖国家旅游度假区湘湖金融小镇二期区块南岸 3B 号楼 108-258 室			
股东情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例

	杭州杭实杭视股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,000.00	0.99%
	杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	40,000.00	39.60%
	杭州高新创业投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	29.70%
	杭州萧山产业基金有限公司	有限合伙人	30,000.00	29.70%
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			

3、宁波工投、和丰创投及宁波通商

宁波工投、和丰创投及宁波通商合计持有发行人 241.40 万股股份，占发行人总股本的 5.62%。宁波通商的基金管理人为宁波通商基金管理有限公司，宁波通商基金管理有限公司、宁波工投、和丰创投均系宁波通商控股集团有限公司控制的企业。

（1）宁波工投

企业名称：	宁波市工业投资有限责任公司		
成立时间：	1995年4月18日		
注册资本：	60,400.00万元		
法定代表人：	王东升		
统一社会信用代码：	91330200254077833T		
类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册地址：	海曙区永丰西路221号2-3室		
主营业务及与公司主营业务的关系	投资平台，未从事与发行人主营业务相关的业务		
股东情况：	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	宁波工业投资集团有限公司	60,400.00	100.00%
经营范围：	项目投资，资产经营和管理，投资咨询（除证券、期货）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外；实物租赁。		

（2）和丰创投

企业名称：	宁波和丰创业投资有限公司
成立时间：	2015年9月16日

注册资本：	60,000.00万元		
法定代表人：	王东升		
统一社会信用代码：	91330203340571600G		
类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册地址：	浙江省宁波市海曙区机场路1000号5号楼103室		
主营业务及与公司主营业务的关系	投资平台，未从事与发行人主营业务相关的业务		
股东情况：	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	宁波工业投资集团有限公司	60,000.00	100.00%
经营范围：	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

（3）宁波通商

企业名称	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2020年6月2日			
认缴出资额	500,000.00万元			
执行事务合伙人	宁波通商基金管理有限公司			
统一社会信用代码	91330203MA2H623117			
企业类型	有限合伙企业			
注册地和主要生产 经营地	浙江省宁波市海曙区灵桥路229号（5-220）			
股东情况	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
	宁波通商基金管理有限公司	普通合伙人	500.00	0.10%
	宁波通商控股集团有限公司	有限合伙人	499,500.00	99.90%
经营范围	一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			

八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况

公司不存在特别表决权股份或类似安排。

九、发行人协议控制架构的情况

公司不存在协议控制架构或类似安排。

十、发行人控股股东、实际控制人的合规性

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十一、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本变化情况

截至本招股说明书签署日，公司总股本为 4,292.1560 万股。本次拟公开发行的股份不超过 1,430.7187 万股，不低于发行后公司总股本的 25%。本次无老股东公开发售股份。

本次发行前后，公司股本结构如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	徐振	959.15	22.35%	959.15	16.76%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%	355.32	6.21%
3	杭州朗新	290.21	6.76%	290.21	5.07%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%	201.35	3.52%
5	黄庆红	176.18	4.10%	176.18	3.08%
6	赋实投资	168.27	3.92%	168.27	2.94%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%	166.23	2.90%
8	视谷创投	109.49	2.55%	109.49	1.91%
9	工融创新	109.49	2.55%	109.49	1.91%
10	宁波工投	109.49	2.55%	109.49	1.91%
11	广发乾和	91.43	2.13%	91.43	1.60%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
12	和丰创投	84.89	1.98%	84.89	1.48%
13	浙江省产业基金	82.28	1.92%	82.28	1.44%
14	张伟杰	75.03	1.75%	75.03	1.31%
15	杭州高新创投	74.09	1.73%	74.09	1.29%
16	舒丽霞	72.55	1.69%	72.55	1.27%
17	湖畔小园	67.79	1.58%	67.79	1.18%
18	海通创新	58.77	1.37%	58.77	1.03%
19	吉六零基金	58.77	1.37%	58.77	1.03%
20	杭州晶悦	58.77	1.37%	58.77	1.03%
21	真和投资	50.34	1.17%	50.34	0.88%
22	宁波通商	47.02	1.10%	47.02	0.82%
23	毅达工投	45.71	1.07%	45.71	0.80%
24	紫金文化	45.71	1.07%	45.71	0.80%
25	翰富智维	45.71	1.07%	45.71	0.80%
26	顾华	45.71	1.07%	45.71	0.80%
27	天堂硅谷	44.28	1.03%	44.28	0.77%
28	博通集成	44.28	1.03%	44.28	0.77%
29	嘉值琨瑜	41.52	0.97%	41.52	0.73%
30	海南优八	38.84	0.90%	38.84	0.68%
31	产才融合	36.57	0.85%	36.57	0.64%
32	无锡鼎晖弘嘉	36.25	0.84%	36.25	0.63%
33	成都鼎晖盈嘉	36.25	0.84%	36.25	0.63%
34	数文基金	35.27	0.82%	35.27	0.62%
35	珠海格金	35.27	0.82%	35.27	0.62%
36	财通创新	34.58	0.81%	34.58	0.60%
37	中叶善水	32.33	0.75%	32.33	0.56%
38	天问磐盈	31.33	0.73%	31.33	0.55%
39	丽水奋智	27.43	0.64%	27.43	0.48%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
40	长三角嘉善	27.43	0.64%	27.43	0.48%
41	中叶至源	26.45	0.62%	26.45	0.46%
42	瑞芯晶飞	24.30	0.57%	24.30	0.42%
43	产投集团	23.51	0.55%	23.51	0.41%
44	鸿溢盛朗	23.51	0.55%	23.51	0.41%
45	湖畔小竹	21.90	0.51%	21.90	0.38%
46	杭州集成电路基地	20.78	0.48%	20.78	0.36%
47	桦昀投资	0.29	0.01%	0.29	0.01%
48	社会公众股	-	-	1,430.72	25.00%
合计		4,292.16	100.00%	5,722.87	100.00%

注：相关持股数量保留两位小数，下同。

（二）本次发行前的前十名股东

截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	徐振	959.15	22.35%
2	杭州汇芯	355.32	8.28%
3	杭州朗新	290.21	6.76%
4	杭州聚芯	201.35	4.69%
5	黄庆红	176.18	4.10%
6	赋实投资	168.27	3.92%
7	鸿溢盛新	166.23	3.87%
8	视谷创投	109.49	2.55%
9	工融创新	109.49	2.55%
10	宁波工投	109.49	2.55%
合计		2,645.20	61.63%

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，公司共有 5 名自然人股东，其在公司担任的职务情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	在公司任职
1	徐振	959.15	22.35%	董事长、总经理
2	黄庆红	176.18	4.10%	董事、副总经理
3	张伟杰	75.03	1.75%	无
4	舒丽霞	72.55	1.69%	无
5	顾华	45.71	1.07%	无
合计		1,328.63	30.95%	-

（四）国有股份或外资股份

截至本招股说明书签署日，公司共有 8 名股东符合《上市公司国有股权监督管理办法》第三条、第七十四条的情形。根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于宁波市工业投资有限责任公司等 8 家国有股东标识管理有关事项的批复》（甬国资办[2025]29 号），上述 8 名国有股东的标识等情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	国有股东标识
1	宁波工投	109.49	2.55%	SS
2	和丰创投	84.89	1.98%	SS
3	浙江省产业基金	82.28	1.92%	SS
4	杭州高新创投	74.09	1.73%	SS
5	海通创新	58.77	1.37%	CS
6	财通创新	34.58	0.81%	CS
7	产投集团	23.51	0.55%	SS
8	杭州集成电路基地	20.78	0.48%	SS
合计		488.40	11.38%	-

注：根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三条规定，该办法所称国有股东是指符合以下情形之一的企业和单位，其证券账户标注“SS”：（一）政府部门、机构、事业单

位、境内国有独资或全资企业；（二）第一款中所述单位或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过 50%，且其中之一为第一大股东的境内企业；（三）第二款中所述企业直接或间接持股的各级境内独资或全资企业。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第七十四条规定，不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理。

发行人不属于由国有企业、事业单位、集体企业改制而来，亦不存在历史上挂靠集体组织经营的情况。

截至本招股说明书签署日，公司股东中无外资股东。

（五）申报前十二个月新增股东情况

发行人申报前 12 个月内新增股东情况如下：

1、新增股东名单

序号	股东名称	方式	入股原因	入股时间	持股数量 (万股)	受让价格 (元/股)	定价依据
1	财通创新	受让入股	看好发行人未来发展前景，通过	2025 年 6 月	34.58	86.76	协商定价
2	嘉值琨瑜	受让入股	受让老股东股份取得发行人股份	2025 年 9 月	41.52	75.00	协商定价

2、新增股东的基本情况

发行人最近一年新增股东的基本情况如下：

（1）财通创新

1）基本情况

截至本招股说明书签署日，财通创新直接持有公司 0.81%的股份，其基本情况如下：

名称	财通创新投资有限公司
法定代表人	张昊
成立日期	2015 年 10 月 15 日
统一社会信用代码	91330000MA27U00F3F
注册资本	500,000.00 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室
经营范围	金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2) 股权结构

截至本招股说明书签署日，财通创新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	财通证券股份有限公司	500,000.00	100.00%
合计		500,000.00	100.00%

(2) 嘉值琨瑜

1) 基本情况

截至本招股说明书签署日，嘉值琨瑜直接持有公司 0.97%的股份，已于 2025 年 9 月 17 日完成私募基金备案，基金编号为 SBFY66。其基本情况如下：

名称	共青城嘉值琨瑜股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	广州嘉值投资管理有限公司（委派代表：卓海漩）
成立日期	2025 年 8 月 4 日
统一社会信用代码	91360405MAERUCTJ3Y
出资额	5,451.00 万元
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2) 股权结构

截至本招股说明书签署日，嘉值琨瑜的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	广州嘉值投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.02%
2	宁波鼎祥名仕创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	18.35%
3	合肥万合创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	18.35%
4	姜钧	有限合伙人	600.00	11.01%
5	姚远	有限合伙人	500.00	9.17%
6	李晓文	有限合伙人	500.00	9.17%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
7	幸晓红	有限合伙人	400.00	7.34%
8	饶冬梅	有限合伙人	350.00	6.42%
9	蒋卓桓	有限合伙人	300.00	5.50%
10	王云兰	有限合伙人	300.00	5.50%
11	刘壮波	有限合伙人	300.00	5.50%
12	张和伟	有限合伙人	200.00	3.67%
合计			5,451.00	100.00%

3）普通合伙人

截至本招股说明书签署日，嘉值琨瑜的普通合伙人为广州嘉值投资管理有限公司，基本情况如下：

名称	广州嘉值投资管理有限公司
法定代表人	林佑刚
成立日期	2009年8月6日
统一社会信用代码	914401066935546623
注册资本	1,000.00 万元
注册地址	广州市天河区天河北路 233 号 2115 房
经营范围	投资咨询服务；投资管理服务；企业管理咨询服务

截至本招股说明书签署日，广州嘉值投资管理有限公司为嘉值琨瑜的私募基金管理人，已于 2017 年 12 月 25 日完成私募基金管理人登记，登记编号 P1066568。

3、新增股东与发行人其他股东、董事、高级管理人员是否存在关联关系，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形等

发行人申报前十二个月新增股东均为外部财务投资人，与发行人其他股东、董事、高级管理人员，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。新增股东持有的发行人股份不存在股份代持情形。

（六）发行人私募投资股东情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有股东 47 名，其中自然人股东 5 名，非自然人股东 42 名。非自然人股东中，26 名股东为私募投资基金，均已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体信息如下：

序号	股东名称	基金编号	备案时间	管理人名称	基金管理人 登记编号
1	赋实投资	SGL306	2019-10-22	杭实资产管理（杭州）有限公司	P1069820
2	鸿溢盛新	SSZ451	2021-10-20	上海襄聚私募基金管理有限公司	P1069965
3	视谷创投	SZP202	2023-04-03	杭实资产管理（杭州）有限公司	P1069820
4	工融创新	SASA31	2024-12-24	工银资本管理有限公司	P1069650
5	湖畔小园	SGW603	2019-09-02	杭州湖畔宏盛投资管理有限公司	P1069542
6	吉六零基金	SVJ030	2022-06-13	海富产业投资基金管理有限公司	P1000839
7	真和投资	SCP093	2018-10-19	杭州枫惠投资管理有限公司	P1066867
8	宁波通商	SLT177	2020-09-03	宁波通商基金管理有限公司	P1069609
9	毅达工投	SNL632	2021-01-05	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	P1032972
10	紫金文化	S23608	2015-03-23	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	P1032972
11	翰富智维	SCB151	2018-01-12	杭州东翰派富私募基金管理有限公司	P1065363
12	天堂硅谷	SQY140	2021-06-28	上海天堂硅谷创业投资管理有限公司	P1008005
13	嘉值琨瑜	SBFY66	2025-09-17	广州嘉值投资管理有限公司	P1066568
14	产才融合	SQZ682	2021-07-20	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	P1032972
15	无锡鼎晖弘嘉	SB9028	2023-10-23	鼎晖股权投资管理（天津）有限公司	P1000301
16	成都鼎晖盈嘉	SAFM21	2024-01-29	鼎晖股权投资管理（天津）有限公司	P1000301
17	数文基金	STF772	2022-01-21	建银国际财富管理（天津）有限公司	P1003983
18	珠海格金	STT570	2022-01-26	广发信德投资管理有限公司	I0011589
19	中叶善水	SZZ924	2023-05-31	上海中叶创业投资管理有限公司	P1074035
20	天问磐盈	STD260	2021-11-23	天问时代私募基金管理（海南）有限公司	P1072396
21	丽水奋智	SVZ464	2022-07-27	北京浙商华盈创业投资管理有限公司	P1071256

序号	股东名称	基金编号	备案时间	管理人名称	基金管理人 登记编号
22	长三角嘉善	SQH841	2021-05-13	上海自贸区股权投资基金管理有限公司	P1012846
23	中叶至源	SJL465	2019-12-20	上海中叶创业投资管理有限公司	P1074035
24	瑞芯晶飞	SVW527	2022-06-27	北京瑞芯私募基金管理有限公司	P1072501
25	鸿溢盛朗	SB4066	2023-07-11	上海襄聚私募基金管理有限公司	P1069965
26	湖畔小竹	SAEG51	2023-12-14	杭州湖畔宏盛投资管理有限公司	P1069542

除上述机构股东外，发行人其他机构股东不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行基金管理人登记、基金备案程序。

（七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例

截至本招股说明书签署日，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系及关联股东如下：

序号	股东名称	直接持股 数量 (万股)	直接持股 比例	关联关系
1	徐振	959.15	22.35%	徐振持有杭州汇芯 78.73%出资额并担任执行事务合伙人；徐振持有杭州朗新 65.00%出资额并担任执行事务合伙人；徐振持有杭州聚芯 0.04%出资额并担任执行事务合伙人。 徐振、黄庆红、章小婵、何涛、寿佳琪系一致行动人，基于相关协议形成一致行动关系。
	杭州汇芯	355.32	8.28%	
	杭州朗新	290.21	6.76%	
	杭州聚芯	201.35	4.69%	
	小计	1,806.03	42.08%	
	黄庆红	176.18	4.10%	
	章小婵	-	-	
	何涛	-	-	
	寿佳琪	-	-	
	合计	1,982.21	46.18%	

序号	股东名称	直接持股数量 (万股)	直接持股比例	关联关系
2	赋实投资	168.27	3.92%	赋实投资、视谷创投的私募基金管理人均为杭实资产管理（杭州）有限公司，实际控制人均为杭州市实业投资集团有限公司。
	视谷创投	109.49	2.55%	
	合计	277.76	6.47%	
3	宁波工投	109.49	2.55%	宁波通商的基金管理人为宁波通商基金管理有限公司，宁波通商基金管理有限公司、宁波工投、和丰创投均系宁波通商控股集团有限公司控制的企业。
	和丰创投	84.89	1.98%	
	宁波通商	47.02	1.10%	
	合计	241.40	5.62%	
4	鸿溢盛新	166.23	3.87%	鸿溢盛新和鸿溢盛朗的执行事务合伙人及私募基金管理人均为显盛（上海）投资管理有限公司。
	鸿溢盛朗	23.51	0.55%	
	合计	189.74	4.42%	
5	毅达工投	45.71	1.07%	毅达工投、紫金文化、产才融合的执行事务合伙人和私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。
	紫金文化	45.71	1.07%	
	产才融合	36.57	0.85%	
	合计	127.99	2.99%	
6	广发乾和	91.43	2.13%	广发乾和与珠海格金的基金管理人、执行事务合伙人广发信德均为广发证券股份有限公司的全资子公司。
	珠海格金	35.27	0.82%	
	合计	126.70	2.95%	
7	海通创新	58.77	1.37%	吉六零基金的基金管理人为海富产业投资基金管理有限公司，海富产业投资基金管理有限公司和海通创新均系国泰海通证券股份有限公司控制的企业，桦昀投资为吉六零基金管理人海富产业投资基金管理有限公司投资管理团队的跟投平台。
	吉六零基金	58.77	1.37%	
	桦昀投资	0.29	0.01%	
	合计	117.84	2.75%	
8	张伟杰	75.03	1.75%	张伟杰系天问时代的控股股东及实际控制人，天问时代系天问磐盈的基金管理人。
	天问磐盈	31.33	0.73%	
	合计	106.36	2.48%	
9	杭州高新创投	74.09	1.73%	杭州集成电路基地的控股股东杭州高新科创集团有限公司与杭州高新创投均系杭州高新金投控股集团有限公司的全资子公司。
	杭州集成电路基地	20.78	0.48%	
	合计	94.87	2.21%	
10	湖畔小园	67.79	1.58%	湖畔小园、湖畔小竹的执行事务合伙人

序号	股东名称	直接持股数量 (万股)	直接持股比例	关联关系
	湖畔小竹	21.90	0.51%	及私募基金管理人均为杭州湖畔宏盛投资管理有限公司。
	合计	89.69	2.09%	
11	无锡鼎晖弘嘉	36.25	0.84%	无锡鼎晖弘嘉、成都鼎晖盈嘉的执行事务合伙人均为无锡鼎晖华祥股权投资有限公司，基金管理人均为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司。
	成都鼎晖盈嘉	36.25	0.84%	
	合计	72.50	1.68%	
12	中叶善水	32.33	0.75%	中叶善水、中叶至源的执行事务合伙人和私募基金管理人均为上海中叶创业投资管理有限公司。
	中叶至源	26.45	0.62%	
	合计	58.78	1.37%	

注：章小婵通过杭州聚芯间接持有发行人 2.27%的股份、何涛和寿佳琪通过杭州汇芯分别间接持有发行人 0.11%、0.11%的股份。

截至报告期末，除上述情形外，本次发行前直接持有公司股份的其他股东之间不存在其他关联关系、一致行动关系。

（八）本次发行前涉及的股东特殊权利及其解除情况

1、公司及其控股股东、实际控制人的股东特殊权利约定情况

公司在朗迅有限设立后的多轮融资和股权转让中，与相关投资者签订了《增资协议》《股权转让协议》等融资交易文件（以下简称“历史交易文件”），相关历史交易文件中曾约定多项股东特殊权利。2024 年 12 月，公司与其当时的全部股东及赋实投资、视谷创投、工融创新、宁波工投、湖畔小竹签署《增资协议（2024 年 12 月）》，以取代历轮融资过程中的其他历史交易文件，对相关股东所享有的股权回购、拖售权、公司创始股东股权转让限制、股东股权转让限制、优先认缴权、优先购买权和随售权、优先清算权、反摊薄权、优先投资权等股东特殊权利进行统一约定。

2025 年 3 月，徐振与宁波通商签署《股权转让协议（2025 年 3 月）》，对回购权、优先购买权和随售权等股东特殊权利进行约定。2025 年 6 月，徐振与财通创新签署《股份转让协议（2025 年 6 月）》，对股份回购、优先购买权和随售权、优先认缴权、优先投资权、优先清算权等股东特殊权利进行约定。

2、公司及其控股股东、实际控制人的股东特殊权利解除情况

2026 年 5 月 21 日，公司与已签署《增资协议（2024 年 12 月）》相关的股东及宁波通商、财通创新等各方签署了《关于杭州朗迅科技股份有限公司投资协议之补充协议》（以下简称“《投资协议之补充协议》”），各相关方约定如下：就签署《增资协议（2024 年 12 月）》相关的全部投资人股东所享有的股东特殊权利，包括但不限于股权回购、拖售权、公司创始股东股权转让限制、股东股权转让限制、优先认缴权、优先购买权和随售权、优先清算权、反摊薄权、优先投资权等；就宁波通商在《股份转让协议（2025 年 3 月）》中享有的股东特殊权利，包括但不限于回购权、优先购买权和随售权；就财通创新在《股份转让协议（2025 年 6 月）》中享有的股东特殊权利，包括但不限于股份回购、优先购买权和随售权、优先认缴权、优先投资权、优先清算权，对涉及公司作为股东特殊权利义务人的于《投资协议之补充协议》签署之日起不可撤销、不可恢复地终止且应视为自始无效，对涉及公司控股股东、实际控制人作为股东特殊权利义务人的于发行人合格 IPO 申请并获得受理前一日起不可撤销、不可恢复地终止且应视为自始无效。上述权利终止后，在任何情形下，股东特殊权利享有方不会基于投资协议的相关条款向公司及其控股股东、实际控制人主张任何权利。

综上所述，公司在历史交易文件中与投资人股东约定的股东特殊权利已基于各方签署的《投资协议之补充协议》不可撤销、不可恢复地终止且应视为自始无效，相关对赌解除协议签订日在财务报告出具日之前。截至公司向深交所提交上市申请文件之日，公司未作为对赌协议的当事人，不存在可能导致公司控制权变化的约定，未与公司市值挂钩，亦不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的相关要求。

（九）公司股东公开发售股份的情况

发行人本次发行均为新股，本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

1、董事

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，3 名为独立董事，基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的董事职务	提名人	本届任职期间
1	徐振	董事长	董事会	2025.10-2028.10
2	黄庆红	董事	董事会	2025.10-2028.10
3	何涛	董事	董事会	2025.10-2028.10
4	章小婵	董事	董事会	2025.10-2028.10
5	果桐	董事	董事会	2025.10-2028.10
6	寿佳琪	职工代表董事	职工代表大会	2025.10-2028.10
7	陆宁	独立董事	董事会	2025.10-2028.10
8	钱程	独立董事	董事会	2025.10-2028.10
9	张开元	独立董事	董事会	2025.10-2028.10

公司董事任期 3 年，任期届满后可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。本届董事任期至 2028 年 10 月。

公司现任董事简历如下：

徐振先生，董事长、总经理，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，在读博士。2004 年 9 月起在浙江机电职业技术学院任教；2010 年 5 月投资设立朗迅有限，并于 2019 年 11 月起全职在朗迅有限任职；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，担任杭州品矽科技有限公司监事。徐振先生于 2012 年 3 月至 2022 年 10 月期间，历任朗迅有限监事、董事长、总经理；2022 年 10 月至今，任朗迅科技董事长、总经理。

黄庆红女士，董事、副总经理，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2009 年 12 月，于杭州实达信息技术有限公司、杭州朗新信息系统有限公司、北京朗新信息系统有限公司、朗新科技

（中国）有限公司等公司任职；2010年1月至2015年8月，自由职业；2015年8月至2016年7月，于北京西普阳光科技股份有限公司任职；2016年7月至2017年9月，于广州佰聆数据股份有限公司任职；2017年12月至2022年10月，历任朗迅有限董事、副总经理；2022年10月至今，历任朗迅科技董事、副总经理。

何涛先生，董事，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2015年3月，任杭州整形医院有限公司人事主管；2015年4月至2018年1月，任邦尔骨科医院集团股份有限公司人力资源总监；2018年2月至2020年9月，任浙江慈继医院管理有限公司人力资源总监；2020年10月至2021年3月，任杭州安圣阁档案管理有限公司人力资源总监；2021年3月至2022年10月，任朗迅有限首席人力资源官；2022年10月至2025年3月，任朗迅科技监事会主席、首席人力资源官；2025年3月至今，任朗迅科技董事、首席人力资源官。

章小婵女士，董事，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月至1993年9月，任杭州市西湖区石灰桥幼儿园教师；1993年10月至1998年4月，于杭州胜利电子器材公司工作；1998年4月至2000年12月，于杭州胜利电子有限公司工作；2001年1月至今，历任杭州理想电子有限公司员工、监事，期间先后在杭州良田电子科技有限公司历任执行董事兼总经理、监事，在杭州诗婭文化创意有限公司历任执行董事兼总经理、监事；2021年6月至2022年10月，任朗迅有限董事；2022年10月至今，担任朗迅科技董事。

果桐先生，董事，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年7月至2016年11月，任招商银行股份有限公司信贷主管；2016年12月至2018年9月，任浙银俊诚（杭州）资产管理有限公司投资总监；2018年10月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司合伙人；2022年6月至2022年10月，任朗迅有限董事；2022年10月至今，任朗迅科技董事。

寿佳琪女士，职工代表董事，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年2月，任浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司人事主管；2016年3月至2018年3月，任杭州国瀚金融控股集团有限公司人事主管；2018年4月至2022年10月，任朗迅有限人事部长；2022

年 10 月至今，任朗迅科技人事部长；2025 年 3 月至 2025 年 10 月，任朗迅科技监事会主席、人事部长；2025 年 10 月至今任朗迅科技职工代表董事、人事部长。

陆宁先生，独立董事，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985 年 8 月至 1988 年 6 月，就读于清华大学，获得硕士学位；1988 年 6 月至 2000 年 12 月，历任中国华晶电子集团公司及其前身 908 工程主管、办公室主任、总厂厂长、总经理助理；2001 年 1 月至 2006 年 6 月，历任华越微电子有限公司副董事长、总经理、党委书记，期间先后在浙江华越芯装电子股份有限公司、绍兴芯谷科技有限公司兼职任职；2006 年 6 月至 2007 年 4 月，任上海贝岭股份有限公司投资副总裁；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任日银 IMP 微电子有限公司总经理；2008 年 4 月至 2022 年 12 月，历任上海贝岭股份有限公司副总经理、党委书记、纪委书记，期间先后在上海贝岭微电子制造有限公司、苏州同冠微电子有限公司、上海先进半导体制造有限公司、上海集成电路研发中心有限公司、上海岭芯微电子有限公司、华大半导体有限公司兼职任职；2025 年 6 月至今，任上海晶沛电子材料有限公司董事长、经理；2025 年 10 月至今，任朗迅科技独立董事。

钱程先生，独立董事，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任金华金辰会计师事务所有限责任公司职员；2002 年 7 月至 2004 年 9 月，任金华市恒发工具厂副总经理；2004 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于浙江工商大学，获得硕士学位；2006 年 9 月至 2018 年 6 月，历任浙江金融职业学院讲师、副教授；2011 年 9 月至 2017 年 3 月，就读于浙江工商大学，获得博士学位；2014 年 1 月至 2017 年 1 月，任杭州资信评估有限公司总经理助理；2018 年 6 月至今，任浙江大学城市学院教授、研究院副院长；2023 年 9 月至今，任朗迅科技独立董事。

张开元先生，独立董事，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 6 月至 2015 年 4 月，任华融证券股份有限公司项目经理；2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任中信建投证券股份有限公司高级经理；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任浙江恒逸集团有限公司资本市场总监；2019 年 12 月至 2023 年 10 月，任宁波璟仁投资有限公司经理；2020 年 10 月至今，任恒逸石化

股份有限公司董事会办公室主任；2023年9月至今，任朗迅科技独立董事。

2、监事

2025年10月，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司共有高级管理人员4名，基本情况如下：

姓名	职位
徐振	董事长、总经理
黄庆红	董事、副总经理
夏丽君	董事会秘书、副总经理
刘思霖	财务总监

徐振、黄庆红简历参见本节之“十二/（一）/1、董事”。

夏丽君女士，董事会秘书、副总经理，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2011年9月，任华立仪表集团股份有限公司财务人员；2011年9月至2014年3月，任弗德里希冷冻设备（杭州）有限公司财务经理；2014年3月至2015年9月，任南方泵业股份有限公司财务部长；2015年9月至2018年3月，任杭州至卓通讯科技有限公司财务总监；2018年3月至2023年8月，历任浙江星华新材料集团股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总经理；2023年8月至今，任朗迅科技董事会秘书、副总经理。

刘思霖先生，财务总监，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理；2013年12月至2018年7月，任招商证券股份有限公司高级经理；2018年7月至2021年7月，历任心有灵犀科技股份有限公司董事会秘书、董事；2021年7月至2022年10月，任朗迅有限财务总监；2022年10月至今，任朗迅科技财务总监。

4、其他核心人员

截至本招股说明书签署日，公司其他核心人员共有核心技术人员 2 名，基本情况如下：

姓名	职位
徐振	核心技术人员
丁盛峰	核心技术人员

徐振简历参见本节之“十二/（一）/1、董事”。徐振作为主要起草人之一制定了国家标准《半导体晶片直径测试方法》（GB/T 14140-2025），入选了第九批国家高层次人才特殊支持计划“创新创业领军人才”，并被评为 2026 年度浙江省科技型企业企业家。

丁盛峰先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2020 年 6 月，任职于杭州士兰微电子股份有限公司；2020 年 7 月至今，任公司研发中心经理。丁盛峰作为主要起草人之一制定了国家标准《半导体晶片直径测试方法》（GB/T 14140-2025）。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员及其他核心人员在除朗迅科技及其子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
徐振	董事长、总经理	杭州聚芯	执行事务合伙人	关联方
		杭州汇芯	执行事务合伙人	关联方
		杭州朗新	执行事务合伙人	关联方
章小婵	董事	杭州智远针织制衣有限公司	监事	关联方
		杭州良田电子科技有限公司	监事	关联方
		杭州理想电子有限公司	监事	关联方
		杭州诗嫫文化创意有限公司	监事	关联方

姓名	本公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
		杭州聚和致盛文化有限公司	董事	关联方
果桐	董事	宁波云德半导体材料有限公司	董事	关联方
		杭州超熔科技有限公司	董事	关联方
		江苏毅达股权投资基金管理有限公司	合伙人	非关联方
陆宁	独立董事	上海晶沛电子材料有限公司	董事长、经理	关联方
钱程	独立董事	杭州路网科技信息有限公司	独立董事	非关联方
		浙江大学城市学院数字金融研究院	副院长	非关联方
张开元	独立董事	恒逸石化股份有限公司	董事会办公室主任	非关联方

除上述人员外，公司的其他董事、高级管理人员及其他核心人员无在外兼职的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的合规性

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员及其他核心人员最近三年未涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查等情形。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的要求，与前述在公司专职工作的董事、高级管理人员和其他核心人员签订了《劳动合同》《保密协议》，对上述人员的忠诚义务和勤勉义务作了相关约定，明确了双方之间的权利和义务。

除此之外，公司与董事、高级管理人员和其他核心人员之间不存在其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议安排。

（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况

1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员及其他核心人员直接或间接持有公司股权的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股比例	间接持股主体	间接持股比例	合计持股比例
1	徐振	董事长、总经理	22.35%	杭州汇芯	6.52%	33.26%
				杭州朗新	4.39%	
				杭州聚芯	0.002%	
2	黄庆红	董事、副总经理	4.10%	-	-	4.10%
3	章小婵	董事	-	杭州聚芯	2.27%	2.27%
4	何涛	董事	-	杭州汇芯	0.11%	0.11%
5	寿佳琪	职工代表董事	-	杭州汇芯	0.11%	0.11%
6	刘思霖	财务总监	-	杭州汇芯	0.28%	0.28%
7	丁盛峰	其他核心人员	-	杭州汇芯	0.11%	0.11%

2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情形。

（七）近三年内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况

1、董事变动情况

报告期内，公司董事变动情况如下：

期间	董事会成员	变动原因
报告期初至2023年9月	徐振、黄庆红、徐守政、章小婵、张伟杰、黄治文、果桐	-
2023年9月-2025年3月	徐振、黄庆红、徐守政、章小婵、张伟杰、果桐、吴越、钱程、张开元	原董事黄治文因个人原因辞去董事职务；新增独立董事吴越、钱程、张开元
2025年3月-2025年10月	徐振、黄庆红、何涛、章小婵、张伟杰、果桐、吴越、钱程、张开元	原董事徐守政因个人原因辞去董事职务，新增董事何涛

期间	董事会成员	变动原因
2025 年 10 月 至今	徐振、黄庆红、何涛、章小婵、 果桐、钱程、张开元、陆宁、寿 佳琪	董事会换届，原董事张伟杰、独 立董事吴越不再担任原职务；新 增职工代表董事寿佳琪、独立董 事陆宁

2、原监事变动情况

报告期内，公司取消监事会前监事变动情况如下：

时间	监事会成员	变动原因
报告期初至 2023 年 6 月	何涛、丁勇、汪明珠	-
2023 年 6 月- 2025 年 3 月	何涛、丁勇、夏明	汪明珠因个人原因辞去监事职务；新 增监事夏明
2025 年 3 月- 2025 年 10 月	丁勇、夏明、寿佳琪	何涛拟担任公司董事，辞去监事职 务；新增监事寿佳琪
2025 年 10 月 至今	无	适配新《公司法》要求，取消监事会

3、高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：

时间	高级管理人员	变动原因
报告期初至 2023 年 8 月	总经理：徐振 财务总监：刘思霖	-
2023 年 8 月 至今	总经理：徐振 副总经理：黄庆红、夏丽君 董事会秘书：夏丽君 财务总监：刘思霖	根据公司经营发展需要，新增副总 经理黄庆红、夏丽君；新增董事会 秘书夏丽君

4、其他核心人员变动情况

报告期内，公司其他核心人员为核心技术人员，始终为徐振、丁盛峰，未发生变动。

5、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动对公司生产经营的影响

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员存在一定的变动，主要系部分董事、监事因个人原因离任、选举独立董事、董事会换届和适配法规规定变动等因素所致。公司核心经营管理人员保持稳定，不影响公司经营决策的连续性和一贯性。上述人员变化均履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的经营管理构成重大不利影响，

发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年未发生重大不利变化。

（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员及其他核心人员除持有公司股份外，其他对外投资情况如下：

单位：万元

姓名	公司职务	被投资公司	出资额	持股比例
徐振	董事长、总经理	杭州聚芯	1.00	0.04%
		杭州汇芯	1,180.94	78.73%
		杭州朗新	104.00	65.00%
		金华市新城印刷厂	10.00	100.00%
何涛	董事	杭州汇芯	20.00	1.33%
章小婵	董事	杭州聚芯	1,160.00	48.31%
		杭州智远针织制衣有限公司	300.00	60.00%
		杭州鲸乾投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	7.08%
		时空电动汽车股份有限公司	182.07	0.18%
		杭州良田电子科技有限公司	300.00	60.00%
		杭州理想电子有限公司	120.00	40.00%
		杭州龙渊慧莉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	7.69%
		杭州诗姆文化创意有限公司	49.00	49.00%
		杭州利和临卓天使创业投资合伙企业（有限合伙）	200.00	2.00%
		杭州聚和致盛文化有限公司	51.00	51.00%
		杭州硬脑创意科技有限公司	5.00	10.00%
		杭州谦贞数字科技有限公司	10.20	5.43%
果桐	董事	南京毅达工投汇员股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	15.87%
		南京毅达同盛企业管理咨询中心（有限合伙）	6.60	10.00%
		南京毅达汇员鼎祺创业投资合伙企业（有限合伙）	50.00	2.50%

姓名	公司职务	被投资公司	出资额	持股比例
		南京毅达汇员中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）	50.00	0.63%
陆宁	独立董事	浙江华越芯装电子股份有限公司	40.00	1.00%
张开元	独立董事	杭州蔚复来智造企业管理合伙企业（有限合伙）	499.00	99.80%
		宁波梅山保税港区汇仁文曲投资合伙企业（有限合伙）	400.00	9.13%
		杭州藕舫翠柏创业投资合伙企业（有限合伙）	100.00	2.29%
		江西博源税务师事务所有限公司	29.85	99.50%
寿佳琪	职工代表董事	杭州汇芯	20.00	1.33%
刘思霖	财务总监	杭州汇芯	50.00	3.33%
丁盛峰	其他核心人员	杭州汇芯	20.00	1.33%

截至本招股说明书签署日，除以上情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未有其他对外投资情况。上述对外投资未与公司及其业务产生利益冲突。

（九）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及履行的程序

公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司章程》及法律法规，负责审核公司董事及高级管理人员的整体薪酬方案。

公司内部董事、取消监事会前的在任监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资及奖金组成，按照相关法律法规规定、公司薪酬政策并结合公司业绩及其在公司内部任职的工作表现，经综合考评后确定。独立董事领取独立董事津贴，津贴由公司参照资本市场中独立董事津贴的一般水平予以确定。

报告期内，公司董事（含董事会审计委员会成员）、监事（取消监事会前）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况已经薪酬与考核委员会、董事会、股东会履行了相应的审议程序。

2、报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事（取消监事会前）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额（不含股份支付）及其占公司利润总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	940.61	768.97	568.93
利润总额	69,903.89	22,748.62	11,181.02
占比	1.35%	3.38%	5.09%

注：关键管理人员薪酬主要包括工资、社保、公积金等，不含股份支付金额，并根据关键管理人员任职、卸任当年的全年薪酬汇总统计。

3、最近一年从发行人及关联企业领取薪酬情况

报告期内，未与公司签订劳动合同的董事、监事不在公司领取薪酬，独立董事在本公司仅领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

本公司现任董事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在发行人及其关联企业领取薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬
1	徐振	董事长、总经理	353.39
2	黄庆红	董事、副总经理	113.59
3	何涛	董事	88.31
4	章小婵	董事	-
5	果桐	董事	-
6	寿佳琪	职工代表董事	40.58
7	陆宁	独立董事	3.00
8	钱程	独立董事	12.00
9	张开元	独立董事	12.00
10	夏丽君	董事会秘书、副总经理	122.82
11	刘思霖	财务总监	78.31
12	丁盛峰	其他核心人员	59.18

报告期内，除上述薪酬情况外，公司董事、高级管理人员与其他核心人员未在公司享受其他待遇或退休金计划。

十三、公司股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况

（一）申报前已实施的股权激励

1、员工持股平台的基本情况

为进一步完善治理结构，增强公司凝聚力，建立长效激励机制，充分调动员工积极性，公司于报告期前通过员工持股平台杭州汇芯对骨干员工进行了股权激励。截至本招股说明书签署日，杭州汇芯持有公司 8.28%股份，具体情况如下：

公司控股股东、实际控制人徐振持有杭州汇芯 78.73%的出资额并担任执行事务合伙人。截至本招股说明书签署日，杭州汇芯的基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七/（三）持有公司 5%以上股份或表决权的其他主要股东”相关内容，公司员工持股平台激励对象均为公司在职员工。

2、锁定期

员工持股的锁定期以员工持股平台杭州汇芯在本次首次公开发行中出具的承诺函以及相关法律法规的要求为准。具体承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五/（一）本次发行前股东所持股份限制流通、自愿锁定及减持意向的承诺”相关内容。

3、对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响情况

公司的股权激励有助于调动员工的积极性和创造性，形成利益共享、风险共担的科学管理体系，有助于优化公司的经营状况、促进公司的良性发展。公司按照股份支付费用总额、股份支付确认日期及股份支付服务期限的最佳估计，计算确认股份支付费用，报告期内各期确认的股份支付费用分别为 128.60 万元、128.60 万元和 128.60 万元。股权激励未对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面产生不利影响。

（二）申报前已制定的股权激励计划

1、股票期权激励计划的审议和实施情况

2025 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于<杭州朗迅科技股份有限公司股票期权激励计划>的议案》。2025

年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，同意实施股票期权激励计划。2025 年 6 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东会，同意实施股票期权激励计划。

2、本次期权激励计划的基本内容

（1）激励对象

本次期权激励计划的对象（剔除已放弃人员）共 19 人，为公司核心业务人员，不包括独立董事、监事。

（2）激励工具及授予数量

期权激励计划拟授予激励对象股票期权，涉及的标的股票来源为发行人上市后向激励对象定向发行的股票。

期权激励计划拟授予激励对象 64.3824 万份的股票期权，约占期权激励计划经公司股东会审议时公司总股本的 1.50%。发行人全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量占本次发行上市前总股本的比例未超过 15%，且未设置预留权益。

（3）行权价格

根据《杭州朗迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，本激励计划授予的股票期权的行权价格为 41.94 元/股，不低于最近一年（2024 年度）经审计的每股净资产，系综合考虑公司经营财务情况、发挥激励作用、增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展等因素，由董事会、股东会审议确定。

（4）有效期及等待期

本激励计划的有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 10 年。

本激励计划授予的等待期指股票期权授予日至股票期权各可行权日，其中第一个可行权日为以下两个日期的孰晚者：（1）自授予日起 24 个月后的首个交易日；（2）公司股票上市之日。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得行权。

（5）行权条件

1) 公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。

2) 激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1) 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第 2) 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予股票期权各年度公司层面的业绩考核指标为：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	上一年度经审计的扣非净利润不低于 2024 年经审计的扣非净利润*1.5 或上一年度经审计的营业收入不低于 2024 年经审计的营业收入*1.5
第二个行权期	上一年度经审计的扣非净利润不低于 2024 年经审计的扣非净利润*1.6 或上一年度经审计的营业收入不低于 2024 年经审计的营业收入*1.6
第三个行权期	上一年度经审计的扣非净利润不低于 2024 年经审计的扣非净利润*1.7 或上一年度经审计的营业收入不低于 2024 年经审计的营业收入*1.7

公司未满足上述业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当期可行权的股票期权均不得行权，对应的股票期权由公司注销。

4) 个人层面绩效考核要求

公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其可行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对

象个人当期实际行权额度=个人层面标准系数×个人当期计划行权额度。

个人层面标准系数由对应年度的《年度绩效考核表》规定的绩效表现考评得出。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
标准系数	100%	80%	60%	0%

若激励对象考核年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则该激励对象可按照本计划规定的比例分期行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象考核年度个人绩效考核评级为不合格，则取消该激励对象当期可行权部分，由公司注销，不得行权或递延至下期行权。

（5）行权安排

等待期满后分三批行权，每批可行权比例分别为授予股票期权总量的 40%、30%和 30%。本次激励计划具体行权安排如下：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	第一个可行权日起至第一个可行权日起 12 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	第二个可行权日（即第一个行权期届满后的首个交易日）起至第二个可行权日起 12 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	第三个可行权日（即第二个行权期届满后的首个交易日）起至第三个可行权日起 12 个月内的最后一个交易日当日止	30%

（6）锁定期

激励对象在公司上市后行权认购的股票，承诺自行权日起三十六个月内不减持。上述禁售期限届满后，激励对象减持按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定执行。

3、对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响情况

公司的股权激励有助于调动员工的积极性和创造性，形成利益共享、风险共担的科学管理体系，有助于优化公司的经营状况、促进公司的良性发展，股

权激励未对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面产生不利影响。公司本次激励计划的相关股份支付费用将在对应的等待期内分期确认，从而对净利润产生一定影响。

4、本激励计划涉及股份支付费用的会计处理

公司对报告期内换取员工服务的以权益结算的股份支付，以授予权益工具在授予日的公允价值计量股份支付费用，在等待期内每个资产负债表日对可行权权益工具数量作出最佳估计，计入相关成本或费用，相应增加资本公积。公司股份支付费用的具体会计处理政策参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四/（十四）股份支付”。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及相关规定：对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确认其公允价值。由于朗迅科技授予的股票期权属于没有活跃市场的权益工具，故发行人股票期权的公允价值选取“Black-Scholes”模型期权定价模型计算确定。

北京中企华资产评估有限责任公司以 2025 年 6 月 26 日为评估基准日，对股票期权激励计划所涉及的股票期权进行评估，并出具了评估咨询报告（浙中企华咨字（2025）第 0151 号），本次评估采用“Black-Scholes”定价模型，股票期权激励计划所涉及的股票期权价值评估值为 2,945.45 万元（1 名拟激励员工未签署《股票期权协议书》并于 2026 年初离职，该评估值未扣除上述拟激励对象拟授予股票数量）。报告期内，公司于 2025 年度因该股权激励计划确认的股份支付金额为 431.04 万元。

综上所述，公司股份支付费用计算过程及会计处理准确，符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》《监管规则适用指引——发行类第 5 号》的相关规定。

十四、发行人员工及其社会保障情况

（一）发行人员工情况

1、员工人数及变化情况

2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司在职员工总数分别为 1,015 人、

2,018 人和 2,949 人。

2、员工专业结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的专业结构如下：

专业构成	人数（人）	占员工总数比例
生产人员	2,181	73.96%
销售人员	42	1.42%
管理人员	171	5.80%
研发人员	555	18.82%
合计	2,949	100.00%

3、员工学历结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的学历结构如下：

学历构成	人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	33	1.12%
本科及大专	2,030	68.84%
高中及以下	886	30.04%
合计	2,949	100.00%

4、员工年龄结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的年龄结构如下：

年龄构成	人数（人）	占员工总数比例
50 岁以上	15	0.51%
41-50 岁	77	2.61%
31-40 岁	812	27.53%
30 岁及以下	2,045	69.35%
合计	2,949	100.00%

（二）员工社会保险和住房公积金缴纳情况

1、社会保险和住房公积金缴纳情况

报告期内，公司及其境内子公司根据国家及所在地地方政府的有关规定，

为员工办理了基本养老保险、基本医疗保险等社会保险，并按国家有关政策建立了住房公积金制度。公司鼓励员工缴纳社会保险和住房公积金，积极为其办理缴纳手续并履行缴纳义务。

报告期各期末，公司及其境内子公司为员工缴纳的各项社会保险和住房公积金的情况统计如下：

单位：人

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	已缴纳	比例	已缴纳	比例	已缴纳	比例
员工总数	2,949	-	2,018	-	1,015	-
社会保险	2,854	96.78%	1,973	97.77%	985	97.04%
住房公积金	2,854	96.78%	1,958	97.03%	980	96.55%

报告期内，公司境外子公司新加坡芯云纵横未实际开展经营活动，无在职员工。公司及其子公司少数员工未缴纳社会保险和住房公积金的主要原因如下：

（1）部分人员已达到法定退休年龄，无需再缴纳社会保险及住房公积金；（2）部分新入职员工因社会保险及住房公积金缴纳手续尚在办理中导致未能在当月缴纳；（3）极少数员工因个人原因自愿不缴纳住房公积金等。

2、公司取得合法合规证明情况

公司及其子公司已取得主管部门出具的《信用报告》，报告期内公司及其子公司在人力资源社会保障领域不存在违法违规情形。根据《新加坡法律意见书》，公司新加坡子公司未受到任何行政处罚，也无任何官方或监管机构的调查或法律纠纷。

（三）劳务派遣情况

2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司的劳务派遣情况如下：

单位：人

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
劳务派遣人数	123	142	17
公司员工人数	2,949	2,018	1,015
用工总量	3,072	2,160	1,032

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
劳务派遣人数占用工总量比例	4.00%	6.57%	1.65%

报告期各期末，劳务派遣人员占公司用工总量的比例均未超过 10%，符合《劳务派遣暂行规定》的规定，且该等劳务派遣人员的主要工种为临时性、辅助性或可替代性强的工作，符合《中华人民共和国劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》等法律法规的相关规定。

（四）劳务外包情况

报告期内，公司存在使用劳务外包作为辅助性补充用工形式的情况，用工岗位主要为少量辅助性或可替代性强的岗位。公司与劳务外包公司均签署了劳务外包合同，相关条款不存在违反法律、行政法规等强制性规定的情况。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）发行人的主营业务、主要产品或服务

1、主营业务基本情况

公司是最大的内资第三方集成电路测试企业，专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。公司凭借优秀的自主研发能力和强大的产业化落地能力，顺应先进工艺和先进封装的行业趋势，持续助力高端芯片测试的国产化替代，为客户提供包括晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、老化测试（BI）、系统级测试（SLT）、工程测试服务等在内的一站式芯片测试解决方案。公司测试的芯片产品包括算力芯片、高性能 SoC 芯片、光学芯片、车载芯片、射频芯片、传感器芯片等多种芯片类型，下游应用聚焦高端算力、消费电子、车载智控、通讯及工控等重要领域，同时还覆盖导航通信、智能家居、穿戴设备等多个重要场景。

集成电路的主要制造环节包括设计、晶圆制造、封装及测试。集成电路测试是集成电路制造中必不可少的环节，能够剔除芯片不良品并进行性能分级，同时进一步提升芯片良率、控制制造成本以及指导工艺改进等。集成电路测试主要包括芯片封装前的晶圆测试（CP）、封装后的成品测试（FT）；近年来随着工艺和制程的发展，成品芯片测试（FT）过程中，接近真实应用环境下的系统级测试（SLT）以及加速老化环境下的老化测试（BI）的业务需求日益强烈，在成品测试（FT）过程中发挥着愈加重要的作用。此外，芯片新产品或新工艺量产前，通常会通过小批量方式进行工程测试，作为量产测试的前置程序，用以验证、导入和迭代产品测试程序及方案，分析和反馈数据结果，同时也可以协助集成电路制造链条上的各个环节对产品及工艺进行诊断定位与改进修正。随着国产高端芯片近年来追赶国际先进的脚步持续加快，高端芯片产品持续推出，产品性能持续改进，公司工程测试服务业务快速增长。

图：集成电路制造的主要环节



注：朗迅科技参与环节以蓝色标注

公司深耕第三方集成电路测试业务，深度参与集成电路国产化和自主可控的历史进程，在时代浪潮中实现了长足发展。随着集成电路产业国产化进程的快速推进，公司不仅是最大的内资第三方集成电路测试企业，也是 2023 至 2025 年度内资第三方集成电路测试领域前五名中增长最快的企业，三年主营业务复合增长率超过 100%。基于在国产化测试工艺、软件系统及国产化测试设备资源等方面的积累和储备，公司已成为国产集成电路产业应对潜在国际政治经济及贸易风险扰动的重要战略选择。

公司自设立以来持续进行研发创新投入，掌握了高端芯片测试的自主核心技术，具备基于国产化平台的全流程测试能力。截至 2025 年末，公司已拥有境内授权专利 100 项，其中发明专利 42 项；拥有软件著作权 203 项，技术积累雄厚。公司荣获国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业称号，设立了省级博士后工作站，并被评为浙江省首批制造业单项冠军企业，朗迅科技、子公司杭州芯云亦荣获浙江省科学技术进步二等奖。

报告期内，公司持续专注于第三方集成电路测试服务业务，主营业务未发生重大变化。

2、主要服务或产品的基本情况

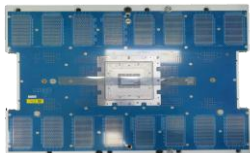
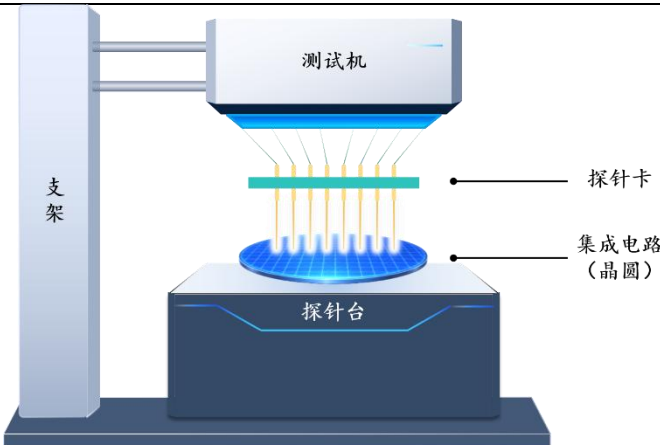
公司主要提供第三方集成电路测试服务，主要包括晶圆测试、成品测试等。相关测试能够在芯片制造过程中促进芯片良率的提升和成本的降低，同时提供有效的测试数据，持续改善和改进芯片工艺和性能，尤其是国产芯片产业化初期的设计与制造。

公司主要提供集成电路测试服务，具体如下：

（1）晶圆测试

晶圆测试（Chip Probing，CP）是指在晶圆流片后、封装前对整片晶圆上的裸芯片（Die）进行电学性能与功能验证的环节，能够剔除无效芯片、评估工艺

良率并进行测试性能分级。测试过程中，尚未切割及封装的晶圆固定在探针台的托盘上，测试机通过探针卡与晶圆上的芯片建立电学连接，通过信号输入和输出值读取，分析芯片良率并形成测试结果，是连接芯片制造和封装的核心质检环节。

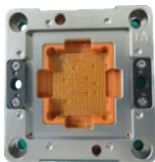
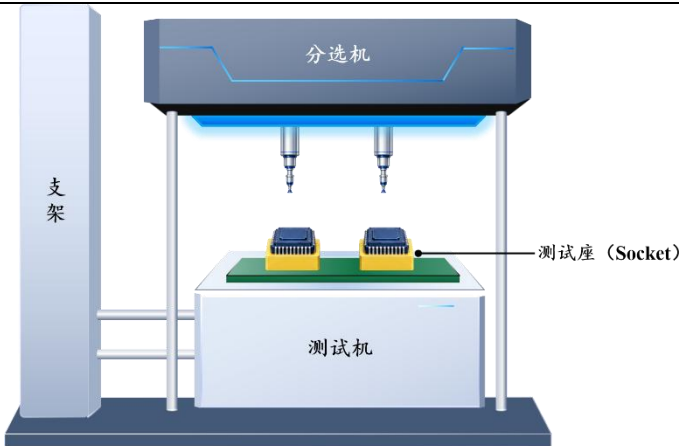
晶圆测试（CP）		
主要测试环节	服务产品类型	
电性及功能测试（高温、常温、低温）等	测试的晶圆尺寸覆盖 12 英寸、8 英寸	
主要测试设备及治具		
测试机	探针台	探针卡
		
测试示意图		
		

（2）成品测试

成品测试（Final Test，FT）是指在芯片完成封装后、出厂交付前进行的性能与可靠性验证环节，能够确认封装的有效性、验证实际工作环境下的性能并保障终端应用安全。测试过程中，芯片通过分选机被传递至测试工位并与测试机相连接，在多种测试环境下，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，经过数据分析，进行成品芯片筛选、性能分级和不良品剔除。

同时，随着芯片制程及封装复杂程度的持续演进，以及高端芯片的高可靠

性要求，仅在成品测试环节进行单一的电性及功能测试难以模拟复杂应用场景，亦难以剔除可能存在早期失效的缺陷芯片，因此系统级测试（SLT）、老化测试（BI）逐渐成为成品测试（FT）中的重要环节。系统级测试（SLT）能够将芯片置于接近真实应用的完整硬件系统中，测试芯片在复杂交互下的整体性能、功耗、散热以及多芯片协同工作等，解决传统成品测试（FT）无法解决和覆盖的问题，常用于复杂的 SoC 芯片、GPU/CPU 芯片等，为芯片实际应用提供最终保证。老化测试（BI）是基于半导体失效“浴盆曲线”的可靠性筛选手段，通过施加高温、高电压等条件对芯片进行长时间加电负载，使芯片加速老化，在短时间内触发可能的失效，提前暴露芯片寿命晚期可能存在的问题或故障，剔除存在潜在工艺缺陷的芯片。老化测试、系统级测试是高端芯片可靠性验证的关键环节，亦是国产芯片量产初期筛查潜在缺陷、优化工艺稳定性的核心支撑。

成品测试（FT）			
主要测试环节		服务产品类型	
电性测试（高温、常温、低温）；老化测试（BI）；系统级测试（SLT）等		测试芯片类型覆盖算力芯片、高性能 SoC、车载芯片、射频芯片、传感器芯片、等多种芯片类型	
主要测试设备及治具			
测试机	分选机	测试座	老化测试炉
			
测试示意图			
			

（3）工程测试服务

芯片在新产品量产或已有产品工艺改进前，通常需以小批量形式开展工程测试，该环节作为量产测试的核心前置程序，用于验证、修改并导入产品测试方案、分析与反馈测试数据结果，同时可协助集成电路制造产业链上下游各环节完成产品性能优化与生产工艺的改进修正。

工程测试是半导体产业核心工程落地能力的关键组成部分，是实现芯片设计方案规模化、稳定化、低成本落地生产的核心支撑，也是半导体企业构筑技术壁垒、夯实产业链核心竞争力的重要环节。芯片工程测试具备测试场景复杂、技术覆盖面广、工艺不确定性高、问题定位难度大的特性，能够提前甄别设计缺陷、工艺偏差、测试适配性不足等各类量产潜在风险，有效规避大规模量产的良品率波动、产能不稳、成本失控等问题。该环节的测试精度、问题迭代效率与工艺优化能力，直接决定芯片量产进程、良品水平、产品性能稳定性及生产成本管控效果，对芯片产业化落地至关重要，高度依赖测试端与设计、制造、封装等产业链各环节的深度协同、精准适配与长期技术沉淀。

公司工程测试服务覆盖晶圆测试（CP）、成品测试（FT）环节，以客户提出的具体测试需求为核心，通常由公司提供所需设备，配置专业人员完成工程测试服务。相关测试环节与量产测试基本一致，主要以小批量晶圆/芯片为测试对象，同时在测试过程中同步向客户反馈发现的技术问题、输出完整的测试数据与信息，为客户产品设计迭代、工艺优化提供数据支撑。此外，工程测试服务还包括少量前沿性的、试验性的工程级别的测试服务。近年来，国产高端芯片追赶国际先进水平的进程持续加快，各类高端芯片产品密集迭代推出、工艺持续优化升级，也带动公司工程测试服务业务实现快速增长。

3、发行人主营业务收入构成及特征情况

报告期内，公司主营业务收入为集成电路测试业务收入。发行人主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	97,895.60	48.14%	53,404.88	51.46%	24,171.98	49.87%
	CP	61,731.51	30.36%	25,517.79	24.59%	13,189.12	27.21%
	小计	159,627.11	78.50%	78,922.67	76.05%	37,361.10	77.07%
工程测试服务		43,715.47	21.50%	24,856.34	23.95%	11,112.72	22.93%
合计		203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

发行人主营业务收入的地区分布以及季节分布情况，具体参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八/（一）营业收入分析”相关内容。

（二）发行人的主要经营模式

1、销售及盈利模式

公司为第三方集成电路测试服务商，测试业务采用直销的模式开展销售，为客户提供晶圆测试、成品测试服务等并取得测试服务收入。

集成电路测试业务由公司营销中心整体负责，通过专业的销售服务团队开展客户沟通维护、销售报价、合同签署等工作，并协同公司制造中心、质量中心完成具体测试安排及商务条款的确定。测试业务的合作关系建立及业务导入所需周期通常较长，公司通常与客户开展长期业务合作，营销中心会持续跟进各测试项目进度、对账结算以及客户关系维护等系列工作。

在销售定价方面，营销中心与客户经过洽谈后确定测试服务价格。由于不同客户及产品的测试方案均具有差异性，通常涉及不同测试站点及设备配置，公司基于所需测试设备、具体测试方案的测试难度和测试工艺要求、订单规模、测试时长等因素进行综合定价。

2、采购模式

公司在综合考虑供应链自主可控、采购及生产稳定性的基础上开展采购，内容主要包括测试设备、测试治具等。其中，测试设备为主要采购内容，主要根据产能需求、设备交期、公司投资安排等情况由公司直接采购；测试治具包括探针卡、测试座等，**主要根据订单及生产需求由公司采购。**

公司采购按照相关采购规章制度执行，由供应链中心等需求部门结合生产计划及发展规划提出采购需求，经过审批后按照采购物资的技术、质量要求选取合格供应商。公司高度重视供应链安全与稳定，建立了较为完善的供应商筛选与管理体系，由供应链中心、质量中心等对供应商的准入、定期评估、产品质量检测等进行协同管理，确保采购产品品质、设备及物料交期等符合公司要求。

3、生产及服务模式

公司采取“以销定产”的生产模式，实行订单式生产，并对各经营主体的测试产能进行总体控制与灵活管理，保障测试作业的顺利完成。公司集成电路测试服务主要由制造中心下属的各个测试主体承担，各业务部门配合完成。具体业务开展过程中，由营销中心根据客户订单及来料情况，在内部生产管理系统中投单排产，制造中心依据排产安排进行产品测试。

公司建立了较为完善的生产管理制度，并设置了质量中心对成品交付质量进行把控、监督，对测试效果、交付及时性等进行持续优化，确保公司测试服务质量。

4、研发模式

公司高度重视研发创新对于业务开展的引领作用，以行业技术发展趋势和产业化探索过程中的问题解决为导向，聚焦集成电路测试领域研发工作，不断迭代提升自身测试技术水平，打造了具备自主知识产权的集成电路测试技术体系。公司建立了完善的技术研发体系，构建了一支行业经验丰富、专业知识过硬的研发团队。公司由研发中心负责整体研发工作，研发项目开展阶段主要包括项目申请、立项评审、组织实施、项目验收等。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

公司专注于提供第三方集成电路测试服务，基于测试服务特性、自身核心技术优势及国家产业政策导向、集成电路产业发展阶段、市场供需格局等形成了契合自身发展需求与行业特征的经营模式。经营模式与行业惯例相一致。报告期内，公司经营模式及影响经营模式的关键因素未发生重大变化。

随着集成电路设计的复杂化以及制造工艺的不断发展，行业专业化、规模

化趋势不断凸显，第三方集成电路测试服务商能够聚焦测试技术研发与积累、实现测试环节的规模效应并保持测试结果独立性。随着中国大陆集成电路行业的快速发展，芯片设计、晶圆制造、封装等各环节企业快速崛起，预计独立第三方集成电路测试模式将得到进一步发展。

（三）公司成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司始终专注于集成电路行业，从设立初期即从事集成电路测试业务，后续开拓了集成电路产教融合软硬件装备的研发与销售业务。2020 年以来，公司把握中国大陆半导体产业链自研自产、自主可控的产业需求，凭借长期技术积累积极投身国产高端集成电路测试的国产化进程。

1、公司成立至 2019 年，专注集成电路领域，从事集成电路测试业务，同时开拓了产教融合软硬件装备的研发与销售业务

公司成立之初即专注于集成电路行业，从事集成电路测试等相关业务。后续公司以集成电路实训设备作为切入口，开发了 LK 系列集成化平台，为高校等客户提供芯片测试及制造、封装实训软硬件装备等，助力集成电路领域人才培养，促进了集成电路的产教融合。

发展初期，公司在集成电路领域持续进行技术积累与研发投入，同时亦注重团队建设与培养，积累了良好的品牌形象及行业口碑，参与了科技部重大专项“战略性先进电子材料”项目。该阶段公司在集成电路测试领域积累了宝贵的业务、技术和产业链资源，并与部分业内主要装备及封装企业建立了业务联系。

报告期内，由于下游行业情况及公司业务发展方向及资源投入等因素，集成电路产教融合软硬件装备业务规模有所下降。

2、2020 年至今，专注于第三方集成电路测试服务，投身高端集成电路研发、生产的国产化进程，测试应用领域持续拓展

该阶段以来，全球产业链稳定性不断受到挑战，贸易摩擦时有发生，保障集成电路测试环节自主可控的重要性不断凸显。

公司积极响应集成电路产业国产化浪潮，依托集成电路测试及相关业务领域的人才及技术积累，开展国产高端芯片的第三方集成电路测试服务，并于2020年成立了杭州芯云。公司扎根于国产化高端集成电路供应链，对基于国产化工艺的晶圆、芯片成品测试需求实现了快速适配及导入。测试业务开展初期，公司业务领域较为聚焦，测试芯片的终端应用领域主要为通信、网络等传统芯片领域。

随后，诸暨芯云、杭州芯云海等生产主体设立并逐步投建，公司产能逐渐铺开，并为不同应用领域的芯片进行测试，服务国产自主研发生产的高端芯片产业链的能力进一步提升。

2024年以来，公司测试产品在算力芯片、光学芯片、车载芯片等领域持续铺开，测试能力全面提升。同时，公司原有测试基地测试产能逐渐爬升，新兴测试基地诸暨越芯、杭州芯光亦在积极筹建中，测试产能快速扩充，服务境内市场测试需求。根据集成电路测试业务收入统计，公司已成为最大的内资第三方集成电路测试企业，也是2023至2025年度内资第三方集成电路测试领域前五名中增长最快的企业，三年主营业务复合增长率超过100%。

报告期内，公司主要提供第三方集成电路测试服务，主营业务、主要服务及经营模式未发生变化。

（四）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司专注于第三方集成电路测试服务，聚焦自主可控的国产集成电路测试供应链，凭借强大的软硬件自主研发能力，持续推进高端芯片测试的国产化替代，业务持续增长，收入及利润规模较大。2023年度、2024年度和2025年度营业收入分别为53,553.63万元、108,728.04万元和206,430.25万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,902.13万元、13,358.44万元和53,457.09万元，主营业务经营情况良好。境内集成电路产业规模的快速增长以及测试等产业环节国产化替代的快速推进，预计将带来持续不断的市场需求和行业发展的长期驱动力。

公司自设立以来持续开展研发创新投入，掌握了高端芯片测试的自主核心技术体系，覆盖测试解决方案开发、测试软件开发及数据分析、测试设备开发

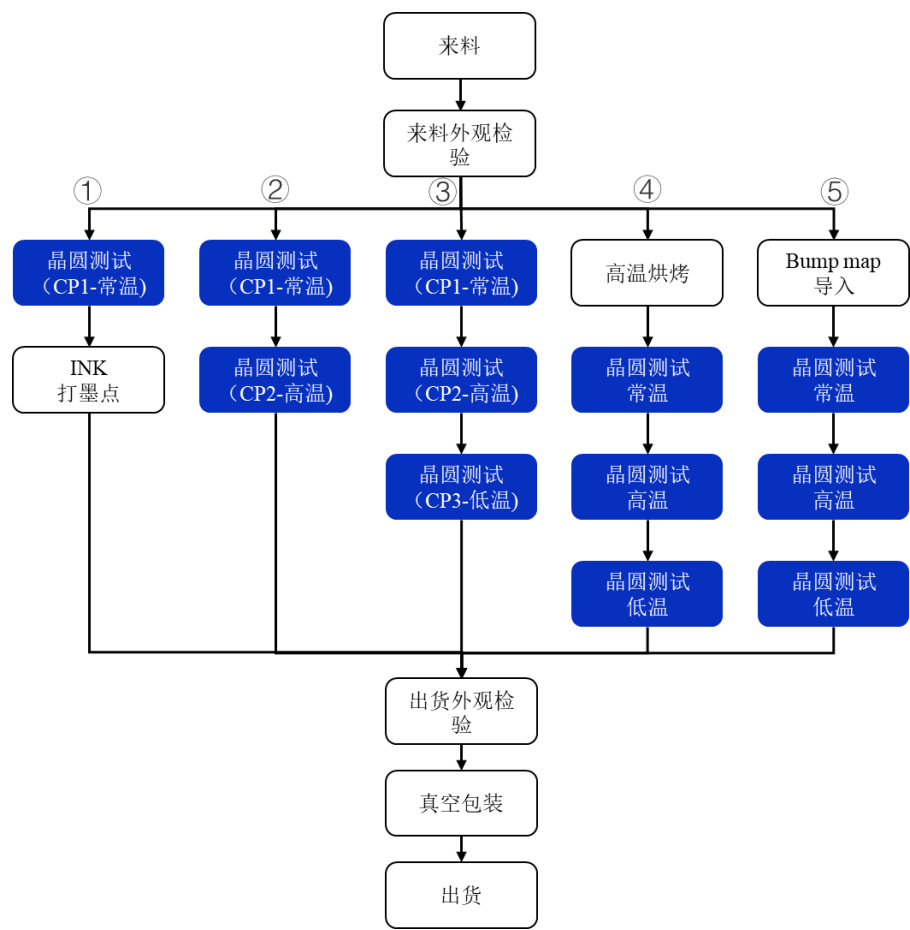
及工艺优化等，具备基于国产化平台的全流程测试开发能力，并已在测试服务中广泛应用。公司测试的芯片产品包括算力芯片、高性能 SoC 芯片、光学芯片、车载芯片、射频芯片、传感器芯片等多种芯片类型，能够为客户提供一站式的量产测试解决方案。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司核心技术相关服务为第三方集成电路测试服务，实现收入金额分别为 48,473.82 万元、103,779.01 万元和 203,342.58 万元，核心技术得到有效产业化应用。

（五）发行人主要产品的工艺流程

公司集成电路测试服务的工艺流程图如下所示：

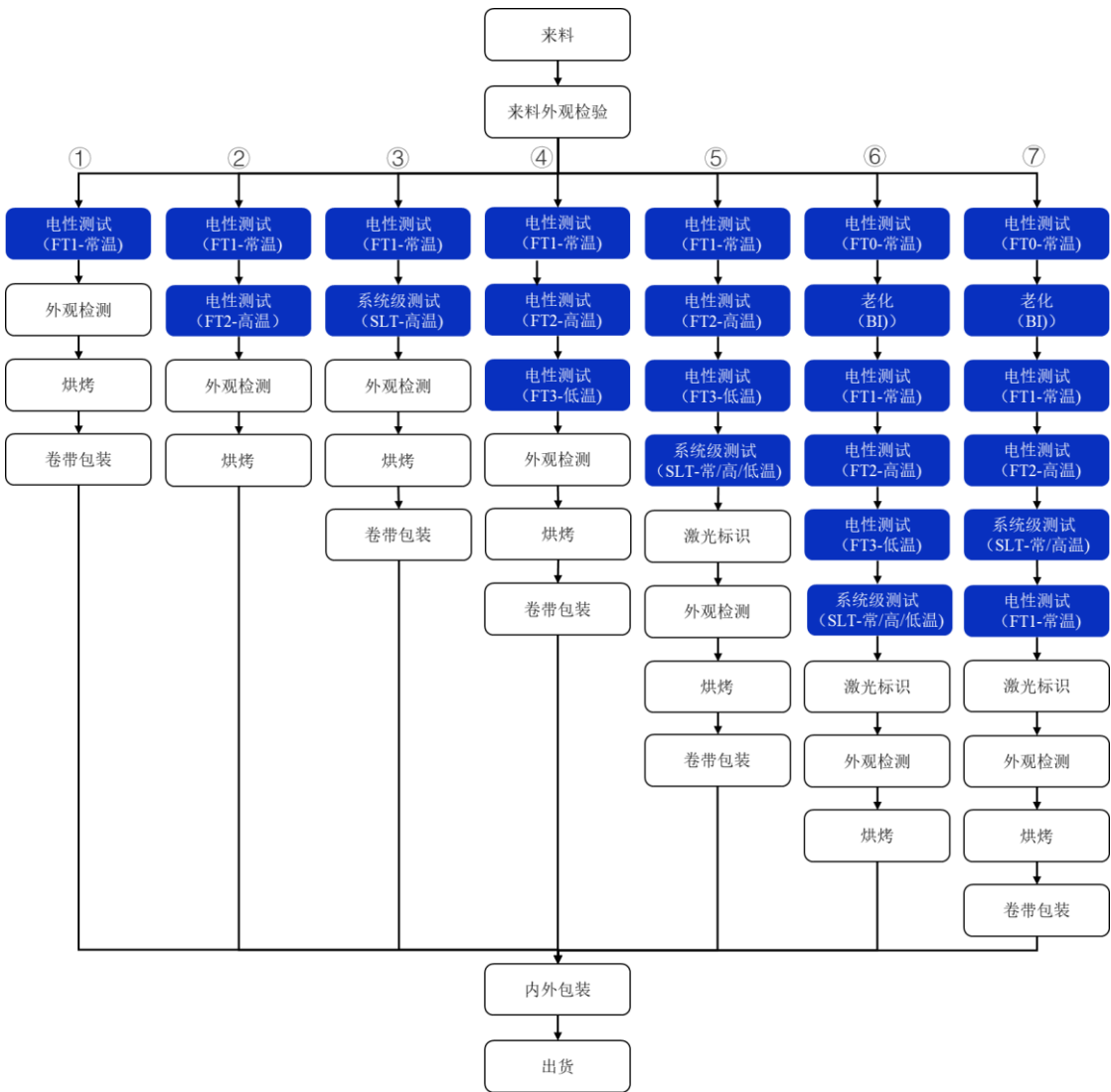
1、晶圆测试



公司根据晶圆类型、客户测试需求等综合确定晶圆测试流程，其中消费电子类晶圆较多使用工艺流程①/②，高端算力晶圆较多使用工艺流程③/④/⑤，射频通讯晶圆较多使用工艺流程②/③，车载智控晶圆较多使用工艺流程③/④/

⑤。

2、芯片成品测试



公司根据芯片类型、客户测试需求等综合确定测试流程，其中消费电子类芯片较多使用工艺流程①/②/③/④/⑦，高端算力芯片较多使用工艺流程③/④/⑤/⑥，射频通讯芯片较多使用工艺流程⑤/⑥/⑦，车载智控芯片较多使用工艺流程⑤/⑥/⑦。

（六）发行人报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况

发行人报告期内主要提供第三方集成电路测试服务，结合所处行业特点、企业自身经营情况，具有代表性的业务指标包括主营业务收入、毛利率、产能利用率等，主要业务指标及其变动情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”及“第五节 业务与技术”之“三、

销售情况和主要客户”相关内容。

（七）发行人主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司主要从事集成电路测试业务，通过测试服务精准识别晶圆或成品芯片的缺陷及故障，并向产业链伙伴反馈相关数据信息，从而提升芯片整体良率、控制制造成本并指导工艺改进。第三方集成电路测试服务基于其独立、客观、产业聚焦的特点，成为集成电路生产过程中不可缺少的环节。具体情况参见本节之“一/（一）/2、主要服务或产品的基本情况”。

近年来，国家出台了一系列措施推动集成电路产业的发展，保障产业自主可控。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中将先进封装与测试纳入了鼓励类的行业范畴；二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，则进一步要求抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化包括集成电路在内的重点产业链发展体制机制。相关政策鼓励和推动了集成电路测试领域健康、高效发展，从国家战略及产业层面提供了强大政策支持。

综上所述，公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略。

二、发行人所处行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为第三方集成电路测试服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造”。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司业务覆盖“2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试”，属于“鼓励类”行业范畴。

（二）行业主管部门、行业监管体制及行业主要法律法规政策

1、行业主管部门和监管体制

公司所处行业的主管部门主要为国家发改委、国家工信部，主要自律组织

主要为中国半导体行业协会。行业主管部门和自律组织构成了集成电路行业的监管体系，行业内企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下面向市场自主经营。

行业主管部门	主要管理职责
国家发改委	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等工作。
国家工信部	提出行业发展战略和政策，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策；制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推进工业、通信业体制改革和管理创新等。
中国半导体行业协会	贯彻落实政府有关的政策、法规，深入研究半导体行业全局性、战略性、前瞻性重大问题，向政府有关部门提出促进本行业发展的政策建议；促进行业质量与标准化工作，开展半导体行业标准研究；反对不正当竞争，保护知识产权，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善等。

2、行业主要法律法规及产业政策

集成电路行业是信息产业的基础和核心，其技术水平关乎国家科技竞争力，对于保障供应链安全、推动经济转型意义重大，相关行业发展受到了国家的高度重视。2024 年 6 月，习近平总书记在《在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话》中提出“要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑”。

近年来，国务院、各级主管部门出台了一系列支持和引导集成电路产业发展的政策法规，具体如下所示：

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
1	2026 年 3 月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
2	2025 年 8 月	国务院	《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	强化智能算力统筹。支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
3	2025 年 8 月	国家工信部、市场监管总局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算等领域科技创新。提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究
4	2025 年 4 月	国家发改委、国家工信部、国家财政部、海关总署、税务总局	《国家发展改革委等部门关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业包括集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业
5	2024 年 7 月	中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制
6	2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	集成电路领域中 2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试属于“鼓励类”产业类别
7	2021 年 12 月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系
8	2021 年 6 月	国家工信部等六部委	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用
9	2021 年 3 月	国家财政部、海关总署、税务总局	《财政部海关总署税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》	集成电路线宽小于 0.5 微米的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税
10	2021 年 3 月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展
11	2020 年 7 月	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》	明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。 进一步加强高校集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置工作，紧密结合产业发展需求及时调整课程

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
				设置、教学计划和教学方式，努力培养复合型、实用型的高水平人才。加强集成电路和软件专业师资队伍、教学实验室和实习实训基地建设

3、行业监管体制及行业政策对发行人的影响

集成电路行业是信息产业的基础和核心，也是确保产业链、供应链自主安全可控的重要一环。近年来，国家大力鼓励和支持集成电路产业的发展，出台了一系列积极的产业政策，为行业发展提供了政策支持与发展机遇；同时，相关政策聚焦高端封装测试、高端芯片等关键核心技术研发，提出了清晰的产业发展规划，有效推动了产业技术创新与升级；此外，通过制定行业标准、引导产业布局，相关政策规范了市场秩序，推动行业整体健康发展，为发行人持续发展创造了良好的经营环境。

（三）行业概况及发展趋势

1、集成电路行业发展情况

（1）集成电路行业简介

集成电路（Integrated Circuit，IC）是一种微型电子器件或部件，其通过一系列特定的半导体加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件，按照一定的电路构成规则，互连“集成”在一块半导体单晶片上，封装在一个外壳内，执行特定的电路或系统功能。近年来，集成电路工艺制程持续演进，同时 2.5D 封装、3D 封装、Chiplet 等先进封装技术逐渐应用，晶体管密度持续提高、集成电路性能不断突破，并进一步推动了广泛的产业信息化变革。

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，在促进整体经济发展、推动产业现代化等方面发挥着广泛而重要的作用。随着人工智能、辅助驾驶、5G 等前沿信息技术的持续不断发展，集成电路行业的地位不断凸显，其技术突破与应用拓展深刻影响着全球科技格局，已经逐渐成为衡量国家整体产业竞争力的重要指标之一。

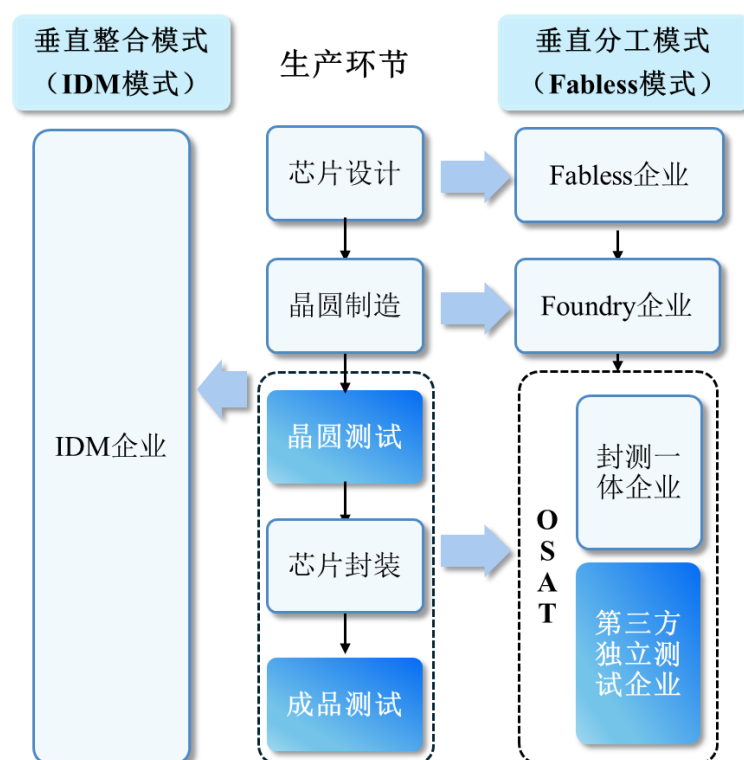
近年来，随着我国产业结构的不断升级，集成电路对于国民经济发展的重

要性日益凸显，国家也已从税收政策、人才培养等多方面出台了一系列政策鼓励行业发展。同时，随着国际贸易保护主义逐渐升温，产业安全持续受到挑战，集成电路行业的稳定性在国家产业及供应链安全、经济平稳运行等方面的作用愈加显著。作为国家战略性新兴产业，推动集成电路全产业链自主可控已成为行业发展的重要目标。

（2）集成电路产业链及其专业化发展趋势

按照生产流程，集成电路产业链主要可以分为芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、成品测试环节。相关环节具有典型的技术、资金及人才密集的特点，需要行业内企业紧跟工艺和生产技术发展趋势，并具有丰富的技术创新能力和人才储备，同时在设计、研发及生产环节均需要大量的资金投入。行业发展早期，集成电路产业以垂直整合制造模式（又称 IDM 模式）为主，即由企业自行设计、生产加工并进行封装、测试。随着集成电路技术的持续发展，各环节对于资金投入及技术水平要求不断提高，行业专业化分工趋势愈发凸显，独立的芯片设计企业（Fabless）、晶圆制造企业（Foundry）、封装测试企业（OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Testing）逐渐产生，形成了“Fabless+Foundry+OSAT”为代表的垂直分工模式（又称 Fabless 模式），且该模式在行业内占比逐渐提升。以晶圆制造为例，根据 QY Research 数据，预计 Fabless 模式占全球晶圆制造市场的比例将从 2019 年的 34.75% 上升至 2025 年的 50.98%

图：集成电路产业链分工模式



在 Fabless 模式下，芯片设计企业在完成设计后交由晶圆制造企业进行生产代工，之后委托专业封装、测试企业进行芯片封测并交付成品芯片。凭借专业化分工带来的产业规模效应、资源聚焦和良好的产业链协同效应，Fabless 模式能够更好地适应集成电路产业的技术和产品的发展趋势，目前已经成为集成电路产业链最主要的分工模式之一。

其中，OSAT 环节的测试工作主要由封测一体企业、第三方测试服务企业承担。第三方测试企业专注于集成电路测试业务，凭借业务聚焦带来的专业性、无需关联封装产能带来的服务灵活性、独立测试带来的结果客观性等优势，已成为集成电路测试环节主要的参与方之一，占集成电路测试整体需求的比例呈现逐年上升态势。

（3）全球集成电路行业整体发展情况

根据全球半导体贸易协会（WSTS）的统计数据，2015 年至 2025 年期间，集成电路行业整体呈现快速增长态势，全球市场规模由 2,745 亿美元增长至 6,779 亿美元，年均复合增长率为 9.46%。随着人工智能、5G 通讯、辅助驾驶等领域带来的技术革新，近年来集成电路应用领域不断拓宽，市场需求持续快

速增长。根据全球半导体贸易协会预测，2026 年度全球集成电路市场规模将进一步增长至 8,743 亿美元，较 2025 年度增加 29%。

图：2015-2025 全球集成电路市场规模及同比增长



数据来源：WSTS（World Semiconductor Trade Statistics），同花顺

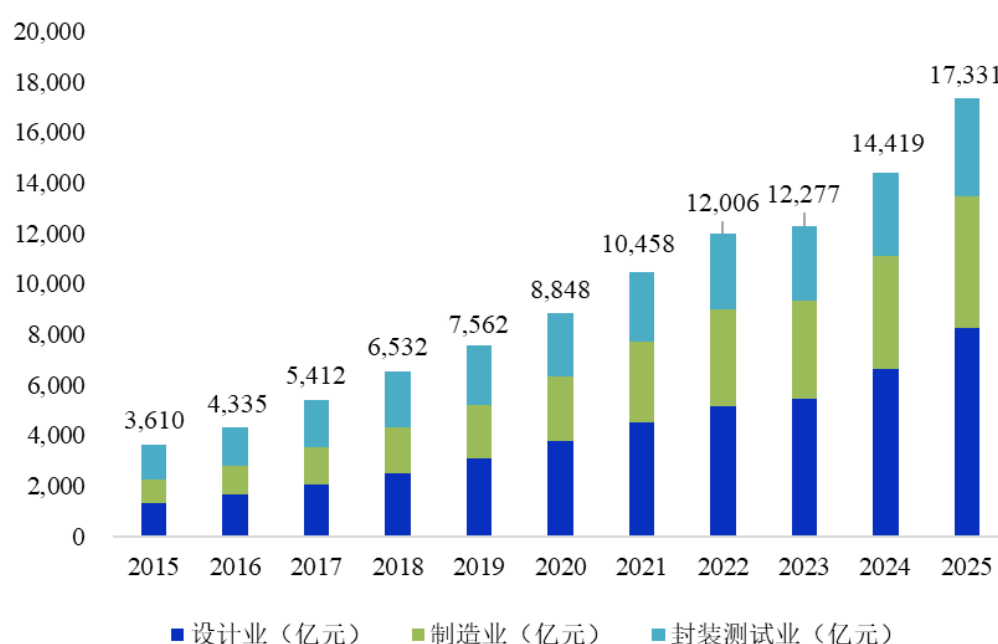
与此同时，根据世界集成电路协会（WICA）统计，2024 年中国大陆集成电路市场规模占全球市场份额的约 30%，是全球最大集成电路单一市场，在全球市场中具有举足轻重的地位。

（4）中国集成电路行业整体发展情况

自进入 21 世纪以来，中国集成电路市场呈现持续高速增长态势。国家持续推进打造集成电路领域自主可控的产业链、供应链，并给予了积极政策支持；同时依托庞大的市场需求、丰富的工程师人才红利和深厚的制造业基础，集成电路产业实现了快速发展，封装测试、芯片设计、晶圆制造等领域具备自主知识产权的企业不断涌现，市场规模持续增长。

根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业规模已从 2015 年的 3,610 亿元快速增长至 2025 年的 17,331 亿元，年均复合增长率为 16.99%，增速显著高于全球发展水平。

图：2015-2025 中国集成电路产业规模



数据来源：中国半导体行业协会、Wind

从产业结构来看，2025 年度中国集成电路设计业、制造业和封装测试业市场规模的占比分别为 47.67%、30.15%和 22.18%，且各领域规模均保持增长态势。其中，封装测试作为集成电路生产必不可少的环节，行业规模从 2015 年的 1,384 亿元跃升至 2025 年的 3,844 亿元。随着近年来中国大陆在集成电路制造、设计领域的快速进步，以及 2.5D、3D、Chiplet 等先进封装形式的不断普及，封装测试行业预计将持续实现规模的增长。

从发展阶段来看，中国集成电路产业自 2000 年国务院发布《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》起逐步进入了快速发展阶段，但在行业发展早期，国内集成电路产业主要以生产较低技术含量的产品和从事产业配套为主，且核心技术、产业生态对于海外依存度较高。2010 年以来，中国集成电路产业持续追赶，在设计环节已逐渐具备旗舰级手机 SoC、5G 通信基带及射频前端、AI 加速芯片等前沿产品的设计能力，涌现了一批具有国际竞争力的设计企业；在制造、封测环节亦逐步向前沿制程迈进，掌握了多种先进封装技术的封装、测试能力。2020 年以来，受全球产业链重构与海外技术管制影响，国内集成电路产业链在向着设计、制造、封测全领域自主可控趋势持续发展，目前，中国集成电路产业已实现 AI 加速芯片、高端存储芯片、通用 GPU、手机

SoC 等前沿产品的设计及规模化量产，在多个下游应用领域全面突破。

（5）中国集成电路行业主要应用领域情况

当今的工业化时代，集成电路已经应用到工业和生活的方方面面，小到日常生活消费、娱乐、出行、医疗，大到工业自动化、电力能源、通信、安防、航天等，一切需供电驱动、搭载自动控制系统、支持数据互联、实现图像信号处理或完成电能转换的设备，均以芯片为不可或缺的核心元器件。中国集成电路产业已经取得了快速的发展和长足的进步，近年来的主要增量市场和决战阵地在于高端算力、消费电子等高端领域。

1) 高端算力

近年来，人工智能的爆发式发展对算力领域集成电路产生了巨大需求。根据 IDC 数据，2025 年中国大陆人工智能加速器市场规模将超过 400 亿美元，预计到 2029 年将进一步超过 1,400 亿美元，是推动集成电路市场规模增长的主要动力之一。在算力领域发展早期，英伟达等境外厂商凭借行业先发优势和制程工艺领先占据了市场绝对主导地位，但目前已有较多境内厂商在 AI 加速芯片、CPU、GPU 等各类算力芯片领域开展布局，持续推进算力领域进口替代与自主可控。

2) 消费电子

我国拥有全球领先的消费电子产品市场，消费电子领域亦是中国集成电路的重要应用市场之一。根据 Statista 数据，2025 年度中国消费电子市场规模为 2,277 亿美元，预计 2028 年将进一步增长至 2,550 亿美元。其中，集成电路在消费电子领域的核心应用品类包括处理器（如手机 SoC 等）、传感器芯片（如 CIS 图像传感器芯片等）、微控制器（MCU）等。

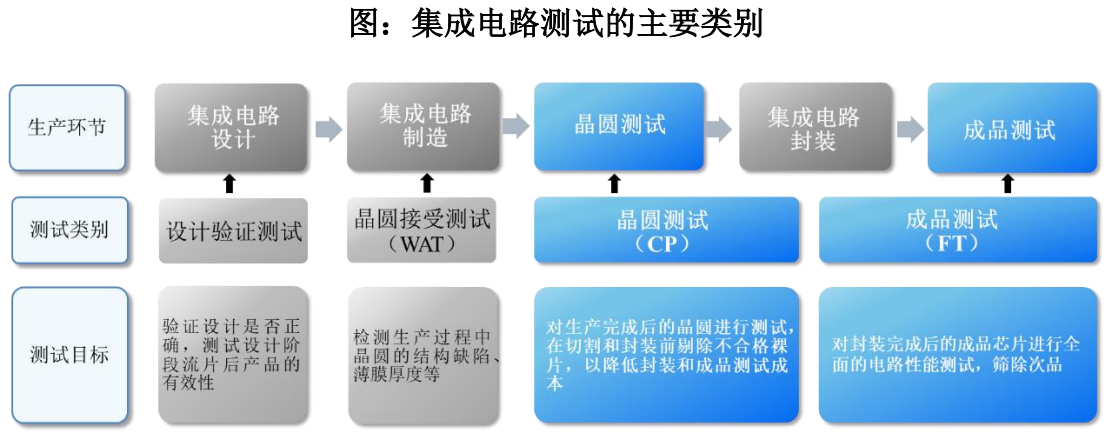
目前，我国在消费电子领域的中低端集成电路产品已能够实现自主可控，国产厂商份额不断提高，但在部分高端产品领域仍有待提升。

2、集成电路测试行业概述及发展情况

（1）集成电路测试的分类与意义

集成电路测试贯穿于集成电路设计、制造、封装测试的全过程，通过对集

成电路的输出响应和预期输出进行比较，确定或评估集成电路元器件功能和性能，是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效及指导应用的重要手段。集成电路测试的测试类别、涉及的生产环节及测试目标如下所示：



集成电路生产过程中的测试环节包括设计验证测试、晶圆接受测试、晶圆测试和成品测试。（1）设计验证测试服务于集成电路设计环节，主要在量产前进行，测试规模较小，通常由芯片设计企业主导进行；（2）晶圆接受测试主要用于工艺监控，贯穿于晶圆制造的整个过程，主要由晶圆生产厂商同步开展；（3）晶圆测试（CP）、成品测试（FT）是集成电路量产阶段主要的独立测试环节，可以由第三方独立测试企业、封测一体企业或 IDM（即垂直整合制造，Integrated Device Manufacturing）生产企业等独立开展。其中：

1）晶圆测试（CP）在晶圆制造后进行，在切割和封装前剔除不合格裸片，减少后续生产环节的无效投入，并通过输出 Wafer Map 等方式记录不合格裸片在晶圆上的准确位置，能够直接反映晶圆制造的合格率，并用以进一步指导芯片设计和晶圆制造的工艺改进。

2）成品测试（FT）则是对封装完成后的成品芯片按照测试规范进行全面的性能测试，筛除次品，并可根据性能参数对良品进行进一步分级，统计所有级别的良品数量和参数，保障终端应用的可靠性。成品测试数据可以进一步指导封装环节的工艺改进。

成品测试（FT）在集成电路产业早期主要仅包括电性测试环节，即根据需求在常温、高温、低温三温环境下，通过测试机向芯片施加标准电信号，采集芯片输出响应并与设计规范对比，判定芯片核心电学性能与功能是否达标。

但随着芯片制程的演进、封装复杂度的提升以及高端芯片的高可靠性要求，仅在成品测试环节进行单一的电性测试难以模拟复杂实际应用场景，亦难以剔除筛选存在潜在失效可能的缺陷芯片，因此系统级测试（SLT）、老化测试（BI）逐渐成为成品测试（FT）中的重要环节。系统级测试（SLT）能够将芯片置于接近真实应用的完整硬件系统中，测试芯片在复杂交互下的整体性能、功耗、散热以及多芯片协同工作等，为芯片实际应用提供最终保证。老化测试（BI）是基于半导体失效“浴盆曲线”的可靠性筛选手段，通过施加高温、高电压等条件对芯片进行长时间加电负载，在短时间内筛选出可能的早期失效，剔除存在潜在工艺缺陷的芯片。老化测试、系统级测试是高端芯片可靠性验证的关键环节，更是国产芯片量产初期筛查潜在缺陷、优化工艺稳定性的核心支撑。

晶圆测试、成品测试的主要区别如下所示：

项目	晶圆测试（CP）	成品测试（FT）
测试对象	未切割的整片晶圆	已完成封装的成品芯片
测试时点	晶圆制造后、芯片封装前	芯片封装后
主要测试设备及治具	测试机、探针台、探针卡等	测试机、分选机、测试座等
接触方式	通过探针接触芯片表面	通过测试座将芯片连接至测试板以及测试机
测试环节	电性测试等	电性测试、老化测试（BI）、系统级测试（SLT）等
测试目的	1、在切割和封装前剔除不合格裸片，节约后续成本； 2、为芯片制造工艺、芯片设计（如国产化工艺）提供缺陷定位、数据反馈和生产指导	1、保证对封装完成后的成品芯片进行全面的性能测试，筛除次品； 2、为芯片封装工艺、芯片设计（如国产先进封装）提供测试数据和改进依据

近年来，随着半导体工艺制程的提升、先进封装形式的引入，相关产品的复杂度和集成度呈现快速增长态势，集成电路生产涉及的工艺步骤数量也不断增加，成熟制程（以 45nm 为例）工艺步骤数约为 400 道，到了先进制程（以 5nm 为例）将会提升至 1,200 道以上，工艺复杂度成倍增长，检测对于保障成品率的重要性愈发凸显。晶圆测试、成品测试能够在集成电路生产的关键节点进行质量把控，为产品生产的良率保障和性能分级保驾护航，在降低后续环节生产成本的同时，对前期工序进行质量评价和工艺反馈，指导和协助前期工艺的改善。

（2）集成电路测试的主要内容

从测试的内容来看，量产阶段集成电路测试主要包括参数测试、功能测试、老化测试以及系统级测试，其中参数测试主要测量电压、电流、时序关键参数，保证芯片的电气性能达标；功能测试主要用于验证芯片逻辑功能能否达到设计要求，参数测试及功能测试亦可以统称为电性测试；老化测试是可靠性测试的一种，主要验证芯片使用的可靠性；系统级测试则对芯片在终端实际应用场景下的可用性进行最终验证。量产阶段相关测试内容及主要的测试项目如下所示：

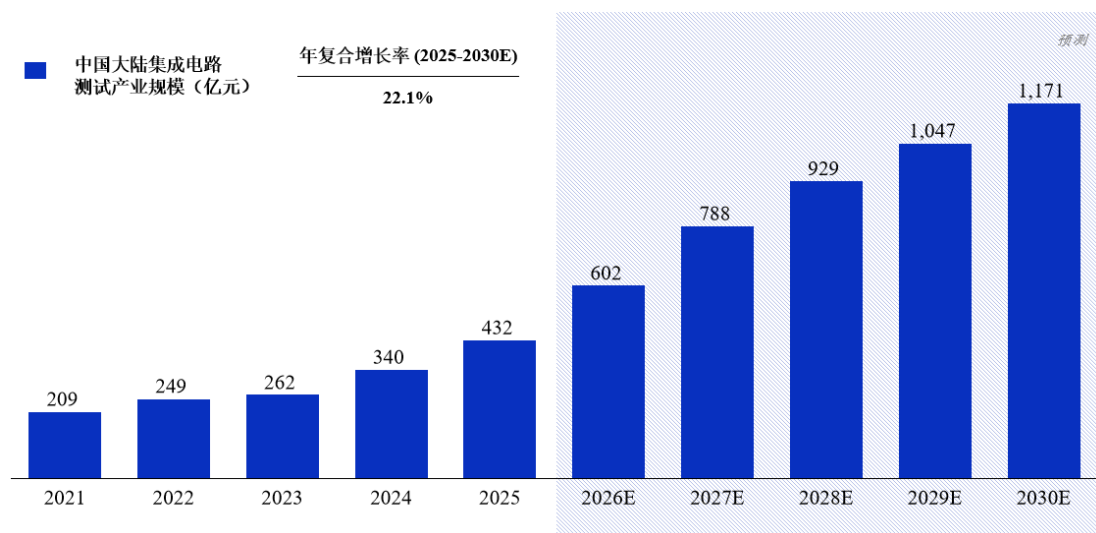
测试类别	主要测试项目	主要测试内容
参数测试	直流参数测试	直流参数主要测试芯片的电压、电流的规格指标。常见测试内容有连接性测试、漏电流测试、输出高/低电平测试等
	交流参数测试	交流参数测试目的是确保芯片的所有时序符合规格。常见的测量内容有上升时间、下降时间、传输延迟时间、建立和保持时间以及存储时间等
功能测试	数字逻辑功能测试	数字逻辑功能测试主要通过输入测试向量验证逻辑输出正确性。常见的测试项目包括 SCAN、BIST 等
	模拟/混合信号功能测试	模拟/混合信号功能测试衡量芯片的数字转模拟模块、模拟转数字模块的性能指标。常见的测试项目有线性度、信噪比、总谐波失真等
	射频功能测试	测试芯片的射频信号是否符合芯片的设计规格，常见的射频模块测试项目有噪声系数、隔离度、接收灵敏度等
	存储器功能测试	存储器功能测试对芯片嵌入式存储器和独立存储器模块的读写功能进行测试，常见的测试内容有读写功能、地址译码、数据保持、擦写寿命测试等
可靠性测试	老化测试	老化测试通过在高温、高电压条件下对芯片进行长时间加电负载，强制其潜在缺陷提前暴露
系统级测试	系统级测试	系统级测试通过模拟终端使用场景，对芯片进行的功能和性能测试，测试内容主要为实际使用负载，亦覆盖部分参数测试、功能测试等，是芯片实际使用功能的最终保证

（3）集成电路测试的行业规模

近年来，伴随全球半导体产业格局的深度调整以及国内集成电路产业自主可控战略的持续推进，中国大陆集成电路产业测试需求进入快速增长通道。与此同时，国内芯片产品加速向中高端领域突破，高端、复杂芯片的测试需求进一步推动集成电路测试产业规模的稳步扩容。根据灼识咨询数据，2025 年中国大陆集成电路测试的产业规模达到 432 亿元人民币，未来随着高端算力、高端 SoC、汽车电子等前沿、复杂芯片测试需求的爆发，预计 2030 年中国集成电路

测试产业规模合计有望达到 1,171 亿元人民币，实现年均复合增长率 22.1%。

图：中国大陆集成电路测试产业规模



数据来源：灼识咨询

3、第三方集成电路测试行业概况

（1）中国大陆第三方集成电路测试服务模式的发展历程

中国大陆第三方集成电路测试服务的产生和发展与集成电路行业的专业化分工密切相关，是技术演进、市场催化、政策鼓励等因素共同作用的结果，且伴随着集成电路行业整体的成长而不断发展壮大，其发展历程如下所示：

1) 2009 年以前，行业萌芽阶段

这一阶段中国大陆集成电路产业规模相对较小，芯片设计企业数量较少，晶圆代工刚刚起步，对集成电路封测的需求也相对较低，支撑独立第三方测试业务发展的产业基础相对较为薄弱，行业整体处于萌芽与初步发展阶段。

这一期间的集成电路测试企业数量较少，且通常主要由半导体领域大型国有企业或研究院所发起设立，相关企业在为主要股东提供测试相关服务的同时，也逐步开展对外测试服务业务，推动了第三方测试服务模式在中国大陆的初步发展。

2) 2010 年-2019 年，专业化分工深化，行业初步发展

随着中国大陆集成电路行业规模的持续扩大和技术的不断迭代，各环节间专业化分工趋势愈发凸显；同时，国内一批芯片设计企业在产业浪潮中逐步崛

起，晶圆制造环节亦初具规模，全产业链协同发展直接带动集成电路测试的市场需求进入快速增长通道。

第三方集成电路测试服务模式能够专注于测试环节，凭借其专业、全面的测试能力、中立性的产业链角色、规模化测试的效率提升与成本优化等优势逐渐受到青睐。利扬芯片（688135.SH）、伟测科技（688372.SH）等一批具有代表性的第三方测试企业陆续成立。朗迅科技亦从集成电路产教融合软硬件装备作为切入口，逐步积累集成电路测试领域技术及产业链资源。

3）2020 年至今，自主可控重要性凸显，行业快速增长

2020 年度，国务院在《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中将集成电路测试与设计、制造、封装等并列，作为独立的环节明确其战略地位；集成电路产业整体受益于国家政策在财税、投融资、研发、人才等方面的一系列支持，亦持续保持快速增长态势，为第三方测试服务的快速发展提供了政策和产业基础。

与此同时，随着国际贸易保护主义的逐渐升温，集成电路产业链条的自主可控能力愈发受到重视，部分中国大陆高端芯片设计公司将测试订单逐步由中国台湾转回中国大陆完成，集成电路测试行业规模快速增长，中国大陆测试厂商获得了良好的发展机遇，且全链条自主可控程度较高的测试厂商愈发受到青睐。

（2）集成电路测试服务的市场主要参与者

1）IDM 企业

IDM 企业完整覆盖了设计、制造、封装及测试全流程，通常以满足自身需求为主，测试产能规划服务于企业内部自身设计及制造的产品，在美国、欧洲、韩国、日本等地区市场占比较高。中国大陆集成电路产业各环节分工较为明确，产业模式以 Fabless 为主，IDM 企业数量较少。同时随着近年来集成电路制程不断演进，功能日趋复杂，测试环节的重要性、专业性愈发凸显，所需资金及研发投入也不断增加，越来越多的 IDM 厂商、晶圆制造企业将测试需求交由专业测试企业完成，进一步助推了独立第三方测试业务的发展。

2) 封测一体厂商

封测一体厂商通常以集成电路封装为主要业务，并相应提供配套测试服务，其既是测试服务的提供方、也是测试服务的需求方，与第三方测试服务企业形成功能互补，是集成电路测试服务市场的参与者之一。

具体而言，晶圆测试及成品测试通常与封装环节相对独立，封测一体厂商往往专注于封装环节及工艺，配置的测试产能通常与自身封装产能绑定，承接第三方测试服务的产能冗余较为有限，同时测试能力也往往与封装的产品类型高度相关，难以完全覆盖包括射频、算力、汽车电子、存储芯片等多种类型集成电路的测试需求，往往将部分测试需求交由第三方测试服务商完成。部分芯片设计厂商出于测试独立性考量，亦会将封装环节、测试环节交由不同厂商完成。封测一体厂商与第三方测试服务厂商一起在产业链中形成了功能互补，共同覆盖不同产品、不同客户的多元化测试需求。

3) 第三方测试服务企业

第三方测试服务企业专注于晶圆测试及成品测试业务，是行业内专门从事集成电路测试业务的参与方，凭借其独立于晶圆代工、芯片封装环节进行测试的客观性、专业性的特点，往往受到芯片设计企业的青睐。根据中国台湾《2024 半导体产业年鉴》，全球最大的第三方测试服务企业京元电子来自芯片设计企业的收入占比约为 76%，芯片设计企业为主要的测试需求方。同时，第三方测试服务企业具有广泛的可测试产品范围、专业化的测试能力和充足的测试产能，亦能承接部分封测一体企业、晶圆制造业务、IDM 企业的测试需求。

4) 晶圆代工企业

晶圆代工企业为满足自身生产验证需要，通常会配置用于晶圆接受测试（WAT）的测试产能，亦可能具有部分晶圆测试等后道检测能力用于特殊测试需求和产品导入。但晶圆代工企业通常以晶圆制造为主要方向，测试可选平台相对较少、测试成本较高，对于超过晶圆代工企业测试能力及产能的测试需求，通常会交由独立第三方测试或封测一体企业来完成。

（3）第三方集成电路测试模式的优势及合理性

1）深耕测试领域，具备技术专业性和服务灵活性优势

第三方集成电路测试企业以测试为核心业务，无需考虑封装、制造环节的资金、人员和资源投入，能够聚焦测试领域并形成深度积累，适配高度复杂的测试需求，适配各类国产芯片制造及检测工艺的催熟，并对新型技术进行快速响应，具备显著的技术专业性和服务灵活性优势。

如面对算力芯片、车规级芯片、射频芯片、存储芯片等领域的差异化测试需要，以及 Chiplet、2.5D、3D 封装等先进封装形式带来的测试技术迭代要求，能够进行设备及方案的快速适配。由于无需像封测一体厂商等其他市场参与者一样考虑大规模量产配套，面对小批量、多品种的测试需求，第三方集成电路测试企业对各类型客户及测试需求均具有灵活的测试服务能力。

2）覆盖量产阶段测试全流程，且测试结果独立客观

第三方集成电路测试企业能够提供量产阶段关键节点的全流程测试服务，覆盖各类型产品的晶圆测试、成品测试类别；而封测一体企业往往专注于与封装配套的成品测试领域，晶圆代工厂商则主要着眼于晶圆测试环节。第三方集成电路测试企业能够提供量产阶段全链条测试服务，客户无需对接多个环节供应商。

同时，由于第三方测试企业不从事设计、制造、封装环节，能够保持必要的独立性，对设计方具有独特的产业价值。与之相对应的，封测一体企业由于以封装业务为主，对于产业链上的其他参与方而言，在测试结果的中立性和客观性上可能存在一定局限性。集成电路测试的目的是对设计环节、晶圆制造环节、封装环节的工作成果进行评价与反馈，测试的可靠性对于应用效果具有直接影响。为保障测试结果的独立客观，第三方测试企业往往更容易获得客户信赖；在算力芯片、车载芯片等可靠性要求较高的芯片领域，第三方测试企业独立、客观的优势也会得到进一步凸显。

3）符合行业分工趋势，且相关模式已在成熟市场经过验证

集成电路产业链的分工细化是技术复杂度提升与成本优化的结果，第三方集成电路测试服务在这种背景下应运而生、不断发展。一方面，制程工艺的演

进和先进封装技术的发展带来了芯片及对应的测试复杂程度的快速提升，测试环节专业性的重要程度日益凸显；同时，集成电路测试对于测试设备等固定资产投资要求较高，专业测试厂商能够通过规模效应达成整体产业链成本与效率的最优解，符合行业分工的趋势和优势。

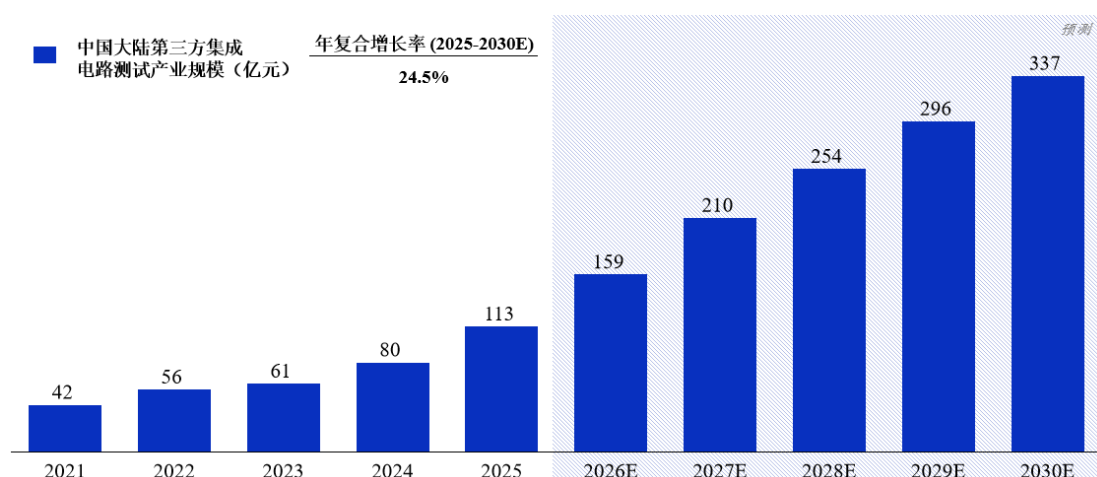
第三方集成电路测试模式最早在中国台湾产生，以京元电子为代表的测试企业已经过近四十年发展，并在规模、技术等方面居于全球领先地位，相关业务模式已经过成熟市场充分验证。近年来，随着中国大陆集成电路产业的发展，包括发行人、伟测科技、利扬芯片等一系列第三方测试企业不断涌现，大陆地区测试服务市场快速成熟与发展。

（4）第三方测试服务的市场规模情况

随着集成电路产业专业化分工的进一步发展，在测试环节除传统的“封测一体化”商业模式之外，专业性、独立性更具优势的第三方集成电路测试模式快速发展。一方面，制程工艺的演进和先进封装带来了芯片及对应的测试复杂程度的快速提升，测试环节的专业性已经逐渐成为产业瓶颈之一；同时，集成电路测试对于测试设备等固定资产投资要求较高，专业测试厂商能够通过规模效应达成整体产业链成本与效率的最优解，符合行业分工趋势。

根据灼识咨询数据，2025 年度境内第三方测试产业规模约为 113 亿元，占集成电路测试服务整体市场规模的比例达到约 26%，且随着行业专业分工的不断深化，市场规模及占比预计将持续提升。到 2030 年度，第三方测试产业规模预计将进一步增长至 337 亿元，2025 年至 2030 年复合增长率约为 24.5%。

图：中国大陆第三方集成电路测试产业规模



数据来源：灼识咨询

4、集成电路测试行业发展趋势

（1）行业自主可控需求增长，供应链本土化持续推进

根据海关总署数据，2025 年度我国集成电路进口金额为 4,244 亿美元，位列所有进口商品第一，且进出口逆差 2,225 亿美元，行业对外依存度较高。随着近年来国际贸易形势快速变化，地缘政治风险不断累积、蔓延，各类贸易限制与技术管控持续威胁我国集成电路产业安全，尽快实现行业自主可控具有重要性和紧迫性。各级主管部门也出台了一系列产业、税收、人才、研发等方面的政策和激励措施，积极鼓励和推进集成电路行业自主可控以及供应链的本土化进程。

与此同时，中国作为全球最大的集成电路消费市场，供应链的本土化有助于降低集成电路物流运输成本、缩短产品交付周期，有利于市场效率的提升和成本的优化。近年来我国本土化集成电路设计、生产业务规模快速增长，并进一步带动了境内测试需求。根据中国半导体行业协会数据，我国集成电路制造行业规模已从 2020 年的 2,560 亿元快速增长至 2025 年的 5,226 亿元。随着境内集成电路产能的快速扩张，测试、封装等一系列需求也将随之增长，并将进一步加速集成电路供应商的本土化进程。

（2）行业分工不断深化，与成熟市场相比大陆地区头部测试企业市场份额仍有较大提升空间

集成电路量产环节测试服务的提供方包括第三方测试企业、封测一体企业、晶圆代工企业以及 IDM 模式企业等。其中，晶圆代工企业和 IDM 模式企业测试服务以服务内部晶圆或芯片产能为目标，通常不对外提供测试服务。封测一体厂商主要资金和资源投入方向面向封装业务，测试业务主要为自检性质的配套服务，仅第三方测试服务厂商专注于测试环节，能够根据需求提供多种类型的测试服务。

随着集成电路制程工艺的演进和封装形式的复杂化，测试环节的技术要求持续提高，行业分工不断深化。第三方测试服务厂商能够将资金、生产资源及研发投入专注于测试环节，快速响应市场需求并通过规模化测试降低单颗芯片的测试成本；与此同时，该类厂商作为独立于设计、制造及封装环节的第三方机构，能够更加中立、客观地反馈测试结果，对芯片设计公司深具产业价值，IDM 企业等其他市场参与方亦会根据需求和产能安排将测试业务交由第三方企业完成。第三方测试服务模式逐渐兴起。

与中国台湾等集成电路产业相对成熟的区域相比，中国大陆集成电路产业专业化分工发展时间较短，第三方测试服务市场规模仍有较大提升空间。中国台湾主要第三方测试服务企业京元电子、矽格、欣铨 2025 年度集成电路测试相关收入规模分别约为 75 亿元、32 亿元和 31 亿元人民币（按照人民币兑新台币 1:4.5 折算），根据中国台湾工研院市场规模数据测算，合计接近中国台湾测试市场规模的约 30%；境内地区主要企业伟测科技、利扬芯片及发行人 2025 年度集成电路测试相关收入分别为 14.95 亿元、5.78 亿元和 20.33 亿元，占境内测试业务市场规模的比例仅为约 10%，远低于中国台湾，预计行业内头部企业仍有较大发展空间，行业集中度有待进一步上升。

（3）先进封装逐渐成为主流的集成电路封装方式，进一步带动测试需求扩容

先进封装技术包括圆片级封装（WLP）、2.5D 封装、3D 封装、Chiplet 等多种封装类型，能够将不同芯片进行统一封装、整合，在不进一步提升芯片制程

的前提下实现芯片的小型化、轻薄化、集成化，已成为“后摩尔时代”提升芯片整体表现的最佳选择之一。与此同时，随着人工智能、5G、汽车电子、高端消费电子等领域的快速发展和对高性能芯片需求的提升，先进封装市场规模快速增长。根据 Yole 数据，先进封装方式占全球封测市场的份额呈现持续增加态势，预计将从 2022 年的 47% 提升至 2028 年的 55%。根据公司公告等公开信息，境内主要封装企业长电科技、通富微电、天水华天等企业亦在持续布局先进封装产能、多维先进封装技术，预计先进封装将逐渐成为集成电路的主流封装方式。

先进封装的高度集成化也进一步提升了芯片测试的复杂程度。测试厂商需要解决多芯片协同测试带来的故障定位困难、测试需求冲突，高密度封装带来的测试接口限制，高功耗密度带来的热测试复杂性等一系列问题，测试从“单芯片级”向“系统级”跨越，对测试厂商的技术研发能力、产业链协同能力提出了进一步要求。

（四）行业技术水平及技术特点、进入壁垒、面临机遇与风险、周期性特征

1、行业技术水平及技术特点

近年来随着芯片复杂度、集成度的持续演进，集成电路测试行业对于测试的专业性要求不断提升，逐渐呈现出软硬件深度协同、产品适配性要求高等技术特点。同时，随着境内测试厂商测试能力的不断提升，集成电路测试已成为支撑国产芯片自主可控的重要节点之一。

在软硬件深度协同方面，晶圆测试、成品测试需要具备硬件升级改造能力，并基于测试设备及定制化测试治具搭建专业的测试环境，同时还需要具备测试解决方案及软件开发能力，实现对硬件的有效协同利用，构建从测试方案导入、测试流程管控到测试数据分析的完整软件解决方案。在产品适配性要求方面，由于芯片类型及测试需求差异较大，且国产芯片制造及封装工艺近年来呈现快速迭代趋势，测试企业需要与集成电路设计企业深度协作，对定制化测试需求及制造工艺的发展实现快速适配，提供稳定的测试服务。

2、行业进入壁垒

（1）技术能力壁垒

集成电路测试行业具备典型的技术密集型特征，业务开展对于测试方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化等方面的技术水平均具有较高要求，且需要长期的行业积累。同时，随着境内集成电路产业国产化进程的快速推进，集成电路工艺制程水平、封装形式不断迭代，产品应用领域也不断扩展，高性能 SoC、高端算力、车载芯片等前沿、复杂产品测试需求持续增长，对集成电路测试厂商的技术水平、行业经验以及根据测试需求快速研发、适配的能力提出了较高要求。

行业内新进入的企业通常难以快速掌握集成电路测试的全流程技术并具备大规模量产和产品适配的能力，行业具有较为显著的技术壁垒。

（2）人才壁垒

集成电路测试涉及微电子、机械、材料、软件工程等多个交叉领域，要求行业内企业具备多学科、高素质的复合型人才，以适应持续发展的集成电路测试需求，及时跟进集成电路生产、封装和应用的前沿技术动态。同时，在研发、管理、生产、市场等不同业务领域，公司亦需要针对性地对人才进行储备和培养。是否具备充足的专业人才队伍将很大程度上决定企业的持续发展能力。

目前，境内集成电路测试行业仍处于快速发展阶段，行业内高素质人才仍相对短缺，新进入企业通常难以及时充分地吸引、培养和打造适配的专业人才队伍，具有一定的人才壁垒。

（3）客户认证与协同壁垒

集成电路产业链中，客户通常对于测试供应商的服务能力、稳定性及效率等具有较高要求，且由于测试环节的复杂性和国产芯片的特殊发展阶段，产业链协作、催熟和共同成长造成的先发优势和相互粘性，对新参与者进入产业链构成较大影响。对于车载等具备特殊要求的芯片，测试供应商通常还需要取得 ISO 26262、IATF 16949 等汽车行业相关体系证书。在集成电路测试业务开展过程中，测试供应商亦需要与客户开展测试数据对接、工艺协同与匹配等系列工作，替换或新增测试供应商具有较大时间、资金成本以及产业链风险，客户通

常倾向于与供应商形成长期、稳定的合作关系。行业内新进入企业通常需要较长的时间和相较于现有企业更大的投入、更好的时机才能够取得客户认可并开展业务，行业具有较高的客户认证和协同壁垒。

（4）资金壁垒

集成电路测试对于行业内企业的资金投入规模具有较高要求。一方面，集成电路测试对于测试设备、场地条件等要求较高，设备购置、场地建设资金需求较大；另一方面，行业技术更新迭代速度较快，对于企业持续的研发及人才投入也提出了较高的要求。行业整体具有一定的资金壁垒。

3、行业面临的机遇与风险

（1）行业发展面临的机遇

1）国家政策持续发力护航，行业发展迎来良好机遇

近年来，国家持续鼓励和支持集成电路产业发展，连续出台了一系列产业政策，为行业发展带来了良好的机遇。2020年7月，国务院出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，明确集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，旨在进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境。2024年7月，二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，明确抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化包括集成电路在内的重点产业链发展体制机制。一系列产业规划、财税减免、投融资引导等领域的政策法规为集成电路测试行业的发展提供了充分的保障和支持。

2）产业链自主可控需求不断攀升，带动测试需求扩大

集成电路产业作为支撑社会经济发展和保障国家产业安全的战略性、基础性和先导性行业，已成为国际产业竞争的关键领域。与此同时，随着国际间各类型技术限制和制裁措施的出台，该领域全球分工的产业模式受到威胁，自主可控的需求不断攀升。

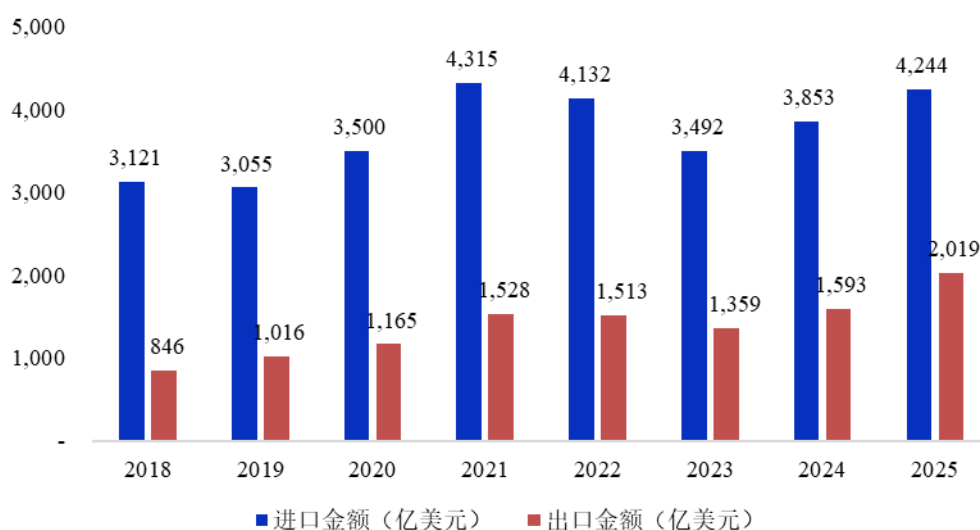
目前，我国集成电路产业经过多年发展和长期的政策支持，设计、制造、封装等领域已取得长足进步。根据中国半导体行业协会数据，2025年度我国集

成电路设计业、制造业及封测行业规模分别为 8,261 亿元、5,226 亿元和 3,844 亿元，整体规模持续增长。同时，国内封装企业已具备多种先进封装形式的产业能力，相关产业链环节的发展带动了集成电路测试需求的不断增加。基于国产化设备及供应链提供测试服务的供应商凭借其自主可控优势、本地化的快速响应能力，受到愈来愈多客户的青睐，测试市场规模不断扩大。

3) 进口依存度仍相对较高，行业进口替代空间广阔

在市场需求持续增长的背景下，我国集成电路目前仍存在较高的进口依存度，进口替代空间广阔，并将为集成电路测试服务带来进一步的市场需求。根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路行业市场规模已从 2015 年的 3,610 亿元快速增长至 2025 年的 17,331 亿元，年均复合增长率为 16.99%，在全球集成电路产业链中重要性愈发凸显。与此同时，根据海关总署统计，2025 年度我国集成电路进口金额为 4,244 亿美元，位列所有进口商品第一，且进出口逆差 2,225 亿美元，行业对外依存度较高。随着境内集成电路测试企业技术的不断突破，以及境内设计、制造、封装等产业环节的增长和对配套测试服务的需求，预计集成电路测试行业将具有广阔的进口替代空间。

图：2018-2025 中国境内集成电路进出口情况



数据来源：海关总署

4) 新兴领域芯片需求快速增长，推动测试行业规模扩张

随着产业技术水平的进步和应用场景的拓展，以 AI 算力、辅助驾驶、5G

等为代表的新兴领域兴起带来了芯片需求的快速增长，并进一步推动了测试行业的扩张。近年来，生成式 AI 技术的爆发带动了巨量的算力需求增长，各类计算芯片需求数量也随之快速增加；汽车产业向电动化、智能化的转型也带来了辅助驾驶、车载信息娱乐系统等各类型车规级芯片的需求爆发；5G 技术的持续普及也带来了射频、高性能 SoC 等芯片需求的增加。上述新兴领域的快速发展带动了测试行业总量的提升。

与此同时，新兴领域芯片通常具有较高的复杂度和先进的封装工艺，测试环节的难度及重要性愈发凸显，具有较强测试技术能力并能够快速适配国产工艺进步的测试厂商能够取得较大优势，同时测试时间、测试项目复杂度的提升亦带来了测试费用的提高，预计新兴领域芯片需求的增长将进一步带动行业规模扩张。

5) 境外独立第三方测试企业难以长期扎根大陆市场，为本土企业发展创造机遇

中国台湾的独立第三方测试模式发展较早，其中京元电子、矽格、欣铨等代表性企业在规模、技术、市场份额等方面在全球及大陆市场具有先发优势和领先地位。近年来，随着国际贸易摩擦的加剧，台资测试厂商愈发重视产能的多元化布局，难以长期深耕中国大陆市场。其中，京元电子已将其持有的大陆地区主要生产主体的股权全部出售；矽格、欣铨来自中国大陆的收入规模则较为有限，且发展相对缓慢。随着中国大陆集成电路行业的快速发展，台资独立第三方测试企业无法完全满足持续增长的测试需求，为本土企业的发展提供了较大机遇。

（2）行业发展面临的挑战

1) 现有企业测试装备进口依存度通常较高，产业链稳定性存在隐患

我国集成电路装备相关领域起步较晚，境外测试装备企业市场份额整体较高。现有测试企业往往基于较少数量的境外厂商的测试平台开展集成电路测试业务，在高端探针卡等测试治具方面亦存在较高对外依存度。近年来，全球产业链稳定性不断受到挑战，中国大陆集成电路产业受到国际贸易争端和多重技术封锁影响，如行业内企业测试装备获取受到限制且短期内无法找到有效替代

方案，则可能会对集成电路测试行业整体发展造成影响。

2) 高端专业人才供给不足

集成电路测试行业具备典型的人才密集型特点，不仅需要了解芯片设计、制程工艺的技术性人才，亦需要精通测试设备操作、测试方案开发的专业人员。与中国台湾、韩国等集成电路产业发展较为成熟的地区相比，中国大陆集成电路测试，尤其是独立第三方测试行业起步较晚，缺乏具有完善知识储备、丰富技术经验的高端专业人才的充足供给，已成为制约行业发展的重要因素之一。

4、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

报告期内，发行人所处行业技术水平及特点、行业主要进入壁垒、行业面临的机遇与风险、行业的周期性特征等未发生重大变化，预计未来一段时间仍将呈现上述特点。

（五）发行人所处行业在产业链中的地位和作用、与上下游行业的关联性

公司专注于第三方集成电路测试服务，行业主要测试服务内容包括晶圆测试、成品测试等，能够确保芯片良率、控制制造成本以及指导工艺改进，在产业链中具有重要地位。就国内集成电路测试环节而言，其上游行业主要为测试设备及治具等生产商，下游客户主要为芯片设计企业，也包括少量封装企业等。

1、发行人所处行业与上游行业的关联性、所处地位及作用

发行人上游行业主要为测试设备及治具等生产商，包括测试机、探针台、分选机等测试专用设备，以及探针卡、测试座等一系列测试治具。境外设备及治具等生产商由于起步较早，具备一定先发优势，市场份额整体较高；近年来，国产设备及治具生产厂商快速崛起，为产业链的自主可控提供了保障。

发行人致力于打造自主可控的集成电路测试产业链，开展集成电路测试业务以来即与国产测试设备厂商积极合作并大规模投入测试量产，加速了国产测试设备的成熟与迭代，深度参与了国产集成电路产业链的构建与催熟。

2、发行人所处行业与下游行业的关系、所处地位及作用

发行人行业下游主要为芯片设计企业，也包括少量封装企业等具备测试需求的产业链参与方。随着芯片设计与工艺的持续迭代和先进封装的逐渐普及，

芯片的复杂度不断提升，下游客户愈发需要通过集成电路测试在晶圆制造、封装等环节把控良率，避免不合格产品流入产业链下一环节。集成电路测试厂商已成为不可或缺的行业参与方。

发行人凭借全流程测试能力，在新工艺量产初期为产品良率和工艺可靠性改进提供了丰富而有益的测试数据、缺陷定位信息，为国产集成电路产业链提供了“验证中心”，亦为下游客户提供了自主可控的国产化产业选择。

（六）行业竞争格局及行业内主要企业、发行人市场地位、竞争优势与劣势及与同行业可比公司的比较情况

1、行业竞争格局

（1）行业整体竞争情况

集成电路测试行业的参与方主要包括第三方测试企业、封测一体企业。行业发展早期，测试服务主要由封测一体企业的测试部门对外提供，随着芯片密度和封装复杂程度的提升，测试难度逐渐提高，产业链对于专业性的要求不断增加；同时，相较于封测一体模式，芯片设计厂商往往需要更具独立性的第三方测试企业进行良率及质量把控，独立第三方测试模式逐渐兴起并快速发展，第三方测试企业市场规模及份额占比呈现逐步上升态势。

目前，中国大陆独立第三方测试占测试市场整体规模的比例已逐步增加至2025年度的约26%；与此同时，中国台湾仅最大的三家独立第三方测试企业占测试市场整体规模的比例已接近30%¹。与成熟市场相比，中国大陆独立第三方测试模式仍有较大增长空间，预计市场份额仍将保持持续增长态势。

（2）第三方测试企业竞争情况

独立第三方测试模式发源于中国台湾，其中，京元电子、欣铨、矽格三家企业规模较大，专注于全球测试需求。中国大陆第三方测试企业起步较晚，目前行业内测试企业主要包括朗迅科技、伟测科技（688372.SH）、利扬芯片（688135.SH）等本土企业，以及京隆科技（原京元电子在中国大陆子公司）等由境外测试厂商在中国大陆设立的企业，行业整体处于快速发展阶段，集中度相对较低。

¹市场占比系根据中国台湾工研院市场规模数据及相关企业公开信息测算

2025 年度，发行人集成电路测试业务收入为 20.33 亿元，在境内第三方集成电路测试服务的市场份额约为 18%，市场份额较高。根据集成电路测试业务收入统计，公司已成为最大的内资第三方集成电路测试企业。

2、主要竞争对手情况

全球主要的独立第三方测试企业介绍如下：

（1）京元电子（2449.TW）

京元电子股份有限公司成立于 1987 年，总部位于中国台湾，主要从事集成电路测试业务，服务项目包括晶圆测试、成品测试、老化测试及其他项目等。根据其官网披露数据，京元电子是全球最大的专业测试厂商。

（2）欣铨（3264.TWO）

欣铨科技股份有限公司成立于 1999 年，总部位于中国台湾，主要提供晶圆测试服务及成品测试服务，根据其年度报告等信息，其测试产品主要运用于电脑、通讯、消费电子产品、一般性工业产品、汽车电子以及资讯安全产品等各项商品市场，是全球主要的第三方测试服务厂商之一。

（3）矽格（6257.TW）

矽格成立于 1988 年，总部位于中国台湾，主要业务包括集成电路测试服务、先进晶圆级封装服务。矽格提供专业的晶圆和成品测试服务，覆盖逻辑、混合信号、射频、存储、电源等等领域；封装服务包括晶圆级封装、晶圆凸块、覆晶封装、窗型栅式数组封装等。

（4）伟测科技（688372.SH）

伟测科技成立于 2016 年，总部位于上海市。公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。

（5）利扬芯片（688135.SH）

利扬芯片成立于 2010 年，总部位于广东省东莞市，主营业务包括集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方专业测试

服务，产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域。

3、发行人竞争优势和劣势

（1）竞争优势

1) 自主可控的产业链优势

行业内主要集成电路测试厂商长期基于较少数量的境外厂商的测试平台进行测试工艺开发和测试量产，业务运行及客户选择可能受到国际政治和贸易摩擦影响，测试产业链自主可控程度相对较低。公司开展集成电路测试业务以来即与国产测试设备、测试治具厂商开展密切合作，并在此基础上进行测试技术开发、测试量产导入，构建了自主可控的产业链条。同时，公司与产业链上下游企业开展深度合作，共同推进国产测试产业链测试能力迭代，推动集成电路产业的国产化进程。目前，公司在晶圆与成品芯片测试尺寸、最高 Pin 数、测试温度范围、高速信号测试等测试技术水平，测试自动化水平、测试产品覆盖范围等领域均已达到行业先进水平。

2) 产能规模优势

随着集成电路国产化进程的持续推进，以 AI 算力、手机 SoC 等为代表的高端芯片集成电路测试需求快速攀升，充足且技术领先的测试产能是承接客户测试需求的基础条件。公司构建了最高可达十级无尘的测试产线，并设立了杭州芯云、诸暨芯云、杭州芯云海、诸暨越芯、杭州芯光等多个集成电路测试主体，并与 D 公司等国内知名设备供应商开展深度合作，形成了深厚的设备与产能积累。

3) 贴近集成电路产业链的区位优势

中国集成电路产业在长三角地区聚集效应显著，具有相当数量的芯片设计、晶圆制造及封装头部企业，集成电路测试需求旺盛。公司总部位于浙江省杭州市，同时在上海、诸暨、苏州等地设立了子公司，能够毗邻前段晶圆生产、芯片封装产业环节，降低运输制造成本，提升了公司的综合竞争力。受益于长三角地区较高的产业聚集度，公司亦能够更好地招揽、组建具备丰富产业经验的人才团队。

同时，与境外集成电路测试服务企业相比，公司能够快速响应芯片设计企业等客户的业务需求，实现产品快速导入和技术迭代，大大增加了客户黏性，能够更为全面地覆盖境内集成电路产业的主要参与者。

4) 技术与研发优势

公司是国内领先的集成电路测试综合服务商，聚焦自主可控的国产集成电路测试供应链，具备基于国产化平台的全流程软硬件测试开发能力，掌握了覆盖测试方案与产品导入、测试系统开发与数据分析、测试设备改造升级、测试工艺与流程改进、测试治具设计技术等领域的核心技术体系，目前测试能力与技术水平已整体达到行业先进水平，测试产品覆盖消费电子、AI 算力、汽车电子、射频通讯等前沿及主流领域，在集成电路测试领域实现了有效的国产化替代。

公司自集成电路测试业务开展以来即立足国产化测试平台及供应链，持续开展技术研发，技术积累雄厚，并组建了具备丰富产业经验的资深研发工程团队。公司荣获国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业称号，设立了省级博士后工作站，并被评为浙江省首批制造业单项冠军企业，朗迅科技、子公司杭州芯云亦荣获浙江省科学技术进步二等奖。

5) 专业人才优势

集成电路产业属于人才、技术密集型行业，对于从业人员专业素质、经验积累具有较高的要求，在国产化芯片产业快速发展的背景下，要求测试人员能够对前沿制程、先进封装技术带来的更高测试需求做到快速响应与技术迭代。公司在长期的技术投入与产业实践中，组建了资深的研发工程团队，核心团队拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发与量产导入、测试产线自动化管理等有着丰富的理论和实践经验，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先的洞察力。同时，公司高度重视研发人才的培养与引进，强大的研发技术团队保障了公司在技术方面的领先地位。

6) 专业化分工优势

公司专注于第三方集成电路测试服务。与封测一体厂商相比，专业测试厂商专注于测试环节及相应的测试技术研究、测试方案开发、测试数据的收集与

分析等，在产能调配上更为灵活。同时，专业测试厂商在测试结果的客观性、中立性上具备产业角色优势，受到产业链的重视和青睐。

（2）竞争劣势

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司集成电路测试设备购置、测试场地建设、人才储备及扩充、研究开发能力提升等均需要大量的资金。公司目前的融资渠道较为单一，主要依靠自身经营积累、银行贷款及股东投入等。随着市场规模的扩展和公司业务的持续增长，有限的融资渠道难以满足公司生产经营和未来发展的资金需求，已成为公司的主要竞争劣势。

4、发行人与同行业上市公司的比较情况

发行人专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。目前 A 股市场中以第三方集成电路测试业务为主营业务，且具有一定规模的公司主要包括伟测科技、利扬芯片。上述公司在经营情况、市场地位、技术实力等方面与发行人的比较情况如下所示：

企业名称	主营业务	2025 年度 营业收入 (万元)	专利数量
伟测科技 (688372.SH)	晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务	157,464.24	发明专利 19 项
利扬芯片 (688135.SH)	集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务	61,839.44	发明专利 51 项
平均值		109,651.84	发明专利 35 项
发行人	专注于第三方集成电路测试业务，为国产自主可控芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）及相关测试配套服务	206,430.25	境内发明专利 42 项，境外发明专利 1 项

2025 年度，发行人已实现营业总收入 20.64 亿元，其中集成电路测试业务收入 20.33 亿元，在内资第三方集成电路测试服务企业中排名第一，经营规模较大。

5、发行人的市场地位

公司是最大的内资第三方集成电路测试企业，深耕第三方集成电路测试业务，深度参与集成电路国产化的历史进程，在时代浪潮中实现了长足发展。近

年来，集成电路产业国产化进程快速推进，2023 至 2025 年度，公司已成为内资第三方集成电路测试领域前五名中增长最快的企业，三年主营业务复合增长率超过 100%。2025 年度，发行人集成电路测试业务收入为 20.33 亿元，在境内第三方集成电路测试服务的市场份额约为 18%，市场份额较高。

（七）引用第三方数据情况

本招股说明书引用的第三方数据主要来源于全球半导体贸易协会、中国半导体行业协会、灼识咨询、Yole、IDC、国家工信部、海关总署等，相关行业数据并非专门为本次发行准备。

三、销售情况和主要客户

（一）主要服务规模情况

公司主要提供包括晶圆测试、成品测试在内的第三方集成电路测试服务，公司按产品的测试工时向客户收取测试费用，获得测试收入。报告期内，公司晶圆测试和芯片成品测试的理论产能、实际产能及产能利用率情况如下：

项目	期间	理论产能 (万小时)	实际产能 (万小时)	产能利用率
晶圆测试	2025 年度	151	133	88%
	2024 年度	75	59	78%
	2023 年度	38	32	83%
成品测试	2025 年度	169	129	76%
	2024 年度	114	84	73%
	2023 年度	72	47	66%

注 1：理论产能总工时=Σ（各月测试平台数量*24 小时*当月天数）*90%-研发用时。其中，测试平台在运转过程中存在产品切换耗时、检修维护耗时等因素，故以 90%计算。

注 2：FT 为成品测试的核心环节，成品测试的理论产能、实际产能以 FT 环节的工作小时数作为代表，未包括 BI、SLT 等。

报告期内，公司业务规模持续快速增长，理论及实际产能不断爬升，晶圆、成品测试产能利用率整体处于较高水平。其中，2023 年度芯片成品测试产能利用率相对较低，主要系公司业务处于快速增长期，公司对于未来成品测试需求进行了前瞻性布局，产能提升较快；同时，2023 年诸暨芯云厂区产能建设基本完成，但受下游产品推出时间较晚影响，产能利用率相对较低。2024 年度和

2025 年度，公司晶圆测试、成品测试产能利用率整体均处于较高水平。

（二）产品或服务的主要客户群体、销售收入及价格的总体变动情况

报告期内，公司主营业务收入为集成电路测试业务，包括量产测试业务和工程测试服务业务，其中量产测试业务包括晶圆测试（CP）和成品测试（FT）。发行人主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	97,895.60	48.14%	53,404.88	51.46%	24,171.98	49.87%
	CP	61,731.51	30.36%	25,517.79	24.59%	13,189.12	27.21%
	小计	159,627.11	78.50%	78,922.67	76.05%	37,361.10	77.07%
工程测试服务		43,715.47	21.50%	24,856.34	23.95%	11,112.72	22.93%
合计		203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

报告期内，公司主营业务收入客户群体以境内半导体产业参与者为主，主要为芯片设计、封装测试厂商等。报告期内，公司主要业务销售单价的变动分析参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八/（一）营业收入分析”。

（三）主要客户销售情况

报告期内，发行人前五大客户收入金额及其占比情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	业务类型	收入	占营业收入比例
2025 年度	1	A 公司	集成电路测试服务	191,100.91	92.57%
	2	B 公司	集成电路测试服务	4,580.30	2.22%
	3	C 公司	集成电路测试服务	2,991.17	1.45%
	4	博通集成	集成电路测试服务	2,802.55	1.36%
	5	盛合晶微	集成电路测试服务	1,285.02	0.62%
	合计			202,759.95	98.22%
2024	1	A 公司	集成电路测试服务	94,035.45	86.49%

年度	序号	客户名称	业务类型	收入	占营业收入比例
年度	2	B 公司	集成电路测试服务	5,748.22	5.29%
	3	博通集成	集成电路测试服务	2,638.81	2.43%
	4	青岛科创	集成电路产教融合软硬件装备	1,316.22	1.21%
	5	C 公司	集成电路测试服务	1,234.76	1.14%
	合计			104,973.46	96.55%
2023 年度	1	A 公司	集成电路测试服务	46,619.36	87.05%
	2	博通集成	集成电路测试服务	1,335.34	2.49%
	3	B 公司	集成电路测试服务	1,192.87	2.23%
	4	杭州弘翌科技有限公司	集成电路产教融合软硬件装备	809.78	1.51%
	5	深圳职业技术大学	集成电路产教融合软硬件装备	251.33	0.47%
	合计			50,208.68	93.75%

注：受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额，其中包括：

（1）博通集成合并口径包括博通集成电路（上海）股份有限公司、上海指极信息科技有限公司。

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 93.75%、96.55%和 98.22%。其中，来自 A 公司的收入分别为占比 87.05%、86.49%和 92.57%，公司业务对 A 公司的销售收入占比较高，主要受客户产业地位、下游市场竞争格局、行业及公司业务发展历程和发展阶段等因素影响。

报告期内，C 公司、盛合晶微、青岛科创新增成为发行人前五大客户。C 公司、盛合晶微主营业务为集成电路封装测试等服务，青岛科创主要从事教育基础设施的建设、管理与运营，向公司采购集成电路产教融合软硬件装备，报告期内开始与发行人进行合作并成为前五大客户。

报告期内，公司前五大客户中，博通集成电路（上海）股份有限公司持有公司 1.03%股权。除上述情形外，公司董事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方和持有 5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益或其他关联关系。

四、发行人采购情况和主要供应商

（一）设备、耗材供应情况

1、主要设备、耗材采购情况

报告期内，公司主要采购内容为测试设备、治具，具体采购情况如下：

单位：万元

类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
设备类	178,900.62	65.53%	151,649.03	73.03%	72,777.55	71.99%
治具类	77,537.50	28.40%	40,999.30	19.74%	24,176.21	23.91%
其他	16,550.27	6.06%	15,006.52	7.23%	4,142.86	4.10%
合计	272,988.38	100.00%	207,654.85	100.00%	101,096.62	100.00%

报告期内，公司采购的主要内容为测试设备和治具，占采购总额的比例分别为 95.90%、92.77%和 93.94%。公司设备采购包括集成电路测试使用的主要设备测试机、分选机和探针台等，以及相关的辅助设备及设备配件。报告期内，公司设备采购金额持续增长，主要受新增测试基地建设进度及产能扩张进度影响。治具采购主要包括集成电路测试所需的测试座、测试板、探针卡等。报告期内，随着测试业务品类及规模增长，发行人治具采购金额持续增加。其他类采购主要包括包辅材及耗材等。

2、主要设备采购单价

报告期内，公司主要测试设备包括测试机、分选机和探针台，其平均采购价格及其变动情况如下：

单位：万元/台

设备	2025 年度	2024 年度	2023 年度
测试机	607.50	617.99	515.18
分选机	183.90	173.39	149.18
探针台	151.33	153.31	160.43

报告期各期，公司各类主要采购设备的价格变动，主要受产品结构、供应商结构、采购规模等因素影响，具有合理性。

（二）发行人前五大供应商情况

报告期内，公司前五大供应商采购额及占比情况如下：

单位：万元					
年度	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例
2025 年度	1	D 公司	测试设备、测试治具	117,898.95	43.19%
	2	E 公司	测试设备	45,991.67	16.85%
	3	F 公司	测试设备	18,702.56	6.85%
	4	G 公司	测试治具	14,432.71	5.29%
	5	苏州法特迪科技股份有限公司	测试治具	13,476.31	4.94%
	合计			210,502.20	77.11%
2024 年度	1	D 公司	测试设备、测试治具	93,667.13	45.11%
	2	E 公司	测试设备	27,674.53	13.33%
	3	F 公司	测试设备	20,526.48	9.88%
	4	G 公司	测试治具	13,327.88	6.42%
	5	H 公司	测试设备	5,264.90	2.54%
	合计			160,460.92	77.27%
2023 年度	1	D 公司	测试设备、测试治具	43,167.88	42.70%
	2	E 公司	测试设备	19,192.94	18.98%
	3	G 公司	测试治具	9,442.27	9.34%
	4	F 公司	测试设备	7,368.82	7.29%
	5	强一半导体（苏州）股份有限公司及其关联方	测试治具	2,534.56	2.51%
	合计			81,706.46	80.82%

注：受同一实际控制人控制的供应商合并计算采购金额，其中包括：

（1）强一半导体（苏州）股份有限公司及其关联方合并口径包括强一半导体（苏州）股份有限公司、圆周率半导体（南通）有限公司。

报告期内，公司向前五大供应商采购内容主要为测试设备和治具，各类设备和治具的供应商总体较为稳定。随着业务规模的扩大，报告期内公司呈持续扩产态势，采购金额总体保持增长态势。D 公司是国产集成电路测试设备龙头企业之一，公司为保持产业链较高的国产化程度，测试机、分选机等主要设备主要向其采购，因此向其采购金额较大、占比较高。

报告期内，H 公司、苏州法特迪科技股份有限公司新增成为公司前五大供应商。H 公司、苏州法特迪科技股份有限公司在成为公司当期前五大供应商前已与公司形成了稳定的合作关系，新增成为前五大供应商主要系随着公司测试业务规模扩大，测试设备和测试治具的采购需求增加所致。

发行人、发行人的股东、发行人的董事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方均未在发行人前五大采购供应商中拥有权益，未与前五大供应商存在关联关系。

（三）主要能源供应情况

公司生产使用的主要能源为电力，能源供应持续、稳定。报告期内公司主要生产主体的电力采购情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电力采购金额（万元）	8,926.47	5,915.95	3,444.72
用电量（万度）	14,514.35	8,739.74	4,781.94
单价（元/度）	0.62	0.68	0.72

注：公司电力采购金额为主要生产主体的生产和经营电力耗用金额。

报告期内，公司电力采购金额及用电量随着业务规模增长而有所增加，均按照市场价格向当地供应单位购买，平均采购价格整体稳定、略有下降。

五、发行人主要资产情况

（一）主要固定资产

公司的主要固定资产包括房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具等，主要为集成电路测试设备和房屋及建筑物，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“十/（一）主要固定资产情况”。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	73,194.42	68,829.57	94.04%
专用设备	488,447.39	422,039.67	86.40%
通用设备	5,828.74	2,984.39	51.20%

项目	账面原值	账面价值	成新率
运输工具	974.70	493.86	50.67%
合计	568,445.25	494,347.48	86.96%

报告期内，公司业务规模持续快速增长，为满足产能需求的增加，公司投建新厂并购入较多新机器设备，因此公司房屋及建筑物、机器设备账面原值持续增加，成新率较高。

（二）主要无形资产

公司的无形资产包括土地使用权、商标、专利、集成电路布图设计、软件著作权、域名及经营资质等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 71 项商标、100 项境内授权专利、1 项境外授权专利、3 项集成电路布图设计、203 项软件著作权、7 项注册域名。具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“十/（二）主要无形资产情况”

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有的无形资产总体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	净值
土地使用权	8,796.76	314.29	8,482.47
软件使用权	1,831.41	967.30	864.10
合计	10,628.17	1,281.59	9,346.57

（三）各要素与所提供产品或服务的内在联系及其他情况

截至本招股说明书签署日，发行人所拥有的固定资产、无形资产等资源要素对发行人的经营发展起到支撑作用，具有充分性、适当性，上述资源要素中除 1 处生产辅助相关租赁建筑物未取得房屋权属证明、尚未办理房屋租赁备案外，其余各要素均不存在瑕疵；发行人主要资产均不存在纠纷或潜在纠纷，对发行人持续经营不存在重大不利影响。

经核查，上述瑕疵不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性法律障碍，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“十/（一）/2、租赁房屋建筑物情况”。

六、特许经营权

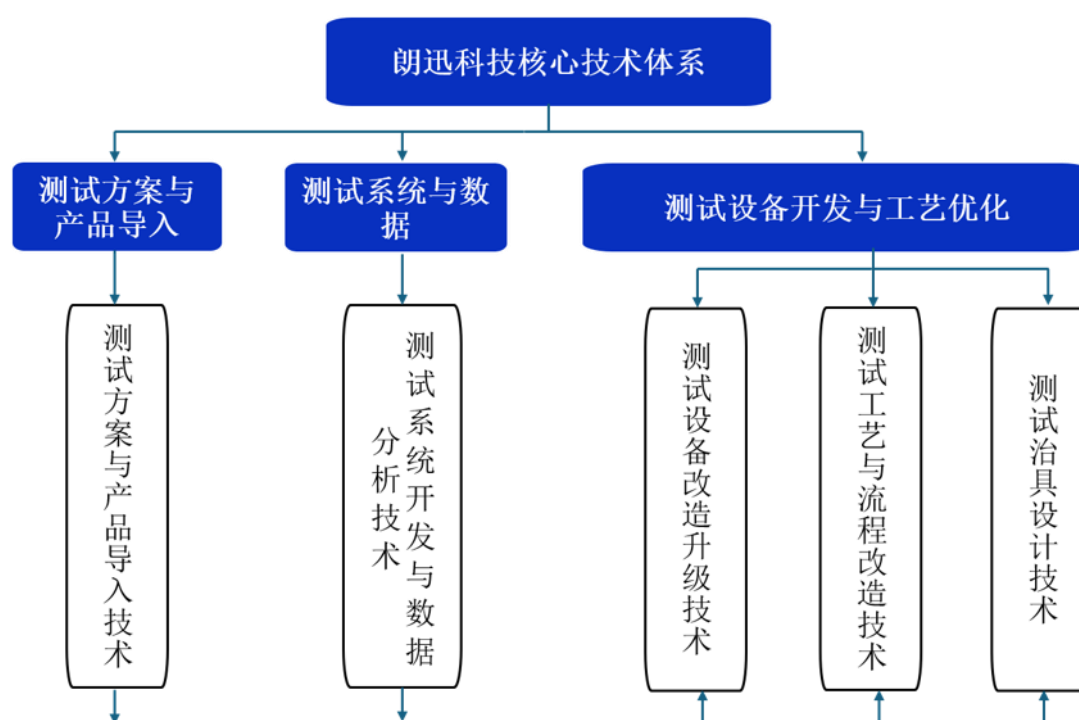
截至本招股说明书签署日，发行人未拥有特许经营权。

七、技术和研发情况

（一）主要产品核心技术

公司打造了涵盖测试方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化的核心技术体系，包括测试方案与产品导入技术、测试系统开发与数据分析技术、测试设备改造升级技术、测试工艺与流程改造技术、测试治具设计技术等领域，测试产品覆盖算力芯片、高性能 SoC、光学芯片、车载芯片、射频芯片、传感器芯片等前沿及主流类型，在集成电路测试领域国产化替代的过程中发挥了重要作用。

图：朗迅科技核心技术体系



依托多年深耕集成电路测试领域的产业实践与项目经验，公司深度扎根自主可控的国产集成电路生产制造体系，持续攻克国产化测试适配、工艺磨合、良率优化等系列难题，逐步探索、沉淀并总结出半导体测试领域的本土化技术经验。基于持续的技术创新研发与前瞻性产业战略布局，公司整合全链条技术资源，搭建起以全流程芯片测试技术为基础、智能化数据分析系统为核心的一

体化技术架构，构建出兼具适配性、稳定性与创新性的核心技术体系。该体系可精准适配主要国产高端芯片测试需求，有效打通产业链各环节的技术壁垒，推动国产半导体产业链深度协同、持续迭代催熟，为公司工程测试业务规模化发展、国产芯片产业化落地与技术升级筑牢核心技术根基。公司的核心技术主要情况具体如下所示：

技术大类	序号	技术名称	技术内容及先进性	技术来源	所处阶段
测试方案与产品导入技术	1	高性能 SoC 测试工艺解决方案	SoC 芯片结构复杂、监控指标多，且存在国产化初期良率波动大、先进封装易压伤芯片的问题，该方案： 1、通过自行开发的监控系统实时进行数据抓取与管控；2、通过制造执行系统管控测试工艺路线，并综合运用二维码识别、过站比对等方式进行防混、防呆管控；3、在测试工艺方案中进行专项设计，在多触点接触的情况下，实现气密性压紧和防止压伤芯片的平衡，并监控压力数据	自主研发	量产
	2	大功率算力芯片测试工艺解决方案	大功率芯片发热显著，测试过程分区域温控要求高，该方案： 1、基于质量管控标准自主设置并在线上系统添加 300 余条温度卡控标准，并通过系统进行线上监控；2、分区实现精确温控和温度补偿。公司对分选机浮动头温控方式及管控软件进行改进，分区监控并进行温度管理，通过分区的方式实现精确控制和温度补偿	自主研发	量产
	3	车载芯片测试工艺解决方案	车载芯片对可靠性与安全性要求、专用设备管控及失效分析能力要求较高，该方案： 1、针对车载产品针对性开发建立全流程、多系统联动的质量管控架构，对于车载产品的物料信息、操作站别、异常事项等进行独立标识、管理；2、对车载测试设备实行专用化管理与资质系统卡控。公司针对机台的可靠性、稳定性指标（如平均故障间隔时间、测试重复性及再现性、机台年份）等设置综合权重，筛选符合车规要求的机台，并通过改进生产管控系统，实现生产前系统自动验证机台资质，对于不符合车载要求的测试程序自动触发系统卡控及流程异常	自主研发	量产
	4	CIS 芯片测试工艺解决方案	CIS 芯片测试的光源一致性难把控、镜头透光率缺陷致测试失真，车间洁净度要求严苛，该方案： 1、建立内部控制规范，保证测试光源的均匀性、一致性，并形成对应量测治具； 2、采用线性传感器阵列，消除图像畸变。公司采用线性传感器阵列，通过与被扫描物体的相对运动来构建二维图像，避免了传统平面阵列测试镜头会产生的桶形或枕形畸变的问题，满足高精度检测需求；3、通过 Class 10 级无尘管控保障测试场地及环境洁净程度，通过高精度粒子监测设备，精准量测各种规格的颗粒物	自主研发	量产
	5	射频芯片测试工艺解决方案	射频芯片并行测试存在信号干扰、PCB 回路高频反射会降低测试灵敏度，该方案： 1、设计了交叉分组测试的方法，设置了两个相互交叉的待测射频芯片组，各组交替进行射频和 DFT（Design For Testability，可测试性设计）测试，通过交替执行实现干扰隔离与并行效率平衡； 2、设计了一种提高射频测试灵敏度的方法，通过优化射频回路、地线优化，以达到最大传输效率并减少干扰	自主研发	量产
	6	导航芯片测试工艺解决方案	导航芯片测试时多卫星信号输入的切换、卫星信号时间数据解码耗时较长，该方案： 1、设计了一种无需切换测试端口输出信号的测试方法，每个测试端口固定一种输出波形，通过移动待测芯片实现完整测试输入，避免各测试端口切换波形的时间损耗；2、统一配置时间参数的波形，将时间参数统一配置成 1KHZ 的正弦波，提升解码效率。	自主研发	量产

技术大类	序号	技术名称	技术内容及先进性	技术来源	所处阶段
	7	基于测试程序的 MD5 码卡控防呆方案	国产化初期测试程序迭代快，易因测试程序错误或误操作影响测试稳定性。该方案基于测试程序的 MD5 码开发了自动防呆管控程序。MD5 码是一种信息特征码，可以唯一地代表原信息的特征，公司自动防呆管控程序在程序版本更新、下载后自动进行 MD5 码校验，仅与客户端信息对比通过的程序方能够导入并开始测试，确保程序版本更新与下载的准确性，防止误操作	自主研发	量产
测试系统开发及数据分析技术	1	测试制造执行系统（MES）	集成电路测试涉及多维度生产协同，存在信息不透明、数据追溯复杂的问题，公司测试制造执行系统能够： 1、根据测试需要实现系统定制化与灵活化。针对集成电路测试行业的特点，系统内置了分 Bin 规则、Tooling 管理、Wafer 追踪等专业模块。支持可视化 workflow 配置，允许根据工艺需求自定义业务流程；2、与其他系统深度集成。制造执行系统与 ERP、设备管理、仓储管理等系统深度集成，实现订单及生产数据的实时同步和双向流动；3、通过实时生产监控和智能调度算法优化设备利用率及排产效率	自主研发	量产
	2	测试数据管理系统（TMS）及数据解析技术	不同测试平台数据格式不统一，且人工核对晶圆 Map 图易出错、海量数据管理困难： 1、公司设置了标准化的数据格式规范（STDF），统一了不同测试平台的数据生产格式；2、公司在测试站点出站时即进行测试过程数据与 Map 图的比较（如坐标、Bin 信息等），数据对比成功后方可出站进入后续质检、包装等站点；3、采用专业的大数据架构和数据仓库技术，对原始测试数据进行解析、压缩、并建立高效的索引	自主研发	量产
	3	测试过程监控及设备自动化系统（EAP）	测试过程的异常可能存在响应滞后、机台报警无法及时汇总处置等问题。 1、公司开发了实时数据解析系统，可动态分析并实现基于规则的实时停卡关机，防止问题扩大。 2、公司建立了异常自动化分级处理系统，通过多通道报警和向对应部门精准推送，提升故障响应效率	自主研发	量产
	4	晶圆图谱质量评估与数据修复技术	跨节点测试数据融合难、大尺寸晶圆测试数据易损坏且修复工作量较大。 1、公司开发了基于多源 Map 数据融合的晶圆质量评估工具。公司对不同批次、不同晶圆制造厂的芯片坐标进行标准化，并在此基础上进行跨节点的测试数据关联，生成综合性的质量评估结果，并支持各站点晶圆 Map 自动融合功能；2、开发支持超大规模晶圆数据的解析与修复算法。对于超大规模晶圆（如行列在 512 以上），公司能够自动识别数据异常，并自动解析每颗芯片的测试值，进行异常晶圆 Map 修复与芯片测试值修改	自主研发	量产
测试设备改造升级技术	1	小型全自动三温分选机设备	传统分选机体积大、占地多，不适用于空间受限场景；且应用于小批量测试时换型调试慢、成本较高。公司通过模块化设计，将分选机小型化、功能精简化，缩短调试周期，满足小规模测试需求。 1、公司聚焦工程批次、研发等小规模测试应用场景，在保证测试能力前提下，通过模块化设计和功能精简（如无需设置多个测试站别等），实现分选机小型化；2、小型分选机设备调试周期较	自主研发	量产

技术大类	序号	技术名称	技术内容及先进性	技术来源	所处阶段
			短，能够通过快速切换不同产品的工作档位，降低切换等待时间		
	2	自动化包装及外观检测平台	测试后包装环节的自动化程度低，包装一致性和准确性受限，易混料、漏包，且人力成本高。 1、公司在包装前新增视觉检测装置，通过识别二维码与外观，防止混料、漏包。公司在 Tray 盘（芯片托盘）打带、捆扎环节前新增了视觉检测装置，通过识别每颗芯片的二维码以及外观检测，来防止混乱、不合格品混入或包装遗漏；2、公司设计了包装环节的自动化打带、扎捆装置，提升包装阶段自动化水平，降低人力需求	自主研发	量产
	3	适配大功率芯片测试的双缸浮动形态分选机压头	传统分选机的测试压头结构简单，且温控能力较弱，难以适应大功率芯片对于测试压力、温度精确控制的要求。公司设计了一种双缸浮动形态分选机压头，通过改造常高温分选机使其适配大功率芯片测试需求。 1、开发具备内外缸结构的双缸压头，使得向待测芯片施加的压力能够在芯片功能区（内缸）和抗压导框（外缸）之间均匀分布，避免芯片损坏；2、改进浮动头温控装置，精确地控制测试环境中的温度，确保芯片在不同功率下都能保持在一个稳定的温度范围；3、优化浮动头上的水循环路径，提升冷却功率，支持更大功率的芯片测试	自主研发	量产
	4	反向击穿电压测试仪和测试设备	反向击穿电压测试通常需要输入较高的测试电压，并会对应产生较大电流，然而现有测试板卡在小电流下精度高，大电压、大电流下测试能力有限。 公司改进了测试方法，通过在正极串联大阻值电阻，有效减少测试电流，提升测量精度。具体而言，公司通过修改外围测试电路，在测量正极串联大阻值电阻，变相降低电源内阻，减少测试电流，提升测量精度	自主研发	量产
	5	烤箱水冷系统改造升级技术	晶圆测试烘烤环节需要长时间、高温加热（如 175℃），现有烤箱设备在散热能力、控制含氧量防止氧化方面存在不足。公司通过设计高效换热管组和改造循环系统，以及在晶圆测试过程中填充氮气，提升了散热效率，避免了晶圆氧化，具体而言： 1、采用不锈钢蛇形水冷管路（耐 350℃以上高温）延长冷却水停留时间，并在水管内壁设置梯形阻流条，扰动水流增强湍流效应，提升热交换率，防止高温变形；2、增加充氮功能，减少氧含量，构建一个氧含量在 20ppm 以下的烘烤环境，防止晶圆氧化	自主研发	量产
	6	测试机及探针台冷却气路改造技术	由于探针台和测试机的冷却管路通常互相独立控制，冷却不同步可能导致针卡结霜、机台振动报警，且需要管路数量较多。 公司通过重新设计气路及配套装置，实现设备同步冷却启停。具体而言，公司在探针台端新增同步控制管路并直连测试机，并改造测试机测试头结构及气路，实现由探针台统一控制双设备气路启停	自主研发	量产
	7	常高温探针台低温测试改造	常规的常高温探针台无法进行低温测试，且从高温切换至常温时降温慢。 公司通过更换三温卡盘、增加制冷装置以及改造气路水管，使常高温机台具备了低温测试能力。公	自主研发	量产

技术大类	序号	技术名称	技术内容及先进性	技术来源	所处阶段
		技术	司通过将晶圆卡盘更换为三温卡盘，并增加制冷装置，以及对卡盘气路、水管等进行系统化改造等方式，使得常高温机台具备低温测试能力		
测试工艺与流程改造技术	1	物料自动运输及上下料系统	晶圆测试、成品测试生产任务复杂，人工搬运上下料工作重复且易出错；老化测试上下料劳动强度大，且手动取放芯片有 ESD（静电放电）损坏风险。 1、公司开发了带机械臂的搬运装置，将生产机台、生产系统与自动导航车连接，通过机械臂实现自动上下料及运输；2、在老化测试站点，公司开发了独立的自动化上下料设备，能够实现测试板卡自动取放，且能够根据生产需要与不同的老化炉灵活搭配	自主研发	量产
	2	三温分选机压头钢片全自动预压平台	钢片作为热传导介质具有一定寿命，到期需更换，且更换后需停机预压，影响设备运行及利用率。公司通过开发钢片预压平台，可离线完成预压，减少分选机停机时间；同时能够通过仿形夹具预先完成钢片塑形。分选机压头在钢片换新后能够在预压平台上实现自动预压，完成后直接安装至分选机，不影响原设备运行，降低设备停机时长	自主研发	量产
测试治具设计技术	1	钢片设计与使用方案	钢片长期使用后向外延展可能导致芯片短路损坏，其寿命和更换频率难以确定。 公司通过具体产品的钢片 DOE（Design of Experiments，试验设计），收集并验证钢片使用数据，输出其可使用寿命，将钢片薄厚及延展管控转化为钢片压接次数和具体的异常特征，并及时更换	自主研发	量产
	2	显微扫描激光测振仪及配套固定装置	探针台和测试机连接后，进行防震测试时如何稳定连接测试设备与探针台且确保测试值稳定可靠的难度较高。 公司采用扫描激光测振仪和定制的测试仪基座，确保了测试准确性及设备连接的稳定性。公司使用扫描激光测振仪测量振动参数，通过激光扫描实时捕捉探针台与测试机连接处的微振动，并定制了测试仪基座，实现了测试仪与探针台的稳定连接	自主研发	量产

（二）研发费用投入情况

公司高度重视技术研发，大力开展研发工作，报告期内研发投入保持较高水平。具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	15,390.31	10,206.53	6,676.54
营业收入	206,430.25	108,728.04	53,553.63
占营业收入的比例	7.46%	9.39%	12.47%

（三）发行人正在进行的研发项目

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人正在从事的主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	所处阶段及进展情况	拟达到的目标
1	集成电路大算力 AI 晶圆先进测试关键技术产业化	在研	研发高精度晶圆先进测试平台，运用光学检测技术、电子束检测技术和 X 光量测技术等，对晶圆表面和内部进行高分辨率成像，从而检测出微小的缺陷和异常，提升高精度晶圆的测试效能。
2	纳米技术与 CIS 芯片超精细测试的研究与开发	在研	研发基于纳米成像技术对 CIS 芯片的高速并行测试方案，构建集成化的超精细测试系统，旨在提高测试速度、准确性和效率，降低测试成本，并为 CIS 芯片的性能和质量控制提供有力的技术支持。
3	晶粒在线显微自动分析仪器研发及应用	在研	研发晶粒在线显微自动分析仪器，集成高精度图像采集与处理模块，研发自动化控制及智能算法分析系统，提升晶粒检测的精度与效率，降低生产成本，提高市场竞争力。
4	智能终端核心芯片先进测试系统研发及应用	在研	研发先进的芯片测试系统，通过集成创新的模块化硬件设备，开发引入先进大模型的自动化测试算法软件技术，提升芯片测试的自动化、精度和效率，满足日益复杂的芯片产品测试需求。
5	异构集成芯片微凸点接触可靠性的研究	在研	围绕先进封装微凸点可靠性测试，构建融合弹性变形、塑性流动与粘着效应的接触力学模型、开发压电陶瓷驱动的柔性探针阵列，集成机器学习算法实现纳米级压力实时调节与磨损补偿；设计兼容 TSV/Hybrid Bonding（混合键合）工艺的探针矩阵，支持微凸点高精度定位与信号完整性检测，形成全链条技术体系。

序号	项目名称	所处阶段及进展情况	拟达到的目标
6	半导体芯片 Multi-site 高并行效率测试的研究与开发	在研	旨在优化 Multi-site 并行测试中的多任务管理、测试资源分配、测试数据的准确性和传输效率等问题，深入分析影响 Multi-site 并行测试效率的多种因素，并给出相应的对策和提高效率的解决方案，避免测试资源的浪费。
7	车规级芯片的高可靠性与低延迟测试方案的研究与开发	在研	旨在构建一套高精度、多维度的芯片测试系统，融合先进的环境模拟技术、超高速信号采集与分析技术以及智能算法驱动的测试流程优化技术，重现车规级芯片在极端温度、湿度、振动和复杂电磁环境下的工况，实现对芯片内部信号传输及处理的精准监测与解析，并对测试流程进行动态优化，有效提升测试效率并确保测试结果的高可靠性与低延迟性能评估的准确性。
8	多芯片串并行智能化测试创新与实现的研究与开发	在研	旨在构建开发多芯片串并行测试架构、智能化测试算法和系统集成与协同技术，优化测试流程及策略，以提高测试的准确性、可靠性、稳定性，降低生产成本。
9	半导体老化测试全栈自动化及精细化分 Bin 构建方案的研究	在研	聚焦于半导体老化测试生产流程优化，引入自动化上下料系统以取代人工操作，以提升作业效率与稳定性。同时，运用智能分 Bin 技术，实现产品精准分类，构建全流程追溯体系，提升测试效率及质量控制水平，降低生产成本。
10	基于机器学习的 FT 测试时间优化与预测模型	在研	通过构建机器学习驱动的 FT 测试时间优化与预测模型，提升测试效率。结合强化学习算法，根据预测结果和测试目标自动生成最优测试方案，实现对 FT 测试时间的优化。

（四）研发人员情况

1、研发人员整体情况

公司及其子公司设置了研发中心对研发活动进行统一管理。报告期内，发行人研发人员数量及占比情况如下：

单位：人

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
研发人员数量	555	404	224
总人数	2,949	2,018	1,015
研发人员占比	18.82%	20.02%	22.07%

报告期各期末，公司研发人员数量分别为 224 人、404 人和 555 人。随着公司经营规模的扩大，研发人员数量有所增长。报告期内，公司测试芯片的型号、应用领域等持续丰富，为保持市场竞争力，公司持续增大研发投入。

报告期各期，公司研发人员学历构成情况如下：

单位：人

学历	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
本科及以上	304	54.77%	217	53.71%	99	44.20%
大专	245	44.14%	181	44.80%	113	50.45%
大专以下	6	1.08%	6	1.49%	12	5.36%
合计	555	100.00%	404	100.00%	224	100.00%

2、公司对核心技术人员的约束激励措施

（1）约束措施

公司高度重视核心技术的保护工作，主要核心技术通过申请专利等方式进行保护，非专利技术通过日常监管、不定期审查、流程管理、文件存储备份、信息技术手段等多种方式予以保护，保证了技术资料的安全性和存储的可靠性。

公司通过与核心技术人员签署保密协议等方式对其进行约束，明确约定了商业技术秘密的保密责任及义务，用专利申请保护与分级管理等方式防止核心技术外泄，并针对核心技术人员在任职期间及离职以后保守公司商业秘密的有关事项进行了约定。

（2）激励措施

公司注重与员工的共同成长，为员工提供了良好的工作环境和有竞争力的薪酬水平，使员工获得认同感和归属感，提升员工对于公司核心技术的自我保护意识和创新意识，保证了核心技术人员的稳定性，推动公司技术的持续创新。

（五）保持技术持续创新的机制、技术储备及创新安排

1、保持技术创新的机制和技术创新安排

（1）健全的创新体制机制

公司立足于集成电路测试领域自主可控的实际需要，基于对集成电路行业发展动态、国产化工艺演进带来的测试需求等的充分理解和判断，开展前瞻性、全面性、体系化的研发活动。公司具备完善的研发项目流程，从项目的立项、计划的开发制订，再到后续实验、评审，各流程前后有序衔接，最大化保证了研发项目的完成质量。

公司不断优化技术创新机制，健全研发体系和研发过程管理，完善技术人员激励制度。公司重视研发人员的培养与持续提高，制定了《研发项目管理制度》等制度，为技术创新提供充分支持，充分调动研发人员创新创造积极性，推动公司加快创新步伐，促进创新成果的转化。

（2）高水平、多层次的研发投入

公司高度重视自主创新，长期保持较高水平的研发投入，报告期内研发费用保持增长态势。公司目前已建立了覆盖测试方案与产品导入、测试系统及数据、测试设备开发与工艺优化等方面的全流程、多层次研发体系。未来，公司将进一步增强对于研发项目的支持力度，持续提升集成电路测试产业链的自主可控水平。

（3）人才引进和培养机制

公司建立了人才引进与流动机制，采取内部培养与外部招聘并重的团队建设机制，加强优秀人才的引进与培养力度，拓宽研发技术人员内部晋升通道，激励引导员工持续创新。公司建立了研发项目动态管理与风险约束机制，提高项目的过程管理效率，有效降低公司的技术研发风险。

2、技术储备

公司主要的技术储备参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“七/（三）发行人正在进行的研发项目”。

八、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司所处行业不属于《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）规定的重污染行业，生产过程中不存在高风险、重污染情况。报告期内，公司通过了ISO14001环境管理体系认证，环保信用良好。

（一）生产经营中主要污染物情况

公司及其子公司生产中所产生污染物较少，仅包括少量废气、废水、固体废弃物、噪声等。公司生产经营过程中涉及的主要环境污染物和主要处理方法具体情况如下：

环境污染种类	主要污染物	处理设施/方式	处理能力
废气	少量工作台的擦拭废气、研发实验废气等	收集后经活性炭吸附、喷淋、除雾等环节处理后通过排气筒达标排放	符合排放标准
废水	生活污水等	预处理达到标准后排入市政污水管网	符合排放标准
固体废弃物	废包装纸、废砂纸、废抹布、废活性炭等	由当地环卫部门统一清运或委托具备相关资质的单位处理	符合排放标准
噪声	设备运行噪声	优化设备布局、做好降噪隔声措施等	符合排放标准

（二）公司污染处理设施运转正常有效

公司高度重视环境保护，严格执行国家环保法相关法律法规，持续加强环保投入。公司根据实际需求配置了必要的环保设施，相关设施运行状况良好，生产过程中产生的各种污染物均得到了合理有效的控制。

（三）公司在环境保护方面不存在违反法律法规的情况

报告期内，公司遵守国家 and 地方环境保护相关法律法规的规定，未发生重大环保污染事故，亦不存在因环境保护事项受到行政处罚的情形。

根据主管部门出具的《信用报告》，报告期内公司生产经营活动符合环境保护相关法律法规及规范性文件的规定，不存在因违反环境保护相关法律法规及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

九、境外经营情况

报告期内，公司拥有新加坡芯云纵横 1 家境外全资子公司，该公司未在境外开展经营活动。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自天健所出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕14270 号）后附的经审计财务报表或根据其中相关数据计算得出。相关财务会计数据及有关分析反映了公司报告期内经审计的财务报表及有关附注的重要内容。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元			
项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动资产：			
货币资金	1,024,522,362.46	826,818,751.99	478,106,291.24
应收账款	739,039,785.33	540,731,404.52	174,416,229.26
预付款项	5,161,907.61	2,461,679.90	1,611,947.22
其他应收款	4,741,709.53	5,786,900.78	6,086,061.08
存货	64,401,309.12	49,131,986.29	28,251,252.09
合同资产	767,531.54	867,295.82	184,438.50
其他流动资产	911,671,229.09	429,778,408.96	186,159,027.29
流动资产合计	2,750,305,834.68	1,855,576,428.26	874,815,246.68
非流动资产：			
固定资产	4,943,474,810.17	3,291,898,265.04	1,561,714,729.90
在建工程	175,402,385.65	271,236,982.84	431,228,475.51
使用权资产	26,871,765.22	10,595,436.91	19,952,295.53
无形资产	93,465,748.49	62,174,460.97	60,807,979.89
长期待摊费用	312,850,643.73	142,113,156.03	95,763,091.86
递延所得税资产	12,144,273.66	9,030,946.10	6,238,418.28

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
其他非流动资产	47,715,359.21	35,961,286.12	8,060,597.98
非流动资产合计	5,611,924,986.13	3,823,010,534.01	2,183,765,588.95
资产总计	8,362,230,820.81	5,678,586,962.27	3,058,580,835.63
流动负债：			
短期借款	216,492,421.59	503,775,827.34	163,123,779.13
应付票据	122,716,653.32	151,065,635.32	110,961,680.00
应付账款	1,544,402,393.56	1,092,263,563.70	506,893,125.68
合同负债	41,507,348.53	1,835,644.26	895,298.60
应付职工薪酬	73,774,655.50	50,014,775.78	25,938,324.57
应交税费	43,330,290.00	55,128,090.91	25,405,118.64
其他应付款	2,031,667.24	1,348,460.99	5,886,406.22
一年内到期的非流动负债	213,711,940.80	162,129,033.04	161,901,865.81
其他流动负债	1,405,457.48	6,845.13	45,632.20
流动负债合计	2,259,372,828.02	2,017,567,876.47	1,001,051,230.85
非流动负债：			
长期借款	2,728,770,573.49	1,459,172,987.02	516,802,734.95
租赁负债	15,385,449.90	2,073,578.87	9,703,489.45
长期应付款	400,000,000.00	-	16,550,270.76
递延收益	511,595,439.21	439,970,177.01	389,024,278.49
递延所得税负债	52,646,349.98	10,403,586.60	-
非流动负债合计	3,708,397,812.58	1,911,620,329.50	932,080,773.65
负债合计	5,967,770,640.60	3,929,188,205.97	1,933,132,004.50
所有者权益：			
股本	42,921,560.00	42,921,560.00	38,322,820.00
资本公积	1,309,458,784.86	1,284,118,974.04	867,431,680.74
盈余公积	101,200.89	101,200.89	101,200.89
未分配利润	962,839,624.72	342,369,817.13	139,856,125.93
归属于母公司所有者权益合计	2,315,321,170.47	1,669,511,552.06	1,045,711,827.56
少数股东权益	79,139,009.74	79,887,204.24	79,737,003.57

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
所有者权益合计	2,394,460,180.21	1,749,398,756.30	1,125,448,831.13
负债和所有者权益总计	8,362,230,820.81	5,678,586,962.27	3,058,580,835.63

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	2,064,302,511.39	1,087,280,429.80	535,536,302.11
减：营业成本	1,122,097,309.78	679,850,537.45	311,208,660.34
税金及附加	10,273,679.96	8,495,958.09	2,362,834.32
销售费用	16,573,019.42	15,701,683.66	11,316,581.74
管理费用	123,979,844.19	76,094,781.36	53,890,922.85
研发费用	153,903,136.04	102,065,304.52	66,765,423.00
财务费用	50,809,159.07	34,783,961.19	29,330,583.46
其中：利息费用	72,491,817.39	47,520,122.44	43,108,183.30
利息收入	7,412,502.12	6,485,258.46	8,754,369.08
加：其他收益	112,449,408.17	74,598,337.76	49,803,978.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,720,960.43	4,438,161.94	1,230,627.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,503,466.41	-20,712,738.74	-139,715.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-623,317.38	-933,486.13	-8,783.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,522.05	-	344,240.43
二、营业利润	699,694,425.69	227,678,478.36	111,891,643.02
加：营业外收入	2,329.35	2,100.41	266.34
减：营业外支出	657,814.78	194,335.01	81,682.63
三、利润总额	699,038,940.26	227,486,243.76	111,810,226.73
减：所得税费用	79,317,327.17	24,822,351.89	12,391,679.29
四、净利润	619,721,613.09	202,663,891.87	99,418,547.44
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润	619,721,613.09	202,663,891.87	99,418,547.44
2、终止经营净利润	-	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1、归属于母公司所有者的净利润	620,469,807.59	202,513,691.20	99,591,226.11
2、少数股东损益	-748,194.50	150,200.67	-172,678.67
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	619,721,613.09	202,663,891.87	99,418,547.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	620,469,807.59	202,513,691.20	99,591,226.11
归属于少数股东的综合收益总额	-748,194.50	150,200.67	-172,678.67
七、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	14.46	5.28	2.78
（二）稀释每股收益	14.40	5.28	2.78

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,705,786,464.49	1,087,419,185.28	867,807,543.76
收到的税费返还	236,850,092.37	46,647,487.19	104,853,693.25
收到其他与经营活动有关的现金	223,147,982.63	137,874,270.33	396,617,696.92
经营活动现金流入小计	3,165,784,539.49	1,271,940,942.80	1,369,278,933.93
购买商品、接受劳务支付的现金	700,435,885.25	392,590,631.14	340,688,276.60
支付给职工以及为职工支付的现金	435,181,852.46	272,038,869.82	153,906,990.51
支付的各项税费	147,590,973.17	33,732,370.86	6,101,109.17
支付其他与经营活动有关的现金	123,754,231.08	84,197,833.72	45,930,287.80
经营活动现金流出小计	1,406,962,941.96	782,559,705.54	546,626,664.08
经营活动产生的现金流量净额	1,758,821,597.53	489,381,237.26	822,652,269.85
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	2,339,654.80	1,294,254.67	856,557.68
收到其他与投资活动有关的现金	1,963,047,200.18	243,563,194.82	394,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,965,386,854.98	244,857,449.49	395,556,557.68

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,298,661,401.80	1,736,166,308.09	816,919,246.67
支付其他与投资活动有关的现金	2,714,385,253.71	310,000,000.00	478,484,482.49
投资活动现金流出小计	5,013,046,655.51	2,046,166,308.09	1,295,403,729.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,047,659,800.53	-1,801,308,858.60	-899,847,171.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	420,000,000.00	460,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	1,694,118,118.05	1,516,777,582.69	397,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,098,907.90	153,693,977.13	18,396,512.50
筹资活动现金流入小计	2,203,217,025.95	2,090,471,559.82	876,446,512.50
偿还债务支付的现金	756,684,882.28	370,333,277.42	461,587,278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,917,471.08	41,797,386.61	31,058,572.19
支付其他与筹资活动有关的现金	27,622,713.21	46,378,464.41	168,417,567.69
筹资活动现金流出小计	854,225,066.57	458,509,128.44	661,063,417.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,348,991,959.38	1,631,962,431.38	215,383,094.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,177,327.90	1,078,788.16	-1,376,222.50
五、现金及现金等价物净增加额	57,976,428.48	321,113,598.20	136,811,970.49
加：期初现金及现金等价物余额	790,902,582.95	469,788,984.75	332,977,014.26
六、期末现金及现金等价物余额	848,879,011.43	790,902,582.95	469,788,984.75

二、注册会计师的审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准

（一）审计意见

天健所接受公司委托，对公司的财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了“天健审〔2026〕14270 号”标准无保留意见《审计报告》。审计意见如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

制，公允反映了朗迅科技 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）关键审计事项

1、收入确认

（1）事项描述

朗迅科技主要从事集成电路测试业务，2023 年度、2024 年度和 2025 年度营业收入金额分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元、206,430.25 万元。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认风险，实施的主要审计程序包括：

- 1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- 3）对营业收入及毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- 4）对于收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库及物流单、验收/对账信息等支持性文件；
- 5）以抽样方式对主要客户进行了函证；
- 6）对主要客户进行访谈，确认报告期销售业务相关情况；
- 7）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- 8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、固定资产账面价值确认

（1）事项描述

朗迅科技 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日固定资产账面价值分别为 156,171.47 万元、329,189.83 万元和 494,347.48 万元。固定资产金额较大，占各期末总资产的比例分别为 51.06%、57.97%、59.12%，管理层对在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点、固定资产的预计可使用寿命及残值等方面的判断会对固定资产的账面价值确定造成影响，由于固定资产账面价值的确定涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，因此将其识别为关键审计事项。

（2）审计应对

- 1) 了解管理层对固定资产确认和计量相关的内部控制，并测试关键控制运行的有效性；
- 2) 选取样本检查固定资产采购合同、发票、收货单、付款单据等资料，测试其入账价值及会计处理是否正确；对于在建工程转入的固定资产，获取达到预定可使用状态的证明文件，评价转固时点的合理性；
- 3) 取得同行业公司折旧政策，评价管理层对固定资产预计可使用寿命及残值的估计是否合理；
- 4) 获取固定资产折旧计算表，复核固定资产折旧的计算过程；
- 5) 执行固定资产监盘程序，关注是否存在减值迹象，并获取管理层在资产负债表日就固定资产是否存在可能发生减值迹象的判断的说明；
- 6) 检查固定资产是否在财务报表中做出恰当列报。

（三）重大事项及重要性水平判断标准

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收票据	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的应收票据坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销应收票据	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额×0.5%

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的单项计提减值准备的应收款项融资	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的应收款项融资减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销应收款项融资	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的合同资产减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销合同资产	单项金额超过资产总额×0.5%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的预付款项	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额×0.5%
重要的逾期借款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的逾期应付利息	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的应付账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的其他应付款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的合同负债	单项金额超过资产总额×0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额×0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额×10%
重要的子公司、非全资子公司	利润总额超过集团利润总额的15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的15%

三、会计报表编制基础、合并范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

（二）合并范围及变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下：

序号	子公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度	备注
1	杭州芯云	是	是	是	
2	诸暨芯云	是	是	是	
3	杭州芯云海	是	是	是	
4	诸暨越芯	是	是	是	
5	朗迅集成	是	是	是	
6	杭州芯光	是	是	-	2024 年 9 月设立
7	上海芯云纵横	是	是	是	
8	苏州芯云纵横	是	是	是	
9	重庆朗芯	是	是	是	
10	新加坡芯云纵横	是	是	-	2024 年 6 月设立
11	朗迅数智	是	是	是	
12	朗迅智杰	是	是	-	2024 年 12 月设立
13	浙江芯华	是	-	-	2025 年 12 月设立
14	诸暨教育	是	是	是	2026 年 4 月已注销
15	江西朗驰	是	是	是	2025 年 3 月已注销
16	浙江华芯	是	是	是	2025 年 2 月已注销
17	江阴芯云	是	是	是	2025 年 2 月已注销

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方

合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（二）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（三）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（四）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其

他综合收益。

（五）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利

得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准

则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足

下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——公司合并范围内关联往来组合	债务人类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——公司合并范围内关联往来组合	债务人类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率	合同资产预期信用损失率
1年以内（含，下同）	5.00%	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（七）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年

限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

（九）在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定可使用状态
需要安装调试的机器设备	安装调试完成，达到预定可使用状态

（十）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

类别	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 3-5 年	直线法

3、研发支出的归集范围

（1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。主要包括直接消耗的材料、燃料和动力费用等费用。

（3）折旧及摊销费用

折旧及摊销费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧摊销费。

（4）委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

（5）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十一）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无

形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十三）职工薪酬

1、职工薪酬范围

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早之日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十四）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处

理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十五）收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

公司集成电路测试业务收入确认的具体方法为：完成测试服务向客户交付成果，并经客户验收/对账后确认收入。

（十六）合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得

转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十七）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（十八）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十九）递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但

不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5、同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十）租赁

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用

寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、售后回租

（1）公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

（2）公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（二十一）重要会计政策、会计估计变更及前期差错更正

报告期内，发行人不存在重要会计政策、会计估计变更及前期差错更正的情形。

五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

报告期各期，公司非经常性损益项目及金额如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.55	-3.06	34.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,725.62	7,099.38	4,667.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	252.92	74.42	77.76
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-1,974.34	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65.55	-16.17	-7.87
小计	8,937.11	7,154.58	4,771.36
所得税影响额（减少利润以负数填列）	347.21	256.11	696.93
少数股东权益影响额（税后）	0.01	5.54	17.43
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,589.89	6,892.93	4,056.99
归属于母公司所有者的净利润	62,046.98	20,251.37	9,959.12
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	53,457.09	13,358.44	5,902.13

报告期内，发行人归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 4,056.99 万元、6,892.93 万元和 8,589.89 万元，主要为计入当期损益的政府补助。公司经营情况良好，随着业务规模的快速增长，非经常性损益占归属于母公司所有者的净利润的比例整体快速降低，对发行人经营成果无重大影响。

六、主要税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、17%、15%、12.5%、0%

（二）税收优惠

1、朗迅科技于 2023 年度通过高新技术企业认定，现持有证书编号为 GR202333001151 的《高新技术企业证书》，可享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期至 2025 年，有效期内企业所得税按 15%税率计缴。

杭州芯云于 2022 年度通过高新技术企业认定，持有证书编号为 GR202233008747 的《高新技术企业证书》，可享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期至 2024 年，有效期内企业所得税按 15%税率计缴。杭州芯云于 2025 年度通过高新技术企业认定，现持有证书编号为 GR202533008206 的《高新技术企业证书》，可享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期至 2027 年，有效期内企业所得税按 15%税率计缴。

诸暨芯云于 2024 年度通过高新技术企业认定，现持有证书编号为 GR202433010993 的《高新技术企业证书》，可享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期至 2026 年，有效期内企业所得税按 15%税率计缴。

杭州芯云海于 2025 年度通过高新技术企业认定，现持有证书编号为 GR202533006820 的《高新技术企业证书》，可享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期至 2027 年，有效期内企业所得税按 15%税率计缴。

2、根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2022 年为杭州芯云、诸暨芯云适用“两免三减半”企业所得税税收优惠的起始年度。

3、根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）、《国

家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，重庆朗芯、江阴芯云、上海芯云纵横、江西朗驰、浙江华芯、苏州芯云纵横、杭州芯光、朗迅智杰、浙江芯华企业所得税适用小微企业所得税税收优惠政策。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）和《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

4、根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），报告期内，朗迅科技销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

5、根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许符合条件的集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

七、主要财务指标

（一）报告期内主要财务指标

报告期内公司主要财务指标情况如下：

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率（倍）	1.22	0.92	0.87
速动比率（倍）	1.19	0.90	0.85
资产负债率（合并）	71.37%	69.19%	63.20%
资产负债率（母公司）	19.46%	7.41%	6.53%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	53.94	38.90	27.29

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	3.06	2.89	2.87
存货周转率（次）	19.77	17.57	10.31
息税折旧摊销前利润（万元）	137,858.97	63,171.38	33,196.60
归属于母公司所有者的净利润（万元）	62,046.98	20,251.37	9,959.12
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（万元）	53,457.09	13,358.44	5,902.13
利息保障倍数（倍）	10.64	5.79	3.59
研发投入占营业收入的比例	7.46%	9.39%	12.47%
每股经营活动现金流量净额（元）	40.98	11.40	21.47
每股现金流量净额（元）	1.35	7.48	3.57

注：各指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货净额） / 流动负债
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产
- 4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的权益 / 期末总股本
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均余额
- 6、存货周转率=营业成本 / 存货期初期末平均净额
- 7、息税折旧摊销前利润=净利润+利息支出+所得税费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
- 8、利息保障倍数=（净利润+所得税费用+利息支出） / （利息支出+资本化利息）
- 9、研发投入占营业收入的比例=研发费用 / 营业收入
- 10、每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本
- 11、每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末总股本

（二）报告期内净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），报告期内发行人的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	2025 年度	31.14%	14.46	14.40
	2024 年度	17.65%	5.28	5.28
	2023 年度	14.97%	2.78	2.78
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2025 年度	26.83%	12.45	12.40
	2024 年度	11.64%	3.49	3.49

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	2023 年度	8.87%	1.65	1.65

每股收益和净资产收益率的计算公式为：

1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、经营成果分析

报告期内，公司的主要经营成果指标如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	206,430.25	108,728.04	53,553.63
营业利润	69,969.44	22,767.85	11,189.16
利润总额	69,903.89	22,748.62	11,181.02
净利润	61,972.16	20,266.39	9,941.85
归属于母公司所有者的净利润	62,046.98	20,251.37	9,959.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	53,457.09	13,358.44	5,902.13

报告期内，公司营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和

206,430.25 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 9,959.12 万元、20,251.37 万元和 62,046.98 万元。受益于集成电路产业的快速发展以及集成电路测试国产化替代的趋势，报告期内公司营业收入和净利润水平实现了快速增长。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	203,342.58	98.50%	103,779.01	95.45%	48,473.82	90.51%
其他业务收入	3,087.67	1.50%	4,949.04	4.55%	5,079.81	9.49%
合计	206,430.25	100.00%	108,728.04	100.00%	53,553.63	100.00%

报告期内，公司营业收入金额分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元。公司主营业务为第三方集成电路测试业务，各年占比分别为 90.51%、95.45%和 98.50%，占比较高且逐年上升。其他业务收入主要包括集成电路产教融合软硬件装备、集成电路测试硬件销售业务等，随着第三方集成电路测试业务的快速发展，占比持续降低。

2、主营业务收入分业务类型构成

报告期内，公司的主营业务收入按照业务类型分类情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	97,895.60	48.14%	53,404.88	51.46%	24,171.98	49.87%
	CP	61,731.51	30.36%	25,517.79	24.59%	13,189.12	27.21%
	小计	159,627.11	78.50%	78,922.67	76.05%	37,361.10	77.07%
工程测试服务		43,715.47	21.50%	24,856.34	23.95%	11,112.72	22.93%
合计		203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

公司主营业务收入来源于第三方集成电路测试业务，包括量产测试和工程测试服务。随着下游行业的快速发展以及公司产能的逐步扩张，公司集成电路测试业务的收入金额及占比逐年上升，是公司主营业务收入的主要来源。

（1）量产测试

随着集成电路产业的快速发展和下游客户需求的持续增长，公司作为国内领先的集成电路测试综合服务商，聚焦自主可控的国产集成电路测试供应链，为下游客户提供一站式的芯片量产测试解决方案，报告期内公司集成电路量产测试业务的销售收入呈逐年上升趋势。2023 年度、2024 年度和 2025 年度，量产测试业务的销售收入分别为 37,361.10 万元、78,922.67 万元、159,627.11 万元，占主营业务收入的比重分别为 77.07%、76.05%和 78.50%。

报告期内，公司 FT 量产测试单价持续上升，主要系消费电子及高端算力领域收入占比和测试单价同步提高所致。随着手机 SoC 芯片、AI 芯片及 CPU 芯片等高端产品持续导入和规模化放量，测试产品的集成度、复杂程度及测试要求不断提高，带动 FT 量产测试单价逐年提升。

报告期内，公司 CP 量产测试单价存在一定波动，主要系各期应用领域及测试产品结构发生变化。2024 年度整体单价保持稳定；2025 年度，受视觉传感领域成为主要测试领域的产品结构变化等因素综合影响，CP 量产测试整体单价有所下降。

（2）工程测试服务

除量产测试外，芯片在新产品量产或已有产品工艺改进前，通常需以小批量形式开展工程测试，该环节作为量产测试的核心前置程序，用于验证、修改并导入产品测试方案、分析与反馈测试数据结果，同时可协助集成电路制造产业链上下游各环节完成产品性能优化与生产工艺的改进修正。此外，工程测试服务还包括少量前沿性的、试验性的工程级别的测试服务。工程测试服务不仅是客户产品量产测试前的重要保障，也为公司搭建了新产品导入的通道，有利于公司更精准、更快速地承接后续的量产测试订单。

近年来，国产高端芯片追赶国际先进水平的进程持续加快，各类高端芯片产品密集迭代推出、工艺持续优化升级，也带动公司工程测试服务业务实现快

速增长。2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司工程测试服务收入分别为 11,112.72 万元、24,856.34 万元和 43,715.47 万元，工程测试服务单价整体呈上升趋势，主要系测试芯片的复杂程度持续提高以及高单价业务收入占比提升。2024 年度，公司工程测试服务单价较上年度基本稳定；2025 年度，随着高端算力、消费电子等领域测试产品的复杂程度和测试要求进一步提高，相关工程测试服务单价有所上升。同时，受 AI 芯片及 CPU 芯片需求增长和产品持续迭代的带动，单价较高的高端算力领域工程测试服务收入及占比快速提高，进一步拉高了公司工程测试服务整体单价。

3、主营业务收入分区域构成

报告期内，公司主营业务收入的区域构成情况如下：

单位：万元

区域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南	181,375.21	89.20%	95,705.91	92.22%	46,646.84	96.23%
华东	17,036.90	8.38%	7,045.40	6.79%	1,705.97	3.52%
其他	4,930.47	2.42%	1,027.69	0.99%	121.01	0.25%
合计	203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

公司实现销售收入的区域均在境内市场。境内集成电路产业的主要区域包括以深圳为代表的珠三角区域、以上海为代表的长三角地区等区域。公司下游客户以集成电路设计、封装企业为主，下游客户生产基地主要集中于华南和华东地区。公司境内销售区域分布与客户生产基地分布及产业集群分布相匹配。

4、季节性因素对各季度经营成果的影响

报告期内，公司主营业务收入分季度构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	38,571.83	18.97%	12,075.45	11.64%	9,188.37	18.96%
第二季度	42,880.87	21.09%	16,294.65	15.70%	10,428.76	21.51%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三季度	57,022.57	28.04%	29,462.79	28.39%	12,121.56	25.01%
第四季度	64,867.31	31.90%	45,946.12	44.27%	16,735.14	34.52%
合计	203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

报告期内，发行人收入无明显的季节性特征，第四季度收入占比较高主要系一方面业务规模总体保持高速增长态势，季度收入规模从第一季度至第四季度持续增长，导致各年四季度主营业务收入占比相对较高。第一季度收入金额及占比较低，还受春节等节假日休假安排影响；另一方面，下游芯片设计公司、封测服务企业普遍在年初制定全年业务规划，后续供应商陆续投入生产和交付，因此公司下半年的收入占比较高。2024 年四季度占比相对较高，主要由于发行人主要测试基地之一杭州芯云海于 2024 年下半年开始投产，第四季度爬坡上量后收入增长较多。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	111,096.12	99.01%	66,566.30	97.91%	29,448.05	94.62%
其他业务成本	1,113.61	0.99%	1,418.75	2.09%	1,672.82	5.38%
合计	112,209.73	100.00%	67,985.05	100.00%	31,120.87	100.00%

报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本，与营业收入构成相匹配。

2、主营业务成本分业务类型构成

报告期内，公司主营业务成本按业务类型分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	54,719.84	49.25%	35,871.18	53.89%	16,714.89	56.76%
	CP	31,403.67	28.27%	15,327.14	23.03%	6,905.49	23.45%
	小计	86,123.51	77.52%	51,198.32	76.91%	23,620.37	80.21%
工程测试服务		24,972.61	22.48%	15,367.98	23.09%	5,827.68	19.79%
合计		111,096.12	100.00%	66,566.30	100.00%	29,448.05	100.00%

报告期内，公司各类业务成本变化幅度与营业收入变化情况基本一致。

3、主营业务成本分成本类型构成

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	29,416.67	26.48%	16,926.16	25.43%	8,488.07	28.82%
折旧摊销及设备租赁	62,827.59	56.55%	38,465.39	57.79%	16,010.10	54.37%
能源消耗	8,135.24	7.32%	5,010.76	7.53%	2,780.76	9.44%
制造费用	10,716.63	9.65%	6,164.00	9.26%	2,169.12	7.37%
合计	111,096.12	100.00%	66,566.30	100.00%	29,448.05	100.00%

公司主营业务成本主要由职工薪酬、折旧摊销等构成。公司主营业务为第三方集成电路测试，主要由测试人员通过测试设备开展业务。集成电路测试设备单价较高，因此集成电路测试业务主要成本为机器设备的折旧。报告期内，主营业务成本中折旧摊销和职工薪酬合计金额分别为 24,498.17 万元、55,391.55 万元和 92,244.26 万元，占主营业务成本的比例分别为 83.19%、83.22%和 83.03%，占比较高，与公司主营业务特点相一致。

（三）营业毛利及毛利率变动分析

1、毛利分析

（1）综合毛利构成

报告期内，公司毛利的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	92,246.46	97.90%	37,212.71	91.34%	19,025.77	84.81%
其他业务	1,974.06	2.10%	3,530.28	8.66%	3,407.00	15.19%
合计	94,220.52	100.00%	40,742.99	100.00%	22,432.76	100.00%

报告期内，公司毛利总额分别为 22,432.76 万元、40,742.99 万元和 94,220.52 万元，呈逐年上涨趋势，公司毛利总额变化趋势与营业收入的变化趋势基本保持一致。公司主营业务毛利占毛利总金额的比例分别为 84.81%、91.34% 和 97.90%，是公司毛利的主要来源。

（2）主营业务毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	43,175.76	46.80%	17,533.70	47.12%	7,457.09	39.19%
	CP	30,327.84	32.88%	10,190.65	27.38%	6,283.64	33.03%
	小计	73,503.60	79.68%	27,724.35	74.50%	13,740.73	72.22%
工程测试服务		18,742.86	20.32%	9,488.36	25.50%	5,285.04	27.78%
合计		92,246.46	100.00%	37,212.71	100.00%	19,025.77	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利金额分别为 19,025.77 万元、37,212.71 万元和 92,246.46 万元，其中量产测试业务是公司主营业务毛利的主要来源，占各期主营业务毛利总额的比例分别是 72.22%、74.50%和 79.68%。

2、毛利率分析

（1）综合毛利率

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率	45.37%	35.86%	39.25%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他业务毛利率	63.93%	71.33%	67.07%
合计	45.64%	37.47%	41.89%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 39.25%、35.86%和 45.37%，是影响公司综合毛利率的主要因素。

（2）主营业务毛利率

公司主营业务按业务类型分类的毛利率情况如下：

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
量产测试	FT	44.10%	48.14%	32.83%	51.46%	30.85%	49.87%
	CP	49.13%	30.36%	39.94%	24.59%	47.64%	27.21%
	小计	46.05%	78.50%	35.13%	76.05%	36.78%	77.07%
工程测试服务		42.87%	21.50%	38.17%	23.95%	47.56%	22.93%
合计		45.37%	100.00%	35.86%	100.00%	39.25%	100.00%

报告期内，公司集成电路测试业务毛利率分别为 39.25%、35.86%和 45.37%。2024 年度，公司集成电路测试业务毛利率有所下降，主要系杭州芯云海 2024 年下半年开始逐步投产，投产初期因产能爬坡导致折旧摊销等刚性的固定成本及费用有所增长，对当年度毛利率产生了阶段性影响。

2023 年度至 2025 年度，量产测试中的 CP 测试毛利率分别为 47.64%、39.94%和 49.13%。2024 年度，CP 量产测试毛利率有所下降，主要系杭州芯云海 2024 年下半年开始逐步投产的影响。2025 年度，随着 CP 量产测试收入规模和产能利用率的提升，规模效应显现带来单位成本的下降，推动当年毛利率有所上升。

2023 年度至 2025 年度，量产测试中的 FT 测试毛利率分别为 30.85%、32.83%和 44.10%，毛利率呈逐年增长趋势。2024 年度，FT 量产测试毛利率较 2023 年上升了 1.98 个百分点，主要得益于当年 FT 量产测试产能利用率提升较多、收入实现较快增长，有效覆盖了产能扩张带来的影响，因此毛利率略有增长。2025 年度，FT 量产测试毛利率增幅明显，一方面系 FT 产能利用率进一步

提升，另一方面系当年手机 SoC 芯片，以及手机 UFS 芯片等测试规模快速增长，相关芯片测试难度和测试单价较高，带动了毛利率增长。

2023 年度至 2025 年度，工程测试服务毛利率分别为 47.56%、38.17%和 42.87%。2024 年度，受产能快速扩张影响，折旧摊销等刚性固定成本及费用增加，导致毛利率有所下降。2025 年度，随着收入规模扩大和产能利用率提升，以及测试难度较高的算力芯片工程测试收入增加，因此当年毛利率有所上升。

3、公司毛利率与可比公司比较情况

报告期内，公司主营业务毛利率与可比公司比较情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
伟测科技	39.01%	37.48%	38.32%
利扬芯片	30.04%	21.91%	29.93%
同行业平均值	34.53%	29.70%	34.12%
公司	45.37%	35.86%	39.25%

注 1：伟测科技毛利率取其主营业务毛利率，利扬芯片毛利率取其“集成电路测试服务”业务的毛利率；

注 2：相关数据来源于同行业上市公司定期报告等公开披露文件。

报告期内，公司与可比公司毛利率变动趋势不存在显著差异。报告期内，发行人毛利率水平高于可比公司平均水平，主要系各公司主要客户和测试内容不同，公司专注于国产高端芯片检测业务，毛利率水平较高。

整体来看，2023 年和 2024 年发行人与伟测科技毛利率水平较为相近，仅 2025 年明显高于伟测科技。根据伟测科技披露的信息：“公司的综合毛利率由第二季度 35.99%攀升至第三季度的 44.59%，环比提升 8.6 个百分点，主要来自于高毛利的高端业务的放量。同时，公司产能利用率比较饱满，带动整体毛利的提升”。2025 年下半年，伟测科技综合毛利率为 42.65%，毛利率水平已恢复至接近发行人水平。

综上所述，发行人毛利率变动趋势与同行业可比公司一致。受服务客户和测试内容不同的影响，发行人毛利率水平整体高于同行业可比公司平均值，但与伟测科技接近。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及其占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,657.30	0.80%	1,570.17	1.44%	1,131.66	2.11%
管理费用	12,397.98	6.01%	7,609.48	7.00%	5,389.09	10.06%
研发费用	15,390.31	7.46%	10,206.53	9.39%	6,676.54	12.47%
财务费用	5,080.92	2.46%	3,478.40	3.20%	2,933.06	5.48%
合计	34,526.52	16.73%	22,864.57	21.03%	16,130.35	30.12%

报告期内，公司期间费用金额分别为 16,130.35 万元、22,864.57 万元和 34,526.52 万元，占营业收入的比例分别为 30.12%、21.03%和 16.73%。报告期内，各项期间费用随着公司业务规模的快速扩大而保持增长，期间费用率随着收入的快速增长而有所下降。

1、销售费用

（1）销售费用构成及变化情况

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,206.05	72.77%	1,084.80	69.09%	647.37	57.21%
业务招待费	190.19	11.48%	159.44	10.15%	118.95	10.51%
办公差旅费	92.52	5.58%	147.83	9.41%	148.58	13.13%
业务宣传费	69.71	4.21%	89.08	5.67%	150.19	13.27%
折旧摊销	42.23	2.55%	40.59	2.59%	19.11	1.69%
其他	56.60	3.41%	48.42	3.08%	47.46	4.19%
合计	1,657.30	100.00%	1,570.17	100.00%	1,131.66	100.00%

报告期内，公司销售费用金额分别为 1,131.66 万元、1,570.17 万元和 1,657.30 万元，占营业收入的比例分别为 2.11%、1.44%和 0.80%，主要由销售

人员职工薪酬、业务招待费、办公差旅费和业务宣传费构成，其他费用金额相对较小。

1) 职工薪酬

报告期内，公司销售费用中职工薪酬金额分别为 647.37 万元、1,084.80 万元和 1,206.05 万元，占销售费用的比例分别为 57.21%、69.09%和 72.77%，是销售费用的主要组成部分。报告期内，销售费用中职工薪酬金额上升主要系公司经营规模扩大，销售团队人员数量及工资水平有所上升，销售人员整体薪酬总额相应增加。

2) 业务招待费

报告期内，公司销售费用中业务招待费分别为 118.95 万元、159.44 万元和 190.19 万元，占销售费用的比例分别为 10.51%、10.15%和 11.48%，主要系公司开发和维护客户产生的招待费用。报告期内，销售费用中业务招待费金额上升主要系公司经营规模扩大，相应的业务招待费有所增长。

3) 办公差旅费、业务宣传费

报告期内，公司销售费用中办公差旅费金额分别为 148.58 万元、147.83 万元和 92.52 万元，主要系销售部门办公用品消耗及销售人员差旅费用；公司销售费用中的业务宣传费分别为 150.19 万元、89.08 万元和 69.71 万元，主要系展会费用及集成电路应用赛项支持费用等。上述费用金额整体较小，主要系开展集成电路产教融合业务产生的相关销售费用，随着发行人该业务规模缩小 2025 年度上述费用金额均有一定程度的下降。

(2) 与可比公司销售费用率的比较情况

报告期内，公司销售费用率与可比公司比较如下：

公司名称	2025年度	2024年度	2023年度
伟测科技	2.50%	2.83%	2.97%
利扬芯片	2.78%	3.72%	3.36%
同行业平均值	2.64%	3.27%	3.16%
公司	0.80%	1.44%	2.11%

注：发行人及可比公司 2023 年至 2025 年销售费用率计算时均已剔除股份支付费用。

报告期内，随着公司业务规模快速扩大，公司销售费用率逐年下降，销售费用率整体低于可比公司平均水平，主要是业务规模、客户结构等差异导致。报告期内，公司业务规模相对较大，且客户集中度相对较高，因此销售费用率相对较低。

2、管理费用

（1）管理费用构成及变化情况

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,841.81	39.05%	3,715.58	48.83%	2,546.94	47.26%
股份支付	2,533.98	20.44%	128.60	1.69%	128.60	2.39%
折旧摊销	1,033.36	8.33%	818.75	10.76%	652.13	12.10%
办公差旅费	1,026.33	8.28%	860.00	11.30%	531.59	9.86%
业务招待费	924.60	7.46%	612.97	8.06%	569.68	10.57%
咨询服务费	538.71	4.35%	507.12	6.66%	425.06	7.89%
劳务费	521.32	4.20%	295.00	3.88%	91.51	1.70%
其他	977.87	7.89%	671.45	8.82%	443.58	8.23%
合计	12,397.98	100.00%	7,609.48	100.00%	5,389.09	100.00%

报告期内，公司管理费用金额分别为 5,389.09 万元、7,609.48 万元和 12,397.98 万元，占营业收入的比例分别为 10.06%、7.00%和 6.01%，主要为职工薪酬、股份支付、折旧摊销、办公差旅费、业务招待费、劳务费和咨询服务费。

1）职工薪酬

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为 2,546.94 万元、3,715.58 万元和 4,841.81 万元，占管理费用（不含股份支付）的比例分别为 48.42%、49.67%和 49.09%，占比较为稳定，为管理费用的主要构成部分。报告期内，公司管理费用中职工薪酬整体呈增长趋势，主要系公司业务规模迅速扩大相应增加管理

人员数量所致。

2) 股份支付

报告期内，公司管理费用中的股份支付费用分别为 128.60 万元、128.60 万元和 2,533.98 万元，2025 年股份支付金额较大主要系 2025 年公司实际控制人受让员工在持股平台层面的出资份额当年一次性计入股份支付费用所致。

其他股份支付费用系员工持股平台杭州汇芯股权激励及期权激励所致，激励情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、公司股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况”。

3) 折旧摊销、办公差旅费、业务招待费

报告期内，公司的折旧摊销、办公差旅费、业务招待费合计金额分别为 1,753.40 万元、2,291.72 万元和 2,984.29 万元，占管理费用（不含股份支付）的比例分别为 33.33%、30.63%和 30.25%，占比较为稳定。报告期内，公司上述费用呈现增长趋势，主要系随着公司经营主体增加、经营规模的扩大，相关费用亦相应增长，与公司收入增长情况相匹配。

4) 咨询服务费

报告期内，公司的咨询服务费分别为 425.06 万元、507.12 万元和 538.71 万元，金额整体较为稳定，主要为公司因日常经营、融资、筹备 IPO 等需求，聘请专业机构发生的费用。

5) 劳务费

报告期内，公司的劳务费分别为 91.51 万元、295.00 万元和 521.32 万元，金额有所增长，主要系随着公司业务规模扩大、新建厂房及办公楼投入使用，安保与保洁费相应增加。

（2）与可比公司管理费用率的比较情况

报告期内，公司管理费用率与可比公司比较如下：

公司名称	2025年度	2024年度	2023年度
伟测科技	4.87%	5.15%	5.68%

利扬芯片	9.59%	10.24%	10.15%
同行业平均值	7.23%	7.69%	7.91%
公司	4.78%	6.88%	9.82%

注：发行人及可比公司 2023 年至 2025 年管理费用率计算时均已剔除股份支付费用。

报告期内，公司管理费用率下降较快主要由于报告期营业收入增速较快，公司管理效率不断提升。而可比公司收入增速低于公司，因此随着发行人收入规模的上升，2024 年起管理费用率低于可比公司平均水平。

3、研发费用

（1）研发投入口径

报告期内，公司不存在资本化的研发支出。公司研发活动主要围绕测试方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化等方面开展，研发投入主要核算上述研究开发活动所发生的费用，主要包括职工薪酬、折旧摊销、直接投入等，具体归集内容如下：

项目	研发投入归集内容
职工薪酬	从事研发活动人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出
折旧摊销	用于研发活动的设备、房屋建筑物等的折旧、摊销费用
直接投入	研发活动领用的材料以及能源耗用等
其他费用	其他费用主要包括研发人员办公费、咨询服务费等与研发活动相关的费用

（2）研发费用构成及变化情况

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,938.63	71.07%	7,496.82	73.45%	4,588.68	68.73%
折旧摊销	2,375.16	15.43%	1,233.82	12.09%	997.94	14.95%
直接投入	1,557.99	10.12%	1,340.45	13.13%	975.05	14.60%
其他	518.54	3.37%	135.43	1.33%	114.87	1.72%
合计	15,390.31	100.00%	10,206.53	100.00%	6,676.54	100.00%

2023 年至 2025 年，公司研发费用金额分别为 6,676.54 万元、10,206.53 万元和 15,390.31 万元，占营业收入的比例分别为 12.47%、9.39%和 7.46%。报告期内，公司持续增大研发投入，研发费用持续增长，研发费用率保持在较高水平。

报告期内，公司研发费用的构成基本保持稳定，各项支出呈持续增长态势。其中，职工薪酬增加主要由于研发人员数量增加，折旧摊销和直接投入增加主要系随着研发活动规模的增长，使用测试相关设备和材料、能源耗用等增加所致。集成电路行业的技术不断发展、持续更新，对测试企业的技术能力要求持续提升，公司需要持续进行研发投入，紧跟行业与技术的发展趋势，确保公司具备技术实力和行业竞争力。

（3）主要研发项目情况

报告期内，公司合计费用前十大的研发项目投入情况如下：

单位：万元

序号	研发项目名称	研发费用发生额			项目进度
		2025 年	2024 年	2023 年	
1	集成电路先进测试实时过程监控装备的研究与开发	1,071.27	580.61	269.21	已结项
2	半导体 IC 测试自动分拣系统的研究与开发	-	-	1,051.69	已结项
3	项目 1	-	557.85	318.19	已结项
4	半导体芯片 Multi-site 高并行效率测试的研究与开发	763.75	80.88	-	进行中
5	面向域控制器的车规级 AI 芯片研发	803.38	34.84	-	进行中
6	半导体测试芯片 multi Bin 一站式分类的研究与开发	563.20	265.10	-	已结项
7	半导体 IC 测试自动化设备温控方案研究与开发	-	522.91	265.85	已结项
8	智能终端核心芯片先进测试系统研发及应用	731.69	28.70	-	进行中
9	异构集成芯片微凸点接触可靠性的研究	742.30	-	-	进行中
10	半导体测试芯片主动温控设备的研究与开发	409.69	326.67	-	已结项

（4）与可比公司研发费用率的比较情况

报告期内，公司研发费用率与可比公司比较如下：

公司名称	2025年度	2024年度	2023年度
伟测科技	9.82%	10.96%	12.04%
利扬芯片	13.06%	15.78%	14.40%
同行业平均值	11.44%	13.37%	13.22%
公司	7.46%	9.39%	12.47%

注：发行人及可比公司 2023 年至 2025 年研发费用率计算时均已剔除股份支付费用。

报告期内，公司高度重视研发投入，研发费用持续增加，研发费用率整体保持在较高的水平。2023 年度发行人研发投入占营业收入的比例与可比公司平均水平相当。2024 年和 2025 年发行人研发投入占营业收入的比例低于可比公司平均值，主要系 2024 年起，公司的营业收入增速高于同行业公司所致。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	7,249.18	4,752.01	4,310.82
利息收入	-741.25	-648.53	-875.44
汇兑损益	290.65	-63.11	169.69
手续费	53.47	44.39	24.98
财政贴息	-1,771.14	-606.37	-697.00
合计	5,080.92	3,478.40	2,933.06

报告期内，公司财务费用金额分别为 2,933.06 万元、3,478.40 万元和 5,080.92 万元，主要系银行借款利息支出。报告期内，随着厂房建设及生产设备采购规模的不断扩大，公司充分利用财务杠杆，通过银行借款筹措资金，因此财务费用相应上升。

（五）其他利润表项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
房产税	517.01	235.40	102.72
印花税	312.76	197.16	66.96
城市维护建设税	79.24	206.04	18.52
土地使用税	59.81	63.18	34.35
教育费附加及地方教育附加	58.11	147.39	13.23
车船税	0.42	0.43	0.50
合计	1,027.37	849.60	236.28

公司的税金及附加主要包括房产税、印花税、城市维护建设税等。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益主要情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	5,267.22	4,377.96	2,243.21
与收益相关的政府补助	3,687.27	2,115.04	1,727.11
增值税加计抵减	2,269.59	922.88	670.27
代扣个人所得税手续费返还	15.09	11.20	2.31
增值税即征即退	5.78	32.75	337.49
合计	11,244.94	7,459.83	4,980.40

报告期内，公司的其他收益主要为政府补助和增值税加计抵减。其中，增值税加计抵减系根据财政部、税务总局发布的《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》等的相关规定，符合条件的集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，可按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司收到的政府补助和增值税加计抵减金额持续增加。

报告期内，公司计入其他收益且年度发生额 100.00 万元以上（含）的政府补助如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产/收益 相关
诸暨芯云招商投资合作项目补助	2,885.60	2,805.11	1,708.02	与资产相关
杭州芯云海集成电路先进测试基地项目补助	1,469.74	992.63	200.78	与资产相关
诸暨芯云设备购置奖补	326.60	326.55	80.74	与资产相关
杭州芯云招商投资合作项目补助	1,039.00	198.29	547.04	与资产相关/与 收益相关
诸暨越芯招商投资合作项目补助	899.19	-	-	与资产相关/与 收益相关
杭州芯云海 2025 年度省进口贴息资金补助	327.67	-	-	与收益相关
晶粒在线显微自动分析仪器研发及应用项目补助	324.50	-	-	与收益相关
越芯半导体 2024 年度省级进口贴息补助	276.44	-	-	与收益相关
市数字经济政策销售收入类奖补	200.00	-	-	与收益相关
高端集成电路芯片测试项目补助	200.00	300.00	-	与收益相关
面向高性能计算的低温 CMOS 工艺设计库和芯片项目补助	141.60	-	-	与收益相关
海外引才计划奖励资金	100.00	100.00	-	与收益相关
杭州芯云海省产业链协同创新项目补助	-	640.00	-	与收益相关
2024 年国家中小企业发展专项补助	-	265.00	-	与收益相关
杭州芯云海 2024 年度省进口贴息资金补助	-	209.54	-	与收益相关
国家特殊支持人才区级奖励	-	120.00	-	与收益相关
杭州芯云数字化改造攻关项目补助	-	100.00	-	与收益相关
绍兴名士之乡英才计划人才奖励	-	-	500.00	与收益相关
高层次人才创业企业销售奖励资金	-	-	334.78	与收益相关
中小企业“专精特新”发展行动计划补助	-	-	100.00	与收益相关

注 1：杭州芯云招商投资合作项目补助、诸暨越芯招商投资合作项目补助项目同时包含与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助；

注 2：杭州芯云招商投资合作项目补助：报告期各期与资产相关的政府补助计入当期损益的金额分别为 198.29 万元、198.29 万元、198.29 万元，与收益相关的政府补助计入当期损益的金额分别为 348.75 万元、0 万元、840.71 万元；

注 3：诸暨越芯招商投资合作项目补助：2025 年度与资产相关的政府补助计入当期损益的金额为 294.96 万元，与收益相关的政府补助计入当期损益的金额为 604.23 万元。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
可转让存单利息	1,119.17	369.39	45.31
理财产品投资收益	252.92	74.42	77.76
合计	1,372.10	443.82	123.06

报告期内，公司投资收益分别为 123.06 万元、443.82 万元和 1,372.10 万元，主要系可转让存单利息。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失金额分别为-13.97 万元、-2,071.27 万元和-1,250.35 万元，均系计提应收账款和其他应收款坏账损失产生的信用减值损失。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失金额分别为-0.88 万元、-93.35 万元、-62.33 万元，主要为存货跌价损失。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为 34.42 万元、0 万元和-1.55 万元，金额较小，主要为零星固定资产和使用权资产处置收益。

7、营业外收入与支出

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为 0.03 万元、0.21 万元和 0.23 万元，金额较小，主要系零星物流赔偿收入。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
和解费用	60.00	-	6.00
非流动性资产报废损失	-	3.06	0.28
其他	5.78	16.38	1.89

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	65.78	19.43	8.17

报告期内，公司营业外支出金额分别为 8.17 万元、19.43 万元和 65.78 万元。其中，2025 年主要为一笔诉讼和解费用支出。报告期内，营业外支出总体金额对公司利润影响较小。

8、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	4,018.79	1,721.13	1,465.97
递延所得税费用	3,912.94	761.11	-226.80
所得税费用合计	7,931.73	2,482.24	1,239.17
利润总额	69,903.89	22,748.62	11,181.02
占利润总额的比例	11.35%	10.91%	11.08%

报告期各期，公司所得税费用金额分别为 1,239.17 万元、2,482.24 万元和 7,931.73 万元，占利润总额的比例分别为 11.08%、10.91%和 11.35%。

（六）主要税种纳税情况

报告期内，公司主要纳税项目为增值税和企业所得税，实际缴纳情况如下：

单位：万元

税种	期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
增值税	2025 年度	-19,829.27	9,006.46	-8,447.89
	2024 年度	-8,408.12	2,767.08	-19,829.27
	2023 年度	-10,205.59	455.90	-8,408.12
企业所得税	2025 年度	3,154.69	4,918.31	2,255.17
	2024 年度	1,433.64	0.08	3,154.69
	2023 年度	-32.05	0.28	1,433.64

天健所对公司报告期内主要税种的纳税情况进行了鉴证，并出具了“天健审〔2026〕14274 号”纳税鉴证报告。

九、资产质量分析

（一）资产构成及其变化的总体情况分析

报告期各期末，公司流动资产和非流动资产及占总资产的比例如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	275,030.58	32.89%	185,557.64	32.68%	87,481.52	28.60%
非流动资产	561,192.50	67.11%	382,301.05	67.32%	218,376.56	71.40%
合计	836,223.08	100.00%	567,858.70	100.00%	305,858.08	100.00%

报告期内，随着集成电路产业的快速发展和下游客户需求的持续增长，公司生产经营规模持续扩大，资产规模呈逐年增长趋势。公司资产规模的快速增长与公司业务实际发展情况相符。

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和其他流动资产等组成，非流动资产主要由固定资产、在建工程和长期待摊费用等组成，资产结构符合公司所处行业特点。报告期内，公司流动资产规模持续上升，主要系随着公司经营规模扩大，货币资金、应收账款、其他流动资产等流动资产项目整体增长较快所致；公司非流动资产规模持续上升，主要由于公司建厂及扩张产能导致固定资产、无形资产等非流动资产项目整体持续增长。

（二）流动资产构成及其变化

报告期各期末，公司流动资产分别为 87,481.52 万元、185,557.64 万元和 275,030.58 万元。报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、其他流动资产等构成，具体结构如下表所示：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	102,452.24	37.25%	82,681.88	44.56%	47,810.63	54.65%
应收账款	73,903.98	26.87%	54,073.14	29.14%	17,441.62	19.94%
预付款项	516.19	0.19%	246.17	0.13%	161.19	0.18%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他应收款	474.17	0.17%	578.69	0.31%	608.61	0.70%
存货	6,440.13	2.34%	4,913.20	2.65%	2,825.13	3.23%
合同资产	76.75	0.03%	86.73	0.05%	18.44	0.02%
其他流动资产	91,167.12	33.15%	42,977.84	23.16%	18,615.90	21.28%
流动资产合计	275,030.58	100.00%	185,557.64	100.00%	87,481.52	100.00%

报告期内，公司各主要流动资产项目变动情况分析如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 47,810.63 万元、82,681.88 万元和 102,452.24 万元，占流动资产的比例分别为 54.65%、44.56%和 37.25%。报告期内，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	5.05	0.00%	2.65	0.00%	2.21	0.00%
银行存款	97,883.41	95.54%	79,087.93	95.65%	46,976.69	98.26%
其他货币资金	4,563.77	4.45%	3,591.29	4.34%	831.73	1.74%
合计	102,452.24	100.00%	82,681.88	100.00%	47,810.63	100.00%

报告期内，公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金主要系保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

报告期各期末，公司货币资金持续增长，主要系公司经营规模持续扩大，经营及回款状况良好；同时公司资信状况良好，发展前景受到认可，因此报告期内公司持续通过直接或间接方式融资获得较为充沛的资金。

2、应收账款

报告期各期末，公司应收账款金额分别为 17,441.62 万元、54,073.14 万元和 73,903.98 万元，占当期流动资产的比例分别为 19.94%、29.14%和 26.87%。

（1）应收账款与营业收入匹配情况

报告期内，公司应收账款余额情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收账款账面余额	77,961.27	56,968.85	18,384.17
当期营业收入	206,430.25	108,728.04	53,553.63
应收账款余额占营业收入的比例	37.77%	52.40%	34.33%

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为 34.33%、52.40% 和 37.77%，存在一定波动，其中 2024 年末应收账款余额占营业收入的比例相对较高主要系受杭州芯云海于 2024 年下半年投产、产能快速释放，导致 2024 年四季度收入占比较高所致。报告期各期末，公司应收 A 公司的款项余额分别为 15,737.69 万元、51,480.69 万元和 72,056.42 万元，占应收账款余额的比例分别为 85.60%、90.37%和 92.43%，占比较高，是影响应收账款余额的主要因素。报告期各期最后三个月份公司对 A 公司的销售总额能够覆盖各期末对 A 公司的应收账款余额。

（2）应收账款账龄情况

报告期各期末，公司应收账款余额及其账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	76,141.08	97.67%	56,595.17	99.34%	18,256.29	99.30%
1 至 2 年	1,609.54	2.06%	276.87	0.49%	110.95	0.60%
2 至 3 年	114.59	0.15%	94.46	0.17%	5.05	0.03%
3 至 4 年	93.70	0.12%	1.86	0.00%	11.39	0.06%
4 至 5 年	1.86	0.00%	-	-	-	-
5 年以上	0.49	0.00%	0.49	0.00%	0.49	0.00%
合计	77,961.27	100.00%	56,968.85	100.00%	18,384.17	100.00%

公司应收账款客户主要为行业内知名客户，信用情况良好。报告期各期末公司应收账款账龄在 1 年以内的比例均在 95%以上，应收账款质量较好。

(3) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款余额按类别计提坏账准备情况如下：

单位：万元

年度	项目	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例	金额	计提比例	
2025-12-31	单项计提坏账准备	12.15	0.02%	12.15	100.00%	-
	按账龄组合计提坏账准备	77,949.12	99.98%	4,045.14	5.19%	73,903.98
	合计	77,961.27	100.00%	4,057.29	5.20%	73,903.98
2024-12-31	单项计提坏账准备	12.15	0.02%	12.15	100.00%	-
	按账龄组合计提坏账准备	56,956.70	99.98%	2,883.56	5.06%	54,073.14
	合计	56,968.85	100.00%	2,895.71	5.08%	54,073.14
2023-12-31	单项计提坏账准备	12.15	0.07%	12.15	100.00%	-
	按账龄组合计提坏账准备	18,372.02	99.93%	930.39	5.06%	17,441.62
	合计	18,384.17	100.00%	942.54	5.13%	17,441.62

公司按照应收账款坏账计提政策对不同账龄的应收账款合理计提了相应比例的坏账准备。报告期各期末，公司按账龄组合计提坏账准备的具体情况如下：

单位：万元

年度	项目	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例	金额	计提比例	
2025-12-31	1 年以内	76,141.08	97.68%	3,807.05	5.00%	72,334.03
	1 至 2 年	1,609.54	2.06%	160.95	10.00%	1,448.59
	2 至 3 年	114.59	0.15%	34.38	30.00%	80.22
	3 至 4 年	81.55	0.10%	40.77	50.00%	40.77
	4 至 5 年	1.86	0.00%	1.49	80.00%	0.37
	5 年以上	0.49	0.00%	0.49	100.00%	-
	合计	77,949.12	100.00%	4,045.14	5.19%	73,903.98
2024-12-31	1 年以内	56,595.17	99.37%	2,829.76	5.00%	53,765.41
	1 至 2 年	276.87	0.49%	27.69	10.00%	249.18

年度	项目	账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例	金额	计提比例	
	2 至 3 年	82.31	0.14%	24.69	30.00%	57.62
	3 至 4 年	1.86	0.00%	0.93	50.00%	0.93
	4 至 5 年	-	-	-	-	-
	5 年以上	0.49	0.00%	0.49	100.00%	-
	合计	56,956.70	100.00%	2,883.56	5.06%	54,073.14
2023-12-31	1 年以内	18,256.29	99.37%	912.81	5.00%	17,343.48
	1 至 2 年	98.80	0.54%	9.88	10.00%	88.92
	2 至 3 年	5.05	0.03%	1.52	30.00%	3.54
	3 至 4 年	11.39	0.06%	5.69	50.00%	5.69
	4 至 5 年	-	-	-	-	-
	5 年以上	0.49	0.00%	0.49	100.00%	-
	合计	18,372.02	100.00%	930.39	5.06%	17,441.62

公司账龄 1 年以内的应收账款余额占比均在 95%以上，应收账款质量较好，应收账款无法收回的风险很小。公司根据统一的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备。

报告期内，公司坏账准备计提比例/预期信用损失率与可比公司对比如下：

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
伟测科技	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
利扬芯片	3.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
平均	4.00%	10.00%	30.00%	75.00%	90.00%	100.00%
发行人	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%

注：相关数据来源于同行业上市公司定期报告等公开披露文件。

公司坏账准备计提比例与可比公司整体不存在重大差异。报告期各期末，公司的应收账款主要分布在 1 年以内，按账龄组合计提坏账准备的应收账款余额中账龄在 1 年以内的比例分别为 99.37%、99.37%和 97.68%。公司 1 年以内应收账款坏账计提比例略高于可比公司平均值。

（4）前五名应收账款情况

报告期各期末，公司前五名应收账款余额情况如下：

单位：万元

期间	序号	公司名称	金额	占比
2025-12-31	1	A 公司	72,056.42	92.43%
	2	青岛科创	1,412.96	1.81%
	3	盛合晶微	1,078.96	1.38%
	4	C 公司	994.76	1.28%
	5	博通集成	802.12	1.03%
	合计		76,345.23	97.93%
2024-12-31	1	A 公司	51,480.69	90.37%
	2	青岛科创	1,412.96	2.48%
	3	B 公司	1,357.84	2.38%
	4	C 公司	1,329.38	2.33%
	5	杭州弘翌科技有限公司	335.27	0.59%
	合计		55,916.14	98.15%
2023-12-31	1	A 公司	15,737.69	85.60%
	2	B 公司	1,321.05	7.19%
	3	博通集成	367.90	2.00%
	4	杭州弘翌科技有限公司	363.93	1.98%
	5	常州科教城现代工业中心	140.09	0.76%
	合计		17,930.66	97.53%

注：同一控制下企业已合并统计。

报告期各期末，公司应收账款前五大客户主要为集成电路行业内知名客户，实力雄厚、商业信誉良好；同时还包括少量集成电路产教融合业务的客户。截至报告期期末应收账款前五大客户的相关款项回收不存在重大风险。

（5）应收账款期后回款情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司应收账款回款金额占报告期各期末应收账款余额的比例均已超过 95%，整体回款情况良好，产生坏账风险的可能性较小。

3、预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 161.19 万元、246.17 万元和 516.19 万元，占流动资产的比例分别为 0.18%、0.13%和 0.19%，金额和占比均较低，主要为预付房租、水电等。

4、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面金额分别为 608.61 万元、578.69 万元和 474.17 万元，占流动资产的比例分别为 0.70%、0.31%和 0.17%，金额和占比较低。报告期各期末，公司其他应收款余额构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
押金保证金	600.33	79.39%	669.65	86.67%	632.03	90.83%
应收暂付款	138.80	18.36%	71.72	9.28%	51.67	7.42%
其他	17.07	2.26%	31.29	4.05%	12.16	1.75%
账面余额	756.21	100.00%	772.66	100.00%	695.86	100.00%
坏账准备	282.03	37.30%	193.97	25.10%	87.25	12.54%
账面价值	474.17	62.70%	578.69	74.90%	608.61	87.46%

公司的其他应收款主要为押金保证金和应收暂付款。公司根据统一的坏账准备计提政策对其他应收款计提了坏账准备。

截至报告期期末，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	款项性质	金额	占比
1	杭州富春湾新城管理委员会	押金保证金	285.00	37.69%
2	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	押金保证金	142.08	18.79%
3	重庆电子科技职业大学	押金保证金	18.54	2.45%
4	上海航都置业有限公司	押金保证金	17.00	2.25%
5	浙江友地安顺安防科技有限公司	押金保证金	15.70	2.08%
合计			478.32	63.25%

5、存货

（1）存货构成及变动情况

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,825.13 万元、4,913.20 万元和 6,440.13 万元，占流动资产的比例分别为 3.23%、2.65%和 2.34%，占比较低，与公司主要从事测试业务相匹配。

报告期各期末，公司存货余额结构如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合同履约成本	2,465.35	37.24%	1,288.62	25.24%	303.18	10.35%
原材料	2,175.89	32.87%	2,325.68	45.56%	1,506.66	51.42%
发出商品	1,069.89	16.16%	643.90	12.61%	259.48	8.86%
库存商品	904.00	13.66%	829.55	16.25%	603.01	20.58%
在产品	4.91	0.07%	17.45	0.34%	257.52	8.79%
合计	6,620.04	100.00%	5,105.20	100.00%	2,929.86	100.00%

公司存货主要由原材料、发出商品、合同履约成本和库存商品等构成。

1) 原材料

报告期各期末，公司原材料的账面余额分别为 1,506.66 万元、2,325.68 万元和 2,175.89 万元，占存货账面余额的比例分别为 51.42%、45.56%和 32.87%，主要为包辅材及耗材等。报告期内，公司原材料金额随着业务规模扩大整体有所增长。

2) 库存商品、发出商品、合同履约成本

报告期各期末，公司库存商品、发出商品、合同履约成本账面余额合计分别为 1,165.67 万元、2,762.07 万元和 4,439.24 万元，占存货账面余额的比例分别为 39.79%、54.10%和 67.06%，金额和占比持续增长，已成为存货的主要构成部分。其中，库存商品主要为量产测试业务已完成测试但尚未发货的测试物对应的履约成本；发出商品主要为已完成测试且测试物已发送至客户但尚未确认部分对应的履约成本；合同履约成本主要为已测试但尚未验收的工程测试服

务对应的履约成本。报告期各期末，上述存货金额和占比持续增长，主要系随着公司集成电路测试业务规模快速扩大，发出商品和合同履约成本增长所致。

（2）存货跌价准备情况

报告期各期末，公司对存货进行减值测试，按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，并计入当期损益。报告期内，公司均以客户提供的产品作为载体提供测试服务，期末正在测试和已测试完成的产品均有对应的订单，期末发出商品、合同履约成本、库存商品中集成电路测试业务相关产品可变现净值均高于账面价值，不存在减值风险。报告期各期末，针对原材料、库存商品等计提的跌价准备金额分别为 104.73 万元、192.00 万元和 179.91 万元，占对应存货账面余额的比例分别为 3.57%、3.76%和 2.72%，存货跌价准备计提充分。

6、合同资产

报告期各期末，公司合同资产账面金额分别为 18.44 万元、86.73 万元和 76.75 万元，占流动资产的比例分别为 0.02%、0.05%和 0.03%，金额和占比均较小，均系集成电路产教融合业务的合同质保金。

7、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
大额可转让存单	74,653.79	81.89%	15,373.93	35.77%	8,415.86	45.21%
待抵扣进项税额	9,760.49	10.71%	21,650.87	50.38%	9,297.33	49.94%
待售集成电路测试硬件	5,148.19	5.65%	5,710.20	13.29%	674.08	3.62%
其他	1,604.64	1.76%	242.85	0.57%	228.64	1.23%
合计	91,167.12	100.00%	42,977.84	100.00%	18,615.90	100.00%

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 18,615.90 万元、42,977.84 万元和 91,167.12 万元，主要是银行大额存单、待抵扣进项税额和待售集成电路测试硬件。待抵扣进项税主要系子公司诸暨芯云、杭州芯云海、诸暨越芯、杭州芯光为项目建设和经营采购工程、设备，产生大额待抵扣进项税。待售集成电路

测试硬件系集成电路测试硬件业务已发送至客户但尚未经验收的测试治具等。

（三）非流动资产构成及其变化

报告期各期末，公司非流动资产分别为 218,376.56 万元、382,301.05 万元和 561,192.50 万元。报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和长期待摊费用等构成，具体结构如下表所示：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	494,347.48	88.09%	329,189.83	86.11%	156,171.47	71.51%
在建工程	17,540.24	3.13%	27,123.70	7.09%	43,122.85	19.75%
使用权资产	2,687.18	0.48%	1,059.54	0.28%	1,995.23	0.91%
无形资产	9,346.57	1.67%	6,217.45	1.63%	6,080.80	2.78%
长期待摊费用	31,285.06	5.57%	14,211.32	3.72%	9,576.31	4.39%
递延所得税资产	1,214.43	0.22%	903.09	0.24%	623.84	0.29%
其他非流动资产	4,771.54	0.85%	3,596.13	0.94%	806.06	0.37%
非流动资产合计	561,192.50	100.00%	382,301.05	100.00%	218,376.56	100.00%

报告期内，各项非流动资产变动情况如下：

1、固定资产

（1）固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产金额分别为 156,171.47 万元、329,189.83 万元和 494,347.48 万元，占非流动资产的比例分别为 71.51%、86.11%和 88.09%。报告期各期末，固定资产的账面价值构成如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	68,829.57	13.92%	45,910.47	13.95%	12,584.43	8.06%
专用设备	422,039.67	85.37%	279,924.27	85.03%	141,826.16	90.81%
通用设备	2,984.39	0.60%	3,087.98	0.94%	1,508.55	0.97%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运输工具	493.86	0.10%	267.10	0.08%	252.33	0.16%
合计	494,347.48	100.00%	329,189.83	100.00%	156,171.47	100.00%

公司固定资产主要为专用设备，包括各类测试机、探针台和分选机等。报告期内，固定资产金额呈快速增长趋势，主要因为报告期内集成电路测试行业快速发展，公司把握行业机遇，为实现营业收入的高速增长而不断采购装备、扩大产能。

（2）固定资产折旧及减值计提情况

报告期各期末，公司固定资产折旧及减值计提情况如下：

单位：万元

2025-12-31					
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	73,194.42	4,364.85	-	68,829.57	94.04%
专用设备	488,447.39	66,407.73	-	422,039.67	86.40%
通用设备	5,828.74	2,844.35	-	2,984.39	51.20%
运输工具	974.70	480.84	-	493.86	50.67%
合计	568,445.25	74,097.76	-	494,347.48	86.96%
2024-12-31					
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	47,884.89	1,974.43	-	45,910.47	95.88%
专用设备	312,450.53	32,526.26	-	279,924.27	89.59%
通用设备	4,596.50	1,508.52	-	3,087.98	67.18%
运输工具	622.30	355.19	-	267.10	42.92%
合计	365,554.23	36,364.40	-	329,189.83	90.05%
2023-12-31					
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	13,340.32	755.89	-	12,584.43	94.33%
专用设备	155,367.51	13,541.35	-	141,826.16	91.28%

通用设备	2,238.39	729.83	-	1,508.55	67.39%
运输工具	519.58	267.25	-	252.33	48.56%
合计	171,465.80	15,294.32	-	156,171.47	91.08%

报告期内，可比公司均未计提固定资产减值准备。公司固定资产运行情况良好，不存在大额长期闲置的固定资产，无迹象表明公司固定资产发生减值，因此，公司未计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，具有合理性。

（3）公司固定资产折旧计提方法与可比公司比较情况

公司采用年限平均法计提折旧，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。报告期内，公司固定资产折旧计提方法与可比公司对比情况如下：

公司名称	固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
伟测科技	房屋及建筑物	年限平均法	20 年	-	5.00%
	专用设备		5-10 年	-	10.00%-20.00%
	运输设备		3 年	-	33.33%
	办公设备		2-5 年	-	20.00%-50.00%
利扬芯片	房屋及建筑物	年限平均法	50 年	5.00%	1.90%
	生产设备		5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
	办公电子设备		3 年	5.00%	31.67%
	运输设备		4 年	5.00%	23.75%
	其他类设备		5 年	5.00%	19.00%
发行人	房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
	专用设备		5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
	通用设备		3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
	运输工具		5 年	5.00%	19.00%

注：相关数据来源于同行业上市公司定期报告等公开披露文件。

由上表可知，公司固定资产折旧计提方法、折旧年限以及残值率与同行业可比公司不存在重大差异。

2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程金额分别为 43,122.85 万元、27,123.70 万元和 17,540.24 万元，占非流动资产的比例分别为 19.75%、7.09%和 3.13%。报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
芯云海集成电路先进测试基地项目	2,811.30	7,252.45	16,746.11
越芯半导体集成电路先进测试基地	2,775.48	5,427.82	635.88
待安装设备	10,305.70	14,342.25	25,180.88
零星工程	1,647.77	101.18	559.98
合计	17,540.24	27,123.70	43,122.85

截至报告期期末，发行人已建设完成并投入量产测试的生产基地为杭州芯云、诸暨芯云和杭州芯云海，其中杭州芯云和诸暨芯云于报告期前已完成建设并投产，杭州芯云海主体厂房产于 2024 年下半年建设完成并转入固定资产。诸暨越芯主体厂房产于 2025 年末建设完成并转入固定资产，预计于 2026 年度投入量产测试。公司在建工程主要为各生产基地及产线建设。报告期各期末，公司在建工程状态良好，不存在减值迹象，无需计提减值准备。

报告期内，公司主要在建工程项目变动情况如下：

单位：万元

2025 年度						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	预算金额	累计投入占预算比例
芯云海集成电路先进测试基地项目	7,252.45	4,233.72	8,674.88	2,811.30	50,500.00	99.10%
越芯半导体集成电路先进测试基地	5,427.82	16,391.78	19,044.12	2,775.48	30,900.00	70.61%
合计	12,680.27	20,625.50	27,719.00	5,586.77	/	/
2024 年度						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	预算金额	累计投入占预算比例
芯云海集成电路先进测试基地项目	16,746.11	29,065.94	38,559.60	7,252.45	50,500.00	90.72%

越芯半导体集成电路先进测试基地	635.88	4,791.94	-	5,427.82	30,900.00	17.57%
合计	17,381.99	33,857.88	38,559.60	12,680.27	/	/
2023 年度						
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	预算金额	累计投入占预算比例
芯云海集成电路先进测试基地项目	203.21	16,542.90	-	16,746.11	50,500.00	33.16%
越芯半导体集成电路先进测试基地	-	635.88	-	635.88	30,900.00	2.06%
合计	203.21	17,178.78	-	17,381.99	/	/

3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产金额分别为 1,995.23 万元、1,059.54 万元和 2,687.18 万元，占非流动资产的比例分别为 0.91%、0.28%和 0.48%，主要系公司及其子公司租赁厂房、办公室等形成的使用权资产。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产金额分别为 6,080.80 万元、6,217.45 万元和 9,346.57 万元，占非流动资产的比例分别为 2.78%、1.63%和 1.67%。报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
土地使用权	8,482.47	90.75%	5,227.54	84.08%	5,278.51	86.81%
软件使用权	864.10	9.25%	989.91	15.92%	802.29	13.19%
合计	9,346.57	100.00%	6,217.45	100.00%	6,080.80	100.00%

公司无形资产主要包括土地使用权和生产经营用软件。2025 年末，公司无形资产规模大幅增加，主要系子公司杭州芯光购置土地所致。报告期内公司不存在开发支出资本化的情形。公司无形资产情况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 9,576.31 万元、14,211.32 万

元和 31,285.06 万元，占非流动资产的比例分别为 4.39%、3.72%和 5.57%。报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
治具费	24,129.80	77.13%	8,333.63	58.64%	3,938.64	41.13%
厂房配套工程	6,573.50	21.01%	5,251.82	36.96%	5,534.40	57.79%
其他	581.76	1.86%	625.87	4.40%	103.28	1.08%
合计	31,285.06	100.00%	14,211.32	100.00%	9,576.31	100.00%

公司长期待摊费用主要包括测试治具和厂房配套工程。长期待摊费用中核算的测试治具系公司采购且已被领用于生产的测试治具，报告期内待摊销治具费增长较快，主要系杭州芯云海等子公司逐步投产，业务规模持续扩大，生产所用治具增多所致。

6、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	6,426.18	1,394.28	1,673.65	238.36	1,828.11	255.19
资产减值准备	4,245.31	543.17	3,089.22	394.99	1,044.93	136.08
内部交易未实现利润	560.63	134.33	-	-	-	-
可抵扣亏损	16,420.70	3,453.89	23,348.23	3,355.74	1,473.44	243.02
租赁负债	2,249.51	319.63	731.32	94.51	1,665.55	217.30
合计	29,902.34	5,845.30	28,842.42	4,083.60	6,012.03	851.59

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	52,118.48	9,532.45	23,938.33	4,104.75	-	-
使用权资产	2,517.95	363.06	832.94	116.11	1,673.07	227.75
合计	54,636.44	9,895.51	24,771.27	4,220.86	1,673.07	227.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	4,630.88	1,214.43	3,180.51	903.09	227.75	623.84
递延所得税负债	4,630.88	5,264.63	3,180.51	1,040.36	227.75	-

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 623.84 万元、903.09 万元和 1,214.43 万元，占非流动资产的比例分别为 0.29%、0.24%和 0.22%，占比较低，主要源于政府补助、可抵扣亏损、计提应收款项坏账准备形成的递延所得税资产。

7、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预付设备款	2,308.49	48.38%	3,418.88	95.07%	743.00	92.18%
定期存款	2,000.00	41.92%	-	-	-	-
待领用治具	463.05	9.70%	177.25	4.93%	63.06	7.82%
合计	4,771.54	100.00%	3,596.13	100.00%	806.06	100.00%

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 806.06 万元、3,596.13 万元和 4,771.54 万元，占非流动资产的比例分别为 0.37%、0.94%和 0.85%，金额

和占比均较低，主要为预付设备款、定期存款和公司采购但尚未被领用的测试治具。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
总资产周转率（次）	0.29	0.25	0.21
应收账款周转率（次）	3.06	2.89	2.87
存货周转率（次）	19.77	17.57	10.31

1、总资产周转率变动分析

报告期内，公司与可比公司总资产周转率对比情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
伟测科技	0.25	0.25	0.21
利扬芯片	0.24	0.21	0.27
平均	0.24	0.23	0.24
发行人	0.29	0.25	0.21

报告期各期，公司总资产周转率分别为 0.21 次、0.25 次和 0.29 次，报告期内呈现稳定上升趋势。报告期期初，公司总资产周转率略低于同行业平均水平，主要系报告期期初发行人集成电路测试业务处于持续扩产初期，为扩大产能规模投入了大量的生产设备，但整体收入规模仍较小，导致总资产周转率较低。随着公司业务和收入规模的快速增长，2024 年起公司总资产周转率已高于可比公司平均水平，资产周转情况较好。

2、应收账款周转率变动分析

报告期内，公司与可比公司应收账款周转率对比情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
伟测科技	3.40	3.09	2.59
利扬芯片	3.33	3.03	3.17

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
平均	3.37	3.06	2.88
发行人	3.06	2.89	2.87

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.87 次、2.89 次和 3.06 次，报告期内呈现稳定上升趋势。报告期内，公司应收账款周转率与可比公司平均水平不存在明显差异。

3、存货周转率变动分析

报告期内，公司与可比公司存货周转率对比情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
伟测科技	65.38	89.16	91.08
利扬芯片	20.66	16.51	15.29
平均	43.02	52.83	53.18
发行人	19.77	17.57	10.31

报告期各期，公司存货周转率分别为 10.31 次、17.57 次和 19.77 次，报告期内呈上升态势。伟测科技存货周转率整体显著高于其他公司，主要系其在完成测试服务并交付测试结果时确认收入，因此其存货中只有周转材料，存货金额相对较低；公司及利扬芯片均在测试物验收后确认收入，已测试完成尚未验收部分需要纳入存货科目核算。报告期各期，公司与利扬芯片存货周转率整体处于同一水平，2023 年度公司存货周转率低于利扬芯片，主要系报告期期初集成电路测试业务处于持续扩产初期，公司为后续业务发展采购了一定金额的包辅材及耗材，但整体业务规模仍较小，导致存货周转率较低。随着集成电路测试业务规模的快速扩大，2024 年起公司存货周转率有所提高，与利扬芯片保持相近水平。

十、偿债能力、流动性及持续经营能力分析

（一）负债结构和偿债能力分析

1、负债构成及其变化的总体情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	225,937.28	37.86%	201,756.79	51.35%	100,105.12	51.78%
非流动负债	370,839.78	62.14%	191,162.03	48.65%	93,208.08	48.22%
负债合计	596,777.06	100.00%	392,918.82	100.00%	193,313.20	100.00%

报告期内，公司负债总额与资产规模变动趋势基本保持一致。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债等组成；非流动负债主要由长期借款、长期应付款、递延收益等组成。报告期内，公司负债规模持续上升，一方面系随着经营规模扩大，公司通过短期借款筹措日常营运资金并扩大采购规模，导致短期借款和应付账款等项目有所增长；另一方面系报告期内公司新投建杭州芯云海、诸暨越芯等生产基地，通过长期借款筹措相应资金，导致长期借款和一年内到期的非流动负债等项目增长较快。

2、流动负债构成及其变化

报告期各期末，公司流动负债分别为 100,105.12 万元、201,756.79 万元和 225,937.28 万元。报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等构成，具体结构如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	21,649.24	9.58%	50,377.58	24.97%	16,312.38	16.30%
应付票据	12,271.67	5.43%	15,106.56	7.49%	11,096.17	11.08%
应付账款	154,440.24	68.36%	109,226.36	54.14%	50,689.31	50.64%
合同负债	4,150.73	1.84%	183.56	0.09%	89.53	0.09%
应付职工薪酬	7,377.47	3.27%	5,001.48	2.48%	2,593.83	2.59%
应交税费	4,333.03	1.92%	5,512.81	2.73%	2,540.51	2.54%
其他应付款	203.17	0.09%	134.85	0.07%	588.64	0.59%
一年内到期的非流动负债	21,371.19	9.46%	16,212.90	8.04%	16,190.19	16.17%
其他流动负债	140.55	0.06%	0.68	0.00%	4.56	0.00%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	225,937.28	100.00%	201,756.79	100.00%	100,105.12	100.00%

报告期内，公司各项流动负债变动情况如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 16,312.38 万元、50,377.58 万元和 21,649.24 万元，占流动负债的比例分别为 16.30%、24.97%和 9.58%。公司短期借款主要为保证借款，主要用于支付采购款及补充流动资金。公司信誉良好，报告期内未发生过逾期未归还贷款或利息的情况。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据金额分别为 11,096.17 万元、15,106.56 万元和 12,271.67 万元，占流动负债的比例分别为 11.08%、7.49%和 5.43%，均为应付银行承兑汇票。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 50,689.31 万元、109,226.36 万元和 154,440.24 万元，占流动负债的比例分别为 50.64%、54.14%和 68.36%。报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工程设备款	119,679.05	77.49%	87,909.34	80.48%	44,107.15	87.01%
货款	33,875.45	21.93%	20,466.92	18.74%	6,458.64	12.74%
费用款	885.73	0.57%	850.09	0.78%	123.52	0.24%
合计	154,440.24	100.00%	109,226.36	100.00%	50,689.31	100.00%

公司应付账款主要为应付供应商工程设备款和货款。报告期内，随着经营规模的扩大，公司采购规模相应增加，应付供应商的款项金额增长较快。公司应付账款中的应付设备工程款主要为应付杭州芯云海、诸暨越芯、杭州芯光等主要生产基地的建设工程款项和设备治具采购款项，应付账款中货款主要为应

付集成电路硬件销售业务采购款项和应付包辅材及耗材等款项。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 89.53 万元、183.56 万元和 4,150.73 万元，占当期流动负债的比例分别为 0.09%、0.09%和 1.84%，金额及占比均较小。2025 年末，合同负债增加较多主要系公司与 A 公司开展新型号芯片量产测试，该项目前期投入较高，A 公司预付了部分测试款项所致。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,593.83 万元、5,001.48 万元和 7,377.47 万元，占流动负债的比例分别为 2.59%、2.48%和 3.27%。应付职工薪酬主要为应付职工的工资、奖金等。报告期各期末，公司应付职工薪酬呈上升趋势，主要系公司经营规模的扩大、员工人数增加所致。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费金额分别为 2,540.51 万元、5,512.81 万元和 4,333.03 万元，占流动负债的比例分别为 2.54%、2.73%和 1.92%。报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
企业所得税	2,296.17	3,188.99	1,467.94
增值税	1,312.60	1,821.60	889.21
房产税	516.90	235.40	102.72
印花税	121.62	132.52	25.84
土地使用税	65.46	63.18	34.35
其他	20.27	71.12	20.46
合计	4,333.03	5,512.81	2,540.51

报告期内，公司应交税费主要由应交企业所得税、增值税和房产税等构成。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为 588.64 万元、134.85 万元和 203.17 万元，占流动负债的比例分别为 0.59%、0.07%和 0.09%，主要为押金保

证金及应付暂收款等。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 16,190.19 万元、16,212.90 万元和 21,371.19 万元，占流动负债的比例分别为 16.17%、8.04%和 9.46%。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
一年内到期的长期借款	20,481.21	13,796.48	11,866.84
一年内到期的长期应付款	-	1,655.03	3,298.44
一年内到期的租赁负债	889.98	761.40	1,024.91
合计	21,371.19	16,212.90	16,190.19

报告期内，公司一年内到期的非流动负债主要为长期借款和长期应付款中一年内到期部分。

（9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 4.56 万元、0.68 万元和 140.55 万元，占流动负债的比例分别为 0.00%、0.00%和 0.06%，均为待转销项税。

3、非流动负债构成及其变化

报告期各期末，公司非流动负债分别为 93,208.08 万元、191,162.03 万元和 370,839.78 万元。报告期内，公司非流动负债主要由长期借款、长期应付款、递延收益等构成，具体结构如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	272,877.06	73.58%	145,917.30	76.33%	51,680.27	55.45%
租赁负债	1,538.54	0.41%	207.36	0.11%	970.35	1.04%
长期应付款	40,000.00	10.79%	-	-	1,655.03	1.78%
递延收益	51,159.54	13.80%	43,997.02	23.02%	38,902.43	41.74%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税负债	5,264.63	1.42%	1,040.36	0.54%	-	-
非流动负债合计	370,839.78	100.00%	191,162.03	100.00%	93,208.08	100.00%

报告期内，公司各项非流动负债变动情况如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款金额分别为 51,680.27 万元、145,917.30 万元和 272,877.06 万元，占非流动负债的比例分别为 55.45%、76.33%和 73.58%。报告期各期末，公司长期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
抵押及保证借款	238,601.06	145,020.46	51,680.27
保证借款	34,275.99	896.84	-
合计	272,877.06	145,917.30	51,680.27

报告期内，公司长期借款主要系为杭州芯云海、诸暨越芯、杭州芯光等生产基地建设向银行借入的长期贷款。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 970.35 万元、207.36 万元和 1,538.54 万元，占非流动负债的比例分别为 1.04%、0.11%和 0.41%，系公司及其子公司租赁厂房、办公室等确认的租赁负债。

（3）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款金额分别为 1,655.03 万元、0.00 万元和 40,000.00 万元，占非流动负债的比例分别为 1.78%、0.00%和 10.79%。报告期各期末，公司长期应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
股权回购义务	40,000.00	-	-

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
设备融资租赁款	-	-	1,655.03
合计	40,000.00	-	1,655.03

公司所处集成电路封测行业具有重资产、资金投入大的特点。杭州禾合滨创股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州鑫创引领自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下合并简称“杭州芯云海少数股东”）看好杭州芯云海未来业务发展，双方于 2025 年 11 月签署《增资协议》，约定杭州芯云海少数股东以 40,000 万元增资认缴杭州芯云海股权，占杭州芯云海的股权比例为 17.38%。基于相关协议中存在股权回购条款，发行人对上述股权投资确认了相应的负债。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 38,902.43 万元、43,997.02 万元和 51,159.54 万元，占非流动负债的比例分别为 41.74%、23.02%和 13.80%，主要为获得的与资产相关政府补助。报告期内，发行人递延收益金额较大，主要系杭州芯云、诸暨芯云、杭州芯云海、诸暨越芯等新建测试基地及对原有测试基地进行扩产而获得的当地政府给予的固定资产投资补助。报告期内，公司与资产相关的政府补助具体明细参见本节之“八/（五）/2、其他收益”。

（5）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债金额分别为 0.00 万元、1,040.36 万元和 5,264.63 万元，占非流动负债的比例分别为 0.00%、0.54%和 1.42%，占比较低，主要源于新增设备一次性扣除形成的递延所得税负债。

4、偿债能力分析

（1）偿债能力指标变动分析

报告期各期，公司的主要偿债能力指标如下：

财务指标	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率（倍）	1.22	0.92	0.87
速动比率（倍）	1.19	0.90	0.85
资产负债率（合并）	71.37%	69.19%	63.20%

资产负债率（母公司）	19.46%	7.41%	6.53%
财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	137,858.97	63,171.38	33,196.60
利息保障倍数（倍）	10.64	5.79	3.59

报告期内，公司流动比率分别为 0.87 倍、0.92 倍和 1.22 倍，速动比率分别为 0.85 倍、0.90 倍和 1.19 倍，呈现逐年增长趋势，不存在较大的流动性风险。报告期各期末，公司资产负债率分别为 63.20%、69.19%和 71.37%，随着经营规模的扩大整体有所上升。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 33,196.60 万元、63,171.38 万元和 137,858.97 万元，逐年快速增长，反映出公司较强的盈利能力。报告期内，公司的利息保障倍数分别为 3.59 倍、5.79 倍和 10.64 倍，公司利润对利息支出的覆盖能力较好，不存在经营成果不足以覆盖利息支出的风险。

报告期内，公司的经营和资产状况良好，银行资信状况良好，与银行建立了较为稳定的合作关系，获得了相对较好的综合授信。公司未来在继续与银行保持良好合作关系的同时，积极准备登陆资本市场融资，拓宽融资渠道，拟通过本次公开发行提高偿债能力，维持更为合理的财务杠杆水平。

（2）同行业可比公司偿债能力指标比较分析

公司与可比公司偿债能力指标比较如下：

指标	公司	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率（倍）	伟测科技	1.00	1.32	1.63
	利扬芯片	1.15	1.71	0.87
	平均	1.08	1.52	1.25
	公司	1.22	0.92	0.87
速动比率（倍）	伟测科技	0.99	1.31	1.63
	利扬芯片	1.12	1.65	0.82
	平均	1.05	1.48	1.22
	公司	1.19	0.90	0.85
资产负债率	伟测科技	61.59%	46.76%	31.86%

指标	公司	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
(合并)	利扬芯片	56.12%	56.74%	45.26%
	平均	58.86%	51.75%	38.56%
	公司	71.37%	69.19%	63.20%

注：相关数据来源于同行业上市公司定期报告等公开披露文件。

报告期内，公司所处的集成电路产业快速发展，下游客户需求持续增长。为抓住行业发展的机遇，满足客户快速增长的需求，公司加快推进产能建设；由于固定资产投资形成的工程及设备投入等因素，应付账款的规模进一步增加。同时，公司作为非上市公司融资渠道相对有限，导致公司项目建设更多地需要依靠自身盈利积累和银行借款，部分流动资产沉淀至固定资产和在建工程等非流动资产，负债余额相对较高。因此，2023 年末和 2024 年末，公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均水平，资产负债率高于同行业可比公司平均水平，符合公司业务和发展的阶段性特点。随着发行人经营规模的快速扩大以及可比公司 2025 年相关投入的加大，2025 年末，发行人流动比率和速动比率已超过同行业平均水平，资产负债率与可比公司平均值之间的差异进一步缩小。

（二）股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配

（三）现金流量分析

报告期内，公司的现金流量表主要情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	175,882.16	48,938.12	82,265.23
投资活动产生的现金流量净额	-304,765.98	-180,130.89	-89,984.72
筹资活动产生的现金流量净额	134,899.20	163,196.24	21,538.31
现金及现金等价物净增加额	5,797.64	32,111.36	13,681.20

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量的构成情况如下：

单位：万元

科目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	270,578.65	108,741.92	86,780.75
收到的税费返还	23,685.01	4,664.75	10,485.37
收到其他与经营活动有关的现金	22,314.80	13,787.43	39,661.77
经营活动现金流入小计	316,578.45	127,194.09	136,927.89
购买商品、接受劳务支付的现金	70,043.59	39,259.06	34,068.83
支付给职工以及为职工支付的现金	43,518.19	27,203.89	15,390.70
支付的各项税费	14,759.10	3,373.24	610.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,375.42	8,419.78	4,593.03
经营活动现金流出小计	140,696.29	78,255.97	54,662.67
经营活动产生的现金流量净额	175,882.16	48,938.12	82,265.23

报告期内，公司净利润调节为经营活动现金流量净额的过程如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	61,972.16	20,266.39	9,941.85
加：资产减值准备	62.33	93.35	0.88
信用减值损失	1,250.35	2,071.27	13.97
固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,266.69	23,984.11	13,265.57
无形资产摊销	400.96	309.52	170.77
长期待摊费用摊销	18,038.25	11,377.12	4,268.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1.55	-	-34.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	3.06	0.28
财务费用（收益以“－”号填列）	7,495.91	4,688.91	4,480.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,372.10	-443.82	-123.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-311.33	-279.25	-226.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,224.28	1,040.36	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,587.88	-2,175.34	381.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,784.09	-58,749.46	1,972.45

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,691.11	46,623.31	48,024.43
股份支付费用	2,533.98	128.60	128.60
经营活动产生的现金流量净额	175,882.16	48,938.12	82,265.23
差额（经营活动现金流量净额-净利润）	113,910.00	28,671.73	72,323.37

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大于净利润主要系公司从事集成电路测试业务，机器设备折旧金额占主营业务成本的比重比较高，固定资产折旧费用、长期待摊费用摊销系非付现成本。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

科目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得投资收益收到的现金	233.97	129.43	85.66
收到其他与投资活动有关的现金	196,304.72	24,356.32	39,470.00
投资活动现金流入小计	196,538.69	24,485.74	39,555.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,866.14	173,616.63	81,691.92
支付其他与投资活动有关的现金	271,438.53	31,000.00	47,848.45
投资活动现金流出小计	501,304.67	204,616.63	129,540.37
投资活动产生的现金流量净额	-304,765.98	-180,130.89	-89,984.72

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-89,984.72 万元、-180,130.89 万元和-304,765.98 万元，各期均为净流出，主要系公司持续进行产能投建，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出较大所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	40,000.00	42,000.00	46,025.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得借款收到的现金	169,411.81	151,677.76	39,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,909.89	15,369.40	1,839.65
筹资活动现金流入小计	220,321.70	209,047.16	87,644.65
偿还债务支付的现金	75,668.49	37,033.33	46,158.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,991.75	4,179.74	3,105.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,762.27	4,637.85	16,841.76
筹资活动现金流出小计	85,422.51	45,850.91	66,106.34
筹资活动产生的现金流量净额	134,899.20	163,196.24	21,538.31

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 21,538.31 万元、163,196.24 万元和 134,899.20 万元，各期均为净流入，主要为公司为加快产能建设，引入外部投资者取得的股东投资款和银行借款。

（四）持续经营能力分析

公司是最大的内资第三方集成电路测试企业，专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。公司凭借优秀的自主研发能力和强大的产业化落地能力，顺应先进工艺和先进封装的行业趋势，持续助力高端芯片测试的国产化替代，为客户提供包括晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、老化测试（BI）、系统级测试（SLT）、工程测试服务等在内的一站式芯片量产测试解决方案。公司测试的芯片产品包括算力芯片、高性能 SoC 芯片、光学芯片、车载芯片、射频芯片、传感器芯片等多种芯片类型，下游应用聚焦高端算力、消费电子、车载智控、通讯及工控等重要领域，同时还覆盖导航通信、智能家居、穿戴设备等多个重要场景。

公司深耕自主可控的第三方集成电路测试服务，经过长期的技术研发与国产工艺适配，与 A 公司等集成电路设计以及封装企业建立了稳定的合作关系。2025 年度，发行人集成电路测试业务收入为 20.33 亿元，在境内第三方集成电路测试服务的市场份额约为 18%、市场份额较高。根据集成电路测试业务收入统计，公司已成为最大的内资第三方集成电路测试企业。

此外，可能对公司盈利能力产生不利影响的风险因素已在本招股说明书“第三节 风险因素”中披露，公司特别提醒投资者仔细阅读本招股说明书中的上述内容。

报告期内，发行人财务状况和盈利能力良好，发行人的经营模式、产品结构未发生重大不利变化；发行人的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大不利变化；发行人在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；发行人最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。综上，发行人具有持续经营能力。

十一、重大投资、资本性支出与业务重组

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为 81,691.92 万元、173,616.63 万元和 229,866.14 万元。报告期内公司资本性支出主要用于建造厂房、购买土地使用权、购置生产用设备等。公司重大资本性支出主要围绕主营业务进行，扩大了公司产能，满足日益增长的市场需求并提升公司的综合竞争力。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

报告期末，公司未来可预见的重大资本性支出计划为本次公开发行股票募集资金投资项目。本次发行募集资金投资项目具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（三）重大资产业务重组

报告期内，公司不存在重大资产业务重组事项。

十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，根据诸暨教育股东会决议，同意对诸暨教育进行清算。截至 2026 年 4 月，诸暨教育已完成对剩余财产的分配，并办妥工商注销登记手续。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在未决诉讼仲裁形成的或有负债，不存在为关联方和非关联方提供的担保事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需披露的重大担保、诉讼及其他重要事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目基本情况

公司本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,430.7187 万股，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于 25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。

本次募集资金投向经公司股东会审议通过，由董事会负责实施。各投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	实施主体
1	杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目	400,000.00	320,000.00	杭州芯光
2	越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目	200,000.00	200,000.00	诸暨越芯
3	总部研发大楼项目	41,683.99	41,683.99	朗迅科技
4	补充流动资金项目	90,000.00	90,000.00	朗迅科技
合计		731,683.99	651,683.99	-

注：杭州芯光、诸暨越芯均为发行人全资子公司。

如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据上述项目的实际情况以自筹资金先行投入，并于募集资金到位后置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过项目需求，公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。

（二）募集资金的使用管理制度

公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。公司将严格履行募集资金使用的相关审批手续，保障募集资金的安全和高效使用。本次募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户集中管理、专款专用，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，规范使用募集资金。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献，对未来经营战略的影响

1、募集资金投资项目对公司主营业务发展的贡献

公司专注于第三方集成电路测试业务。近年来，公司主营业务规模持续增长，市场竞争力不断增强。本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务、基于发行人现有核心技术开展，与公司未来发展规划相一致，致力于进一步提升公司的先进集成电路测试能力、加强技术研发实力，并为公司业务发展提供长期资金支持。

杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目专注于集成电路测试业务，公司把握高端芯片测试的国产化替代机遇，以及人工智能、车载智控、消费电子等领域快速增长的测试需求，通过在杭州市富阳区新建生产基地、配置自动化测试设备以进一步提升公司集成电路测试能力。项目的实施有助于并进一步增强公司对高端芯片的测试能力，满足持续增长的测试需求，推动公司规模化发展、巩固行业内市场地位，为市场及客户提供自主可控的集成电路测试服务选择。

越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目亦着力于提升公司集成电路测试能力，项目专注于消费电子、车载智控等领域，通过在诸暨市新建生产基地，进一步扩充公司高端产品测试产能，完善公司生产基地布局。

总部研发大楼项目致力于完善办公及研发环境、提升人才吸引力，同时提升公司研究开发能力、增强公司技术储备、为促进公司未来经营规模增长、保持行业技术领先提供有力支撑。通过新建总部基地及研发中心，购置先进研发设备，进行前瞻性的全流程测试技术研发，进一步完善、深化公司核心技术体系。同时，通过优化研发及办公环境，提升公司对于行业高端人才的吸引力，增强公司综合竞争力。

补充流动资金项目将扩大公司流动资金规模，有助于满足公司业务快速发展的需要，提高短期偿债能力，从而进一步增强公司财务的稳健性，为公司持续快速发展提供有力支持。

2、募集资金投资项目对公司未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目与公司未来发展战略紧密结合，项目的建设实施

是公司未来发展的重要环节。本次募集资金投资项目紧密结合公司主营业务发展需求和行业变化趋势，着力提升公司在人工智能、高端消费电子、车载智控等芯片领域的测试服务能力，增强公司研发技术实力以及整体财务稳定性，对增强竞争优势、落实未来发展战略具有重要意义。

（四）募集资金投资项目与发行人主要业务、核心技术之间的关系

公司专注于第三方集成电路测试业务，核心技术覆盖集成电路测试的全流程软硬件体系。本次募集资金投资项目包括杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目、越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目、总部研发大楼项目、补充流动资金项目，对公司提升高端芯片测试能力、扩大主营业务规模、加强业务创新能力和充实公司资金实力提供了有力的支撑，切实增强公司主营业务的持续经营能力，推动公司核心技术体系应用和深化，巩固公司核心竞争力和市场领先地位。

（五）募集资金投资项目实施后对公司同业竞争情况及独立性的影响

本次募集资金投资项目中，杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目实施主体为杭州芯光，越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目实施主体为诸暨越芯，总部研发大楼项目、补充流动资金项目实施主体为朗迅科技，上述项目实施主体均为发行人及其全资子公司，实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争，不会对公司独立性产生不利影响。

（六）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，募集资金均投向公司主营业务相关领域，与公司现有的发展阶段、生产经营规模、财务状况、技术水平及管理能力相适应，符合国家产业政策、环保政策以及其它相关法律、法规的规定，投资估算及效益分析表明项目各项财务指标良好。

本次募集资金具体运用及项目建设的情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、募集资金具体运用情况”。

二、公司未来发展战略规划

（一）发展规划

公司专注于第三方集成电路测试服务，致力于推动集成电路测试领域的自主可控进程，在 CP、FT 测试能力基础上，进一步整合了 BI、SLT 测试以及工程测试服务，提供了全流程测试解决方案，并与行业内头部集成电路设计企业建立了稳定业务往来，目前已成为最大的内资第三方集成电路测试企业。

未来公司将秉承“建设世界一流的集成电路测试基地”的愿景，发挥在参与国产集成电路产业链构建与催熟过程中积累的核心技术、产业经验等方面的优势，继续深耕前沿集成电路测试领域，并进一步推动测试能力增长，满足包括算力芯片、光学芯片、车载芯片等一系列高端芯片的测试需求。同时，公司将在服务好现有客户的基础上持续进行客户拓展与开发，进一步巩固和扩大竞争优势，更好地推动集成电路产业链国产化进程。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续保持高水平的研发投入，强化公司技术积累

公司高度重视自主创新，报告期内研发投入长期保持在较高水平，并随着经营规模的扩大而持续增长。公司立足国产化测试平台及供应链，持续开展技术研发，形成了完整的集成电路软硬件装备的技术开发能力。同时，公司在长期的产业实践中打造了资深的研发技术团队，建立了健全的创新体制机制，在测试方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化等领域有着丰富的理论和实践经验。公司高水平的研发投入夯实了公司的技术积累，为增强公司核心竞争力及可持续发展能力提供了重要保障。

2、立足自主可控的集成电路产业链，推进国产化替代进程

公司深度融入集成电路国产化进程，为产业链上下游提供包括工艺缺陷定位、测试数据反馈、设备量产验证在内的多项产业信息，参与了国产化测试产业链设备、工艺及软件系统的催熟。公司与设计方、国产测试设备厂商等开展密切合作，并在此基础上进行测试技术开发、测试量产导入，构建了自主可控的产业链条，共同推进国产测试产业链测试能力的发展和迭代。

3、持续推动测试产能建设，满足快速增长的市场需求

报告期内，境内集成电路测试需求快速增长，公司持续推动测试产能建设、扩充，满足快速增长的市场需求，目前，公司已在杭州、诸暨等多地设立了高端测试基地、实验室，主要测试主体包括杭州芯云、杭州芯云海、诸暨芯云等，测试产品从早期的通信网络芯片，拓展至高性能 SoC 芯片、光学芯片、高端算力芯片，并进一步延伸至车载芯片等，满足快速增长的市场需求，并持续拓展市场份额，为公司经营规模的快速增长提供保障。

（三）未来规划采取的措施

1、积极实施募集资金投资项目

公司本次申请首次公开发行，募集资金将用于杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目、越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目、总部研发大楼项目、补充流动资金项目。通过募集资金投资项目实施，公司高端芯片测试服务能力将得到进一步提升，为公司业务规模增长、巩固市场地位提供有力支撑。同时，公司研发创新能力、人才吸引力亦将得到提高，为公司把握行业发展机遇、实现发展战略提供重要的支持。公司将按照计划积极推进募集资金投资项目的建设，严格按照相关法律法规和《募集资金管理制度》管理和使用募集资金。

2、增强研发技术投入，引领公司业务发展

集成电路产业属于人才、技术密集型行业，对于从业人员专业素质、产业经验具有较高的要求，需要测试人员能够对前沿制程、先进封装技术带来的更高测试需求做到业务的快速响应与知识的持续迭代。公司未来将继续立足国产化的集成电路测试产业链，持续加大研发投入，推动公司在测试方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化等方面核心技术的持续深化与应用，并为产业链上下游提供设备、工艺及软件系统的催熟，以持续的研发技术投入引领公司业务发展，增强公司的市场竞争力。

3、丰富多样化的产品测试能力，满足市场需求

近年来，人工智能、辅助驾驶等一系列新兴领域快速发展，带动了高端算力、车载、存储芯片等一系列新型产品测试需求；同时圆片级封装（WLP）、

2.5D 封装、3D 封装、Chiplet 等多种先进封装技术加速应用，亦对测试厂商测试能力提出了进一步要求。公司未来将持续丰富多样化的产品测试能力，对于市场趋势进行前瞻性分析和技术布局，不断拓宽公司测试服务领域，满足市场及客户需求，为公司可持续发展提供增长空间。

4、进一步提升测试服务规模，配置测试产能

充足的测试服务规模和产能是公司业务开展的基础。与京元电子等全球领先的第三方测试服务商相比，公司在测试基地规模、测试服务产能方面仍有一定距离。为满足集成电路国产化趋势下持续增长的业务需求，公司未来将持续增加对于测试服务能力的投入，通过杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目、越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目的投入，进一步扩充整体产能，并通过配置高洁净度的测试环境、先进的测试设备，强化公司在高端芯片测试领域的的能力优势，为公司行业地位的巩固和市场份额的提升夯实基础。

5、重视人才培养和人才队伍建设

公司在研发、生产、管理等各领域已形成较为完善的人才梯队，为公司持续发展壮大提供了有力的支撑。未来，随着公司业务规模的扩大以及研究开发需求的增长，公司对于具备相关专业领域知识的高素质人才需求将持续增加。公司将进一步以总部研发大楼项目为契机，提升公司人才吸引力，提供有市场吸引力的薪酬水平，重视在研发、生产、管理方面的人才引进和培养，建立内部培养与外部招聘并重的团队建设机制，为公司发展提供坚实的人才支撑。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自整体变更设立股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，并参照中国证监会、深交所的其他相关要求，建立健全了公司股东（大）会、董事会及其专门委员会和经营管理层组成的公司治理架构，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等规范性文件。

截至本招股说明书签署之日，公司治理规范不存在重大缺陷。公司股东（大）会、董事会、审计委员会（取消监事会前的监事会）和高级管理人员均能按照相关法律法规以及公司治理制度文件的要求履行职责。公司各项重大决策严格依据公司相关文件规定的程序和规则进行，公司法人治理结构和制度运行有效。

二、公司内部控制评价意见

（一）内部控制的自我评估意见

根据《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具了《内部控制自我评价报告》，评价结论如下：

“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”

（二）注册会计师对公司内部控制的审计意见

天健所根据财政部《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，对公司内部控制制度进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕14271号），认为：“朗迅科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

三、公司违法违规情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运作、依法经营，不存在重大违法违规行为，也未受到相关主管机关的重大处罚。

报告期内，公司受到 1 起行政处罚，相关处罚不属于重大违法违规或重大处罚情形，具体如下：

序号	涉及主体	处罚机关	处罚金额	处罚事项及内容	不属于重大违法违规或重大处罚的说明
1	浙江华芯	国家税务总局金华义新区（金东区）税务局孝顺税务分局	150 元	浙江华芯半导体技术有限公司 2024-03-01 至 2024-03-31 个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报，违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，合并处罚 1-3 月未申报，给予浙江华芯罚款 150 元的简易程序处罚（金东税孝 顺 简 罚 字 [2024]2368 号）	根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。 浙江华芯及时缴纳了罚款并采取了改正措施，且根据上述规定，浙江华芯的违法情形属于法定裁量标准中较轻的处罚情形，处罚金额属于上述规定中处罚幅度的较低阶次。公司前述行政处罚适用简易程序作出，罚款金额较小，违法情节轻微，不属于重大违法违规行为，不会对公司日常经营活动造成不利影响，不会对本次发行上市构成实质障碍。

除上述行政处罚外，公司及其子公司报告期内未受到其他处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。根据《新加坡法律意见书》，报告期内，公司新加坡子公司未受到任何行政处罚，也无任何官方或监管机构的调查或法律纠纷。

四、公司资金占用和对外担保情况

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。目前，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整情况

公司系由朗迅有限整体变更设立，承继了朗迅有限全部资产、负债及权益，整体变更后，公司依法办理了相关资产和产权的变更登记。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和相关配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的采购和销售体系。公司资产权属清晰，与股东资产严格分开，并完全独立运营。

截至本招股说明书签署日，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。

（二）人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员未

在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职。

（三）财务独立情况

公司已根据《企业会计准则》等法律法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立进行财务决策。公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员。公司在银行开立了独立的账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法进行纳税申报并履行纳税义务。

（四）机构独立情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规及相关规定建立了股东会、董事会等有效的法人治理结构。公司根据经营发展的需要，建立了一套符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，明确了各机构的职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业机构混同的情形。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，未发生控股股东或其他股东干预发行人机构设置和生产经营活动的情况。

（五）业务独立情况

公司拥有独立、完整的技术研发体系和生产、销售、服务体系，所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定情况

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更。

（七）其他对持续经营有重大影响事项

报告期内，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在同业竞争

公司专注于第三方集成电路测试服务，聚焦自主可控的国产集成电路测试供应链，凭借强大的软硬件自主研发能力，持续推进高端芯片测试的国产化替代。截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，公司实际控制人及其近亲属直接或间接控制的企业情况如下：

序号	公司名称	持股比例	主营业务
1	金华市新城印刷厂	徐振持有 100.00%股权	主要从事印刷品印刷业务，未从事与发行人主营业务相关的业务
2	杭州汇芯	徐振持有 78.73%出资额，并担任执行事务合伙人	员工持股平台，未从事与发行人主营业务相关的业务
3	杭州朗新	徐振持有 65.00%出资额，并担任执行事务合伙人	投资平台，未从事与发行人主营业务相关的业务
4	杭州聚芯	徐振持有 0.04%出资额，并担任执行事务合伙人	投资平台，未从事与发行人主营业务相关的业务

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业实际从事的业务与发行人不存在相同或相似的情形。

（二）防范利益输送、利益冲突及保持独立性的具体安排

为避免今后可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人徐振及一致行动人黄庆红、章小婵、何涛、寿佳琪已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五/（七）关于避免新增同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定并对照公司实际情况，公司关联方及关联关系情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司的控股股东、实际控制人为徐振。黄庆红、章小婵（一致行动关系有效期为协议生效之日起至上市后 60 个月），何涛、寿佳琪（一致行动关系有效期为其董事在任期间）为实际控制人徐振的一致行动人。

相关具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二/（一）/1、董事”。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，徐振除控制发行人及其子公司外，还控制杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯和金华市新城印刷厂，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州汇芯	徐振持有 78.73%出资额，并担任执行事务合伙人
2	杭州朗新	徐振持有 65.00%出资额，并担任执行事务合伙人
3	杭州聚芯	徐振持有 0.04%出资额，并担任执行事务合伙人
4	金华市新城印刷厂	徐振持股 100.00%

杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯的具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七/（三）/1、杭州汇芯、杭州朗新及杭州聚芯”。

金华市新城印刷厂的具体情况如下：

企业名称：	金华市新城印刷厂
统一社会信用代码：	91330702704532750W
成立时间：	1998年5月19日
注册资本：	10.00万元

投资人：	徐振
注册地和主要生产经营地：	浙江省金华市婺城区白龙桥工业园区（机场路）
主营业务及与公司主营业务的关系：	主要从事印刷品印刷业务，未从事与发行人主营业务相关的业务
经营范围：	其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（凭有效许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、持有公司 5%及以上股份的其他股东

除公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业外，其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	赋实投资、视谷创投	赋实投资和视谷创投为关联股东，合计持有公司 6.47%的股份，共同构成直接持有公司 5%以上股份的股东
2	宁波工投、和丰创投、宁波通商	宁波工投、和丰创投和宁波通商为关联股东，合计持有公司 5.62%的股份，共同构成直接持有公司 5%以上股份的股东

上述股东的具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七 /（三）持有公司 5%以上股份或表决权的其他主要股东”。

4、公司控股、参股子公司

发行人的控股、参股子公司具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人子公司、参股公司情况”。

5、公司的董事、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不存在监事。公司董事、高级管理人员为公司的关联自然人，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二/（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”。

6、公司关联自然人关系密切的家庭成员

公司以上关联自然人的关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等。

7、关联自然人直接或间接控制或施加重大影响的或者担任董事、高级管理人员的其他法人或组织

截至报告期末，除前述关联法人外，公司关联自然人直接或间接控制或施加重大影响的或者担任董事、高级管理人员的其他法人或组织（独立董事担任独立董事的除外）如下：

关联方	关联关系
杭州智远针织制衣有限公司	董事章小婵持有 60.00%股权；配偶唐建林持有 40.00%股权并担任执行董事兼总经理
杭州良田电子科技有限公司	董事章小婵持有 60.00%股权；配偶唐建林持有 40.00%股权并担任执行董事兼总经理
杭州聚和致盛文化有限公司	董事章小婵持有 51.00%股权并担任董事；配偶唐建林持有 49.00%股权并担任经理
杭州理想电子有限公司	董事章小婵持有 40.00%股权；配偶唐建林持有 60.00%股权并担任执行董事兼总经理
杭州诗娜文化创意有限公司	董事章小婵持有 49.00%股权；子女唐诗娜持有 51.00%股权并担任执行董事兼总经理
杭州超熔科技有限公司	董事果桐担任董事
宁波云德半导体材料有限公司	董事果桐担任董事
杭州灵竹贸易有限公司	董事果桐之配偶的父亲李冯持有 30.00%股权
杭州灵影食品有限公司	董事果桐之配偶的父亲李冯持有 49.00%股权
磐安县浙宇中药材经营部	董事何涛之配偶的姐妹王浙娜经营的个体工商户
杭州萧山丰加寸食品店	董事寿佳琪之父寿元才经营的个体工商户
上海晶沛电子材料有限公司	独立董事陆宁担任董事长、经理
金华恒发工贸有限公司	独立董事钱程之兄弟钱能持有 70.00%股权并担任执行董事、经理；兄弟之配偶赵榄持有 30.00%股权
浙江斯诺科技有限公司	独立董事钱程之兄弟钱能持有 95.00%股权并担任执行董事、经理；兄弟之配偶赵榄持有 5.00%股权
江西博源税务师事务所有限公司	独立董事张开元持有 99.50%股权并担任董事、经理
杭州蔚复来智造企业管理合伙企业（有限合伙）	独立董事张开元持有 99.80%合伙份额
江西新开源房地产土地资产评估有限公司	独立董事张开元之母何莉持有 40.00%股权并担任总经理
杭州佳柏建筑工程有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳持有 100.00%股权并担任经理、董事和财务负责人
杭州汉双商务服务有限公司	杭州佳柏建筑工程有限公司持有 51.00%股权
杭州均华建筑工程有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳持有 100.00%股权并担任经理、董事和财务负责人
杭州广双商务服务有限公司	杭州均华建筑工程有限公司持有 51.00%股权

关联方	关联关系
杭州杰岚置业有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州杰阳置业有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
浙江中贯建设工程有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
浙江杰升房地产开发有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
浙江杰天房地产开发有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
浙江杰大房地产开发有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
淳安千岛湖杰立度假酒店有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州慧双企业管理有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州敏双房地产开发有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州万双房地产开发有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州伟双企业管理有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
合肥杰立建材商贸有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州杰立物资贸易有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
浙江杰立酒店管理有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
浙江杰立控股有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州中贯物业服务有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟的配偶柏佳佳担任财务负责人
杭州智程电子有限公司	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟夏礼航持有 100.00% 股权；配偶周晓华担任执行董事兼总经理、财务负责人
义乌市护卫电子商务商行	董事会秘书、副总经理夏丽君之兄弟夏礼航经营的个体工商户
哈尔滨市华通电线电缆厂	财务总监刘思霖之配偶的母亲王嘉颖持有 30.00% 股权；配偶的父亲宁连滨持有 10.00% 股权
萍乡市创友信息技术有限公司	财务总监刘思霖之姐妹的配偶胡家明持有 100.00% 股权并担任董事、经理
杭州心柠科技有限公司	财务总监刘思霖之配偶宁昀熙持有 60.00% 股权并担任董事、经理；配偶的母亲王嘉颖持有 40.00% 股权

8、其他关联方

报告期内曾为公司关联方的自然人、法人或者其他组织主要情况如下：

关联方	关联关系
徐守政	报告期内曾任董事，已于 2025 年 3 月卸任
黄治文	报告期内曾任董事，已于 2023 年 9 月卸任
吴越	报告期内曾任独立董事，已于 2025 年 10 月卸任
丁勇	取消监事会前在任监事，已于 2025 年 10 月卸任
夏明	取消监事会前在任监事，已于 2025 年 10 月卸任
汪明珠	报告期内曾任监事，已于 2023 年 6 月卸任
洪涛	报告期前 12 个月曾任发行人监事
尹素君	报告期前 12 个月曾任发行人董事
浙江华芯	发行人曾持有 100.00%股权，已于 2025 年 2 月注销
江西朗驰	朗迅数智曾持有 100.00%股权，已于 2025 年 3 月注销
江阴芯云	杭州芯云曾持有 100.00%股权，已于 2025 年 2 月注销
鸿溢盛新	报告期内合计曾持有 5%以上股权的股东，其执行事务合伙人及私募基金管理人均为显璠（上海）投资管理有限公司
鸿溢盛朗	
张伟杰	张伟杰报告期内曾任董事；张伟杰系天问时代的实际控制人，天问时代系天问磐盈、天问华欣的基金管理人、执行事务合伙人，系天问愿景的执行事务合伙人，张伟杰、天问磐盈、天问华欣、天问愿景报告期内直接及间接持股曾合计超过 5%
天问磐盈	
天问华欣	
天问愿景	
杭州润唐文化创意有限公司	董事章小婵之配偶的姐妹唐建妹曾任监事，已于 2023 年 12 月卸任，依据实质重于形式原则认定为关联方
宁波迪泰科技股份有限公司	董事果桐曾任董事，已于 2025 年 3 月卸任
宁波璟仁投资有限公司	独立董事张开元曾任经理，已于 2023 年 10 月卸任
江西天平工程造价咨询有限责任公司	独立董事张开元之母亲何莉曾任总经理，已于 2024 年 9 月卸任
浙江星华新材料集团股份有限公司及其子公司	董事会秘书、副总经理夏丽君曾任董事会秘书、财务总监、副总经理，已于 2023 年 8 月卸任
浙江省半导体行业协会	报告期内监事丁勇施加重大影响的行业协会，依据实质重于形式原则认定为关联方
杭州集成电路基地	报告期内监事丁勇担任总经理的企业

除此之外，上述关联方报告期内、在过去十二个月内或根据安排在未来十二个月内，存在上述第 1 至 7 项的法人、其他组织、自然人，亦属于公司的关联方。

（二）关联交易

1、报告期内关联交易总体情况

报告期内，公司发生的全部关联交易情况如下：

单位：万元

交易类别	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度	是否重大关联交易
经常性关联交易	关联采购	2.20	4.80	2.20	否
	关键管理人员薪酬	881.42	712.27	527.08	否
偶发性关联交易	关联采购	-	-	55.08	否
	关联担保	参见本节之“七/（二）/3、重大关联交易”			是

注：以上关键管理人员薪酬主要包括：工资、社保、公积金等，未含以权益结算的股份支付金额（具体参见本招股说明书第六节之“八/（四）/2、管理费用”），且根据关键管理人员任职、卸任当年的全年薪酬汇总统计。

2、重大关联交易的判断标准

参考《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将以下关联交易认定为重大关联交易：（1）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；（2）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。此外，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出，视作一般关联交易。

3、重大关联交易

报告期内，公司不存在重大经常性关联交易，存在接受关联担保的重大偶发性关联交易，具体情况如下：

（1）关联担保

报告期内，公司存在实际控制人及其配偶为发行人银行借款提供的保证担保，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保主债权	保证期间	截至报告期末担保是否履行完毕
1	徐振、郭晓晨	朗迅集成	中国银行股份有限公司滨江支行	2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日期间发生的最高额不超过 500.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 2 年	是

序号	担保人	被担保人	债权人	担保主债权	保证期间	截至报告期末担保是否履行完毕
2	徐振、郭晓晨	朗迅科技	中国银行股份有限公司滨江支行	2020年9月3日至2023年9月2日期间发生的最高额不超过1,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起2年	是
3	徐振、郭晓晨	杭州芯云	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2021年9月23日至2022年6月30日期间发生的最高额不超过4,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
4	郭晓晨	杭州芯云	南京银行股份有限公司杭州分行	2021年11月10日至2022年11月9日期间发生的最高额不超过500.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
5	徐振	杭州芯云	南京银行股份有限公司杭州分行	2021年11月10日至2022年11月9日期间发生的最高额不超过500.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
6	徐振、郭晓晨	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	2022年1月11日至2024年1月10日期间发生的最高额不超过5,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
7	徐振、郭晓晨	杭州芯云	上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	2022年1月12日至2025年1月12日期间发生的最高额不超过2,100.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
8	徐振、郭晓晨	朗迅科技	江苏银行股份有限公司杭州分行	2022年1月21日至2023年1月18日期间发生的最高额不超过1,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
9	徐振、郭晓晨	朗迅科技	北京银行股份有限公司杭州分行	2022年1月26日至2023年1月25日期间发生的最高额不超过2,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
10	徐振	诸暨芯云	交通银行股份有限公司杭州城西支行	2022年3月9日至2027年12月20日期间发生的最高额不超过56,500.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	否
11	徐振	朗迅科技	宁波银行股份有限公司杭州分行	2022年5月16日至2027年5月31日期间发生的最高额不超过1,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起2年	是
12	徐振、郭晓晨	诸暨芯云	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022年5月25日至2025年5月25日期间发生的最高额不超过4,000.00万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起3年	是
13	徐振、郭晓晨	杭州芯云、诸暨芯云	中信金融租赁有限公司	2022年6月28日至2025年6月27日期间发生的11,111.67万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起	是

序号	担保人	被担保人	债权人	担保主债权	保证期间	截至报告期末担保是否履行完毕
					3 年	
14	郭晓晨	朗迅科技	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的最高额不超过 1,320.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
15	徐振	朗迅科技	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的最高额不超过 1,320.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
16	徐振、郭晓晨	朗迅科技	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的 200.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
17	郭晓晨	朗迅集成	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的 100.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
18	徐振	朗迅集成	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的 100.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
19	郭晓晨	杭州芯云	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的最高额不超过 1,650.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
20	徐振	杭州芯云	杭州银行股份有限公司科技支行	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间发生的最高额不超过 1,650.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
21	徐振	诸暨芯云	兴业银行股份有限公司杭州分行	2022 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日期间发生的最高额不超过 35,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	否
22	徐振	杭州芯云、诸暨芯云	浙商融资租赁有限公司	2022 年 9 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日期间发生的 8,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
23	徐振	朗迅科技	兴业银行股份有限公司杭州分行	2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 30 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
24	徐振	杭州芯云	兴业银行股份有限公司杭州分行	2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 30 日期间发生的最高额不超过 2,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
25	徐振、郭晓晨	朗迅科技	浙商银行股份有限公司杭州	2022 年 9 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日期间发生的	主合同下债务履行期限	是

序号	担保人	被担保人	债权人	担保主债权	保证期间	截至报告期末担保是否履行完毕
			分行	最高额不超过 2,200.00 万元债权	届满之日起 3 年	
26	郭晓晨	朗迅科技	南京银行股份有限公司杭州分行	2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
27	徐振	朗迅科技	南京银行股份有限公司杭州分行	2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
28	郭晓晨	杭州芯云	南京银行股份有限公司杭州分行	2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
29	徐振	杭州芯云	南京银行股份有限公司杭州分行	2022 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
30	徐振、郭晓晨	杭州芯云	江苏银行股份有限公司杭州分行	2022 年 11 月 7 日至 2023 年 9 月 28 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
31	徐振、郭晓晨	朗迅科技	上海银行股份有限公司杭州分行	2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 8 日期间发生的最高额不超过 1,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
32	徐振、郭晓晨	杭州芯云	上海银行股份有限公司杭州分行	2022 年 11 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日期间发生的最高额不超过 2,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
33	徐振、郭晓晨	诸暨芯云	浙商诸暨农村商业银行股份有限公司	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 7 月 30 日期间发生的最高额不超过 9,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
34	徐振	朗迅科技	中国光大银行股份有限公司杭州分行	2023 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日期间发生的最高额不超过 3,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是
35	徐振	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 19 日期间发生的最高额不超过 8,000.00 万元债权	主合同下债务履行期限届满之日起 3 年	是

4、一般关联交易

（1）一般经常性关联交易

报告期内，发行人一般经常性关联交易主要系发行人接受关联方服务及支付关键管理人员薪酬，主要情况如下：

单位：万元

类别	关联方	关联交易内容	是否重大关联交易	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关联采购	浙江省半导体行业协会	会费及服务费	否	2.20	4.80	2.20
关键管理人员薪酬	董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员	薪酬	否	881.42	712.27	527.08

注：以上关键管理人员薪酬主要包括：工资、社保、公积金等，未含以权益结算的股份支付金额（具体参见本招股说明书第六节之“八/（四）/2、管理费用”），且根据关键管理人员任职、卸任当年的全年薪酬汇总统计。

1）关联采购

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人接受服务金额分别为 2.20 万元、4.80 万元和 2.20 万元，占当期营业成本比重较低，主要系发行人向浙江省半导体行业协会支付行业协会会费及服务费。公司作为浙江省半导体行业协会会员，缴纳协会会费及相关服务费具有合理性，与浙江省半导体行业协会向其他成员提供服务的价格不存在明显差异。

2）关键管理人员薪酬

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员领取的薪酬金额分别为 527.08 万元、712.27 万元和 881.42 万元。

发行人向部分董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员发放薪酬为正常经营需要，未来将持续发生。

（2）一般偶发性关联交易

报告期内，发行人一般偶发性关联交易主要为关联采购，主要情况如下：

单位：万元

类别	关联方	关联交易内容	是否重大关联交易	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关联采购	杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	集成电路服务	否	-	-	5.66

	杭州润唐文化创意有限公司	购买商品	否	-	-	49.42
--	--------------	------	---	---	---	-------

2023 年，发行人向杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司关联采购金额为 5.66 万元，为零星集成电路软件服务采购。2023 年，发行人向杭州润唐文化创意有限公司关联采购金额为 49.42 万元，为员工福利物品采购。上述交易金额较小，均基于公司实际经营需求，交易价格系依据市场供需情况确定，具备真实、合理的商业背景，整体规模较小，与非关联第三方交易价格相比不存在显失公允的情形。

5、关联方应收应付款项

报告期各期末，公司对关联方除应付职工薪酬、应付报销款外，无关联方应收应付款项。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司已建立了独立的采购、生产、销售系统，与关联企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均相互独立，对关联方不存在重大依赖，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司报告期内与关联方的交易金额较小，具备商业合理性，不存在显失公允的情形，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，亦不存在关联交易非关联化的情形。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

（四）报告期内关联交易履行的程序及独立董事的意见

公司已按照《公司法》《证券法》等相关要求制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规章制度，对关联交易决策权限和程序、关联股东和关联董事的回避表决制度等作出了明确的规定，以促进公司关联交易合规合法。

公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第七次会议、2026 年第三次临时股东会，对公司 2023 年至 2025 年的关联交易情况进行了确认，上述会议关联董事和关联股东均已回避表决。

公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，对公司 2023 年至 2025 年的关联交易情况发表了独立意见：“公司三年内与关联方已经发生的关联交易

均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况”。

（五）关联方变化情况

公司报告期内关联方变化情况主要为关联自然人不再于相关方任职、投资，以及关联法人注销所致，具体变化情况等内容请参见本节之“七/（一）关联方及关联关系”。

（六）减少和规范关联交易的措施

报告期内，公司的主营业务不存在对关联方及关联交易重大依赖的情况。发行人自整体变更为股份有限公司以来，为持续减少及规范关联交易，采取了以下措施：

1、制度约束

公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等规章制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定，公司将严格按照上述规章制度规范运行。

2、关于减少和避免关联交易的承诺

公司控股股东及实际控制人徐振及其控制的杭州汇芯、杭州聚芯、杭州朗新及公司董事、高级管理人员黄庆红、章小婵、何涛、寿佳琪、夏丽君、刘思霖已出具《关于减少和避免关联交易的承诺》，参见本招股说明书“第十二节附件”之“五/（八）关于减少和避免关联交易的承诺”。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东依照其所持股份比例共同享有。

二、本次发行前后的股利分配政策及差异

（一）发行人当前股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司缴纳所得税后的利润，按下列方式进行利润分配：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反法律法规及本章程规定分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）重要子公司的分红政策

发行人持有重要子公司杭州芯云 100% 的股权，杭州芯云的分红政策如下：

根据杭州芯云现行有效的章程第十一条“公司不设股东会，公司股东依法行使《公司法》第五十九条规定的第1至第8项职权”；第十三条“公司不设董事会，设一名董事，经股东委派产生，行使《公司法》规定的董事会职权”。

《公司法》第五十九条规定“股东会行使下列职权：……（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案”；第六十七条规定“董事会行使下列职权：……（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；……”

（三）本次股票发行后的股利分配政策

1、本次发行后的股利分配政策

根据公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分配政策如下：

“（一）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

（三）现金分红条件和比例

在满足下列条件时，应当进行分红：

1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条件时，公司上市后连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策。

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（四）股票股利发放条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

（五）利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（六）对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红

利，以偿还其占用的资金。”

2、公司利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

（3）独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

（4）审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。

（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、利润分配政策调整的决策程序

遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（1）由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金

分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（2）股东会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会对现金分红政策调整的具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

（四）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由等

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的利润分配政策和监督机制，积极有效地回报投资者，公司制定了上市后适用的《公司章程（草案）》和《公司股票上市后三年的股东分红回报规划》，相关规划已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

（五）上市后三年内现金分红等利润分配计划

公司上市后适用的《公司章程（草案）》和《公司股票上市后三年的股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配的决策程序、机制和具体分红比例，具体参见本节之“二/（三）本次股票发行后的股利分配政策”。

（六）公司长期回报规划以及规划制定时的主要考虑因素

公司制定的《公司股票上市后三年的股东分红回报规划》同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保障利润分配政策的持续性和稳定性。公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

（七）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后，公司的股利分配政策不存在重大变化。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，应披露保护投资者合法权益的各项措施

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或其他类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情形。

第十节 其他重要事项

一、重要合同

（一）销售合同

报告期内，公司与主要客户的合作模式为框架协议加订单方式或订单式销售。其中，框架协议加订单方式中的框架协议就订单、合同的有效期限等进行约定，当发生具体需求时，以订单确认具体规格型号、数量等。

公司重要的销售合同指公司及其控股子公司与客户签署的，报告期各期累计交易金额超过 2,000.00 万元人民币或等值外币的重要框架合同或销售合同，具体情况如下：

序号	客户名称	签订主体	签署时间	合同标的	合同总额 (万元)	履行情况
1	A 公司	杭州芯云	2023 年 2 月	由订单具体约定	框架协议	正在履行
2	B 公司	杭州芯云	2024 年 7 月	由订单具体约定	框架协议	正在履行
3	C 公司	杭州芯云	2024 年 8 月	晶圆测试、集成电路测试	框架协议	正在履行
4	博通集成	杭州芯云	2022 年 7 月	由订单具体约定	框架协议	正在履行

（二）采购合同

报告期内，公司已履行的和正在履行的金额超过 2,000.00 万元人民币或等值外币的采购合同或框架协议情况如下：

序号	供应商名称	签订主体	签署时间	合同标的	合同总额 (万元)	履行情况
1	D 公司	杭州芯云	2025 年 12 月	由订单具体约定	框架协议	正在履行
2	D 公司	杭州芯云	2023 年 12 月	由订单具体约定	框架协议	履行完毕
3	D 公司	杭州芯云	2021 年 12 月	由订单具体约定	框架协议	履行完毕
4	E 公司	杭州芯光	2025 年 11 月	测试设备	32,225.64	正在履行
5	E 公司	杭州芯云	2025 年 7 月	测试设备	4,300.51	履行完毕
6	E 公司	杭州芯云	2025 年 7 月	测试设备	2,468.49	履行完毕
7	E 公司	杭州芯光	2025 年 6 月	测试设备	4,300.51	履行完毕

序号	供应商名称	签订主体	签署时间	合同标的	合同总额 (万元)	履行 情况
8	E 公司	杭州芯云	2025 年 4 月	测试设备	13,300.25	履行 完毕
9	E 公司	杭州芯云	2025 年 4 月	测试设备	2,687.31	履行 完毕
10	E 公司	杭州芯云	2025 年 3 月	测试设备	4,563.65	履行 完毕
11	E 公司	杭州芯云	2025 年 3 月	测试设备	3,369.23	履行 完毕
12	E 公司	杭州芯云	2024 年 11 月	测试设备	3,583.06	履行 完毕
13	E 公司	诸暨越芯	2024 年 9 月	测试设备	4,394.38	履行 完毕
14	E 公司	诸暨越芯	2024 年 8 月	测试设备	2,336.26	履行 完毕
15	E 公司	诸暨越芯	2024 年 6 月	测试设备	3,725.93	履行 完毕
16	E 公司	杭州芯云海	2024 年 6 月	测试设备	5,723.19	履行 完毕
17	E 公司	诸暨越芯	2024 年 6 月	测试设备	2,710.72	履行 完毕
18	E 公司	诸暨越芯	2024 年 5 月	测试设备	5,736.79	履行 完毕
19	E 公司	杭州芯云海	2023 年 10 月	测试设备	4,739.09	履行 完毕
20	E 公司	杭州芯云海	2023 年 5 月	测试设备	7,331.10	履行 完毕
21	E 公司	诸暨芯云	2023 年 1 月	测试设备	2,048.05	履行 完毕
22	F1 公司	杭州芯云	2025 年 7 月	测试设备	2,965.62	履行 完毕
23	F1 公司	杭州芯云	2025 年 5 月	测试设备	2,202.22	履行 完毕
24	F1 公司	杭州芯光	2025 年 4 月	测试设备	3,303.33	履行 完毕
25	F1 公司	杭州芯光	2025 年 4 月	测试设备	2,202.22	履行 完毕
26	F1 公司	杭州芯光	2025 年 3 月	测试设备	2,202.22	履行 完毕
27	F1 公司	杭州芯云海	2024 年 6 月	测试设备	4,623.30	履行 完毕
28	F1 公司	杭州芯云海	2024 年 6 月	测试设备	6,629.81	履行 完毕
29	F1 公司	杭州芯云海	2024 年 4 月	测试设备	6,698.79	履行 完毕
30	F2 公司	诸暨芯云	2023 年 5 月	测试设备	3,774.60	履行 完毕
31	F2 公司	杭州芯云海	2023 年 5 月	测试设备	2,097.00	履行 完毕

序号	供应商名称	签订主体	签署时间	合同标的	合同总额 (万元)	履行 情况
32	I 公司	杭州芯云	2025 年 8 月	测试治具	2,864.66	履行 完毕
33	苏州法特迪科技股份有 限公司	诸暨芯云	2025 年 9 月	测试治具	2,080.78	履行 完毕
34	苏州法特迪科技股份有 限公司	诸暨芯云	2025 年 5 月	测试治具	3,382.81	履行 完毕
35	旺矽科技（苏州）有限 公司	杭州芯云	2025 年 5 月	测试治具	2,166.41	履行 完毕
36	F 公司	杭州芯云海	2024 年 6 月	测试设备	4,535.82	履行 完毕
37	F 公司	杭州芯云海	2023 年 2 月	测试设备	3,701.47	履行 完毕

注：其中外币合同金额按签订年度的年末人民币汇率中间价折算，数据来源为国家外汇管理局。若当年末未公告人民币汇率中间价，则以当年度最后一个工作日公告的相应汇率折算。

（三）重要融资合同

1、借款合同

报告期内，公司已履行的和截至报告期末正在履行的单笔借款金额 5,000 万元以上的重大借款合同如下：

序号	合同编号	贷款人	借款人	借款额度 (万元)	借款期限	履行情况
1	（2024）进出银 （浙信合）字第 1- 089 号	中国进出口银行浙 江省分行	杭州芯云	6,000.00	2024.09.25- 2025.09.24	履行完毕
2	2023 信银杭城西固 贷字第 811088437293 号	中信银行股份有限 公司杭州分行	杭州芯云	5,000.00	2023.01.19- 2026.01.19	履行完毕
3	BJGD20250001	中国光大银行股份 有限公司杭州分行	杭州芯云	14,000.00	2025.06.27- 2030.05.27	履行中
4	2025 杭州芯云固贷 字第 001 号	中信银行股份有限 公司杭州分行	杭州芯云	5,000.00	2025.04.23- 2030.03.23	履行中
5	工银浙银团 2025-1- 09 号	中国工商银行股份 有限公司杭州朝晖 支行、中国银行股 份有限公司杭州滨 江支行	杭州芯云	35,000.00	2025.09.20- 2033.09.20	履行中
6	进银新基金 （2025）浙 035 号	进银新型政策性金 融工具有限公司 （授权管理人：中 国进出口银行浙江 省分行）	杭州芯云	9,800.00	2025.10.27- 2032.10.26	履行中
7	进银新基金 （2025）浙 040 号	进银新型政策性金 融工具有限公司 （授权管理人：中	杭州芯云	22,000.00	2025.10.28- 2034.04.27	履行中

序号	合同编号	贷款人	借款人	借款额度 (万元)	借款期限	履行情况
		国进出口银行浙江省分行)				
8	2022CXGD003	交通银行股份有限公司杭州城西支行	诸暨芯云	6,859.37	2022.05.19-2026.12.25	履行中
9	2022CXGD001	交通银行股份有限公司杭州城西支行	诸暨芯云	13,318.63	2022.04.20-2026.12.25	履行中
10	2022CXGD005	交通银行股份有限公司杭州城西支行	诸暨芯云	15,000.00	2022.12.23-2027.12.20	履行中
11	2023CXGD001	交通银行股份有限公司杭州城西支行	诸暨芯云	5,000.00	2023.01.09-2027.12.20	履行中
12	兴杭科技固贷（2022）001号	兴业银行股份有限公司杭州分行	诸暨芯云	30,000.00	2022.09.05-2032.09.04	履行中
13	兴杭科技银团（2024）001号、（2024）浙信补字第1-019号、（2024）浙信补字第1-018号	中国进出口银行浙江省分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行	诸暨越芯	63,900.00	2024.08.29-2034.08.26	履行中
14	2024 芯海前期贷字第001号	中信银行股份有限公司杭州分行	杭州芯云海	15,000.00	2024.09.30-2025.07.08	履行完毕
15	2024 芯海前期贷字第002号	中信银行股份有限公司杭州分行	杭州芯云海	7,000.00	2024.11.08-2025.11.08	履行完毕
16	95242024JZ0001	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州芯云海	77,000.00	2024.02.07-2031.12.25	履行中
17	工银浙银团 2025-1-01号、《固定资产银团贷款合同补充协议》（工银浙银团 2025-1-01号-1）	上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中信银行股份有限公司杭州分行	杭州芯云海	63,000.00	2025.07.04-2032.11.25	履行中
18	工银浙银团 2025-1-04号	中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司	杭州芯光	49,000.00	2025.06.26-2033.05.08	履行中

序号	合同编号	贷款人	借款人	借款额度 (万元)	借款期限	履行情况
		司杭州分行、兴业 银行股份有限公司 杭州滨江科技支行				

注：上表中的“借款额度”系指对应借款合同当中所载明的合同金额。

2、担保合同

公司及其控股子公司截至报告期末正在履行的或报告期内已履行完毕的与前述重大借款合同所对应的担保/抵押合同情况如下：

序号	合同编号	担保人	债务人	债权人	担保金额	主债务履行 期限/主债权 发生期间	担保方式
1	(2024)进出银(浙信保)字第 1-033 号	朗迅科技	杭州芯云	中国进出口银行浙江省分行	6,000 万元	2024.09.25-2025.09.24	保证担保
2	2023 信银杭城西最保字第 81108843729302 号	朗迅科技	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	不超过 8,000 万元	2023.01.19-2026.01.19	最高额保证担保
3	2023 信银杭城西最保字第 81108843729303 号	诸暨芯云	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	不超过 5,000 万元	2023.01.19-2026.01.19	最高额保证担保
4	2023 信银杭城西最抵字第 811088437293 号	杭州芯云	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	不超过 7,906.457556 万元	2023.01.19-2026.01.19	最高额抵押担保
5	BJBZ20250001	朗迅科技	杭州芯云	中国光大银行股份有限公司杭州分行	14,000 万元	2025.06.27-2030.05.27	保证担保
6	BJDY20250001	杭州芯云	杭州芯云	中国光大银行股份有限公司杭州分行	14,000 万元	2025.06.27-2030.05.27	抵押担保
7	2025 杭州芯云固贷最保字第 001 号	朗迅科技	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	不超过 14,000 万元	2025.04.22-2030.03.23	最高额保证担保
8	2025 杭州芯云设备最抵字第 001 号	杭州芯云	杭州芯云	中信银行股份有限公司杭州分行	不超过 15,060.213147 万元	2025.12.12-2030.06.28	最高额抵押担保
9	2025 年朝晖银团(保)字 0006 号	朗迅科技	杭州芯云	中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行	35,000 万元	2025.09.20-2033.09.20	保证担保
10	进银新基金(2025)浙保 020 号	朗迅科技	杭州芯云	进银新型政策性金融工具有限公司(授权管理人：中国进出口银行浙江省分行)	9,800.00 万元	2025.10.27-2032.10.26	保证担保
11	进银新基金(2025)浙保 023 号	朗迅科技	杭州芯云	进银新型政策性金融工具有限公司(授权管理人：中国进出口银行浙江省分行)	22,000.00 万元	2025.10.28-2032.10.27	保证担保
12	2022CXBZ021	朗迅科技	诸暨芯云	交通银行股份有限公司杭州城西支行	不超过 56,500 万元	2022.03.09-2027.12.20	最高额保证担保
13	2022CXBZ022	杭州芯云	诸暨芯云	交通银行股份有限公司杭州城西支行	不超过 56,500 万元	2022.03.09-2027.12.20	最高额保证担保

序号	合同编号	担保人	债务人	债权人	担保金额	主债务履行期限/主债权发生期间	担保方式
14	2023XCDY005	诸暨芯云	诸暨芯云	交通银行股份有限公司杭州城西支行	不超过 10,000 万元	2022.03.09-2027.12.20	最高额抵押担保
15	2024CXDY01	诸暨芯云	诸暨芯云	交通银行股份有限公司杭州城西支行	不超过 50,190.477132 万元	2022.04.19-2027.12.31	最高额抵押担保
16	兴杭科技抵（2022）001 号	诸暨芯云	诸暨芯云	兴业银行股份有限公司杭州分行	30,000 万元	2022.09.05-2032.09.04	抵押担保
17	兴杭科技抵（2022）002 号	诸暨芯云	诸暨芯云	兴业银行股份有限公司杭州分行	30,000 万元	2022.09.05-2032.09.04	抵押担保
18	兴杭科技抵（2023）001 号	诸暨芯云	诸暨芯云	兴业银行股份有限公司杭州分行	30,000 万元	2022.09.05-2032.09.04	抵押担保
19	兴杭科技高保（2022）002 号	朗迅科技	诸暨芯云	兴业银行股份有限公司杭州分行	不超过 35,000 万元	2022.09.05-2027.09.05	最高额保证担保
20	兴杭科技保（2024）006 号	朗迅科技	诸暨越芯	中国进出口银行浙江省分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州分行	63,900 万元	2024.08.29-2034.08.26	保证担保
21	兴杭科技抵（2024）001 号	诸暨越芯	诸暨越芯	兴业银行股份有限公司杭州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州分行	63,900 万元	2024.08.29-2034.08.26	抵押担保
22	兴杭科技抵（2024）002 号	诸暨越芯	诸暨越芯	兴业银行股份有限公司杭州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州分行	63,900 万元	2024.08.29-2034.08.26	抵押担保
23	兴杭科技抵（2025）002 号	诸暨越芯	诸暨越芯	兴业银行股份有限公司杭州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州分行	63,900 万元	2024.08.29-2034.08.26	抵押担保
24	兴杭科技抵（2025）001 号	诸暨越芯	诸暨越芯	兴业银行股份有限公司杭州分行、中国进出口	63,900 万元	2024.08.29-2034.08.26	抵押担保

序号	合同编号	担保人	债务人	债权人	担保金额	主债务履行期限/主债权发生期间	担保方式
				银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州分行			
25	2024 芯海前期贷最保字第 001 号	杭州芯云	杭州芯云海	中信银行股份有限公司杭州分行	27,000 万元	2024.09.29-2027.09.29	最高额保证担保
26	2024 芯海前期贷最保字第 002 号	朗迅科技	杭州芯云海	中信银行股份有限公司杭州分行	27,000 万元	2024.09.29-2027.09.29	最高额保证担保
27	2024 芯海前期贷最保字第 003 号	诸暨芯云	杭州芯云海	中信银行股份有限公司杭州分行	27,000 万元	2024.09.29-2027.09.29	最高额保证担保
28	ZB9524202400000004	朗迅科技	杭州芯云海	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	77,000 万元	2024.02.02-2031.12.25	保证担保
29	ZB9524202400000002	杭州芯云	杭州芯云海	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	77,000 万元	2024.02.02-2031.12.25	保证担保
30	ZD9524202400000005、ZD9524202400000005-01、ZD9524202400000005-2	杭州芯云海	杭州芯云海	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	不超过 45,560.336746 万元	2024.02.02-2031.12.25	最高额抵押担保
31	ZD9524202500000026	杭州芯云海	杭州芯云海	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	不超过 14,598.861862 万元	2024.02.02-2031.12.25	最高额抵押担保
32	ZD9524202400000010	杭州芯云海	杭州芯云海	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行、上海浦东发展银行股份有	不超过 55,409.182356 万元	2024.02.02-2031.12.25	最高额抵押担保

序号	合同编号	担保人	债务人	债权人	担保金额	主债务履行期限/主债权发生期间	担保方式
				限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行			
33	2025 年朝晖银团（保）字 0003 号	朗迅科技	杭州芯云海	上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中信银行股份有限公司杭州分行	63,000 万元	2025.07.02-2026.08.01	保证担保
34	2025 年朝晖银团（保）字 0004 号	杭州芯云	杭州芯云海	上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行、中信银行股份有限公司杭州分行	63,000 万元	2025.07.02-2026.08.01	保证担保
35	2025 年朝晖银团（保）字 0001 号、2025 年朝晖银团（保）字 0001 号-01 号	杭州芯云	杭州芯光	中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州滨江科技支行	49,000 万元	2025.06.26-2033.05.08	保证担保
36	2025 年朝晖银团（保）字 0002 号、2025 年朝晖银团（保）字 0002 号-01 号	朗迅科技	杭州芯光	中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州滨江科技支行	49,000 万元	2025.06.26-2033.05.08	保证担保
37	0120200017-2025 年朝晖（抵）字 0101 号、0120200017-2025 年朝晖（抵）字 0101 号-1 号	杭州芯光	杭州芯光	中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州滨江科技支行	49,000 万元	2025.06.26-2033.05.08	抵押担保

注 1：上述担保合同当中，如担保方式为最高额担保的，则上表所示期间为主债权发生期间，否则，为主债务履行期限；

注 2：上表所示第 5、6 项合同所担保的主债权为同一笔，第 16、17、18 项合同所担保的主债权为同一笔，第 20、21、22、23、24 项合同所担保的主债权为同一笔，第 28、29 项合同所担保的主债权为同一笔，第 33、34 项合同所担保的主债权为同一笔，第 35、36、37 项合同所担保的主债权为同一笔。

（四）工程合同

报告期内，发行人已履行和正在履行的其他重要合同主要为各生产基地建设工程合同，各生产基地建设总承包合同具体情况如下：

序号	供应商名称	签订主体	签署时间	合同标的	合同总额（万元）	履行情况
1	浙江宏兴建设有限公司	杭州芯云海	2023 年 5 月	杭州芯云海半导体有限公司集成电路先进测试基地建安总承包工程	26,022.88	履行完毕
2	浙江宏兴建设有限公司	诸暨越芯	2024 年 11 月	越芯半导体集成电路先进测试基地总承包工程	7,900.00	正在履行

二、对外担保

报告期内，发行人无对外担保。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、子公司、公司董事、高级管理人员和其他核心人员均不存在作为一方当事人的可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。

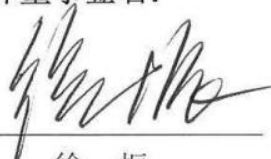
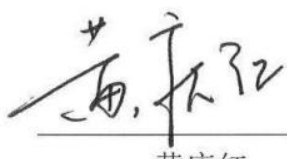
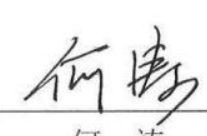
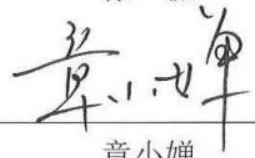
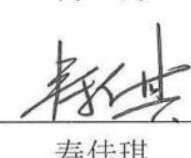
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

第十一节 声明

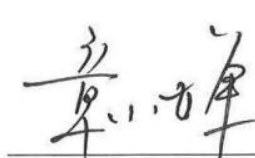
一、发行人及其全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

 徐 振	 黄庆红	 何 涛
 章小婵	 果 桐	 寿佳琪
 陆 宁	 钱 程	 张开元

全体审计委员会成员签名：

 张开元	 钱 程	 章小婵
--	--	--

全体非董事高级管理人员签名：

 夏丽君	 刘思霖
--	--

杭州朗迅科技股份有限公司

2020 年 9 月 20 日



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：


徐 振

杭州朗迅科技股份有限公司

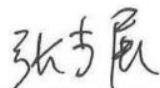


2026年8月20日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：



张李展

保荐代表人：

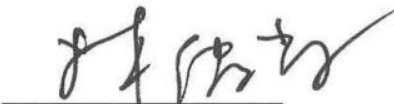


周天宇



郑 睿

法定代表人：



林传辉

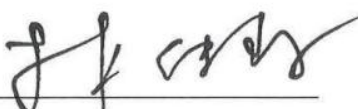


2020 年 9 月 20 日

保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读杭州朗迅科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：


林传辉



2020年9月20日

保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读杭州朗迅科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：


秦 力

广发证券股份有限公司
2024年9月20日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

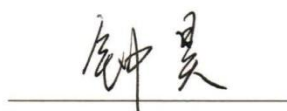
经办律师：



赵 琰



姚 远



钟 昊

律师事务所负责人：



章靖忠



2026年8月20日



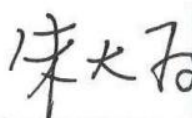
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

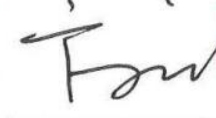
地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《杭州朗迅科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕14270号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕14271号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭州朗迅科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


朱大为


郭云华


俞晓佳

天健会计师事务所负责人：


沈培强

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年九月二十日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

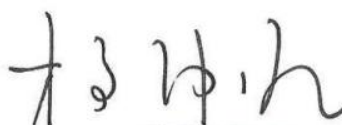
签字资产评估师：


郁奇凌 郁奇凌
31080033

正式执业会员
资产评估师

彭丽莹（已离职）

资产评估机构负责人：


杨伟墩

上海立信资产评估有限公司

2016 年 9 月 20 日

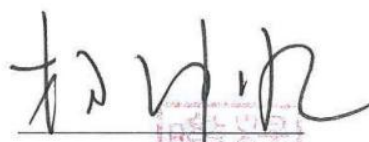
关于签字资产评估师离职的说明

上海立信资产评估有限公司于 2022 年 9 月出具了《杭州朗迅科技有限公司拟改建为股份有限公司所涉及的杭州朗迅科技有限公司净资产资产评估报告》（信资评报字[2022]第 050048 号），签字资产评估师为郁奇凌、彭丽莹。

至本说明出具日，原资产评估报告的签字资产评估师彭丽莹已离职，故无法在本公司出具的资产评估机构声明中签字，但签字资产评估师的离职不影响本公司已出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人：


杨伟墩

上海立信资产评估有限公司



2026 年 9 月 20 日

七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


曾涛
中国注册会计师
曾涛
330000012268

陈颖（已离职）

会计师事务所负责人：


李惠琦
中国注册会计师
李惠琦
1100000150172

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2026年9月2日

关于签字注册会计师离职的说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月出具了《杭州朗迅科技股份有限公司（筹）验资报告》（致同验字（2022）第332C000605号），签字注册会计师为曾涛、陈颖。

至本说明出具日，原验资报告的签字注册会计师陈颖已离职，故无法在本公司出具的验资机构声明中签字，但签字注册会计师的离职不影响本公司已出具的上述验资报告的法律效力。

特此说明。

会计师事务所负责人：



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2026年9月20日



地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《杭州朗迅科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2026〕167号、天健验〔2026〕168号、天健验〔2026〕169号、天健验〔2026〕170号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭州朗迅科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

朱大为

朱大为

郭云华

郭云华

天健会计师事务所负责人：

沈培强

沈培强

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年八月二十日

第十二节 附件

一、备查文件

在本次发行承销期内，投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、董事会审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）子公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

本次股票发行承销期内，除法定节假日以外的每日上午 9：30-11：30，下

午 14:00-16:00。

三、查阅地点

（一）发行人：杭州朗迅科技股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢（南）5 楼 E5029 室

联系人：夏丽君

联系电话：0571-8668 1836

（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区珠江新城马场路 26 号广发证券大厦 41 楼

联系人：周天宇、郑睿

联系电话：020-6633 8888

四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《投资者关系管理制度》等制度的要求，认真落实投资者关系管理相关规定，规范公司投资者关系管理工作，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，具体如下：

1、信息披露制度和流程

公司根据中国证监会及交易所相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》。该制度对信息披露的内容及标准、信息披露程序、信息披露相关责任划分、保密措施等事项均进行了详细规定。本次公开发行并上市后，公司将根据有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，提升规范运作和公司治理水平，保证投资者能够公开、公正、公平地获取披露的信息，切实保护投资者的合法权益。

2、投资者沟通渠道的建立情况

公司本次公开发行并上市后，将认真履行信息披露义务，并积极采取定期报告与临时公告、股东会等多样化方式开展与投资者的沟通工作，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，确保投资者沟通渠道畅通。

公司董事会办公室全面负责组织和协调投资者关系管理工作，负责公司日常信息披露，解答投资者的有关问题，联系方式如下：

董事会秘书	夏丽君
电话	0571-8668 1836
互联网网址	https://www.luntek.com.cn
电子信箱	IR@luntek.cn

3、投资者服务计划

发行人将严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，建立良好的投资者关系管理制度并严格执行，以保障公司与投资者之间的良好沟通，增加投资者对公司的了解与认同。为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面能提供制度保障，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（二）股利分配决策程序

《公司章程（草案）》规定了发行后的股利分配决策程序，具体参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二/（三）/2、公司利润分配政策的论证程序和决策机制”。

（三）股东投票机制建立情况

《公司章程（草案）》已按照相关法律、法规的规定建立了股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策事项的权利，具体内容如下：

1、累积投票制度建立情况

股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事的简历和基本情况。

2、中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、对法定事项采取网络投票方式的相关机制

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

4、征集投票权的相关机制

禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、与投资者保护相关的承诺

（一）本次发行前股东所持股份限制流通、自愿锁定及减持意向的承诺

公司相关主体关于股份限制流通、自愿锁定及减持意向的承诺，其中所涉减持部分股份为首次公开发行前所持股份以及由该等股份孳生的送股、转增股份。

1、发行人控股股东、实际控制人承诺

徐振作为发行人控股股东、实际控制人，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份（“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人持有的首发前股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格，下同）。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本

人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍遵守前述承诺。

在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

如发行人业绩下滑的：（1）发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

徐振作为发行人控股股东、实际控制人，就所持发行人股份减持意向的事宜，承诺如下：

“本人未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份。

1、本人将严格遵守本次发行关于股份限制流通和股份锁定的承诺，在所持

有的本次发行前发行人股份（“首发前股份”）的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后 24 个月内，本人在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、如本人计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，将在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

4、本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他法律法规、深圳证券交易所业务规则的相关规定。

6、若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。

7、以上股份不包括本人通过二级市场买入的发行人股份，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》另有规定的除外。”

2、发行人实际控制人控制的主体承诺

杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯作为同受公司实际控制人控制的主体、持股 5%以上股东及关联股东，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已直接或间接持有的发行人股份（“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

如发行人业绩下滑的：（1）发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本合伙企业届时所持股份锁定期限 6 个月；（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本合伙企业届时所持股份锁定期限 6 个月；（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本合伙企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本合伙企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本合伙企业同意按照该等规定执行。

本合伙企业所持公司股份锁定期届满后，本合伙企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任。”

杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯作为同受公司实际控制人控制的主体、持股 5%以上股东及关联股东，就所持发行人股份减持意向的事宜，承诺如下：

“本合伙企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份。

1、本合伙企业将严格遵守本次发行关于股份限制流通和股份锁定的承诺，在所持有的本次发行前发行人股份（“首发前股份”）的锁定期届满后拟减持首发前股份的，将通过符合届时法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，将在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

3、本合伙企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

4、本合伙企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份》及其他法律法规、深圳证券交易所业务规则的相关规定。

5、若因本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。”

3、发行人实际控制人的一致行动人承诺

黄庆红作为公司实际控制人的一致行动人、董事/高级管理人员，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定、减持意向的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份（“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

自本人所持首发前股份锁定期届满后的 24 个月内，以及前述 24 个月期限届满后的五年内，本人承诺每年转让或减持的首发前股份不超过本人在公司上市后所持首发前股份总额的 20%。

如本人持有的首发前股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格，下同）。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍遵守前述承诺。

在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及其他不时颁布实施的关于锁定期

及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

如发行人业绩下滑的：（1）发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

章小婵作为公司实际控制人的一致行动人、董事/高级管理人员，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定、减持意向的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份（“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人持有的首发前股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格，下同）。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6

个月内仍遵守前述承诺。

在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

如发行人业绩下滑的：（1）发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限6个月；（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限6个月；（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限6个月。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

何涛、寿佳琪作为公司实际控制人的一致行动人、董事/高级管理人员，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定、减持意向的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份（“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人持有的首发前股份在锁定期满后24个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增

股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格，下同）。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。

本人作为发行人实际控制人徐振的一致行动人，在一致行动期间，如徐振因相关监管规定或承诺被延长股票锁定期限的，本人所持首发前股份的锁定期限也相应延长。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍遵守前述承诺。

在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

4、发行人其他持股 5%以上的股东承诺

赋实投资、视谷创投、宁波工投、和丰创投、宁波通商作为发行人持股 5% 以上股东，就持有发行人股份限制流通、自愿锁定的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业/本人不转让或

者委托他人管理本次发行前本公司/本合伙企业/本人已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本公司/本合伙企业/本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司/本合伙企业/本人同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本公司/本合伙企业/本人将依法承担赔偿责任。”

赋实投资、视谷创投、宁波工投、和丰创投、宁波通商作为发行人持股 5% 以上股东，就所持发行人股份减持意向的事宜，承诺如下：

“本企业/本合伙企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份。

1、本企业/本合伙企业将严格遵守本次发行关于股份限制流通和股份锁定的承诺，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、如本企业/本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，将在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

3、本企业/本合伙企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

4、本企业/本合伙企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他法律法规、深圳证券交易所业务规则的相关规定。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业/本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其

他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业/本合伙企业将依法赔偿损失。

6、以上股份不包括本企业/本合伙企业通过二级市场买入的发行人股份，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》另有规定的除外。”

5、发行人申报前 12 个月内的新增股东承诺

财通创新、嘉值琨瑜作为发行人申报前 12 个月内的新增股东，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定的事宜，承诺如下：

“发行人通过证券交易所审核通过并经中国证监会注册后，自本公司/本合伙企业取得发行人股份之日起 36 个月内以及发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准），本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本合伙企业已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本公司/本合伙企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司/本合伙企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担赔偿责任。”

6、持有发行人股份的董事、高级管理人员承诺

刘思霖作为间接持有发行人股份的董事/高级管理人员，就所持发行人股份限制流通、自愿锁定、减持意向的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份（“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人持有的首发前股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增

股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格，下同）。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有首发前股份的锁定期自动延长 6 个月。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍遵守前述承诺。

在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

7、发行人其他股东承诺

发行人其他股东（不包括无锡鼎晖弘嘉、成都鼎晖盈嘉）就所持发行人股份限制流通、自愿锁定的事宜，承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本合伙企业/本人已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本公司/本合伙企业/本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司/本合伙企业/本人同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本公司/本合伙企业/本人将依法承担赔偿责任。”

发行人其他股东无锡鼎晖弘嘉、成都鼎晖盈嘉就所持发行人股份限制流通、自愿锁定的事宜，承诺如下：

“自发行人本次发行上市的股票在证券交易所完成上市之日起 12 个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

如中国适用法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本合伙企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本合伙企业将遵守该等适用规定。

若本企业未能履行上述承诺事项给发行人造成损失的，本合伙企业将依法承担相应的法律责任。”

（二）稳定股价的措施和承诺

1、发行人稳定股价的预案

按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规的相关要求，公司制定了首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案。上述预案已经发行人董事会和股东会审议通过。拟定的公司上市后三年内稳定股价预案如下：

（1）启动股价稳定预案的条件

为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司将

启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（2）启动股价稳定预案的实施主体及措施

本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东、实际控制人以及公司的董事（独立董事除外）和高级管理人员，其中，董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。

公司制定稳定股价方案时，应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购的相关规定，不可导致公司股权分布不符合上市条件。

公司及相关主体将按照下述顺序采取一项或多项稳定公司股价措施：

- 1) 公司回购股票；
- 2) 公司控股股东、实际控制人增持公司股票；
- 3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票。

稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。

在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

（3）稳定公司股价的具体安排

1) 公司回购公司股票的具体安排

公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 15 个交易日内制订稳定公司股价具体方案，在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信息披露要求予以公告。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东会中投赞成票。

公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的

每股净资产（以最近一期审计报告为依据；因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，具体回购事项将在启动股价稳定措施时提前公告。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票的具体安排

当公司已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司连续 10 个交易日股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（以最近一期审计报告为依据；因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司控股股东、实际控制人应在 10 个交易日内启动内部决策程序，就其增持公司股票的具体计划（包括拟买入的数量、价格区间、完成时间等）书面通知公司并由公司进行公告。公司控股股东、实际控制人将自公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以合法方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（以最近一期审计报告为依据；因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。公司控股股东合计单次用于增持的资金不超过其最近一次从公司取得的税后现金分红的 10%，年度用于增持的资金合计不超过其最近一次从公司取得的税后现金分红的 20%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。具体增持事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及相关信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3）公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排

当公司、控股股东、实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司连续 10 个交易日股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利

利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司董事、高级管理人员应在 10 个交易日内就其增持公司股票的具体计划（包括拟买入的数量、价格区间、完成时间等）书面通知公司并由公司进行公告。公司董事、高级管理人员将自公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份。公司董事、高级管理人员单次用于增持股份的货币资金不超过董事和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的 10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的税后薪酬的 20%，具体增持事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及相关信息披露应符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

公司未来在聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

（4）稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第 1、第 2 所述情形），则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1）公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

3）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持公司股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。

2、稳定股价的具体承诺

公司承诺：“本公司上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动股份稳定措施的具体条件后，公司将严格遵守并执行《稳定股价预案》。”

公司控股股东、实际控制人承诺：“发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，控股股东、实际控制人将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。”

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：“将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。”

3、稳定公司股价承诺的约束措施

如公司未能履行稳定公司股价的承诺，则应在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

如控股股东、实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权将其应用于增持股票的等额资金从应付其现金分红中予以扣留，直至其履行增持义务。

如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权将其应用于增持股票的等额资金从应付董事、高级管理人员的税后薪酬和津贴中予以扣留，直至其履行增持义务。

（三）股份回购和股份购回的措施与承诺

1、发行人承诺

公司就股份回购与股份购回及其措施承诺如下：

“1、本公司保证，本公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上

市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）根据届时中国证监会及交易所规定可以采取的其他措施。

3、本公司承诺根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

4、本公司承诺在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

5、上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

2、发行人控股股东、实际控制人承诺

徐振作为公司控股股东、实际控制人，就股份回购与股份购回及其措施承诺如下：

“1、本人保证发行人本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上

市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本发行人本次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本人违反上述承诺的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）根据届时中国证监会及交易所规定可以采取的其他措施。

3、本人承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、控股股东、实际控制人进行利益输送等行为损害公司及其股东合法权益。

4、本人承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

5、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

（四）对欺诈发行上市的股份购回的承诺

1、发行人承诺

公司就欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

“1、本公司申请首次公开发行并在主板上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，保证本公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行

的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

3、上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

2、发行人控股股东、实际控制人承诺

徐振作为公司控股股东、实际控制人，就欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

“1、发行人申请首次公开发行并在主板上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，保证公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

3、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施

公司拟申请首次公开发行股票并在主板上市，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过加快募投项目建设，强化募集资金的管理、提高公司销售收入，科学管控成本、费用，提高利润水平、严格落实现金分红政策、优化投资回报机制、增加公司投资价值等方式，提升资产质量，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报，具体拟采取的措施如下：

（1）加快募投项目建设，强化募集资金的管理

本次募投项目均围绕公司主营业务线开展。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争

取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

募集资金到位后，公司将严格按照《公司章程（草案）》和《募集资金管理制度》履行相应的使用审批程序，按照缓急轻重的原则安排募集资金继续投入，公司拟在资金的计划、使用、核算和风险防范方面强化风险管理，保证募集资金投资项目建设顺利推进并实现预期收益的前提下能产生最大效益回报股东。

（2）提高公司销售收入，科学管控成本、费用，提高利润水平

公司本次发行完成后，公司资产和业务规模将大幅增加，公司综合竞争实力、抗风险能力、长远发展能力将显著提升，为公司加快发展和加强盈利能力提供了良好的机遇。公司将不断加大研发投入和强化升级自主创新能力，积极开拓市场，巩固和提升公司市场地位，推动公司业绩平稳、健康、持续发展。同时，公司将实行严格、科学的成本费用管理，不断提升管理水平，强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序，全面有效的控制公司经营风险、管理风险，不断提升公司的利润水平。

（3）严格落实现金分红政策、优化投资回报机制、增加公司投资价值

为切实保护投资者的合法权益，公司已在《公司章程（草案）》《公司股票上市后未来三年股东回报规划》中明确了持续、稳定的回报机制，并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定，根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配，通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督，不断增加公司的投资价值。

2、发行人控股股东、实际控制人承诺

徐振作为公司控股股东、实际控制人，就关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函如下：

“（1）任何情形下，均不会滥用控股股东/实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）将切实履行作为控股股东/实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（3）不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（4）不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动，对职务消费行为进行约束；

（5）将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现；

（6）将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（8）将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

本承诺出具日后，如中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。”

3、发行人董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员，就关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函如下：

“（1）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（3）全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行规范；

（4）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核

委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会及股东会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有表决权）；

（6）如公司拟实施员工股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力支持公司将员工股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会及股东会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有表决权）；

（7）若中国证监会或深圳证券交易所对本承诺存在不同要求，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。

本承诺出具日后，如中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。”

（六）利润分配政策的承诺

公司就本次发行后的利润分配政策承诺如下：

“公司将严格按照有关法律法规、《公司章程（草案）》和《关于制订<公司股票上市后三年的股东分红回报规划>的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

（七）关于避免新增同业竞争的承诺

1、发行人控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人徐振就避免新增同业竞争承诺如下：

“1、截至本承诺函签署日，本人及本人近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）控制的其他企业（不含发行人及其下属企业，下同）未从事与发行人及其下属企业主营业务相同或相似的业务。

2、本人将不以任何直接或间接的方式从事与发行人及其下属企业的业务构成竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事与发行人及其下属企业的业务相竞争的任何活动的业务。

3、如发行人进一步拓展其业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务产生竞争的，本人控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争：A、停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到发行人来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、如违反以上承诺，对公司或其他股东造成损失的，本人将依法赔偿公司或其他股东的实际损失。

5、本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。”

2、发行人实际控制人控制的主体承诺

杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯作为同受实际控制人控制的主体，就避免新增同业竞争承诺如下：

“1、截至本承诺函签署日，本企业及本企业控制的其他企业（不含发行人及其下属企业，下同）未从事与发行人及其下属企业主营业务相同或相似的业务。

2、本企业将不以任何直接或间接的方式从事与发行人及其下属企业的业务构成竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业控制的其他企业不从事与发行人及其下属企业的业务相竞争的任何活动的业务。

3、如发行人进一步拓展其业务范围，本企业及控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务产生竞争的，本企业及控

制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争：**A、停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到发行人来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。**

4、如违反以上承诺，对公司或其他股东造成损失的，本企业将依法赔偿公司或其他股东的实际损失。

5、本承诺函在本企业作为发行人实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可变更或撤销。”

3、发行人实际控制人的一致行动人承诺

公司实际控制人的一致行动人黄庆红、章小婵、何涛和寿佳琪就避免新增同业竞争承诺如下：

“1、截至本承诺函签署日，本人及本人近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）控制的其他企业（不含发行人及其下属企业，下同）未从事与发行人及其下属企业主营业务相同或相似的业务。

2、本人将不以任何直接或间接的方式从事与发行人及其下属企业的业务构成竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事与发行人及其下属企业的业务相竞争的任何活动的业务。

3、如发行人进一步拓展其业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务产生竞争的，本人控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争：**A、停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到发行人来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。**

4、如违反以上承诺，对公司或其他股东造成损失的，本人将依法赔偿公司或其他股东的实际损失。

5、本承诺函在本人作为发行人实际控制人之一致行动人期间内持续有效且不可变更或撤销。”

（八）关于减少和避免关联交易的承诺

1、发行人控股股东、实际控制人承诺

徐振作为发行人控股股东、实际控制人，就减少和避免关联交易承诺如下：

“1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

2、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；

3、如果发行人在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接和/或间接损失。”

2、发行人实际控制人控制的主体承诺

杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯作为同受实际控制人控制的主体，就减少和避免关联交易承诺如下：

“1、本合伙企业将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

2、本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金，也不要求发行人为本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业进行违规担保；

3、如果发行人在今后的经营活动中必须与本合伙企业或本合伙企业控制的

其他企业发生不可避免的关联交易，本合伙企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。

5、如违反以上承诺，本合伙企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接和/或间接损失。”

3、发行人实际控制人的一致行动人承诺

公司实际控制人的一致行动人黄庆红、章小婵、何涛、寿佳琪，就减少和避免关联交易承诺如下：

“1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

2、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；

3、如果发行人在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接和/或间接损失。”

4、发行人高级管理人员承诺

公司高级管理人员夏丽君、刘思霖，就减少和避免关联交易承诺如下：

“1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主

决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

2、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；

3、如果发行人在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接和/或间接损失。”

（九）关于股东信息披露的专项承诺

公司就关于股东信息披露事宜承诺如下：

“1、截至本专项承诺函出具之日，本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

2、除广发乾和投资有限公司及珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人广发信德投资管理有限公司系本次发行上市的保荐机构广发证券股份有限公司的全资子公司外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

3、本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。

4、本公司及本公司股东及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露股东信息，履行了信息披

露义务。如本公司上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本公司将依法承担相应责任。”

（十）关于未履行承诺的约束措施

1、发行人承诺

公司就未履行承诺的约束措施承诺如下：

“公司将严格履行招股说明书披露的承诺：（1）公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项（因相关法律法规政策变化、自然灾害及其他不可抗力等不可控制的客观原因导致的除外），将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失；（3）公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（4）公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施，用于承担前述赔偿责任。”

2、发行人控股股东、实际控制人承诺

徐振作为公司控股股东、实际控制人，就未履行承诺的约束措施承诺如下：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东会审议；

4、本人将停止从发行人处获得薪酬、分红或津贴，同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

3、发行人实际控制人控制的主体承诺

杭州汇芯、杭州朗新、杭州聚芯作为同受实际控制人控制的主体、持股 5% 以上股东及关联股东，就未履行承诺的约束措施承诺如下：

“1、本企业应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、本企业将停止从发行人处获得分红或其他收益，同时本企业直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本企业履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

4、本企业未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

4、发行人实际控制人的一致行动人承诺

黄庆红、章小婵、何涛、寿佳琪作为发行人实际控制人的一致行动人，就未履行承诺的约束措施承诺如下：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东会审议；

4、本人将停止从发行人处获得分红或其他收益，同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

5、发行人其他持股 5%以上股东承诺

赋实投资、视谷创投、宁波工投、和丰创投、宁波通商作为发行人持股 5%以上股东，就未履行承诺的约束措施承诺如下：

“1、本公司/本企业应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、本公司/本企业将停止从发行人处获得分红或其他收益，同时本公司/本企业直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本公司/本企业履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

4、本公司/本企业未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

5、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司/本企业应将出售发行人的股票收益所得上缴发行人。”

6、发行人董事、高级管理人员承诺

发行人的董事、高级管理人员，就未履行承诺的约束措施承诺如下：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得薪酬或津贴；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

（十一）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、发行人承诺

公司就关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺如下：

“1、公司首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。

3、如公司首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

4、本公司将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行上述承诺，本公司将在本公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。”

2、发行人控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人徐振就关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺如下：

“1、发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

3、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

4、本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。”

3、发行人董事、高级管理人员承诺

发行人董事、高级管理人员就关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺如下：

“1、发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

2、发行人首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，

如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

3、本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。”

（十二）在审期间不进行现金分红的承诺

发行人承诺：“1、本公司拟在深圳证券交易所主板首次公开发行股票并上市的申报受理后至完成上市前（即在审期间）不进行现金分红或提出现金分红的方案。2、上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

（十三）本次发行相关中介机构的承诺

1、保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司承诺

“本公司为本次发行上市制作、出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

2、发行人律师浙江天册律师事务所承诺

“因本所在发行人本次发行上市工作期间未勤勉尽责，导致本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。”

3、发行人会计师、验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

“因我们为杭州朗迅科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

4、发行人资产评估机构上海立信资产评估有限公司承诺

“上海立信资产评估有限公司为本次发行上市制作、出具的文件真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

5、发行人验资机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

“致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市制作、出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

六、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规要求，已形成了股东会、董事会和管理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；并制订了股东会、董事会的职权和议事规则，对独立董事产生办法及发挥作用的制度进行了具体规定。公司目前治理机构运行情况良好，管理层履职尽责。

（一）股东会制度的建立、健全及运行情况

1、股东会制度的建立健全

公司根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》，制定了《股东会议事规则》，建立了股东会制度。公司股东会严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权力。

2、股东会的运行情况

自股份公司设立以来，公司股东会的召集、提案、出席、召开、议事、决议事项的内容及签署流程符合《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，运作规范。公司股东均按照相关规定依法行使股东权利，认真履行股东义务，尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东（大）会机构及相关制度的建立和实施，对完善公司法人治理结构、规范公司经营运作发挥了积极的作用。

（二）董事会制度的建立、健全及运行情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士，董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

1、董事会制度的建立健全

公司根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》，制定了《董事会议事规则》，建立了董事会制度。公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和义务。

2、董事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司董事会运作规范，历次董事会均由全体董事亲自或委托代表出席，董事会的召开程序、决议内容等符合《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，签署的决议与会议记录真实、有效。

（三）监事会制度的建立、健全及运行情况

截至报告期末，公司监事会已取消。报告期内，公司曾设监事会，公司根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》，曾制定《监事会议事规则》。公司曾设的监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人、职工代表监事 1 人。自股份公司设立以来，公司监事会按照相关规定规范运作，有效履行了监督等职责。

根据《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等中国证监会配套制度规则规定，2025 年 10 月，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，决议取消监事会，并将由审计委员会依据《公司法》相关规定承接监事会职权。

（四）独立董事制度的建立、健全及运行情况

1、独立董事制度的建立情况

发行人在董事会中设立 3 名独立董事，其中会计专业人士 1 名，独立董事

人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一。公司根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、职权、发表独立意见等做了详细的规定，独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

2、公司独立董事的履职情况

自发行人设立独立董事以来，各独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》及其他相关法律法规的要求认真履行独立董事职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

（五）董事会秘书制度的建立、健全及运行情况

1、董事会秘书制度建立情况

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责权限等作出了明确规定。公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

2、董事会秘书工作情况

自公司董事会聘任董事会秘书以来，公司董事会秘书按照《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，履行相应的权利和义务，出席了公司历次董事会；历次股东（大）会和董事会均按照有关规定为股东和董事提供会议通知和会议材料等文件，履行了《董事会秘书工作制度》中规定的有关职责。

七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设四个专门委员会，包括：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，对各专门委员会的人员构成进行确定，在此基础上审议通过了各专门委员会工作细则。

针对董事会各专门委员会的人员构成，按照《上市公司治理准则》要求，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员中，独立董事占多数

并担任召集人。各专门委员会的具体设置和运行情况如下：

（一）战略委员会

公司制定了《战略委员会工作细则》，对战略委员会的职责权限、会议召开、会议表决等事项作出了详细规定。公司第二届董事会战略委员会由徐振、黄庆红、陆宁组成，徐振为主任委员。

（二）提名委员会

公司制定了《提名委员会工作细则》，对提名委员会的职责权限、会议召开、会议表决等事项作出了详细规定。公司第二届董事会提名委员会由钱程、陆宁、章小婵组成，钱程为主任委员。

（三）薪酬与考核委员会

公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，对薪酬与考核委员会的职责权限、会议召开、会议表决等事项作出了详细规定。公司第二届董事会薪酬与考核委员会由陆宁、张开元、果桐组成，陆宁为主任委员。

（四）审计委员会

公司制定了《审计委员会工作细则》，对审计委员会的职责权限、会议召开、会议表决等事项作出了详细规定。公司第二届董事会审计委员会由张开元、钱程、章小婵组成，张开元为主任委员。

八、募集资金具体运用情况

（一）杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目

1、项目概况

公司拟用部分募集资金投资于杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目，以进一步提升公司高端芯片的集成电路测试服务的能力。本项目由公司全资子公司杭州芯光实施，总投资金额为 400,000.00 万元，选址位于浙江省杭州市，建设期约 48 个月。

本项目拟基于集成电路国产化趋势，依托公司自主可控的测试产业链核心技术，建设高端芯片集成电路测试服务基地，以进一步提升公司测试服务产能，

满足持续增长的客户及市场需求并推动公司持续快速发展。

2、项目投资概算

本项目投资总额为 400,000.00 万元，其中拟使用募集资金投资 320,000.00 万元，包括土地购置费用 3,271.00 万元，建筑工程费用 41,117.15 万元，设备及软件购置费用 244,592.60 万元，铺底流动资金及预备费 31,019.25 万元。

3、项目投资的必要性和可行性

（1）项目投资的必要性

1）顺应集成电路产业自主可控的战略要求，把握市场发展机遇

近年来，随着国际贸易摩擦的逐渐加深，我国集成电路产业链受到的外部限制风险并未下降，集成电路产业链自主可控需求不断增长。中国大陆高端芯片设计公司开始为保障供应链稳定愈发青睐大陆本土的测试服务供应商，加速了国产化替代进程。公司把握住国际政治与国内产业环境下境内集成电路产业的发展契机，与核心客户一同打造国产自主可控集成电路产业链，不断加大对于高端芯片测试的研发及生产投入，业务规模快速上升。杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目聚焦自主可控的集成电路测试服务，能够助力公司精准把握行业发展机遇，巩固市场领先地位，同时持续推进高端芯片测试国产化进程。

2）突破产能瓶颈，为公司业绩持续增长提供产能基础

近年来，公司经营规模保持持续快速增长态势，目前已成为最大的内资第三方集成电路测试服务厂商，业务量快速上升，产能逐渐饱和，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。

杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目能够有效提升公司产能上限，实现高端芯片测试产能扩充，服务客户快速增长的集成电路测试需求，巩固并提升公司的行业地位，为公司业绩持续增长提供产能基础。

（2）项目投资的可行性

1）国家产业政策的支持为项目实施提供了政策基础

国家高度重视集成电路产业并制定了一系列支持政策。国务院于 2020 年发

布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》推出了财税、投融资、研究开发、进出口等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业的发展环境，鼓励集成电路产业的发展，引导更多的资金、资源和人才进入到集成电路产业。

公司深度融入集成电路国产化进程，与产业链上下游企业进行深度协作，共同推进国产测试产业链测试能力的发展和迭代，促进集成电路国产化整体进程，本项目的实施符合国家的产业发展政策和行业发展趋势。

2) 公司自主可控的核心技术储备为项目实施提供了技术支持

公司掌握集成电路测试的全流程软硬件核心技术，涵盖测试解决方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化等领域。公司自主可控的核心技术储备为本项目的顺利实施提供了重要保障。

3) 市场规模持续扩容为项目实施奠定了良好的产能消化基础

随着集成电路产业专业化分工的进一步深化，具备专业性、独立性优势的第三方集成电路测试模式快速发展。2025 年度境内第三方测试产业规模约为 113 亿元，预计到 2030 年度，第三方测试产业规模预计将进一步增长至 337 亿元，持续增长的下游市场需求为项目实施奠定了良好的产能消化基础。

4、项目建设周期和时间进度

本项目实施主体为杭州芯光，计划建设期 48 个月，拟使用募集资金投资 320,000.00 万元，项目建设期包括前期准备、工程建设、设备购置、安装调试、人员招聘及项目验收等。截至本招股说明书签署日，该项目已由公司以自筹资金开展前期建设及准备工作。

5、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目建设地点为杭州市富阳区，实施主体为杭州芯光。对于本项目的新增土地需求部分，杭州芯光已取得证号为“浙（2025）杭州市不动产权第 0652539 号”的国有建设用地使用权。

6、项目审批或备案情况

因项目不同建设内容的备案权限分属不同主管部门，本项目已取得杭州市

富阳区发展和改革局出具的《项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2509-330111-04-01-775640），取得杭州市富阳区经济和信息化局出具的《项目备案通知书》（项目代码：2602-330111-07-02-509529、2602-330111-07-02-241363）。

上述项目备案均已取得杭州市生态环境局出具的《环境影响评价文件承诺备案通知书》（杭环富备[2026]1 号、杭环富备[2026]20 号、杭环富备[2026]21 号）。

（二）越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目

1、项目概况

公司拟用部分募集资金投资于越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目，以进一步提升公司在消费电子、车载智控等领域的集成电路测试服务的能力。本项目由公司全资子公司诸暨越芯实施，总投资金额为 200,000.00 万元，选址位于浙江省诸暨市，建设期约 36 个月。

本项目拟通过在诸暨市新建生产基地，进一步扩充公司高端产品测试产能，完善公司生产基地布局。

2、项目投资概算

本项目投资总额为 200,000.00 万元，拟全部由募集资金投入，包括土地购置费用 2,128.00 万元，建筑工程费用 37,715.60 万元，设备及软件购置费用 138,425.87 万元，铺底流动资金及预备费 21,730.52 万元。

3、项目投资的必要性和可行性

（1）项目投资的必要性

1) 提前布局市场需求，为公司业绩持续增长提供产能保障

目前，我国在消费电子领域的国产厂商份额不断提高，在部分领军企业的带领下，我国在高端产品领域亦逐渐追赶，并由此催生了大量终端 SoC 及配套芯片的测试需求。与此同时，依托全球最大的新能源汽车市场，集成电路产业中的车载智控领域亦已成为增长最快的下游领域之一，车载互联、控制芯片等亦已成为汽车电子领域的核心刚需组件。

基于下游应用场景的快速发展预期，越芯半导体高端智能终端与车规级芯

片先进测试基地项目建设拟通过配置测试机、分选机等先进测试设备，提前储备相关领域相应测试产能，抢抓行业增长机遇，为公司业绩持续增长提供产能保障。

2) 服务集成电路测试产业自主可控的需要

在集成电路产业自主可控战略的引导与推动下，下游终端产品国产化替代进程持续推进，对芯片测试环节的国产化配套能力提出了更高标准的要求，预计将带来持续不断的市场需求和行业发展的长期驱动力。公司自设立以来持续进行研发创新投入，掌握了高端芯片测试的自主核心技术，具备基于国产化平台的全流程软硬件测试能力，公司已成为国产集成电路产业应对潜在国际政治经济及贸易风险扰动的重要战略选择。

通过越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目建设，公司能够更好满足集成电路测试自主可控需求，助力国产化供应链长期持续稳定发展，并进一步夯实公司在集成电路测试领域的行业地位。

(2) 项目投资的可行性

国家产业政策的支持、公司自主可控的核心技术储备以及市场规模扩容为项目实施提供了有力支持，具体参见本节之“八/（一）/3、项目投资的必要性和可行性”相关内容。

4、项目建设周期和时间进度

本项目实施主体为诸暨越芯，计划建设期 36 个月，拟使用募集资金投资 200,000.00 万元，项目建设期包括前期准备、工程建设、设备购置、安装调试、人员招聘及项目验收等。截至本招股说明书签署日，该项目已由公司以自筹资金开展前期建设及准备工作。

5、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目建设地点为浙江省诸暨市，实施主体为诸暨越芯，拟通过新取得土地方式开展项目建设。诸暨越芯已就本项目用地取得证号为“浙（2026）诸暨市不动产权第 1015020 号”的国有建设用地使用权。

6、项目审批或备案情况

本项目已在诸暨市发展和改革局备案，取得了《项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2604-330681-04-01-348308）。

本项目已取得绍兴市生态环境局出具的《环境影响登记表备案通知书》（诸环建备[2026]27号）。

（三）总部研发大楼项目

1、项目概况

公司拟投资 41,683.99 万元用于总部研发大楼项目，以进一步提升公司研究开发能力、完善研发及办公环境。本项目由朗迅科技实施，选址位于浙江省杭州市。

本项目拟通过新建总部基地及研发中心、购置先进研发设备等方式，增强公司技术储备、提升人才吸引力，为公司未来经营规模增长、保持行业技术领先提供有力支撑。

2、项目投资概算

本项目投资总额为 41,683.99 万元，拟全部使用募集资金投入，包括土地购置费用 1,539.34 万元、建筑工程费用 23,856.67 万元，设备及软件购置费用 10,850.90 万元，研发人员薪酬 5,090.00 万元，基本预备费 347.08 万元。

3、项目投资的必要性和可行性

（1）项目投资的必要性

1）提升研发创新能力，促进公司可持续发展

随着集成电路制程演进和工艺日趋复杂化，制造过程中对参数控制和缺陷检测等的要求越来越高，对集成电路测试专业化能力水平的要求也随之提升。这就需要测试企业不断开发新的测试技术、开发新的测试软件系统、改造和优化测试设备，才能使产品和技术的开发应用跟上行业整体发展的步伐。

本项目实施后，公司将引进行业内各类先进测试设备，完善公司整体研发基础条件，为研发人员提供独立的研发场地，为公司增强研发实力提供有力支

持。同时，研发中心的建设也有利于公司的研发部门能够吸收到产业前端最新的科研技术成果，引入行业顶尖人才，进一步提升公司整体的技术创新能力，符合公司未来的长期发展战略。

2) 改善办公环境，促进公司长期稳定发展

随着公司规模的不不断扩大，现有办公场所使用已接近饱和，同时考虑到未来公司还将不断引进专业研发人员、管理人员，现有场所难以满足公司进一步扩大规模的需求。总部研发大楼建成后，可以改善员工办公环境，吸引更多专业人才的加入，促进公司长期稳定发展。

（2）项目投资可行性

1) 公司领先的技术积累为本项目的实施提供了技术与创新支持

公司自设立以来持续进行研发创新投入，具备雄厚的研发实力。截至 2025 年 12 月末，公司已拥有境内授权专利 100 项，其中发明专利 42 项，拥有软件著作权 203 项。公司掌握了基于国产化平台的全流程软硬件测试开发能力，积累了丰富的研究开发经验，为本项目的顺利实施提供了技术与创新支持。

2) 优秀的研发队伍和健全的研发体系为项目建设提供保障

集成电路产业属于人才、技术密集型行业，对于从业人员专业素质、产业经验具有较高的要求。公司在长期的产业实践中，打造了资深的研发技术团队，核心团队拥有深厚的专业背景，在测试方案与产品导入、测试系统与数据、测试设备开发与工艺优化等领域有着丰富的理论和实践经验，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先的洞察力，保障了公司在技术方面的领先地位。在研发体系建设方面，公司制定了有竞争力的人才引进、培养、激励和晋升发展机制，为项目实施提供了健全的体系支撑。

4、项目建设周期和时间进度

本项目实施主体为朗迅科技，投资总额为 41,683.99 万元，项目建设期为 36 个月，包括工程及配套设施建设、设备购置及安装、人员招聘、项目实施等。截至本招股说明书签署日，该项目正在筹备中。

5、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目实施地点位于浙江省杭州市，拟通过新取得土地方式开展建设。

6、项目审批或备案情况

本项目已在杭州高新开发区（滨江）发展和改革局备案，取得了《杭州高新区（滨江）企业投资项目备案通知书》（编号：滨发改金融[2026]001）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年）等相关规定，本项目主要内容为总部研发大楼建设，不涉及环境影响评价事项，无需环境影响评价主管部门出具批复文件。

（四）补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟使用 90,000.00 万元募集资金补充流动资金，以满足公司经营规模的持续增长所带来的营运资金需求，保障公司未来发行上市后的持续、健康、稳定发展。

2、项目实施的必要性

近年来，随着下游市场需求的持续增长，公司包括资本支出在内的投入不断加大，生产与经营规模亦逐年上升。业务规模的不断扩大导致公司对营运资金的需求也持续增加，公司将需要大量的营运资金用于扩充产能与拓展市场。公司自设立以来，资金需求主要依靠股东投入、银行借款、留存收益等方式解决。补充流动资金将为公司业务发展提供长期资金支持，同时优化资本结构、提高财务安全性和灵活性，为公司进一步发展奠定良好的基础。

3、流动资金的管理安排

公司已建立募集资金专项存储制度，并将按照《募集资金管理制度》的有关规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将按照有关法律法规要求与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格按照证监会、证券交易所颁布的有关规定以及公司的《募集资金管理制度》，结合业务发展的需要，使用该项流动资金。

九、子公司、参股公司简要情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 5 家子公司、11 家孙公司，报告期初至本招股说明书签署日，公司注销了 4 家子（孙）公司。其中重要子公司为杭州芯云、杭州芯云海、诸暨芯云；发行人无参股公司、有 2 家分公司。发行人重要子公司及分公司具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人子公司、参股公司情况”相关内容，其他子公司和注销子公司情况如下：

（一）其他子公司

1、朗迅数智

（1）基本情况

企业名称：	杭州朗迅数智科技有限公司
成立时间：	2019年8月29日
注册资本：	1,000.00万元
实收资本：	1,000.00万元
统一社会信用代码：	91330108MA2GPRW68A
注册地和主要生产经营地：	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号一幢（南）五楼E5040室
经营范围：	许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务；礼仪服务；计算机及办公设备维修；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；专业设计服务；广告制作；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；物联网设备销售；云计算设备销售；集成电路销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路制造；电子元器件批发；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；物联网设备制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，发行人持有朗迅数智 100.00%股权。

(3) 经营业绩

朗迅数智最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	1,076.41
净资产	984.02
营业收入	2.12
净利润	-17.62

注：上述数据已经天健所审计。

2、朗迅智杰

(1) 基本情况

企业名称：	北京朗迅智杰科技有限公司
成立时间：	2024年12月4日
注册资本：	500.00万元
实收资本：	150.00万元
统一社会信用代码：	91110108MAE57X1NXU
注册地和主要生产经营地：	北京市海淀区翠微中里14号楼四层A711
经营范围：	一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程和技术研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；基于云平台的业务外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 股权情况

截至本招股说明书签署日，发行人持有朗迅智杰 100.00%股权。

(3) 经营业绩

朗迅智杰最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	31.72
净资产	31.72
营业收入	-
净利润	-98.30

注：上述数据已经天健所审计。

3、朗迅方夏

(1) 基本情况

企业名称：	北京朗迅方夏科技有限公司
成立时间：	2026年2月2日
注册资本：	300.00万元
实收资本：	225.00万元
统一社会信用代码：	91110108MAK761814J
注册地和主要生产经营地：	北京市海淀区翠微中里14号楼四层A539
经营范围：	一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程和技术研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；基于云平台的业务外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 股权情况

截至本招股说明书签署日，发行人持有朗迅方夏 100.00%股权。

(3) 经营业绩

截至报告期末，朗迅方夏尚未成立。

4、浙江芯华

（1）基本情况

企业名称：	浙江芯华云景智能科技有限公司
成立时间：	2025年12月22日
注册资本：	1,000.00万元
实收资本：	650.00万元
统一社会信用代码：	91330702MAK4H7ME3D
注册地和主要生产经营地：	浙江省金华市婺城区竹马乡二环北路4789号6号楼1层101室
经营范围：	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，发行人持有浙江芯华 65.00%股权，杭州芯宇管理咨询合伙企业（有限合伙）持有浙江芯华 35.00%股权

（3）经营业绩

截至报告期末，浙江芯华尚未实际经营。

5、朗迅集成

（1）基本情况

企业名称：	杭州朗迅集成电路有限公司
成立时间：	2016年12月23日
注册资本：	200.00万元
实收资本：	200.00万元
统一社会信用代码：	91330108MA28L0JW5E
注册地和主要生产经营地：	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号一幢（南）五楼E5002室

经营范围：	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、销售：集成电路芯片、计算机软硬件、电子产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：智能技术；生产、检测：集成电路芯片；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
-------	--

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有朗迅集成 100.00%股权。

（3）经营业绩

朗迅集成最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	706.52
净资产	529.79
营业收入	780.65
净利润	14.45

注：上述数据已经天健所审计。

6、重庆朗芯

（1）基本情况

企业名称：	重庆朗芯半导体有限公司
成立时间：	2019年4月18日
注册资本：	200.00万元
实收资本：	-
统一社会信用代码：	91500106MA60BPJ904
注册地和主要生产经营地：	重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第一层8-3-566号
经营范围：	生产、测试：集成电路；研发、生产、销售、加工电子产品、半导体；半导体的技术开发、技术服务；销售：计算机软件、电子产品（不含电子出版物）、集成电路；货物及技术进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有重庆朗芯 100.00%股权。

（3）经营业绩

重庆朗芯最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	24.94
净资产	-42.39
营业收入	-
净利润	-0.44

注：上述数据已经天健所审计。

7、上海芯云纵横

（1）基本情况

企业名称：	芯云纵横半导体（上海）有限公司
成立时间：	2022年2月23日
注册资本：	2,000.00万元
实收资本：	2,000.00万元
统一社会信用代码：	91310115MA7J4HGH6E
注册地和主要生产经营地：	中国（上海）自由贸易试验区金港路333号820室
经营范围：	一般项目：半导体器件专用设备销售；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有上海芯云纵横 100.00%股权。

（3）经营业绩

上海芯云纵横最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	2,155.26
净资产	929.03
营业收入	2,091.35
净利润	240.19

注：上述数据已经天健所审计。

8、诸暨越芯

（1）基本情况

企业名称：	越芯半导体（诸暨）有限公司
成立时间：	2022年11月18日
注册资本：	35,000.00万元
实收资本：	35,000.00万元
统一社会信用代码：	91330681MAC49MB014
注册地和主要生产经营地：	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建业路19号
经营范围：	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；软件开发；会议及展览服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有诸暨越芯 100.00%股权。

（3）经营业绩

诸暨越芯最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	121,570.09
净资产	40,374.33

项目	2025-12-31/2025 年度
营业收入	16,012.06
净利润	5,088.63

注：上述数据已经天健所审计。

9、新加坡芯云纵横

（1）基本情况

企业名称：	XINYUN ZONGHENG (SINGAPORE) PTE. LTD.
成立时间：	2024年6月13日
注册资本：	100.00万美元
实收资本：	100.00美元
唯一实体编号（UEN）：	202423855D
注册地和主要生产经营地：	3 Phillip Street, #10-04, Royal Group Building, Singapore 048693
经营范围：	主要业务：半导体的组装和测试；次要业务：各种商品的批发贸易（未定名主导产品）

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有新加坡芯云纵横 100.00%股权。

（3）经营业绩

截至报告期末，新加坡芯云纵横尚未实际经营。

10、杭州芯光

（1）基本情况

企业名称：	杭州芯光半导体有限公司
成立时间：	2024年9月18日
注册资本：	87,000.00万元
实收资本：	70,210.00万元
统一社会信用代码：	91330183MAE0QK9731
注册地和主要生产经营地：	浙江省杭州市富阳区灵桥镇罗山路155号
经营范围：	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；技术服

	务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
--	--

(2) 股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有杭州芯光 100.00%股权。

(3) 经营业绩

杭州芯光最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	90,646.81
净资产	23,025.16
营业收入	6,296.86
净利润	1,937.50

注：上述数据已经天健所审计。

11、苏州芯云纵横

(1) 基本情况

企业名称：	芯云纵横半导体（苏州）有限公司
成立时间：	2022年9月16日
注册资本：	2,000.00万元
实收资本：	-
统一社会信用代码：	91320508MA27Q98A64
注册地和主要生产经营地：	江苏省苏州市姑苏区虎丘街道虎丘路388号1号楼2637室
经营范围：	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；机械设 备研发；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询

	服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，上海芯云纵横持有苏州芯云纵横 100.00%股权。

（3）经营业绩

苏州芯云纵横最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025-12-31/2025 年度
总资产	0.25
净资产	-0.70
营业收入	-
净利润	-0.25

注：上述数据已经天健所审计。

12、福建晋芯

（1）基本情况

企业名称：	福建晋芯半导体有限公司
成立时间：	2026年6月29日
注册资本：	2,000.00万元
实收资本：	200.00万元
统一社会信用代码：	91350582MAKH77YR3R
注册地和主要生产经营地：	福建省晋江市福兴东路罗山段3号14号楼101室
经营范围：	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有福建晋芯 100.00%股权。

（3）经营业绩

截至报告期末，福建晋芯尚未成立。

13、深圳芯云湾

（1）基本情况

企业名称：	芯云湾科技（深圳）有限公司
成立时间：	2026年9月9日
注册资本：	1,000.00万元
实收资本：	-
统一社会信用代码：	91440300MAKMN5Q595
注册地和主要生产经营地：	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区惠厦路1号平湖创科大厦709
经营范围：	一般经营项目是：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权情况

截至本招股说明书签署日，杭州芯云持有深圳芯云湾 100.00%股权。

（3）经营业绩

截至报告期末，深圳芯云湾尚未设立。

（二）注销子公司

1、江阴芯云

企业名称	江阴芯云信息技术有限公司
成立时间	2022 年 10 月 26 日
注销时间	2025 年 2 月 18 日
注册资本	420.00 万元
实收资本	420.00 万元
注册地和主要生产经营地	江阴市芦花路 407 号 2401 室、2402 室、2403 室
股东情况	发行人全资子公司杭州芯云持有 100%股权
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江阴芯云注销前未实际经营。

2、浙江华芯

企业名称	浙江华芯半导体技术有限公司
成立时间	2022 年 1 月 14 日
注销时间	2025 年 2 月 25 日
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	30.00 万元
注册地和主要生产经营地	中国（浙江）自由贸易试验区金华市金东区孝顺镇正涵南街 1088 号楼 5 楼 513、514、515 室（自主申报）
股东情况	发行人持有 100%股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；机械设备研发；会议及展览服务；信息技术咨询服务；信息咨

	询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	---

浙江华芯注销前未实际经营。

3、江西朗驰

企业名称	江西朗驰科技有限公司
成立时间	2019 年 12 月 4 日
注销时间	2025 年 3 月 25 日
注册资本	200.00 万元
实收资本	38.00 万元
注册地和主要生产经营地	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号科创中心 2# 楼一楼 101-103 室
股东情况	发行人全资子公司朗迅数智持有 100% 股权
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；用人单位人力资源管理咨询服务；职业中介服务；市场调查（社会调查除外）；教育咨询服务；电脑加工图片服务；会议、展览及相关服务；公司礼仪服务；各种项目的策划服务与公关服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；文化、体育用品销售；软件开发；信息系统集成；网络工程；网上贸易代理；文化活动服务；策划创意服务；企业形象策划，贸易咨询；企业管理咨询；国内贸易。自营和代理国内各类技术和商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西朗驰注销前未实际经营。

4、诸暨教育

企业名称	诸暨芯云教育发展有限公司
成立时间	2020 年 12 月 23 日
注销时间	2026 年 4 月 16 日
注册资本	5,714.29 万元
实收资本	5,714.29 万元
注册地和主要生产经营地	浙江省诸暨市暨阳街道北二环路 81 号
股东情况	发行人持有 70% 股权，诸暨市新芯创业投资有限公司持有 30% 股权
经营范围	一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；单位后勤管理服务；教育教学检测和评价活动；会议及展览服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；技术服务、技术开发、技术

	咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
--	---

诸暨教育注销前未规模化开展经营。

十、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

1、自有房屋建筑物情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司自有房屋建筑物情况如下：

序号	证件编号	所有权人	所处地区	坐落位置	建筑面积（平方米）	用途
1	浙（2023）诸暨市不动产权第 0001268 号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园 19 号厂房 000101 室	5,556.56	厂房
2	浙（2023）诸暨市不动产权第 0001271 号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园 19 号厂房 000501 室	2,280.68	厂房
3	浙（2023）诸暨市不动产权第 0001273 号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园 19 号厂房 000401 室	2,280.68	厂房
4	浙（2023）诸暨市不动产权第 0001274 号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园 19 号厂房 000201 室	5,837.00	厂房
5	浙（2023）诸暨市不动产权第 0001279 号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园 19 号厂房 000301 室	5,837.00	厂房
6	浙（2026）杭州市不动产权第 0202858 号	杭州芯云海	浙江杭州	富阳区灵桥镇罗山路 155 号	75,104.19	工业

2、租赁房屋建筑物情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司主要租赁房产情况如下：

序号	承租人	出租人	坐落地	租赁面积（m ² ）	租赁期限	租赁用途
1	朗迅科技	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州滨江区六和路 368 号一幢（南）二楼 F11-2 区域、（南）五楼 E3、E4-1、E4-2 区域	1,465.00	2025/10/1-2028/9/30	生产经营
2	朗迅科技	杭州高新技术产业开发区资产经营	杭州滨江区六和路 368 号一幢（南）五楼 E5029 室（南五楼 E5-1、E5-3 区	431.00	2025/10/1-2028/9/30	生产经营

序号	承租人	出租人	坐落地	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
		有限公司	域)			
3	杭州芯云	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（南）一楼辅房部分区域（河边仓库）	202.00	2025/12/3-2028/12/2	生产辅助
4	杭州芯云	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州市滨江区浦沿街道六和路 368 号 1 幢（南）二楼 F8-1 区域	1,229.00	2025/6/20-2026/6/19	生产经营
5	杭州芯云	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州市滨江区浦沿街道六和路 368 号一幢南一楼 F6、F7-2、F9、F1-1、F1-2、E3、F2-2、F2-3、F5-3、F1050 室、F1001 室、南二楼 F7、南五楼 E2、E1-2 区域	17,108.00	2025/12/3-2028/12/2	生产经营
6	朗讯数智	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（南）五楼 E5040 室（E5-2-1 区域）	50.00	2025/11/4-2028/11/3	生产经营
7	朗讯集成	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（南）五楼 E5002 室（E5-2-2 区域）	105.00	2025/3/7-2026/3/6	生产经营
8	上海芯云纵横	上海航都置业有限公司	上海市浦东新区新金桥路 1369 号 3 幢一楼二楼	700.00	2023/3/1-2028/10/31	生产经营

截至 2025 年 12 月 31 日，上述租赁房屋建筑物均已签订租赁合同。除上表第 3 项杭州芯云 202 m² 租赁房屋建筑物未取得相关房屋权属证书外，其余均已取得相关房屋权属证明并办理租赁备案。

经核查，上表第 3 项租赁房屋用途为设备存放，具有较强可替代性，相关房屋租赁面积占杭州芯云在该区域租赁总面积的 1.09%，占比较小。

出租方杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司已出具承诺，确认如因未取得相关房屋权属证书原因导致杭州芯云的前述设备需搬离的，“本公司将积极协调在同一园区内向杭州芯云提供合适的租赁场所”。

综上所述，保荐机构认为上述房屋租赁瑕疵不会对发行人持续生产经营活动造成重大不利影响，不会对本次发行上市造成实质性障碍。其余房屋租赁均已取得相关房屋权属证明并办理房屋租赁备案，不存在重大权属纠纷，不会对

公司正常生产经营造成影响。

截至本招股说明书签署日，发行人不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	证件编号	所有权人	所处地区	坐落位置	用地面积（m²）	规划用途	取得方式
1	浙（2023）诸暨市不动产权第0001268号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园19号厂房000101室	1,450.98	工业用地	出让
2	浙（2023）诸暨市不动产权第0001271号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园19号厂房000501室	595.55	工业用地	出让
3	浙（2023）诸暨市不动产权第0001273号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园19号厂房000401室	595.55	工业用地	出让
4	浙（2023）诸暨市不动产权第0001274号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园19号厂房000201室	1,524.21	工业用地	出让
5	浙（2023）诸暨市不动产权第0001279号	诸暨芯云	浙江绍兴	暨阳街道诸暨数智安防产业园19号厂房000301室	1,524.21	工业用地	出让
6	浙（2025）诸暨市不动产权第0032078号	诸暨越芯	浙江绍兴	陶朱街道，千禧路与建业路交叉口东北侧	28,093.18	工业用地	出让
7	浙（2026）杭州市不动产权第0202858号	杭州芯云海	浙江杭州	富阳区灵桥镇罗山路155号	38,001.00	工业用地	出让
8	浙（2025）杭州市不动产权第0652539号	杭州芯光	浙江杭州	富阳区富春湾新城灵桥镇	42,369.00	工业用地	出让
9	浙（2026）诸暨市不动产权第1015020号	诸暨越芯	浙江绍兴	陶朱街道建业路以北、创业路以西、越芯半导体技术（诸暨）有限公司东侧	25,148.10	工业用地	出让

2、商标

截至2025年12月31日，发行人及其子公司拥有的商标情况如下：

序号	权利人	注册号	图案	类别	有效期限	取得方式
----	-----	-----	----	----	------	------

序号	权利人	注册号	图案	类别	有效期限	取得方式
1	朗迅科技	18390509		第 9 类	2017/3/21-2027/3/20	原始取得
2	朗迅科技	39529276	摩尔工坊	第 45 类	2020/9/7-2030/9/6	原始取得
3	朗迅科技	39543817	摩尔工坊	第 7 类	2020/9/14-2030/9/13	原始取得
4	朗迅科技	39541570	摩尔工坊	第 9 类	2020/10/7-2030/10/6	原始取得
5	朗迅科技	39539410	摩尔工坊	第 42 类	2020/11/7-2030/11/6	原始取得
6	朗迅科技	52796132	朗迅芯云	第 7 类	2021/8/21-2031/8/20	原始取得
7	朗迅科技	52801537	朗迅芯云	第 41 类	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
8	朗迅科技	51533778	芯云派	第 35 类	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
9	朗迅科技	51545773	芯云派	第 41 类	2022/1/7-2032/1/6	原始取得
10	朗迅科技	51538389	芯云派	第 42 类	2022/1/7-2032/1/6	原始取得
11	朗迅科技	51538003	芯云派	第 9 类	2022/5/7-2032/5/6	原始取得
12	朗迅科技	80769085	朗迅芯云	第 9 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
13	朗迅科技	80775489	朗迅芯云	第 16 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
14	朗迅科技	80774406	朗迅芯云	第 35 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
15	朗迅科技	80767736	朗迅芯云	第 37 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
16	朗迅科技	80774424	朗迅芯云	第 40 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
17	朗迅科技	80769923	朗迅科技	第 16 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
18	朗迅科技	80775402	朗迅科技	第 41 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
19	朗迅科技	80762275	芯云派	第 37 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
20	朗迅科技	80762596	芯云派	第 40 类	2025/2/21-2035/2/20	原始取得
21	朗迅科技	80762403		第 7 类	2025/3/7-2035/3/6	原始取得
22	朗迅科技	80770913		第 16 类	2025/3/7-2035/3/6	原始取得
23	朗迅科技	80764202	芯云	第 37 类	2025/3/7-2035/3/6	原始取得
24	朗迅科技	80771488	芯云	第 40 类	2025/3/28-2035/3/27	原始取得
25	朗迅科技	80775247A		第 9 类	2025/4/7-2035/4/6	原始取得

序号	权利人	注册号	图案	类别	有效期限	取得方式
26	朗迅科技	80773426A		第 37 类	2025/4/7-2035/4/6	原始取得
27	朗迅科技	80767754A	朗迅芯云	第 42 类	2025/4/7-2035/4/6	原始取得
28	朗迅科技	80760974	朗迅科技	第 7 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
29	朗迅科技	80766331	朗迅科技	第 37 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
30	朗迅科技	80775957	朗迅科技	第 40 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
31	朗迅科技	80772761	朗迅科技	第 42 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
32	朗迅科技	80768793	芯云派	第 7 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
33	朗迅科技	80762266	芯云派	第 35 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
34	朗迅科技	80764181A	芯云	第 7 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
35	朗迅科技	80762422		第 35 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
36	朗迅科技	80762435		第 40 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
37	朗迅科技	80773439		第 41 类	2025/5/14-2035/5/13	原始取得
38	朗迅科技	80765663A		第 42 类	2025/07/14-2035/07/13	原始取得
39	朗迅科技	69499694		第 9 类	2024/10/14-2034/10/13	原始取得
40	朗迅科技、杭州芯云	51311046	芯云	第 14 类	2021/10/7-2031/10/6	原始取得
41	朗迅科技、杭州芯云	51303370	芯云	第 16 类	2021/10/7-2031/10/6	原始取得
42	朗迅科技、杭州芯云	51301976	芯云	第 41 类	2021/10/7-2031/10/6	原始取得
43	杭州芯云	51280599		第 14 类	2021/8/7-2031/8/6	原始取得
44	杭州芯云	51283642		第 7 类	2021/8/14-2031/8/13	原始取得
45	杭州芯云	51312685		第 41 类	2021/8/21-2031/8/20	原始取得
46	杭州芯云	51285017		第 9 类	2021/10/14-2031/10/13	原始取得
47	杭州芯云	63851719		第 35 类	2022/10/14-2032/10/13	受让取得

序号	权利人	注册号	图案	类别	有效期限	取得方式
48	杭州芯云	63854518		第 9 类	2022/12/21-2032/12/20	受让取得
49	杭州芯云	63852046		第 42 类	2022/12/21-2032/12/20	受让取得
50	杭州芯云	76411967		第 9 类	2024/7/14-2034/7/13	原始取得
51	杭州芯云	76407582		第 41 类	2024/7/14-2034/7/13	原始取得
52	杭州芯云	76414181		第 16 类	2024/7/14-2034/7/13	原始取得
53	杭州芯云	76419994		第 7 类	2024/7/21-2034/7/20	原始取得
54	杭州芯云	76414194		第 35 类	2024/7/21-2034/7/20	原始取得
55	杭州芯云	76425920		第 42 类	2024/7/21-2034/7/20	原始取得
56	杭州芯云	80754634		第 37 类	2025/3/7-2035/3/6	原始取得
57	杭州芯云	80767819		第 16 类	2025/3/28-2035/3/27	原始取得
58	杭州芯云	80774069		第 40 类	2025/3/28-2035/3/27	原始取得
59	杭州芯云	80769213		第 35 类	2025/11/21-2035/11/20	原始取得
60	杭州芯云海	72542375		第 7 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得
61	杭州芯云海	72555020		第 9 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得
62	杭州芯云海	72554664		第 35 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得
63	杭州芯云海	72542341		第 42 类	2024/2/28-2034/2/27	原始取得
64	杭州芯云海	80771260		第 16 类	2025/5/28-2035/5/27	原始取得
65	杭州芯云海	80762612		第 37 类	2025/5/28-2035/5/27	原始取得

序号	权利人	注册号	图案	类别	有效期限	取得方式
66	杭州芯云海	80776560		第 40 类	2025/5/28-2035/5/27	原始取得
67	朗迅数智	72550821		第 41 类	2024/2/28-2034/2/27	原始取得
68	上海芯云纵横	72550897		第 7 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得
69	上海芯云纵横	72555065		第 9 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得
70	上海芯云纵横	72561288		第 35 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得
71	上海芯云纵横	72567642		第 42 类	2023/12/14-2033/12/13	原始取得

注：上表第 47-49 项注册商标系杭州芯云受让自浙江华芯。

3、专利

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司境内拥有 100 项专利，其中发明专利 42 项，实用新型专利 53 项，外观设计专利 5 项。发行人境外拥有 1 项专利，为发明专利。前述专利具体情况如下：

（1）境内专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
1	朗迅科技	一种老化设备批量上下料装置和方法	ZL202510455679.1	发明专利	2025/4/11	2025/10/10	原始取得
2	朗迅科技	晶圆位置的调整方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202510330248.2	发明专利	2025/3/20	2025/5/23	原始取得
3	朗迅科技	一种高密度探针卡及制备方法、测试方法	ZL202311010393.X	发明专利	2023/8/11	2023/10/24	原始取得
4	朗迅科技	一种晶圆的测试方法及装置	ZL202310849714.9	发明专利	2023/7/12	2023/9/29	原始取得
5	朗迅科技	一种双模组集成电路高频测试设备	ZL202310237824.X	发明专利	2023/3/14	2023/6/16	原始取得
6	朗迅科技	一种无接触式芯片质量检测装置及检测方法	ZL202310170034.4	发明专利	2023/2/27	2023/5/23	原始取得
7	朗迅科技	一种集成电路测试方法及系统	ZL202310206780.4	发明专利	2023/2/27	2023/9/26	原始取得
8	朗迅科技	一种基于下压式 SOP 测试座的自动测试装置	ZL202211670643.8	发明专利	2022/12/22	2023/8/29	原始取得
9	杭州芯云	一种晶圆测试数据的处理方法、装置、电子设	ZL202510343470.6	发明专利	2025/3/21	2025/9/19	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
		备及介质					
10	杭州芯云	一种用于芯片修调的电源电路、芯片修调电路及修调方法	ZL202411164791.1	发明专利	2024/8/23	2024/10/22	原始取得
11	杭州芯云	一种用于导航芯片的测试系统及测试方法	ZL202410719374.2	发明专利	2024/6/5	2024/8/6	原始取得
12	杭州芯云	按键电路的测试方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202410368858.7	发明专利	2024/3/28	2025/7/11	原始取得
13	杭州芯云	一种射频芯片的测试方法及系统	ZL202410026408.X	发明专利	2024/1/9	2024/6/14	原始取得
14	杭州芯云	一种用于半导体测试的实时监控方法及装置	ZL202311826343.9	发明专利	2023/12/28	2024/3/22	原始取得
15	杭州芯云	一种基于老化测试的半导体器件分选方法及系统	ZL202311782578.2	发明专利	2023/12/22	2024/3/12	原始取得
16	杭州芯云	一种集成多个测试温度区的晶圆测试系统及测试方法	ZL202311008507.7	发明专利	2023/8/11	2024/2/6	原始取得
17	杭州芯云	一种高电流释放测试座的制造方法及测试座	ZL202310246770.3	发明专利	2023/3/15	2023/6/30	原始取得
18	杭州芯云	一种消除半导体测试设备的三相负载不平衡的装置及方法	ZL202310214701.4	发明专利	2023/3/8	2023/5/16	原始取得
19	杭州芯云	一种箱门传感器限位保护装置、安装方法及半导体烘箱	ZL202310210543.5	发明专利	2023/3/7	2023/6/16	原始取得
20	杭州芯云	一种分选机旁侧 ESD 消散装置、静电消散方法及安装方法	ZL202310106223.5	发明专利	2023/2/13	2023/5/30	原始取得
21	杭州芯云	一种 IC 部件螺丝孔滑牙校正方法	ZL202310080265.6	发明专利	2023/2/8	2023/4/25	原始取得
22	杭州芯云	一种编带缝合异物吹气装置及吹气方法	ZL202310016167.6	发明专利	2023/1/6	2023/7/7	原始取得
23	诸暨芯云	一种芯片承载盘输送装置及输送方法	ZL202310337433.5	发明专利	2023/3/31	2023/7/14	受让取得
24	诸暨芯云	一种多组半导体测试设备集中降温的温控装置及方法	ZL202310203296.6	发明专利	2023/3/6	2024/6/25	受让取得
25	诸暨越芯	GPS 测试方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202410064132.4	发明专利	2024/1/17	2024/3/29	受让取得
26	杭州芯云海	环境温度的调节方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202411586979.5	发明专利	2024/11/8	2025/2/18	原始取得
27	杭州芯云海	一种多异步芯片测试信号的处理方法及装置	ZL202411477300.9	发明专利	2024/10/22	2024/12/17	原始取得
28	杭州芯云海	区域中心点坐标的确定	ZL202410487908.3	发明	2024/4/23	2024/7/5	原始

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
		方法、装置及智能仓库系统		专利			取得
29	杭州芯云海	一种压力均匀度检测方法、装置、设备和存储介质	ZL202410450353.5	发明专利	2024/4/15	2025/10/10	原始取得
30	杭州芯光	一种卷盘来料拆料装置	ZL202411559241.X	发明专利	2024/11/4	2025/9/23	受让取得
31	朗迅科技	一种闪烁氙灯电路装置	ZL202510458169X	发明专利	2025/4/14	2025/7/11	原始取得
32	朗迅科技	一种恒流控制装置及恒流控制方法	ZL202310251840.4	发明专利	2023/3/16	2023/5/12	原始取得
33	朗迅科技	一种 FPGA 电路模拟仿真的方法及装置	ZL202310228966.X	发明专利	2023/3/10	2023/6/6	原始取得
34	朗迅科技	一种嵌入式硬件电路调试验证的驱动系统	ZL202111624459.5	发明专利	2021/12/28	2023/3/14	原始取得
35	朗迅科技	一种共地式功率因数校正电路	ZL202010390204.6	发明专利	2020/5/8	2021/5/7	受让取得
36	朗迅科技	一种全流程可视化编辑虚拟现实 VR 实现方法与系统	ZL202310465185.2	发明专利	2023/4/27	2023/8/15	原始取得
37	朗迅科技	一种集成电路封装产业线的虚拟仿真模型及实训系统	ZL202210080743.9	发明专利	2022/1/24	2023/5/12	原始取得
38	朗迅科技	基于 Unity 3D 技术的集成电路制造工艺 VR 操作系统构建方法	ZL202111273970.5	发明专利	2021/10/29	2024/11/26	原始取得
39	朗迅科技	一种适合于电力电子变换器数字控制的采样方法	ZL201910130237.4	发明专利	2019/2/21	2020/8/4	受让取得
40	朗迅科技	软开关高功率因数交流-直流变换装置	ZL201811238616.7	发明专利	2018/10/23	2020/7/14	受让取得
41	杭州芯云	一种三相并网变流器控制装置	ZL201810401483.4	发明专利	2018/4/28	2021/2/19	受让取得
42	杭州芯云	一种双向 LLC 谐振直流-直流变换器	ZL201711144941.2	发明专利	2017/11/17	2020/11/17	受让取得
43	杭州芯云	一种用于复测结构的夹爪	ZL202422399890.X	实用新型	2024/9/30	2025/5/16	原始取得
44	杭州芯云	晶圆测试仪和测试设备	ZL202420697780.9	实用新型	2024/4/7	2025/1/28	原始取得
45	杭州芯云	反向击穿电压测试仪和测试设备	ZL202420625131.8	实用新型	2024/3/28	2024/12/10	原始取得
46	杭州芯云	用于测试设备的移动插接箱、配电装置和测试辅助设备	ZL202420410628.8	实用新型	2024/3/4	2025/1/10	原始取得
47	杭州芯云	射频探针卡以及测试设备	ZL202420175092.6	实用新型	2024/1/24	2024/8/23	原始取得
48	杭州芯云	自对准半导体芯片测试夹具装置	ZL202121622022.3	实用新型	2021/7/16	2022/1/11	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
49	杭州芯云	一种探针台芯片 CP 测试装置	ZL202121620918.8	实用新型	2021/7/16	2021/12/7	原始取得
50	诸暨芯云	一种连接半导体测试设备的循环冷却水双边通道装置	ZL202422676933.4	实用新型	2024/11/4	2025/10/10	原始取得
51	诸暨芯云	一种打带机切割异味吸收装置	ZL202422456151.X	实用新型	2024/10/11	2025/9/12	原始取得
52	诸暨芯云	一种有助于提升编带机封刀温度稳定性的治具	ZL202422399898.6	实用新型	2024/9/30	2025/7/8	原始取得
53	诸暨芯云	一种冷媒罐装气体的存放装置	ZL202422399894.8	实用新型	2024/9/30	2025/7/18	原始取得
54	诸暨芯云	束力测量装置及打带机	ZL202421777157.0	实用新型	2024/7/25	2025/4/29	原始取得
55	诸暨芯云	一种 Jam 报警自检装置	ZL202421693273.4	实用新型	2024/7/17	2025/1/17	原始取得
56	诸暨芯云	一种 Handler jam 自动锁机	ZL202421693276.8	实用新型	2024/7/17	2025/1/17	原始取得
57	诸暨芯云	一种 Nest 感温线磁吸固定装置	ZL202421284736.1	实用新型	2024/6/6	2025/3/25	原始取得
58	诸暨芯云	一种用于分选机空盘的夹取装置	ZL202421284724.9	实用新型	2024/6/6	2025/3/4	原始取得
59	诸暨芯云	一种原材料模型切割雕刻模具	ZL202420809234.X	实用新型	2024/4/18	2024/10/18	原始取得
60	诸暨芯云	一种带有警示结构的老化测试机	ZL202420028168.2	实用新型	2024/1/4	2025/3/4	原始取得
61	诸暨芯云	一种能快速转移的存放装置	ZL202420022977.2	实用新型	2024/1/4	2024/10/29	原始取得
62	诸暨芯云	一种测试分选机芯片上料检测结构	ZL202323664564.9	实用新型	2023/12/29	2024/9/24	原始取得
63	诸暨芯云	一种带有产品种类分区隔离结构的载盘	ZL202323660601.9	实用新型	2023/12/29	2024/9/6	原始取得
64	诸暨芯云	一种用于 tray 盘置料的防落结构	ZL202323500260.9	实用新型	2023/12/21	2024/8/20	原始取得
65	诸暨芯云	一种集成电路良品分类装置	ZL202321649202.X	实用新型	2023/6/27	2024/2/9	原始取得
66	诸暨芯云	一种带有监控装置的分类机	ZL202321649594.X	实用新型	2023/6/27	2023/12/15	原始取得
67	诸暨芯云	一种 IC 部件螺丝的一字槽结构	ZL202321612769.X	实用新型	2023/6/25	2023/12/12	原始取得
68	诸暨芯云	一种翘料检测装置	ZL202321612815.6	实用新型	2023/6/25	2023/11/10	原始取得
69	朗迅科技	打带自动上料机械手	ZL202520031144.7	实用新型	2025/1/7	2025/10/3	原始取得
70	朗迅科技	一种集成电路的源测量装置和测试设备	ZL202423225565.8	实用新型	2024/12/25	2025/12/16	原始取得
71	朗迅科技	一种虚实结合的 PVD 溅射原理演示装置	ZL202423060139.3	实用新型	2024/12/12	2025/11/28	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
72	朗迅科技	利用舵机进行多维度红外遥指图片物体识别的辅助装置	ZL202323384914.6	实用新型	2023/12/12	2024/6/18	原始取得
73	朗迅科技	一种集成电路测试用探针卡固定架装置	ZL202321759486.8	实用新型	2023/7/6	2024/2/6	原始取得
74	朗迅科技	集成化 IC 测试平台	ZL201920116361.0	实用新型	2019/1/23	2019/10/22	原始取得
75	朗迅科技	一种微电子硬件检测平台	ZL201721825842.6	实用新型	2017/12/22	2018/7/27	原始取得
76	朗迅科技	IC 快封教学装置	ZL202123065110.0	实用新型	2021/12/8	2022/5/17	原始取得
77	朗迅科技、杭州职业技术学院	基于农业病虫害图像采集识别防治装置	ZL201921759908.5	实用新型	2019/10/18	2020/7/10	原始取得
78	朗迅科技	集成电路教学测试平台	ZL201920112163.7	实用新型	2019/1/23	2019/12/6	原始取得
79	朗迅科技	基于单片机控制的自动寻迹小车控制系统	ZL201821505367.9	实用新型	2018/9/14	2019/5/31	原始取得
80	朗迅科技	基于 EnOcean 的智慧家居系统	ZL201721826084.X	实用新型	2017/12/22	2018/7/27	原始取得
81	朗迅科技	一种多功能智能仪表系统	ZL201621491769.9	实用新型	2016/12/31	2017/9/26	原始取得
82	朗迅科技	一种便携式蓝牙音箱	ZL201621484422.1	实用新型	2016/12/31	2017/11/24	原始取得
83	朗迅科技	基于 BITWISE 的无线智能家居实训系统	ZL201620913671.1	实用新型	2016/8/21	2017/4/5	原始取得
84	朗迅科技	无线智能家居实训系统	ZL201620918050.2	实用新型	2016/8/21	2017/4/5	原始取得
85	朗迅科技	实验平台	ZL201620918030.5	实用新型	2016/8/21	2017/5/10	原始取得
86	朗迅科技	实训台的受控设备架	ZL201620917172.X	实用新型	2016/8/21	2017/8/29	原始取得
87	朗迅科技	立体实训台	ZL201620918114.9	实用新型	2016/8/21	2017/8/29	原始取得
88	朗迅科技	托盘检测装置	ZL202530100691.1	外观设计	2025/3/5	2025/10/3	原始取得
89	朗迅科技	集成电路智能制造展示模型	ZL202230131755.0	外观设计	2022/3/15	2022/8/5	原始取得
90	朗迅科技	集成化 IC 测试平台	ZL201930209722.1	外观设计	2019/4/30	2020/1/10	原始取得
91	朗迅科技	集成电路自动化测试设备（LK8820）	ZL202030310681.8	外观设计	2020/6/17	2020/10/27	原始取得
92	朗迅科技	集成电路教学测试平台	ZL201930210660.6	外观设计	2019/4/30	2020/1/10	原始取得
93	朗迅集成	一种集成电路测试定位器	ZL202320117707.5	实用新型	2023/2/6	2023/6/27	原始取得
94	朗迅集成	一种测试压紧装置	ZL202320117687.1	实用新型	2023/2/6	2023/7/7	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
95	朗迅集成	智能电子秤	ZL202021310896.0	实用新型	2020/7/7	2021/1/19	原始取得
96	朗迅集成	一种智能控制寻迹小车	ZL201821505291.X	实用新型	2018/9/14	2019/12/6	原始取得
97	上海芯云纵横	光筒装置	ZL202423194401.3	实用新型	2024/12/24	2025/10/3	原始取得
98	上海芯云纵横	一种可量产稳定抗干扰的悬臂卡射频	ZL202423194399.X	实用新型	2024/12/24	2025/10/3	原始取得
99	上海芯云纵横	芯片测试装置	ZL202422468275.X	实用新型	2024/10/12	2025/9/30	原始取得
100	上海芯云纵横	探针台	ZL202323599968.4	实用新型	2023/12/27	2024/9/10	原始取得

注 1：上表所列发明专利的期限为 20 年，实用新型专利的期限为 10 年，外观设计专利的期限均为 10 年，均自申请日期起算；

注 2：除上表第 35 项、第 39-42 项专利系自杭州电子科技大学处受让取得外，剩余受让取得的专利均系发行人及其子公司基于集团资源安排，内部转让得到。

（2）境外专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	登记日	取得方式	国家/地区
1	朗迅科技	一种用于导航芯片的测试系统及测试方法	7680807	发明专利	2025/5/13	原始取得	日本

4、集成电路布图设计情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 3 项尚在保护期内的集成电路布图设计登记证书，具体情况如下：

序号	权利人	布图设计名称	登记号	申请日	登记证书号
1	朗迅科技	无线通信网络核心芯片 LKG0120	BS.165514809	2016/7/25	第 13098 号
2	朗迅科技	低耗无线传感器网络通讯芯片 LKG0050	BS.165514817	2016/7/25	第 13104 号
3	朗迅集成	用于失效分析的高能效混合计算芯片	BS.205530877	2020/5/13	第 31531 号

5、软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有软件著作权 203 项，具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
1	朗迅科技	朗迅 8120IC 测试机调试系统软件 V1.0	2012SR124314	2012/12/14	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
2	朗迅科技	朗迅 8810IC 测试机系统 驱动软件 V1.0	2013SR012500	2013/2/7	原始取得
3	朗迅科技	朗迅 8820IC 测试机驱动 系统软件 V1.0	2013SR067401	2013/7/17	原始取得
4	朗迅科技	朗迅 LK8830 测试系统软 件 V1.01	2014SR048707	2014/4/24	原始取得
5	朗迅科技	LK8200 集成电路测试系 统 V1.0	2014SR075623	2014/6/11	原始取得
6	朗迅科技	CD74HC123 芯片测试系 统 V1.0	2016SR331084	2016/11/15	原始取得
7	朗迅科技	朗迅多自由度机器人驱 动控制及测试软件 V1.0	2018SR057743	2018/1/24	原始取得
8	朗迅科技	朗迅电子产品创新实验 实训系统驱动控制软件 V1.0	2018SR116634	2018/2/22	原始取得
9	朗迅科技	朗迅电子产品设计创新 云平台驱动控制软件 V1.0	2018SR151335	2018/3/7	原始取得
10	朗迅科技	朗迅 LK8810S 集成电路 教学测试软件 V1.0	2019SR0092008	2019/1/25	原始取得
11	朗迅科技	朗迅 LK220T 集成电路 应用开发资源系统软件 V1.0	2019SR0395427	2019/4/25	原始取得
12	朗迅科技	朗迅 LK-ICVS-I IC 制造 虚拟仿真平台软件 V1.0	2019SR0580035	2019/6/6	原始取得
13	朗迅科技	朗迅集成电路制造工艺 虚拟仿真训练平台 V1.0	2019SR1031375	2019/10/11	原始取得
14	朗迅科技、杭 州职业技术学院	基于图像处理技术的农 作物病虫害识别系统软 件 V1.0	2019SR1131464	2019/11/8	原始取得
15	朗迅科技	朗迅 IC 制造虚拟仿真教 学平台 V1.0	2019SR1176997	2019/11/20	原始取得
16	朗迅科技	朗迅 LK8820 集成电路开 发教学平台 V1.0	2020SR0366966	2020/4/23	原始取得
17	朗迅科技	朗迅 LK-ED-II 电子产品 设计创新云平台 V1.0	2020SR0562519	2020/6/3	原始取得
18	朗迅科技	朗迅 LK230T 集成电路 应用开发资源系统 V1.0	2020SR0560556	2020/6/3	原始取得
19	朗迅科技	朗迅 LK2220TS 智能芯 片分选系统 V1.0	2020SR0560563	2020/6/3	原始取得
20	朗迅科技	朗迅 LK-AIRB 智能移动 教学机器人平台 V1.0	2020SR0593197	2020/6/9	原始取得
21	朗迅科技	朗迅 LK400S 无人机开发 者实训系统 V1.0	2020SR0673003	2020/6/24	原始取得
22	朗迅科技	朗迅 LK300 无人机综合 应用平台 V1.0	2020SR0671284	2020/6/24	原始取得
23	朗迅科技	朗迅 LK6610 集成电路教 学检测综合平台 V1.0	2020SR0672995	2020/6/24	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
24	朗迅科技	IC 制造虚拟仿真教学平台 V2.0	2020SR0724744	2020/7/6	原始取得
25	朗迅科技	集成电路制造工艺虚拟仿真训练平台 V2.0	2020SR0724630	2020/7/6	原始取得
26	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆切割虚拟仿真交互软件 V1.0	2020SR1628310	2020/11/23	原始取得
27	朗迅科技	朗迅 IC 测试平移式分选虚拟仿真交互软件 V1.0	2020SR1628315	2020/11/23	原始取得
28	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆烘烤虚拟仿真交互软件 V1.0	2020SR1915609	2020/12/30	原始取得
29	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆打点虚拟仿真交互软件 V1.0	2020SR1915643	2020/12/30	原始取得
30	朗迅科技	朗迅 IC 制造单晶硅生长虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0245635	2021/2/18	原始取得
31	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆氧化虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0245636	2021/2/18	原始取得
32	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆曝光虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0245637	2021/2/18	原始取得
33	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆干法刻蚀虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0353530	2021/3/8	原始取得
34	朗迅科技	朗迅 IC 封装切筋成型虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0353531	2021/3/8	原始取得
35	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆涂胶虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0353532	2021/3/8	原始取得
36	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆化学气相淀积虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0410656	2021/3/18	原始取得
37	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆离子注入虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0410663	2021/3/18	原始取得
38	朗迅科技	朗迅 IC 测试转塔式分选机虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0410655	2021/3/18	原始取得
39	朗迅科技	朗迅 IC 重力式编带虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0447602	2021/3/25	原始取得
40	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆扎针测试虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0447661	2021/3/25	原始取得
41	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆贴膜虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0447550	2021/3/25	原始取得
42	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆物理气相淀积虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0481872	2021/4/1	原始取得
43	朗迅科技	朗迅 IC 制造晶圆显影虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0481871	2021/4/1	原始取得
44	朗迅科技	朗迅 IC 测试料管外观检查虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0533273	2021/4/14	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
45	朗迅科技	朗迅 IC 测试料盘外观检查虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0533241	2021/4/14	原始取得
46	朗迅科技	朗迅 IC 封装芯片粘接虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0533254	2021/4/14	原始取得
47	朗迅科技	朗迅 IC 制造硅提纯虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0631584	2021/4/30	原始取得
48	朗迅科技	朗迅 IC 制造硅衬底制备虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0631585	2021/4/30	原始取得
49	朗迅科技	朗迅 IC 封装引线键合虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0631598	2021/4/30	原始取得
50	朗迅科技	朗迅 IC 测试料管真空包装虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0631586	2021/4/30	原始取得
51	朗迅科技	朗迅 IC 制造湿法刻蚀虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0661051	2021/5/11	原始取得
52	朗迅科技	朗迅生产车间进入准备虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0661100	2021/5/11	原始取得
53	朗迅科技	朗迅洁净车间进入准备虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR0661050	2021/5/11	原始取得
54	朗迅科技	朗迅 IC 塑封虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038533	2021/7/14	原始取得
55	朗迅科技	朗迅 IC 编带外观检查虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038532	2021/7/14	原始取得
56	朗迅科技	朗迅 IC 测试重力式分选虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038534	2021/7/14	原始取得
57	朗迅科技	朗迅 IC 测试晶圆外检及真空入库虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038547	2021/7/14	原始取得
58	朗迅科技	朗迅 IC 测试编带真空入库虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038545	2021/7/14	原始取得
59	朗迅科技	朗迅 IC 封装电镀虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038483	2021/7/14	原始取得
60	朗迅科技	朗迅 IC 制造化学机械抛光虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038484	2021/7/14	原始取得
61	朗迅科技	朗迅 IC 测试料盘真空入库虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038546	2021/7/14	原始取得
62	朗迅科技	朗迅 IC 封装激光打标虚拟仿真交互软件 V1.0	2021SR1038531	2021/7/14	原始取得
63	朗迅科技	集成电路开发设计资源系统 V1.0	2021SR1568239	2021/10/26	原始取得
64	朗迅科技	集成电路设计模块配套辅材与耗材实训系统 V1.0	2021SR1568276	2021/10/26	原始取得
65	朗迅科技	集成电路设计数据中心智能管理系统 V1.0	2021SR1568243	2021/10/26	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
66	朗迅科技	集成电路设计验证平台 V1.0	2021SR1568244	2021/10/26	原始取得
67	朗迅科技	集成电路封装技术虚拟仿真实训系统 V1.0	2022SR0111631	2022/1/18	原始取得
68	朗迅科技	LK280 集成电路原型仿真系统 V1.0	2022SR0512648	2022/4/24	原始取得
69	朗迅科技	LCK019 芯云派平台 V1.0	2022SR0512647	2022/4/24	原始取得
70	朗迅科技	LK6620 集成电路测试系统 V1.0	2022SR0575381	2022/5/11	原始取得
71	朗迅科技	集成电路测试技术虚拟仿真 VR 操作系统 V1.0	2022SR0669550	2022/5/30	原始取得
72	朗迅科技	芯云学院 APPV1.0	2022SR0887403	2022/7/5	原始取得
73	朗迅科技	基于互联网的可重构集成电路设计软件 V1.0	2023SR0997566	2023/9/1	原始取得
74	朗迅科技	可重构集成电路在线应用训练平台 V1.0	2023SR0998508	2023/9/1	原始取得
75	朗迅科技	LCK019 芯云派平台 V2.0	2023SR1463059	2023/11/17	原始取得
76	朗迅科技	可重构集成电路实践过程记录监控软件 V1.0	2023SR1494725	2023/11/23	原始取得
77	朗迅科技	朗迅 LK210T 集成电路应用开发资源系统软件 V1.0	2023SR1525420	2023/11/28	原始取得
78	朗迅科技	LK-280D 模拟原型仿真教学系统软件 V1.0	2023SR1600375	2023/12/11	原始取得
79	朗迅科技	集成电路虚拟仿真实训管理系统 V1.0	2024SR0051453	2024/1/8	原始取得
80	朗迅科技	LK-ICVS-PVD-3 PVD 工艺模拟器教学实训系统 V1.0	2024SR0051670	2024/1/8	原始取得
81	朗迅科技	朗迅晶圆制造技术虚拟仿真实训系统 V1.0	2024SR0053103	2024/1/9	原始取得
82	朗迅科技	朗迅集成电路封装数字工厂软件 V1.0	2024SR0123368	2024/1/18	原始取得
83	朗迅科技	LK-ICVS-PVD-2 PVD 设备运行维护实训系统 V1.0	2024SR0173777	2024/1/26	原始取得
84	朗迅科技	朗迅 LK8300 高速芯片测试机驱动系统软件 V1.0	2024SR0215250	2024/2/1	原始取得
85	朗迅科技	朗迅智慧储藏系统 V1.0	2024SR0251252	2024/2/7	原始取得
86	朗迅科技	LK-ICVS-PVD-1 PVD 工艺模拟器硬件设备系统 V1.0	2024SR0285755	2024/2/21	原始取得
87	朗迅科技	集成电路测试技术虚拟仿真实训系统 V1.0	2024SR0321780	2024/2/28	原始取得
88	朗迅科技	朗迅 LK9000 芯片架构验证系统软件 V1.0	2024SR0327825	2024/2/28	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
89	朗迅科技	集成电路工艺仿真实训平台 V1.0	2024SR0564913	2024/4/25	原始取得
90	朗迅科技	朗迅 LD1117 芯片测试系统 V1.0	2024SR0580194	2024/4/28	原始取得
91	朗迅科技	朗迅 STC15W408AS 芯片测试系统 V1.0	2024SR0578275	2024/4/28	原始取得
92	朗迅科技	朗迅 SN74HC245 芯片测试系统 V1.0	2024SR0579703	2024/4/28	原始取得
93	朗迅科技	朗迅 P25Q80H 芯片测试系统 V1.0	2024SR0580250	2024/4/28	原始取得
94	朗迅科技	朗迅 LM358BA 芯片测试系统 V1.0	2024SR0580701	2024/4/28	原始取得
95	朗迅科技	朗迅 TLC1549 芯片测试系统 V1.0	2024SR0584554	2024/4/29	原始取得
96	朗迅科技	朗迅高速芯片测试机应用开发资源系统 V1.0	2024SR0636856	2024/5/11	原始取得
97	朗迅科技	芯片光学字符识别系统 V0.7	2024SR0680717	2024/5/20	原始取得
98	朗迅科技	朗迅高速芯片测试机开发实训拓展包系统 V1.0	2024SR0721004	2024/5/27	原始取得
99	朗迅科技	朗迅集成电路制造技术虚拟仿真实训系统 V1.0	2024SR0735834	2024/5/29	原始取得
100	朗迅科技	IC 制造虚拟仿真教学平台 V5.0	2024SR1081533	2024/7/29	原始取得
101	朗迅科技	点胶机 3D 仿真软件 V1.0	2025SR0744870	2025/5/8	原始取得
102	朗迅科技	真空回流炉 3D 仿真软件 V1.0	2025SR0744094	2025/5/8	原始取得
103	朗迅科技	高精度贴片机 3D 仿真软件 V1.0	2025SR0743911	2025/5/8	原始取得
104	朗迅科技	等离子体清洗机 3D 仿真软件 V1.0	2025SR0750147	2025/5/9	原始取得
105	朗迅科技	SMT 贴片机 3D 仿真软件 V1.0	2025SR0750389	2025/5/9	原始取得
106	朗迅科技	小型三温分选系统控制软件 V1.0	2025SR2349265	2025/12/4	原始取得
107	朗迅科技	BD050 老化炉自动上下料控制系统 V1.0	2025SR2356418	2025/12/5	原始取得
108	朗迅科技	FT 型高温打光测试台管理软件 V1.0	2025SR2356430	2025/12/5	原始取得
109	杭州芯云	芯片测试数据管理系统 V1.20	2021SR1083114	2021/7/22	原始取得
110	杭州芯云	多通道射频信号测量系统 V1.11	2021SR1083293	2021/7/22	原始取得
111	杭州芯云	测试参数信息数据库管理系统 V1.12	2021SR1083115	2021/7/22	原始取得
112	杭州芯云	测试数据异常预测预警及 GPS 定位精准度测试系统 V1.13	2021SR1263016	2021/8/25	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
113	杭州芯云	芯片测试数据跟踪查询系统 V1.10	2021SR1259460	2021/8/25	原始取得
114	杭州芯云	机械手模拟测试系统 V2.12	2021SR1265382	2021/8/26	原始取得
115	杭州芯云	成品率控制信息管理系统 V1.10	2021SR1266291	2021/8/26	原始取得
116	杭州芯云	半导体元器件自动分拣控制软件 V1.10	2021SR1265381	2021/8/26	原始取得
117	杭州芯云	检测报警控制系统 V1.10	2021SR1272659	2021/8/26	原始取得
118	杭州芯云	晶圆移片控制系统 V2.0	2021SR1265380	2021/8/26	原始取得
119	杭州芯云	芯片测试数据筛选系统 V1.0	2021SR1272981	2021/8/27	原始取得
120	杭州芯云	自动化 IC 测试在线监测分析系统 V1.12	2021SR1807521	2021/11/19	原始取得
121	杭州芯云	半导体制程全流程仿真系统 V2.10	2021SR2000619	2021/12/6	原始取得
122	杭州芯云	半导体失效定位分析测试管理系统 V2.23	2022SR0256252	2022/2/22	原始取得
123	杭州芯云	半导体封装智控工艺仿真系统 V1.0	2022SR0307532	2022/3/4	原始取得
124	杭州芯云	芯云文件管控系统 V1.0	2023SR0010567	2023/1/4	原始取得
125	杭州芯云	芯云产品质量先期策划系统 V1.0	2023SR0011392	2023/1/4	原始取得
126	杭州芯云	芯云实时数据分析系统 V1.0	2023SR0011390	2023/1/4	原始取得
127	杭州芯云	芯云进销存管理系统 V1.0	2023SR0017648	2023/1/5	原始取得
128	杭州芯云	芯云机台客户端实时数据解析系统 V1.0	2023SR0017649	2023/1/5	原始取得
129	杭州芯云	芯云测试数据分析与可视化软件 V1.0	2024SR2057959	2024/12/12	原始取得
130	诸暨芯云	集成电路板测试分析系统 V1.0	2022SR0651867	2022/5/26	原始取得
131	诸暨芯云	芯云物流追踪系统 V1.0	2023SR0011085	2023/1/4	原始取得
132	诸暨芯云	芯云工厂制造执行系统 V1.0	2023SR0010779	2023/1/4	原始取得
133	诸暨芯云	芯云报表管理系统 V1.0	2023SR0012003	2023/1/4	原始取得
134	诸暨芯云	芯云关务管理系统 V1.0	2023SR0010577	2023/1/4	原始取得
135	诸暨芯云	文档管理系统 V1.0	2023SR0455276	2023/4/10	原始取得
136	诸暨芯云	测试数据分析系统 V1.5	2023SR0455275	2023/4/10	原始取得
137	诸暨芯云	芯云测试参数信息管理系统 V1.0	2023SR0827083	2023/7/11	原始取得
138	诸暨芯云	芯云半导体失效定位分	2023SR0827055	2023/7/11	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
		析管理系统 V1.0			
139	诸暨芯云	芯云设备在线监测管理系统 V1.0	2023SR0827054	2023/7/11	原始取得
140	诸暨芯云	芯云需求管理系统 V1.0	2025SR2262744	2025/11/24	原始取得
141	诸暨越芯	越芯实时测试数据分析系统 V1.0	2023SR1453785	2023/11/16	原始取得
142	诸暨越芯	越芯成品率控制管理系统 V1.0	2023SR1459811	2023/11/17	原始取得
143	诸暨越芯	越芯半导体测试数据筛选系统 V1.0	2023SR1459396	2023/11/17	原始取得
144	诸暨越芯	越芯智能报警检测控制软件 V1.0	2024SR0079943	2024/1/11	原始取得
145	诸暨越芯	越芯智能报警检测系统运维管理软件 V1.0	2024SR0079590	2024/1/11	原始取得
146	诸暨教育	集成电路老化测试软件 V1.0	2022SR0656295	2022/5/27	原始取得
147	杭州芯云海	芯海成品率控制管理系统 V1.0	2023SR1433607	2023/11/14	原始取得
148	杭州芯云海	芯海智能检测报警控制系统 V1.0	2023SR1434553	2023/11/14	原始取得
149	杭州芯云海	芯海实时测试数据分析系统 V1.0	2023SR1434534	2023/11/14	原始取得
150	杭州芯云海	芯海晶圆级温度循环测试控制软件 V1.0	2023SR1438692	2023/11/15	原始取得
151	杭州芯云海	芯海晶圆级老化测试控制软件 V1.0	2023SR1455230	2023/11/16	原始取得
152	杭州芯云海	芯海半导体测试数据筛选系统 V1.0	2023SR1465259	2023/11/20	原始取得
153	杭州芯云海	芯海基于大数据的芯片老化测试数据分析系统 V1.0	2024SR0079318	2024/1/11	原始取得
154	杭州芯云海	芯海基于云计算的半导体测试参数检测软件 V1.0	2024SR0086281	2024/1/12	原始取得
155	杭州芯光	芯光测试数据分析与可视化软件 V1.0	2025SR2218161	2025/11/18	原始取得
156	杭州芯光	芯光岗位合规性智能认证管理软件 V1.0	2025SR2218225	2025/11/18	原始取得
157	杭州芯光	芯云测试数据质量评审与可视化工具系统 V1.0	2025SR2218261	2025/11/18	原始取得
158	杭州芯光	芯光营收报表系统 V1.0	2025SR2224960	2025/11/19	原始取得
159	杭州芯光	芯光设备资产管理系统 V1.0	2025SR2225028	2025/11/19	原始取得
160	杭州芯光	芯光测试实时过程监控管理系统 V1.0	2025SR2226028	2025/11/19	原始取得
161	杭州芯光	芯光设备在线监测管理系统 V1.0	2025SR2264797	2025/11/24	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
162	杭州芯光	芯光半导体失效定位分析管理系统 V1.0	2025SR2264331	2025/11/24	原始取得
163	朗迅数智	博朗通集成电路实训教学虚拟仿真系统软件 V1.23	2021SR0778318	2021/5/27	原始取得
164	朗迅数智	朗迅集成电路封装技术虚拟仿真实训系统 V2.0	2023SR0288401	2023/3/1	原始取得
165	朗迅数智	朗迅芯片故障分析决策系统 V1.0	2023SR1440909	2023/11/15	原始取得
166	朗迅数智	朗迅集成电路测试实训系统 V1.0	2023SR1445428	2023/11/15	原始取得
167	朗迅数智	朗迅集成电路设计验证交互系统 V1.0	2023SR1440899	2023/11/15	原始取得
168	朗迅数智	朗迅集成电路开发设计资源系统 V1.0	2023SR1445726	2023/11/15	原始取得
169	朗迅数智	朗迅集成电路先进封装技术在线管理系统 V1.0	2024SR0321660	2024/2/28	原始取得
170	朗迅集成	朗迅集成 MT8200 测试机系统驱动软件 V1.0	2019SR0004521	2019/1/2	原始取得
171	朗迅集成	朗迅集成电路新品试制全流程管理系统 V1.11	2020SR0569386	2020/6/4	原始取得
172	朗迅集成	朗迅嵌入式高精度集成电路失效分析与定位控制系统 V1.0	2020SR0569377	2020/6/4	原始取得
173	朗迅集成	朗迅集成电路封装运营信息管理系统 V1.20	2020SR0569395	2020/6/4	原始取得
174	朗迅集成	朗迅嵌入式自适应多尺寸芯片封装智控系统 V1.0	2020SR0569690	2020/6/4	原始取得
175	朗迅集成	基于 LK32T102 的智能温控系统 V1.0	2020SR0789714	2020/7/17	原始取得
176	朗迅集成	基于 LK32T102 的智能交通系统 V1.0	2020SR0789586	2020/7/17	原始取得
177	朗迅集成	集成电路测试设备数据源联动分析软件 V1.0	2023SR0301077	2023/3/6	原始取得
178	朗迅集成	半导体制程与封装智控工艺仿真系统 V1.0	2023SR0301114	2023/3/6	原始取得
179	朗迅集成	标准样品件测试信息管理软件 V1.0	2023SR0301113	2023/3/6	原始取得
180	朗迅集成	高速信号频率测量软件 V1.0	2023SR0303514	2023/3/7	原始取得
181	朗迅集成	多工位 IC 测试校准软件 V1.0	2023SR0303799	2023/3/7	原始取得
182	朗迅集成	面向列测试数据库管理软件 V1.0	2023SR0309165	2023/3/9	原始取得
183	朗迅集成	自动分拣与检测报警控制软件 V1.0	2023SR0309092	2023/3/9	原始取得
184	朗迅集成	自动化 IC 测试在线监测分析系统 V1.0	2023SR0309118	2023/3/9	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
185	朗迅集成	集成电路输入输出引脚连通性测试软件 V1.0	2023SR0309500	2023/3/9	原始取得
186	朗迅集成	校准装置误差测量软件 V1.0	2023SR0309091	2023/3/9	原始取得
187	朗迅集成	模拟电压源电压参数驱动测压测试软件 V1.0	2023SR0309499	2023/3/9	原始取得
188	上海芯云纵横	芯云纵横晶圆移片控制系统 V1.0	2023SR1595330	2023/12/8	原始取得
189	上海芯云纵横	芯云纵横成品率控制信息管理系统 V1.0	2023SR1590910	2023/12/8	原始取得
190	上海芯云纵横	芯云纵横晶圆测试系统控制软件 V1.0	2023SR1593359	2023/12/8	原始取得
191	上海芯云纵横	芯云纵横芯片测试参数信息管理软件 V1.0	2023SR1592376	2023/12/8	原始取得
192	上海芯云纵横	芯云纵横实验室管理系统 V1.0	2023SR1616888	2023/12/12	原始取得
193	上海芯云纵横	芯云纵横检测报警控制系统 V1.0	2023SR1616927	2023/12/12	原始取得
194	上海芯云纵横	芯云纵横失效定位分析管理系统 V1.0	2023SR1616899	2023/12/12	原始取得
195	上海芯云纵横	芯云纵横测试数据筛选系统 V1.0	2023SR1616911	2023/12/12	原始取得
196	上海芯云纵横	芯云纵横智能化数据挖掘预测分析系统 V1.0	2024SR0447100	2024/3/29	原始取得
197	上海芯云纵横	芯云纵横智能数据分析决策支持系统 V1.0	2024SR0447058	2024/3/29	原始取得
198	上海芯云纵横	芯云纵横芯片测试智能管理系统 V1.0	2025SR0141207	2025/1/21	原始取得
199	上海芯云纵横	芯云纵横芯片可靠性测试系统 V1.0	2025SR0141202	2025/1/21	原始取得
200	上海芯云纵横	芯云纵横参数配置管理系统 V1.0	2025SR0141204	2025/1/21	原始取得
201	上海芯云纵横	芯云纵横智能决策分析系统 V1.0	2025SR0141200	2025/1/21	原始取得
202	上海芯云纵横	芯云纵横测试流程管控系统 V1.0	2025SR0141199	2025/1/21	原始取得
203	上海芯云纵横	芯云纵横测试数据实时监控与分析软件 V1.0	2025SR0141206	2025/1/21	原始取得

6、作品著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人拥有作品著作权 3 项，具体情况如下：

序号	权利人	登记号	作品名称	创作完成日期	取得方式	他项权利
1	朗迅科技	国作登字-2019-F-00796290	集成电路教学测试平台	2019/1/7	原始取得	无
2	朗迅科技	国作登字-2019-I-00918330	IC制造虚拟仿真教学平台动	2019/10/8	原始取得	无

序号	权利人	登记号	作品名称	创作完成日期	取得方式	他项权利
			漫视频			
3	朗迅科技	国作登字-2020-I-01061572	IC制造虚拟仿真教学平台动漫视频	2020/5/10	原始取得	无

7、域名

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有注册域名 7 项，具体情况如下：

序号	注册人	域名	审核通过日期	网站备案号/许可证号
1	朗迅科技	luntek.com.cn	2022/11/24	浙 ICP 备 14011051 号-1
2	朗迅科技	ic-edu.net	2022/11/24	浙 ICP 备 14011051 号-3
3	杭州芯云	lkxinyun.com.cn	2024/7/29	浙 ICP 备 2020035974 号-1
4	诸暨芯云	zjxinyun.com.cn	2023/12/28	浙 ICP 备 2022022601 号-1
5	诸暨教育	xinyunedu.com.cn	2022/7/28	浙 ICP 备 2022021806 号-1
6	朗迅数智	iluntek.com	2023/6/20	浙 ICP 备 2023016636 号-1
7	上海芯云纵横	xinyunsh.com.cn	2023/7/6	沪 ICP 备 2022033171 号-1

8、主要经营资质

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的主要经营资质情况如下：

序号	持有主体	资质名称	所在地 海关/发证机关	证书编号	有效期至
1	朗迅科技	进出口货物收发货人	钱关萧办	3301965D45	长期
2	杭州芯云	进出口货物收发货人	钱关萧办	33013602D5	长期
3	诸暨芯云	进出口货物收发货人	绍关诸办	3322961CCS	长期
4	诸暨越芯	进出口货物收发货人	绍关诸办	3322961DF6	长期
5	杭州芯云海	进出口货物收发货人	钱关富办	3301960W4C	长期
6	杭州芯光	进出口货物收发货人	钱关富办	3301960CKH	长期
7	朗迅集成	进出口货物收发货人	钱关萧办	3301961M12	长期
8	上海芯云纵横	进出口货物收发货人	浦东海关	3122261ARU	长期
9	朗迅科技	固定污染源排污登记回执	全国排污许可证管理信息平台	913301085551621509001W	2023/7/21-2028/7/20
10	杭州芯云	固定污染源排污登记	全国排污许可证	91330108MA2HXBHQ77001Y	2023/7/18-2031/1/11

序号	持有主体	资质名称	所在地 海关/发证机关	证书编号	有效期至
		回执	管理信息平台		
11	诸暨芯云	固定污染源排污登记 回执	全国排污许可证 管理信息平台	91330681MA2JU D605U001X	2023/7/18- 2028/7/17
12	诸暨越芯	固定污染源排污登记 回执	全国排污许可证 管理信息平台	91330681MAC49 MB014001Z	2024/4/22- 2031/1/11
13	杭州芯云海	固定污染源排污登记 回执	全国排污许可证 管理信息平台	91330183MABY QNLKXW001X	2025/1/9- 2031/2/26